

本年報可於以下網址查詢 公開資訊觀測站: http://mops.twse.com.tw/mops/web/index 本公司網站: http://www.aseglobal.com 刊印日期: 中華民國一〇六年二月二十八日

本公司發言人

吳田玉 職稱 | 營運長

代理發言人

董宏思 職稱 | 財務長 電話 | (02) 87805489 電子郵件信箱 | ir@aseglobal.com

總公司

台北辦公室

中壢分公司

高雄工廠

地址 | 高雄市楠梓加工出口區經三路26號 電話 | (07)3617131

中壢工廠

地址 | 桃園市中壢區中華路一段550號 電話 | (03)4527121

股票過戶機構

統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址 | 台北市松山區東興路8號地下一樓 網址 | http://www.uni-psg.com 電話 | (02)27463797

最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱 | 勤業眾信聯合會計師事務所會計師姓名 | 陳珍麗會計師、江佳玲會計師地址 | 高雄市前鎮區成功二路88號3樓網址 | http://www.deloitte.com.tw電話 | (07)5301888

海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱

紐約證券交易所(NYSE)

查詢該海外有價證券資訊之方式及公司網址

http://www.aseglobal.com





日月光集團以創新思維,強化功能整合與微型化技術, 置入智能應用產品,落實穿戴裝置的輕薄短小, 連結自動化的互聯環境,體現科技未來無所不在的智慧型生活。

致股東報告書

各位股東女士、先生:

2016上半年全球景氣一如預期的疲軟,已開發經濟體復甦力道不足,新興市場成長動能放緩。所幸下半年似見寒冬中的一抹嫩綠,景氣稍有反轉向上的趨勢。半導體產業則因消化完庫存而在第三季呈現兩位數成長,逐步擺脱不景氣。根據 Gartner i 的統計,2016年半導體市場銷售值為3,397億美元,較2015年成長1.5%。 Gartner預測2017年全球半導體銷售值將 達3,641億美元,較2016年成長7.2%。

根據工研院IEK ITIS計畫之統計,2016年台灣IC封裝測試業產值為新台幣4,638億元,較2015年成長約5.1%。封裝業產值為新台幣3,238億元,較2015年成長4.5%;測試業產值為新台幣1,400億元,較2015年成長6.5%。茲將本公司過去一年來的營運狀況報告如下:

2016年營業結果

- 1. **2016年營業計畫實施成果** 本公司2016年集團合併營收為新台幣2,749億元,較2015年減少約84億元,衰退約3%。就半導體封裝測試業務來看,2016年度合併營收為新台幣1,605億元(含部門間收入新台幣10億元),較2015年增加約60億元,成長約3.9%,主要肇因於半導體封裝服務外包趨勢增加及本公司生產能力改進。另就集團電子代工服務業方面,2016年合併營收為新台幣1,155億元(含部門間收入新台幣1億元),較2015年減少約229億元,衰退16.5%。不過電子代工服務業務毛利率由2015年的7.5%成長至2016年的9.8%。
- 2. 預算執行情形 | 本公司於2016年並未公開財務預測。
- 3. 財務收支及獲利能力分析 | 本公司2016年度合併財務報告顯示 實收資本額為新台幣796億元,歸屬於本公司業主之權益總計為新 台幣1,574億元,佔總資產新台幣3,579億元之44%;長期資金佔固 定資產比率為169%,流動比率為136.7%,本年度財務比率與上年 度相當。本年度集團營業毛利率19.4%優於2015年的17.7%;營業 淨利為新台幣267億元,較2015年增加新台幣18億元,成長約 7.2%;歸屬於本公司業主之淨利為新台幣217億元,較上年度增加 新台幣25億元,成長約13%。合併財報稅前息前折舊攤銷前純益 亦較2015年上升約4.3%。獲利能力相較於2015年度為佳。
- 4. 研究發展狀況 | 驅動全球微電子與半導體效率的摩爾定律,隨 著PC與行動裝置普及化,單晶片整合逐漸邁入成熟階段。接著 在物聯網效應引動泛在運算的過程中,產業鏈努力往更高價值 系統整合層次邁進,彰顯出異質晶片封裝在系統整合創新的重 要性,使功能整合強化與尺度微縮技術齊頭並進,以創造更高 效能的智慧連網環境與裝置,促進人類智能生活更加便利。本公 司持續建構關鍵技術平台如:先進系統封裝/模組、覆晶凸塊/銅 銲線及中低腳數封裝等,而2016年成功開發之重點產品與技術 歸類如下:(1)覆晶封裝:10奈米銅製程技術認證,14/16奈米銅 製程/超低介電晶片覆晶封裝應用、雙面封膠保護技術。(2)銲線 封裝:銀合金線於混合式覆晶球格陣列式封裝、內埋線路基板應 用、超細間距與線徑銅/金銲線技術,並延伸20/28奈米技術應用 認證。(3)晶圓級封裝:先進扇出封裝aWLP-II(InFO-like結構)、 2.5D矽穿導孔堆疊新產品導入、微機電露晶粒露錫球封裝、整合 被動元件穿導孔玻璃基板/堆疊焊線封裝、微間距錫銀/銅柱電鍍 晶圓凸塊、15微米穿導孔填孔技術。(4)先進封裝與模組:高密 度SiP封裝4G通訊模組、隔間式屏蔽技術、選擇性區域封膠技術、 雙面選擇性區域封膠技術等。

董事長 張虔生

根护生





- 1. 經營方針 | (1)提供客戶「至高品質」的服務
 - (2) 為公司及客戶創造長期且穩定的利潤
 - (3)與協力廠商攜手共創榮景
 - (4)訓練員工成為各領域之專業菁英
- (5)「公平且合理」地對待所有員工
- (6)提供員工「和諧、愉快、開放」的工作環境
- (7)在營運中儘可能地保持彈性。
- 2. **預期銷售數量及其依據** | 依據產業景氣、未來市場需求及本公司之產能狀況,本公司2017年預計銷售量如下: **封裝**:預計銷售數量約185億個 **測試**:預計銷售數量約23億個
- 3. 重要產銷政策 | 回顧2016年,本公司封測營收年成長率達3.9%,為半導體產業成長率的兩倍。主要原因除了封裝服務外包趨勢增加及本公司產能成長外,在覆晶封裝、凸塊及晶圓級封裝的研發及努力也是重要的成長動因,我們相信在2017年這方面仍將高度成長。同時,本公司也會持續拓展如扇出型封裝、銅柱凸塊封裝、內埋基板技術等領域,擴增面板級扇出型封裝產能,帶動先進封測技術由晶圓級走向面板級製程。低成本與高效能及高整合度的趨勢是不變的原則。我們相信2017年市場狀況將會持續改善,本公司將會更專注於公司整體獲利及投注更多的資金在技術研發及改善。此外,系統級封裝(SiP)依然是我們關注的重點,本公司將持續在各種SiP產品、市場與客戶中提供多樣化的選擇,唯有不斷的研發與創新才能在充滿競爭的市場搶得先機。

未來公司發展策略

從長期而言,全球半導體產業成長的主要驅動力是人口、生活方式和新效率這三大要素。儘管台灣GDP占全球比重僅0.7%,但在全球封裝測試占比達56.6%,台灣半導體產業更占全球比重達22%。可見台灣半導體產業獲得全球夥伴的信任關係,也創造新的價值,打造出新的商業模式。本公司持續專注在技術創新,增加研發與資本支出,藉著提高創新整體經濟規模,產生足夠的獲利成長空間,才能讓本公司不斷成長。本公司與矽品合併案最大的考量正是"創新"。除此之外,分工讓大家各自作自己擅長的事,更能提升整體效率。半導體是全球競爭的產業,資源整合提高效率、降低成本後回饋客戶,減少重複投資、把更多資源放在開發與創新研發上,客戶也能因此得到更好的技術與服務,這對整體產業長期來說,是正面良性循環。

受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

展望2017年,多數研究預測機構審慎保守看待。尤其美國大選 後的政策走向將左右全球經濟發展的關鍵因素,若能成功活絡 其內需市場,其他國家也將隨之受惠。在中國方面,預期政府 將持續推動總體調控政策,經濟結構可望朝既定目標強化,但 低成長率的趨勢恐難以避免。此外,全球經濟也面臨了諸如美 國升息效應、新興市場債務風險及貿易保護主義興起等不確定 因素。而國內因改善勞動條件及環保意識抬頭而產生的法規改 變,促使本公司更努力去思考營運績效與幸福企業之間的平衡 點。放眼來年,依然是荊棘滿布,充滿挑戰,但本公司將不斷 的用更新、創新、與時俱進,來迎向未來。

副董事長 張洪本

e, 4016 Update, Published: 13 ood, Adriana Blanco, Amy Teng,



The Gartner Report(s) described herein, (the "Gartner Report(s)") represent(s) data, research opinion or viewpoints published, as part of a syndicated subscription service, by Gartner, Inc. ("Gartner"), and are not representations of fact. Each Gartner Report speaks as of its original publication date (and not as of the date of this Annual Report) and the opinions expressed in the Gartner Report(s) are subject to change without notice.

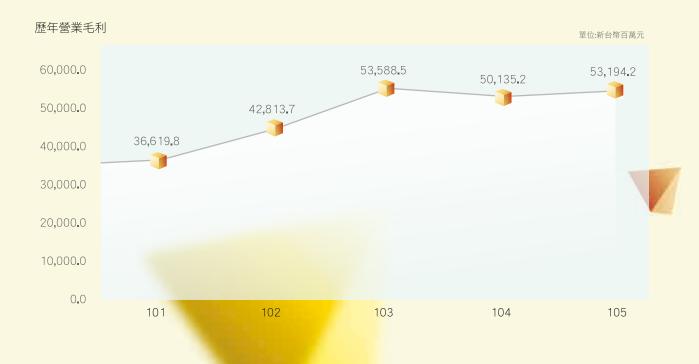


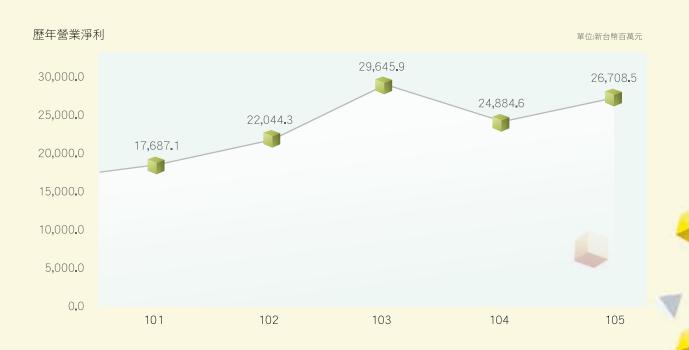
經營摘要

					單位:新台幣百萬元
經營摘要(合併)	101 (2010年版IFRSs)	102 (2010年版IFRSs)	103 (2013年版IFRSs)	104 (2013年版IFRSs)	105 (2013年版IFRSs)
營業收入	193,972.4	219,862.4	256,591.4	283,302.5	274,884.1
營業毛利	36,619.8	42,813.7	53,588.5	50,135.2	53,194.2
營業淨利	17,687.1	22,044.3	29,645.9	24,884.6	26,708.5
税前淨利	16,584.3	19,356.7	28,548.2	25,006.9	28,041.3
税後淨利	13,523.6	16,155.0	24,281.6	20,167.7	22,949.9
每股盈餘(元/股,追溯調整後之稀釋每股盈餘)	1.71	2.03	2.96	2.41	2.37
現金股利 (元/股)	1.04945018	1.29411842	2.00379984	1.59718596	(註1)
固定資產淨額 (不動產、廠房及設備)	127,197.8	131,497.3	151,587.1	149,997.1	143,880.2
股東權益淨額 (權益合計)	110,951.8	127,165.0	158,438.0	168,138.5	169,347.4
資產總額	247,709.8	286,813.9	333,984.8	365,006.2	357,943.1
員工總數(人)	57,259	60,199	68,100	65,789	66,711
日月光總市值(註2)	191,577.8	215,704.3	299,484.7	300,570.2	262,578.1

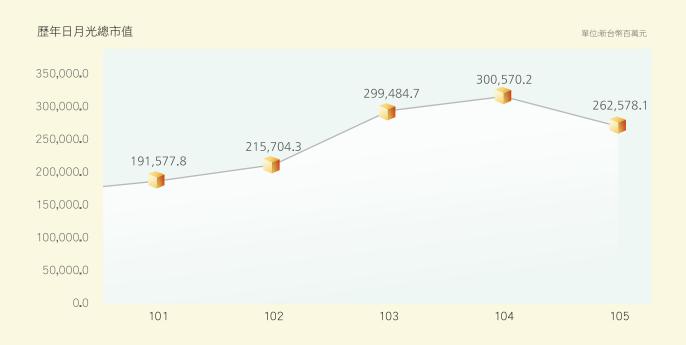
註1:俟股東會決議後定案。 註2:總市值=年底收盤價*流通在外股數。











日月光半導體製造股份有限公司 一〇五年度年報

目錄 一〇五年度年報

壹、致股東報告書及經營摘要

2 貳、公司簡介

參、公司治理報告

- 8 一、組織系統
- 10 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
- 15 三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
- 19 四、公司治理運作情形
- 30 五、會計師公費資訊
- 31 六、更換會計師資訊
- 31 七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之情形
- 32 八、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 32 九、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以内之親屬關係之資訊
- 33 十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數

肆、募資情形

- 34 一、資本及股份
- 41 二、公司債辦理情形
- 42 三、特別股辦理情形
- 42 四、海外存託憑證辦理情形
- 43 五、員工認股權憑證辦理情形(含限制員工權利新股)
- 45 六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形
- 45 七、資金運用計畫執行情形

伍、營運概況

- 46 一、業務内容
- 55 二、市場及產銷槪況
- 63 三、從業員工資料
- 64 四、環保支出資訊
- 66 五、勞資關係
- 69 六、重要契約

陸、財務概況

- 70 一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表
- 73 二、最近五年度財務分析
- 75 三、最近年度財務報告之監察人或審計委員會審查報告
- 76 四、最近年度財務報告
- 177 五、最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告
- 226 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,發生財務週轉困難之情事

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

- 227 一、財務狀況
- 227 二、財務績效
- 227 三、現金流量
- 227 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
- 228 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫
- 228 六、風險事項分析評估
- 233 七、其他重要事項

捌、特別記載事項

- 234 一、關係企業相關資料
- 246 二、私募有價證券辦理情形
- 246 三、子公司持有或處分本公司股票情形
- 246 四、其他必要補充說明事項

246 玖、其他事項

貳、公司簡介

一、設立日期:民國七十三年三月二十三日

二、公司沿革:

本公司之創立係由歸國學人張虔生及張洪本基於工業報國之精神,並配合政府發展高科技政策,以現金及專門技術作價集 資所創建,所營事業為各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售等。

本公司記事如下:

- 73年03月 公司正式成立。
- 73年07月 工廠開工。
- 73年08月 塑膠立體型積體電路(PDIP),開始外銷歐美及日本。
- 74年02月 陶瓷立體型積體電路(CDIP),開始外銷日本及歐美。
- 74年10月 高品質塑膠晶粒承載器積體電路(PLCC)開始外銷美國。
- 76年05月 高品質多腳型針格排列積體電路(PGA)及塑膠多腳型針格排列積體電路(PPGA) 開始外銷歐美。
- 78年5-7月 78年5月25日經證期會(78)台財證(一)字第24594號函核准並經臺灣證券交易所(78)上字第4461號函核覆股權 分散符合標準,並於同年7月19日正式在臺灣證券交易所上市掛牌買賣。
- 79年03月 收購台灣福雷電子股份有限公司股權百分之九十九點九,計支付價金新台幣105,006,183元,以併購方式進入半導體測試業務市場。
- 80年03月 轉投資設立日月光電子(馬來西亞)股份有限公司,從事各型積體電路之製造、加工、組合、測試及外銷,另轉投資設立日月光半導體貿易(香港)股份有限公司,以便利轉接海外(馬來西亞)生產基地訂單及服務客戶。
- 80年08月 新產品平面型塑膠晶粒承載器積體電路(EQFP)開始量產。
- 80年11月 本公司產品榮獲MOTOROLA公司頒發品質優良獎(Award of Excellence for Quality)。
- 81年04月 榮獲國際標準組織(ISO 9002)品質認證合格。
- 84年07月 在亞洲、美國及歐洲等地發行海外存託憑證8,600仟單位,每單位表彰本公司普通股5股,計發行43,000仟股,每股面額10元,售價每單位美金15.25元溢價發行,募集資金折合新台幣33.9億元。
- 85年06月 本公司之子公司「ASE Test Limited」在美國NASDAQ證券市場掛牌買賣。
- 86年09月 本公司發行美金2億元之海外可轉換公司債(Euro Convertible Bond)。
- 86年11月 通過SAC(Semiconductor Assembly Council)認證。
- 87年01月 本公司之子公司新加坡福雷電子公司(ASE Test Limited)以1,500,000股普通股發行120,000,000單位之台灣存託憑證(TDR),並於台灣證券交易所掛牌買賣。
- 87年03月 榮獲國際標準組織(QS 9000)品質認證合格。
- 87年09月 榮獲ISO14001環境品質認證合格。
- 88年03月 本公司之子公司新加坡福雷電子公司(ASE Test Limited)第二次以2,500,000股普通股發行台灣存託憑證 (TDR),並於台灣證券交易所掛牌買賣。
- 88年05月 本公司之子公司新加坡福雷電子公司(ASE Test Limited)收購ISE LAB七成股權。
- 88年07月 日月光集團收購摩托羅拉台灣中壢及南韓PAJU兩廠,藉此更能與摩托羅拉公司進行長期之策略聯盟,強化日月光集團垂直整合的力量,並可擴大產品涵蓋範圍。

- 88年2-7月 為提昇日月光集團電子專業代工之領域,進一步增加對客戶之服務項目,進而擴大客戶群,遂於88年度自集中交易市場買入環隆電氣股份有限公司股票,參與經營權,持股比率20.67%。
- 89年09月 為提昇本公司於全球半導體市場之競爭力,進而強化公司形象及國際知名度,於美國時間9月25日完成美國存託憑證(ADR)發行作業,本次發行數量計20,000,000單位,每單位表彰本公司普通股5股,計發行普通股100,000,000股面額10元,發行價格每單位美金7元,募集資金折合新台幣計43.8億元。
- 91年09月 榮獲「第十屆經濟部產業科技發展獎」傑出獎。
- 92年09月 本公司發行美金2億元之海外可轉換公司債(Euro Convertible Bond)。
- 92年10月 本公司董事會決議合併子公司日月欣半導體股份有限公司與日月宏科技股份有限公司,本公司發行 282,315,437股以進行合併換股事宜。
- 93年02月 日月光集團與NEC簽立股權買賣合約,併購該公司位於山形縣之封裝測試廠。
- 93年07月 本公司於93年6月經董事會決議通過投資設立日月光半導體(昆山)有限公司,投資金額美金壹仟貳佰萬元,並於93年7月23日經投審會核准在案。
- 93年08月 本公司與子公司日月欣半導體股份有限公司及日月宏科技股份有限公司正式辦理合併,以本公司為存續公司,並設立中壢分公司。

本公司概括承受原由子公司日月欣半導體股份有限公司投資Omniquest Industrial Limited在大陸地區設立之日月光半導體(上海)(股)公司,並於93年8月10日經投審會核准在案。

本公司於93年7月經董事會決議通過投資設立日月光電子元器件(上海)有限公司,投資金額美金壹仟貳佰萬元,並於93年8月20日經投審會核准在案。

- 93年11月 本公司於93年9月經董事會決議通過增資金額美金參仟萬元於日月光半導體(上海)(股)公司,並於93年11月25日經投審會核准在案。
- 94年06月 本公司於94年5月經董事會決議通過增資金額美金參仟萬元於日月光半導體(上海)(股)公司,並於94年6月30日經投審會核准在案。
- 94年10月 榮獲「第十三屆經濟部產業科技發展獎」傑出獎。
- 94年11月 本公司於94年8月經董事會決議通過增資金額美金參仟萬元於日月光半導體(上海)(股)公司,並於94年11月2 日經投審會核准在案。

本公司於94年11月在菲國總統「國際優良廠商頒獎典禮」頒獎之夜獲頒最高獎項「菲律賓總統獎」。

- 94年12月 本公司於94年11月經董事會決議通過投資設立日月光高新科技(上海)有限公司,投資金額美金壹仟伍佰萬元,並於94年12月21日經投審會核准在案。
- 95年03月 本公司以新台幣參仟萬元投資設立「日月光電子股份有限公司」,持股比率為100%。
- 95年05月 本公司經董事會決議通過將材料事業部分割予子公司日月光電子股份有限公司,換股比例為被分割之材料事業部營業價值每新台幣十元換取日月光電子股份有限公司普通股一股。
- 95年08月 本公司正式將材料事業部分割予日月光電子股份有限公司,本公司計取得日月光電子股份有限公司普通股 294,929,700股。

本公司於95年6月經董事會決議通過增資金額美金參仟萬元於日月光半導體(昆山)有限公司,並於95年8月1 日經投審會核准在案。

95年09月 本公司為配合集團之全球營運策略及財務規劃之考量,將本公司所持有之日月光電子股份有限公司普通股 147,500,000股及147,429,700股,分別轉讓予子公司ASE Labuan Inc.及ASE Mauritius Inc.。

- 95年12月 本公司於95年11月經董事會決議通過透過子公司J&R Holding Limited以其自有資金美金陸仟萬元,受讓中國大陸地區之現有事業威宇科技測試封裝有限公司100%股權,並於95年12月29日經投審會核准在案。 為配合集團之全球營運策略及財務規劃之考量,本公司之子公司ASE Mauritius Inc.將其持有之日月光電子股份有限公司普通股147,429,700股,轉讓予本公司另一子公司ASE Labuan Inc.。
- 96年06月 本公司為配合集團之全球營運策略及財務規劃之考量,將本公司所持有之日月光電子股份有限公司普通股 3,000,000股,轉讓予子公司ASE Labuan Inc.。
- 96年07月 本公司於96年3月經董事會決議以海外自有資金美金21,600,000元,透過子公司J&R Holding Limited購買 NXP B.V.所持有中國大陸之恩智浦半導體蘇州有限公司60%股權,並於96年7月2日經投審會核准在案。(另 於97年3月7日核准更名為蘇州日月新半導體有限公司)
- 96年08月 本公司為整合集團名稱,將大陸地區投資事業威宇科技測試封裝有限公司名稱更名為「日月光封裝測試(上海)有限公司」,並於96年8月29日經投審會核准在案。
- 97年02月 本公司於96年10月經董事會決議通過增資金額美金參仟萬元於日月光封裝測試(上海)有限公司,並於97年2月20日經投審會核准在案。
 本公司於97年01月經董事會決議通過以自有資金美金柒佰萬元,透過子公司J&R Holding Limited受讓中國大陸地區之現有事業威海愛一和一電子有限公司100%股權,並於97年2月15日經投審會核准在案。(另於97年5月22日核准更名為日月光半導體(威海)有限公司)。
- 97年05月 本公司於97年03月經董事會決議通過增資美金玖仟萬元於日月光封裝測試(上海)有限公司,並於97年5月16 日經投審會核准在案。 本公司於97年04月經董事會決議通過增資金額美金壹仟參佰萬元於日月光半導體(威海)有限公司,並於97年5月22日經投審會核准在案。
- 97年08月 本公司於97年07月經董事會決議通過增資美金陸佰萬元於日月光電子元器件(昆山)有限公司,並於97年8月7日經投審會核准在案。
- 98年02月 本公司於97年12月經董事會決議通過增資美金貳仟萬元於日月光半導體(威海)有限公司,並於98年2月4日經 投審會核准在案。
- 98年07月 本公司於98年06月經董事會決議通過增資美金參仟貳佰萬元於日月光半導體(昆山)有限公司,並於98年7月 31日經投審會核准在案。
- 98年11月 本公司於98年11月經董事會決議通過,以現金及子公司J&R Holding Limited及新加坡福雷電子股份有限公司所分別持有之本公司普通股107,308,600股及199,287,400股合計306,596,000股作為對價,對環隆電氣股份有限公司(下稱環隆電氣)之股份進行公開收購。
- 99年02月 前述共同公開收購案已於99年2月9日完成,本次共收購環隆電氣普通股股份641,669,316股,加計收購前集團原持有普通股股份192,944,213股,完成收購後總計約占環隆電氣已發行有表決權股份總額78.1%。
- 99年08月 本公司於99年4月經董事會決議通過同意環隆電氣之股票終止上市申請案,同時承諾收購環隆電氣之股票。 本公司已於99年8月5日完成該公開收購案,共收購環隆電氣流通在外股份222,243,661股,加計收購前集團原持有環隆電氣股份834,613,529股,完成收購後總計約占環隆電氣已發行有表決權股份總額98.9%。
- 99年11月 本公司為配合主管機關之政策,於99年11月26日將本公司發行之股票轉換為全面無實體發行。
- 100年01月 本公司為配合集團營運策略之考量,於100年1月經董事會決議通過設立南投分公司以承接子公司環隆電氣之微電子構裝業務。
- 100年03月 本公司於99年11月經董事會決議通過透過子公司ASE (Korea) Inc.以其自有資金美金陸仟萬元增資日月光半導體(威海)有限公司,並於100年3月1日經投審會核准在案。

- 100年11月 本公司為強化與子公司日月鴻科技股份有限公司(以下簡稱「日月鴻」)其資源、人力及技術整合效益之目的,於2011年11月8日經董事會決議通過以每股現金新臺幣18.5元為對價,透過公開收購方式收購除本公司外其他股東所持有之日月鴻普通股,本公司並已於2011年11月18日完成該公開收購案,共收購日月鴻普通股股份105,697,703股,收購金額約新台幣19.6億元,若加計本公司原持有日月鴻55.7%股權計算,本公司持有日月鴻之股權已達99.2%。
- 100年12月 本公司於100年12月榮獲經濟部頒發「一百年國家發明創作獎之貢獻獎」殊榮。
- 101年05月 本公司為整合整體資源,提昇營運效益及競爭力於101年3月經董事會決議通過同意以現金合併日月鴻。以本公司為合併後存續公司,日月鴻科技為消滅公司,本合併案之合併基準日為101年5月1日。
- 101年11月 本公司2011 CSR Report於101年11月榮獲財團法人台灣永續能源研究基金會「台灣企業永續報告獎-銅獎」之肯定。
- 101年12月 本公司於101年12月榮獲經濟部頒發「智慧財產經營管理優質獎:企業組-優質獎及最佳智財報告書」二項殊 榮。
 - 本公司K12自2009年建廠規劃導入綠建築標準,以台灣綠建築EEWH"鑽石級"與美國LEED"金級"為設計準則,歷經規劃設計、施工、成效驗證、書面審查及現場查核等過程,順利於2012年12月通過内政部審核並榮獲台灣EEWH 最高等級之鑽石級標章。
- 102年07月 本公司兩家大陸子公司日月光半導體(昆山)有限公司及日月光電子元器件(昆山)有限公司,鑑於集團資源整合及產業規模經濟之考量,由日月光半導體(昆山)有限公司辦理吸收合併日月光電子元器件(昆山)有限公司,日月光電子元器件(昆山)有限公司為消滅公司,合併完成後日月光電子元器件(昆山)有限公司辦理清算,日月光半導體(昆山)有限公司收回/註銷美金2,400萬元之投資。
- 102年08月 本公司為整合整體資源,提昇營運效益及競爭力於102年7月經董事會決議通過同意與本公司持股比例達 100%之子公司洋鼎科技,依企業併購法及其他相關法令之規定進行簡易合併,以本公司為合併後存續公司,洋鼎科技為消滅公司,本合併案之合併基準日為102年8月30日。
- 102年09月 本公司發行美金4億元之海外第三次無擔保轉換公司債(Zero Coupon Convertible Bonds)。
- 102年10月 本公司於102年08月經董事會決議通過經由海外子公司ASE (Korea) Inc.以債作股,以美金貳仟伍佰萬元增資日月光半導體(威海)有限公司,並於102年10月29日經投審會核准在案。
- 103年07月 本公司於103年07月經董事會決議通過透過子公司ASE (Korea) Inc.以其自有資金美金貳仟萬元增資日月光半 導體(威海)有限公司,並於103年08月18日經投審會核准在案。
- 103年09月 本公司於103年09月榮獲富比世(Forbes)雜誌評選為亞洲企業五十強(Fab 50), 亦是2014年台灣唯一上榜之上市公司。
- 103年10月 本公司於103年10月再次向關務署高雄關重新申請安全認證優質企業認證(Authorized Economic Operator,簡稱AEO),結果通過實地驗證,再次取得AEO資格。
- 104年01月 本公司集團董事長暨執行長張虔生先生與營運長吳田玉博士於美國加州舉行的2015 SEMI產業技術論壇 (Industry Strategy Symposium, ISS)獲頒2014 SEMI Award,此獎項認可日月光在封裝製程上的努力開發與 研究能突破傳統金打線技術,導入銅打線技術的表現。
- 104年05月 本公司與日商TDK Corporation簽署合資協議,共同設立日月陽電子(股)公司合資金額共美金39,490,000元之等值新台幣,本公司取得約51%之股權,TDK Corporation取得約49%之股權。
 本公司之中壢分公司通過海關AEO安全認證優質企業(Authorized Economic Operator,簡稱AEO)。
- 104年07月 本公司發行美金2億元之海外第四次無擔保轉換公司債(Currency Linked Zero Coupon Convertible Bonds due 2018)。
 - 榮獲經濟部國際貿易局頒發金貿獎「最佳貿易貢獻獎」之殊榮。

104年10月 本公司於104年8月經董事會決議通過第一次收購矽品精密工業(股)公司之普通股股份。本公司已於104年10 月完成該公開收購案,共收購矽品精密工業(股)公司流通在外普通股股份779,000,000股,占其已發行有表決 權股份總額之24.99%。

本公司高雄廠K11、K12廠通過經濟部工業局「綠色工廠標章認證」,正式成為綠色工廠,並榮獲「綠色工廠」標章。

104年11月 本公司於台灣永續能源研究基金會評選2015 TCSA台灣企業永續獎,本公司榮獲「台灣TOP 50企業永續報告獎-電子資訊製造業」銀獎。

本公司高雄廠K4、K7、K8、K10、K11、K12共6棟廠榮獲德國聯邦資訊安全局(Germany Federal Office for Information Security, BSI) ISO 15408安全認證EAL6現場驗證(Site Certification)證書,為全球唯一獲此認證之半導體晶圓封測代工廠。

104年12月 惠譽國際信用評等股份有限公司於104年12月16日公布本公司國内長期信用評等等級為A+(twn)。

本公司兩家大陸子公司日月光半導體(上海)有限公司及日月光電子元器件(上海)有限公司,鑑於集團資源整合及產業規模經濟之考量,於104年12完成合併。

本公司為善盡企業社會責任,以永續發展為目標邁進,自101年開始,連續四年榮獲BSI(英國標準協會)肯定,得到「包容性綠色成長獎」及「GRC管理典範獎」之獎項,104年更於12月23日獲頒「綠色企業典範獎」之殊榮,彰顯本公司在綠色企業面向的努力。

本公司高雄廠K3與K5廠於104年12月再度通過經濟部工業局綠色工廠認證。

本公司高雄廠K9於102年2月1日通過清潔生產認證,並於104年12月取得經濟部工業局清潔生產展延認證。

- 105年01月 本公司高雄廠K8已於102年2月1日取得清潔生產認證,並於105年1月取得經濟部工業局清潔生產展延認 證。
- 105年03月 本公司於104年12月經董事會決議通過第二次公開收購矽品精密工業(股)公司之普通股股份,預定公開收購 之最高數量為矽品精密工業(股)公司普通股770,000,000股(含該公司流通在外美國存託憑證所表彰之普通股 股數),約占其已發行有表決權股份總額之24.71%,惟本案因公平交易委員會未於收購期間屆滿前審理完 成,故宣布收購條件無法成就。
- 105年04月 本公司於3月及4月分別依105年3月24日及105年4月1日董事會之決議,於集中交易市場合計購買矽品公司普通股258,000,000股,購買完成後本公司累計持有矽品公司普通股1,037,300,000股,持股比例約為33.29%。

2015年第二屆公司治理評鑑名列上市公司前6%至前20%之公司。

- 105年07月 入選臺灣證券交易所「臺灣公司治理100指數」成分股。
- 105年08月 榮獲亞洲企業商會頒發「2016 AREA亞洲企業社會責任獎」之殊榮。
- 105年10月 本公司中壢廠成為全球封測代工業第一家通過德國TÜV NORD Group的Trusted Production ISO 26262認證。
- 105年11月 本公司於105年6月經董事會決議通過與矽品公司簽訂「共同轉換股份協議」,並於105年11月17日經台灣公平交易委員會決議通過不禁止本公司與矽品公司結合。

本公司入選2016年台灣唯一CDP氣候變遷評鑑A級評價之企業。

本公司榮獲台灣永續能源研究基金會評選的2016 TCSA台灣企業永續獎-「台灣TOP 50企業永續報告」金獎、台灣企業永續的單項績效類「氣候領袖獎」及「供應鏈管理獎」之殊榮。

105年12月 本公司高雄廠K1、K2廠通過經濟部工業局清潔生產認證,以構築日月光高雄廠「綠色工廠藍圖」。

高雄廠自2009年起新建物導入台灣綠建築EEWH及美國綠建築LEED認證,截至2016年高雄廠已有2棟建物取得LEED認證、10棟取得EEWH認證,K22廠房於2016年12月通過USGBC審查,取得LEED-NC最高等級白金級認證。本公司高雄廠獲得LEED-NC白金級認證數量為全國之冠,體現本公司持續推行綠建築之承諾。

本公司高雄廠亦通過德國 TÜV NORD Group之Trusted Production 認證,為全球100%符合 ISO 26262《道路車輛一功能安全認證》廠商,成為功能安全認證領先國際之封測代工廠。

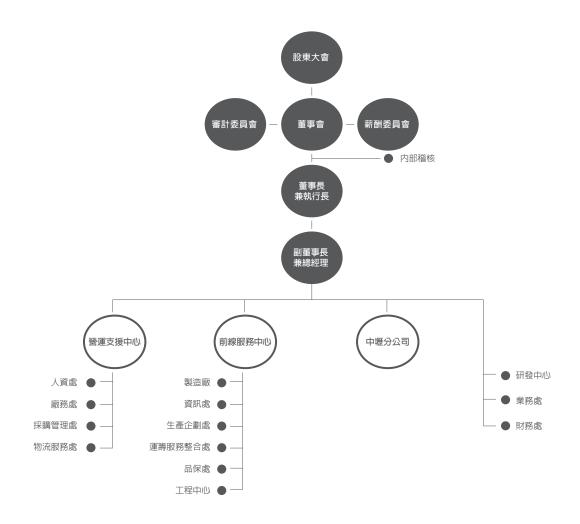
106年3月 本公司中壢廠A、B、C、L廠區通過Common Criteria安全認證EAL6現場驗證(Site Certification)證書。

本公司舉行「日月光集團供應商永續經營獎」評選後,首次頒發永續經營獎,落實本集團企業永續發展與企業公民之承諾,更藉此提升供應鏈之競爭力。

參、公司治理報告

一、組織系統

(一)組織結構:



(二)主要部門所營業務

〈營運支援中心〉

人 資 處:人力資源管理及組織發展

- 人資營運服務處:提供員工服務、制定 人力需求計畫及人員招募、薪酬、福利 及績效制度規畫及管理、中央安防管理
- 人資營運發展處:組織發展規劃及策略 規劃、強化員工關懷與員工照顧、CSR 社會責任與公益活動參與

廠 務 處:廠房及行政區環境保護、庶務管理及工安管制

- 新建工程處:規劃廠區擴建計畫、新建 廠監造及驗收管理、營運發展
- 企業職安處:整合廠區廠務組織、強化 法令與規範鑑別及標準化作為、負責職 安環境管理及永續發展
- 廠務技術整合處:整合與強化廠務系統 之供應品質與可靠度、廠房安全維護之 整合運作、新技術與設備引進規劃

採購管理處:機台、產品投料之採購、管理及控制

- 採購管理一處:整合生產原物料採購及 供應商資源管理
- 採購管理二處:修繕總務採購專業分工、跨部門資源整合管理
- 採購管理三處:整合機器設備採購資源、跨單位制度訂定與推動

物流服務處: 倉儲、進出口業務及保稅帳務管理

〈前線服務中心〉

製 造 廠:半導體封裝之代工、掌理產品之生產計 劃、產品製造、進度管理、現場管理、設 備維修等相關事官

資 訊 處:公司資訊系統建構、推動e化經營策略及系 統服務

- 自動化及工程資訊處:自動化及工程資 訊系統策略發展、創新、架構規劃、系 統整合、系統設計及維護
- 技術資訊處:公司資訊系統軟硬體評估、導入、建置及維運服務
- 營運及客戶資訊處:公司營運管理及客 戶資訊服務 IT 應用系統之發展規劃、開 發及維護管理
- 製造資訊處:製造執行資訊系統策略發展、創新、架構規劃、系統整合、系統設計及維護

生產企劃處:生產企劃及營運效率管理

運籌服務整合處: 為公司對客戶的直接應對窗口,提供快速、正確且完整的服務藉以提升整體產品生產製造的最大價值

- 運籌服務整合:客戶的對應窗口,整 合式地提供所有與生產、營運相關的 服務及回覆
- 營運管理:提供市場狀況解讀、建議公司營運方向及長遠的公司營運規劃
- 訂單管理:系統化地整合客戶訂單及 收費條件、增強服務的價值化

品 保 處:產品品質檢驗及品質確保

- 品質保證處:確保品質管理機制、確 保產品品質
- 品質系統處:建立產品可靠度、保證 測量儀器精確度
- 品質工程處:客戶溝通與協調、建立 品質檢驗流程、監控及品質確保

工程中心:基板設計及生產技術開發

- 設計工程處:新技術與新材料開發及 系統流程整合與自動化,提供全球客 戶在地支援設計服務
- 封裝工程處:新設備與新材料開發及 導入評估、工程執行系統整合

〈其他〉

研發中心:先進技術研究發展與生產技術導入、設計 與製造規格之制定、新產品與新技術之研 究發展與評估

業 務 處:亞洲、美洲、歐洲等地區業務開拓推廣與 產品銷售之執行

財 務 處: 財務及會計,包括資金管理、資產管理、 成本與管理會計、租稅規劃及股務作業

内部稽核:内部政策、流程及標準稽核、評估内部控制制度之合理及各部門有效性

〈中壢分公司〉

包括總經理辦公室、人資暨公共關係、財務、品保、生產運籌管理、資訊、工程發展中心、封裝測試製造廠、晶圓級凸塊作業暨封裝製程、策略資材、業務推廣及集團研發等單位業務。

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料:

(一)董事資料(年報刊印日 106.02.28)

單位:股

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有	有股份	現在持有股	數(註1)	配偶、未成年子女 現在持有股份(註1)	
	5111176					口知	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
董事本人	香港	張洪本 (副董事長)	男	104.06.23	三年	73.03.11	104,414,941	1.32%	104,414,941	1.31%	121,929,346	1.53%
董事本人	美國	張能傑	男	104.06.23	三年	98.06.25	1,779,708	0.02%	1,779,708	0.02%	_	_
董事本人	香港	香港商微電子 國際公司		104.06.23	三年	80.03.30	1,327,202,773	16.82%	1,327,202,773 (註2)	16.69%	_	_
	新加坡	張虔生 (董事長)	男									
董事之法	中華民國	吳田玉	男									
人代表人	中華民國	董宏思	男									
八亿亿八	中華民國	羅瑞榮	男									
	中華民國	陳昌益	男									
	中華民國	陳天賜	男									
獨立董事	中華民國	游勝福	男	104.06.23	三年	98.06.25	_	_	_	_	4,632	0.00%
獨立董事	美國	徐大麟	男	104.06.23	三年	98.06.25	_	_	_	_	_	_
獨立董事	中華民國	何美玥	女	104.06.23	三年	104.06.23	_	_	_	_	_	_

 職 稱	姓名	利用他人名義	持有股份(註1)	主要經(學)歷	具配偶或二親等L	以内關係之其他主管	、董事或監察人
地 件	姓名	股數	持股比率	目前兼任本公司及其他公司之職務(註3)	職稱	姓名	關係
董事本人	張洪本 (副董事長)	_	-	中原大學工業工程學系畢	董事長	張虔生	兄
董事本人	張能傑	_	_	美國衛斯理大學心理系學士	董事長	張虔生	父
董事本人	香港商微電子 國際公司	_	_				
	張虔生			台灣大學電機工程系畢	副董事長	張洪本	弟
	(董事長)			美國伊利諾理工學院碩士	董事	張能傑	子
	是田玉			美國賓州大學應用機械博士	-	-	_
董事之法人	董宏思			美國南加州大學企管碩士 美商花旗銀行企業融資部副總裁	_	_	_
代表人	羅瑞榮			交通大學電子物理系畢	_	-	_
	陳昌益			加拿大英屬哥倫比亞大學企管碩士 美商信孚銀行台北分行副總裁	_	_	_
	陳天賜			中原大學工業工程與管理系	_	-	_
獨立董事	游勝福	_	_	台灣大學商學系會計組 政大會計研究所碩士	_	_	=
獨立董事	徐大麟	_	-	台灣大學物理學學士 美國紐約州布魯克林理工學院電子物理學 碩士 美國加州柏克萊分校電機工程博士	_	_	_
獨立董事	何美玥	_	-	台灣大學農化系學士	_	-	-

註1:截至年報刊印日止實際持有股數。 註2:截至年報刊印日止質押股數為248,471,522股。

張虔生

日月光半導體製造(股)公司-執行長、董事長及董事(代表人)

日月瑞(股)公司-董事長及董事(代表人)

ASE Japan Co., Ltd. -董事

台灣福雷電子(股)公司-董事長及董事(代表人)

ASE Test Holding, Ltd. - 董事

ASE (Korea) Inc. -董事

ISE Labs, Inc.-董事

A.S.E. Holding Ltd. -董事

J&R Holding Ltd. -董事

Innosource Ltd. - 董事

日月光半導體(昆山)有限公司-董事

ASE Test Limited (Singapore) -董事

日月光半導體(上海)有限公司-董事長

日月光電子元器件(上海)有限公司-董事

日月光投資(昆山)有限公司-董事長

日月光電子(股)公司-董事長及董事(代表人)

ASE Mauritius Inc. -董事

ASE Corporation - 董事

蘇州日月新半導體有限公司-董事長

ASE Labuan Inc. - 董事

日月光集成電路製造(中國)有限公司-董事

ASE Singapore Pte. Ltd. - 董事

Alto Enterprises Ltd.-董事

Super Zone Holdings Ltd. -董事

Anstock Limited -董事

Anstock II Limited -董事

環旭電子(股)公司-董事

環電(股)公司-董事

Wealthy Joy Co. Ltd. -董事

北京鼎固鼎好實業有限公司-董事

上海鼎榮房地產開發有限公司 - 董事

重慶鼎固房地產開發有限公司-董事

上海鼎莘房地產開發有限公司-董事

昆山鼎耀房地產開發有限公司-監事

比山峁滩房地产用没有限公司—监争

上海鼎嘉房地產開發有限公司-監事

上海鼎通房地產開發有限公司-監事

上海鴻翔置業有限公司-監事

上海名龍建設發展有限公司-監事

上海鼎溢房地產開發有限公司-董事
True Elite Holdings Limited-董事

溫州宏德建設開發有限公司-董事

Excellent Worth Holdings Limited-董事

ASE Enterprises - 董事

鼎昌投資(股)公司-董事

鼎固投資(股)公司-董事

萬昌投資(股)公司-董事

萬亞投資(股)公司-董事

偉東投資(股)公司 - 董事長 瑞昌投資(股)公司 - 董事長

紹昌投資(股)公司-董事長

嘉慶投資(股)公司-董事長

嘉學投資(股)公司-董事長

明通投資(股)公司-董事長

明祥投資(股)公司-董事長

啓昌投資(股)公司-董事長

日月光半導體製造(股)公司-營運長及董事(代表人)

ISE Labs, Inc.-董事

ASE Japan Co., Ltd. -董事

ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd. -董事

GAPT-Cayman-董事

日月光封裝測試(上海)有限公司-董事

蘇州日月新半導體有限公司-董事

日月光半導體(威海)有限公司-董事

無錫通芝微電子有限公司-董事

環電(股)公司-董事(代表人)

張洪本

日月光半導體製造(股)公司 - 總經理及副董事長

日月瑞(股)公司-董事(代表人)

Innosource Ltd. -董事

日月光半導體(上海)有限公司-董事

台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)

Omniquest Industrial Ltd. - 董事

ASE Test Limited (Singapore) -董事

ASE (Korea) Inc. -董事

ASE Electronics (Malaysia) Sdn, Bhd. -董事

A.S.E. Holding Ltd. -董事

J&R Holding Ltd. -董事

日月光半導體(昆川)有限公司-董事長

日月光電子元器件(上海)有限公司-董事長

GAPT-Cayman - 董事

日月光封裝測試(上海)有限公司-董事

ASE Japan Co., Ltd. -董事

日月光半導體(香港)有限公司-董事長

日月光集成電路製造(中國)有限公司-董事

Alto Enterprises Ltd. -董事

Super Zone Holdings Ltd. - 董事

Anstock Limited -董事

日月光投資(昆山)有限公司-董事

RTH公司-董事

環旭電子(股)公司-董事長

環銓電子(昆山)公司-董事長

環勝電子(深圳)公司-董事長

環旭科技有限公司-董事

環鴻科技(股)公司-董事(代表人)

USI Enterprise Limited-董事

環鴻電子(昆山)有限公司 - 董事長

環降雷氣(股)公司-董事(代表人)

環電(股)公司-董事

環維電子(上海)有限公司-董事長

環豪電子(上海)有限公司-董事長

Universal Global Technology Co., Limited-董事

Sino Horizon Holdings Limited-董事長

Wealthy Joy Co. Ltd.一董事

Peak Vision International Limited - 董事

Peak Paramount International Limited-董事

Great Sino Development Ltd. -董事

Sino Engine Group Limited-董事

Fairwheel Holdings Limited-董事

洪裕有限公司 – 董事

北京鼎固鼎好實業有限公司-董事長

上海鼎固置業有限公司-董事長

上海鼎嘉房地產開發有限公司-董事長

上海鼎通房地產開發有限公司 – 董事長

上海鴻翔置業有限公司-董事長

上海名龍建設發展有限公司-董事長

上海鼎榮房地產開發有限公司-董事長 上海鼎霖房地產開發有限公司-董事長

上海鼎莘置業有限公司 – 董事長

昆山鼎耀房地產開發有限公司-董事長

重慶鼎固房地產開發有限公司-董事長

上海日月光百貨有限公司 – 董事

重慶鼎固物業管理有限公司 - 總經理 上海鼎溢房地產開發有限公司 - 董事長

無錫鼎固房地產開發有限公司-執行董事

温州宏德建設開發有限公司-董事

重慶鼎好市場經營管理有限公司-董事

ASE Enterprises一董事

溫地發展有限公司-董事

嘉瑩投資(股)公司-董事 明祥投資(股)公司-董事

明涌投資(股)公司-董事

瑞昌投資(股)公司-董事

嘉慶投資(股)公司-董事

偉東投資(股)公司-董事

紹昌投資(股)公司-董事 啓昌投資(股)公司-董事

鼎昌投資(股)公司-董事長

萬昌投資(股)公司-董事長 萬亞投資(股)公司-董事長

鼎固投資(股)公司-董事長

董宏思

日月光半導體製造(股)公司-財務長及董事(代表人)

日月瑞(股)公司-董事(代表人)

ASE Japan Co., Ltd. - 監察人

台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)

ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd. - 監察人

Innosource Ltd. - 董事

J&R Holding Ltd. -董事

ASE Investment (Labuan) Inc. -董事

A.S.E. Holding Ltd. -董事

Omniquest Industrial I td - 董事

ASE Test Holding, Ltd. - 董事

ASE (Korea) Inc - 董事

ASE Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd. -董事

ASE Mauritius Inc. - 董事

日月光電子(股)公司-董事(代表人)

ASE Labuan Inc. -董事

ASE Corporation-董事

Alto Enterprises I td - 董事

Anstock Limited -董事

環電(股)公司-監察人

陸竹開發(股)公司-董事(代表人)

無錫通芝微電子有限公司-監事

日月光貿易(上海)有限公司-董事

大衆商業銀行(股)公司-獨立董事

元隆電子(股)公司-董事(代表人)

笛林傑國際科技(股)公司-董事

亞太新興產業創業投資(股)公司-董事(代表人)

日月光半導體製造(股)公司-董事(代表人)及高雄廠區總經理

台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)及總經理

日月光半導體製造(股)公司-董事(代表人)及中壢分公司總經理

台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)

陸竹開發(股)公司-董事(代表人)

蘇州日月新半導體有限公司-監事

張能傑

日月光半導體製造(股)公司-董事

日月光半導體(上海)有限公司-董事

日月光集成電路製造(中國)有限公司-董事

台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)

日月光封裝測試(上海)有限公司-董事

日月光半導體(昆山)有限公司-監事

日月光半導體(威海)有限公司-董事 上海鼎匯房地產開發有限公司-董事

上海鼎威房地產開發有限公司-董事

上海鼎裕层地產開發有限公司-董事

昆山鼎泓房地產開發有限公司-董事

昆川県悦房地産開發有限公司-董事

環旭電子(股)公司-董事

環電(股)公司-董事(代表人)

無錫通芝微電子有限公司-董事

北京鼎固鼎好實業有限公司-董事

陳昌益

日月光半導體製造(股)公司-董事(代表人)及上海總部總經理

台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)

日月光半導體(昆山)有限公司-董事

ASE Test Limited (Singapore) - 董事

ASE Test Holdings Ltd. - 董事

Omniquest Industrial Ltd. 一董事

ISE Labs, Inc.-董事

ASE Investment (Labuan) Inc. - 董事

日月光電子元器件(上海)有限公司-董事

日月光封裝測試(上海)有限公司-監事

上海鼎匯房地產開發有限公司-董事長

日月光雷子(股)公司-董事(代表人)

日月光半導體(香港)有限公司-董事

蘇州日月新半導體有限公司-董事

上海鼎威房地產開發有限公司-董事長

上海鼎裕房地產開發有限公司-董事長

昆山鼎泓房地產開發有限公司-董事長 昆山鼎悦房地產開發有限公司-董事長

上海鼎祺物業管理有限公司-董事長 上海県17.百貨有限公司 - 董事長

日月光貿易(上海)有限公司-董事

Super Zone Holdings Ltd. -董事

環電(股)公司-監察人

HHI公司-董事

環旭電子股份有限公司-董事

三商投資控股(股)公司-獨立董事及薪資報酬委員會委員

江蘇榮成環保科技(股)公司-董事

日月光半導體製造(股)公司-獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員

華信光電科技股份有限公司-董事

順達科技股份有限公司-監察人

三福化工股份有限公司-監察人

華冠通訊股份有限公司-監察人

全大麟

日月光半導體製造(股)公司-獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員

漢鼎亞太公司-總裁暨創辦人 漢鼎股份有限公司-董事長

何美玥

日月光半導體製造(股)公司-獨立董事及審計委員會成員

友達光電股份有限公司-獨立董事及審計委員會成員

高雄銀行股份有限公司-獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員 金寶電子工業股份有限公司-獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員 Ausnutria Dairy Corporation Ltd. - 獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委

俞旭濬

上海鼎匯房地產開發有限公司-董事

上海鼎威房地產開發有限公司-董事

昆山鼎泓房地產開發有限公司-董事

昆川県悦房地産開發有限公司-董事

上海鼎祺物業管理有限公司-董事

上海鼎凡百貨有限公司-董事 環電(股)公司-監察人

陸竹開發(股)公司-監察人

郭宏銘

台灣福雷電子(股)公司-監察人(代表人)

ASE Singapore Pte. Ltd. -董事

Anstock II Limited - 董事

陸竹開發(股)有限公司-董事(代表人)

1.1 董事為法人股東其主要股東

106年02月28日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
香港商微電子國際公司	Aintree Limited	100.00%

1.2 董事為法人股東其主要股東為法人者其上一層主要股東

106年02月28日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例		
Aintree Limited	JC Holdings Limited	100.00%		

1.3 董事所具專業知識及獨立性之情形(106.02.28)

條件	是否具有五年」		列專業資格			符合獨立性情況		
	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公和關科系之公和財政上	法官 ()	商務、法 務、財務、 會計或公司 業務所須之 工作經驗	01.非為公司或 其關公原係 業之 人	02. 原事 (司司、本國之本 一之之察為母公或令立不 之之察為母公或令立不 也或、本國之者限 主孫 (司司、本國之者 (司司、本國之子 (司司、本國之者 (司司、司司、司司、司司、司司、司司、司司、司司、司司、司司、司司、司司、司司、	03.非本、人人及其配子人人及其不不人人及其不不人人及其不不,或有所以有人的人。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	04.非前三款所列明,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	05.非直接持有公司已 發行因為 分之五額 分之五五董 察人改重 。 或持股東之董 。 或持股東之董 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
姓名								
張虔生			V					
張洪本			V					
吳田玉			V				V	V
董宏思			V				V	V
羅瑞榮			V			V	V	V
陳昌益			V			V	V	V
陳天賜			V			V	V	V
張能傑			V			V		V
游勝福	V	V	V	V	V	V	V	V
徐大麟			V	V	V	V	V	V
何美玥			V	V	V	V	V	V

條件		符合獨立性情	形			
姓名	06.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東	07. 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶	08.未與其他董 事間具有配 偶或二親 以内之親屬 關係	09.未有公司法 第30條各款 情事之一	10.未有公司法 第27條規定 以政府、法 人或其代表 人當選	兼任其他公開發行公 司獨立董事家數
張虔生		V		V		0
張洪本		V		V	V	0
吳田玉	V	V	V	V		0
董宏思		V	V	V		1
羅瑞榮	V	V	V	V		0
陳昌益		V	V	V		1
陳天賜	V	V	V	V		0
張能傑	V	V		V	V	0
游勝福	V	V	V	V	V	0
徐大麟	V	V	V	V	V	0
何美玥	V	V	V	V	V	3

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

單位:股(截至年報刊印日止實際持有股數)

High TAX	FR 455	44.47	.## DII	±4/7 (7.44)		股份	配偶、未成年	
職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	股數	持股比率	股數	持股比率
執行長	新加坡	張虔生	男	92.05	85,070,931	1.07%	-	_
總經理	香港	張洪本	男	92.02	104,414,941	1.31%	121,929,346	1.53%
營運長	中華民國	吳田玉	男	96.02	6,453,386	0.08%	_	_
財務長	中華民國	董宏思	男	83.12	5,151,908	0.06%	274,915	0.00%
高雄廠區總經理	中華民國	羅瑞榮	男	95.04	3,565,643	0.04%	1,182	0.00%
上海總部總經理	中華民國	陳昌益	男	105.05	2,100,802(註2)	0.03%	-	_
副總經理	中華民國	俞旭濬	男	88.08	619,259	0.01%	-	_
副總經理	中華民國	李世文	男	93.01	1,016,234	0.01%	-	_
副總經理	中華民國	周光春	男	103.01	82,203	0.00%	-	_
副總經理	中華民國	林國堂	男	93.08	2,037,773	0.03%	3,242	0.00%
副總經理	中華民國	莫煥華	男	93.08	858	0.00%	-	=
副總經理	中華民國	葉清昆	男	93.08	276,622	0.00%	-	=
中壢分公司總經理	中華民國	陳天賜	男	104.08	2,292,054	0.03%	-	=
副總經理	中華民國	鄭楨銘	男	95.07	6,416	0.00%	-	=
副總經理	中華民國	洪松井	男	100.01	72,275	0.00%	-	=
副總經理	中華民國	曹燕傑	男	101.12	=	-	-	=
副總經理	中華民國	洪志斌	男	103.03	410,000	0.01%	25,000	0.00%
副總經理暨會計長	中華民國	郭宏銘	男	103.08	46,000	0.00%	-	_

職稱	姓名	利用他人名義	持有股份	→ 西 Ø / Ø / 厚	目前兼任其他	具配偶或二	親等以内關	係之經理人
100円	姓名	股數	持股比率	主要學(經)歷	公司之職務	職稱	姓名	關係
	張虔生	1,693,208,250	21 200/	台灣大學電機工程系畢	連典即第11百	副董事長	張洪本	弟
料 打長	派及生	(註1)	21.29%	美國伊利諾理工學院碩士	請參閱第11頁	董事	張能傑	子
總經理	張洪本	-	_	中原大學工業工程學系畢	請參閱第11頁	董事長	張虔生	兄
營運長	吳田玉	-	=	美國賓州大學應用機械博士	請參閱第11頁	-	_	-
財務長	董宏思	_		美國南加州大學企管碩士	請參閱第12頁			
划務 技	里厷芯	_	_	美商花旗銀行企業融資部副總裁	胡参阅第12貝	_	_	_
高雄廠區總經理	羅瑞榮	_	_	交通大學電子物理系畢	請參閱第12頁	-	-	-
上海總部總經理	陳昌益			加拿大英屬哥倫比亞大學企管碩士	請參閱第12頁			
上/母心印心社生	アボロ田田		_	美商信孚銀行台北分行副總裁	明参阅第12只			
				國立藝專廣播電視科				
副總經理	俞旭濬	_	-	東森傳播公司副總經理	請參閱第12頁	-	_	-
				鑫凱傳播公司總經理				
副總經理	李世文	_	-	成功大學物理系畢	無	_	_	-
副總經理	周光春	_	-	成功大學機械系畢	無	-	_	-
副總經理	林國堂	_	-	崑山工專電子科畢	無	-	_	-
副總經理	莫煥華	_	_	伯明罕大學機械工程所	無	_	_	-
副總經理	葉清昆	-	-	東吳大學物理系	無	_	-	-
中壢分公司總經理	陳天賜	-	-	中原大學工業工程與管理系	請參閱第12頁	_	-	-
副總經理	鄭楨銘	-	=	淡江大學機械工程系	無	_	_	-
副總經理	洪松井	-	-	德州大學機械博士	無	_	_	_
副總經理	曹燕傑	-	=	文化大學物理系	無	_	_	_
副總經理	洪志斌	-	_	英國PAISLEY大學電子博士	無	_	_	_
副總經理暨會計長	郭宏銘	-	_	美國波士頓大學企管碩士	請參閱第12頁	_	_	_

註1:其中設質股數為248,471,522股。

註2:質押股數為700,000股。

三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一) 董事之酬金

105年12月31日 單位:仟股:新台幣仟元

					董事	酬金					及D等四項 ・後純共立	兼任員取相關	
職稱	姓名	報酬	報酬(A) 退職退休金(B) 董事酬勞(C)(註1) 業務執行費用(D		ī費用(D)	一總額占稅後純益之 比例		薪資、獎金及 特支費等(E)(註3)					
		本公司	財務報告内所有公司	本公司	財務報告内所有公司	本公司	財務報告内所有公司	本公司	財務報告内所有公司	本公司	財務報告内所有公司	本公司	財務報告内所有公司
董事本人	張洪本 (副董事長)												
董事本人	張能傑												
董事本人	香港商微電 子國際公司												
	張虔生 (董事長)												
	吳田玉	7,467	7,467	_	_	148,000	156,100	_	_	0.72%	0.75%	120,200	194,879
董事之法 人代表人	董宏思	,	,			,	,					,	,
/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	羅瑞榮												
	陳昌益												
	陳天賜												
獨立董事	游勝福												
獨立董事	徐大麟												
獨立董事	何美玥												

				兼任員工領	取相關酬金			A D O D	5 500000000000000000000000000000000000	
職稱	姓名	退職退休金(F) (註2)			員工酬勞	∮(G)(註1)	A、B、C、D、 總額占稅後	有無領取來自 子公司以外轉		
地 件	姓在	本公司	財務報告内所	本公	2司	財務執	股告内 公司	本公司	財務報告内所	投資事業酬金
			有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額		有公司	
董事本人	張洪本 (副董事長)									
董事本人	張能傑									
董事本人	香港商微電 子國際公司									
	張虔生 (董事長)									
	吳田玉	540	864	213,100	_	259,430	_	2.26%	2.85%	無
董事之法 人代表人	董宏思					,				
/(1V1X//	羅瑞榮									
	陳昌益									
	陳天賜									
獨立董事	游勝福									
獨立董事	徐大麟									
獨立董事	何美玥									

註1:本公司董事會於106年3月30日決議,擬訂分派105年度董事酬勞為新台幣148,000仟元,員工酬勞新台幣2,151,900仟元(全部以現金發放),惟截至刊印日止本次員工酬勞分派名單尚未決定,茲以去年員工酬勞之實際分派比例估算擬議分派數如上,上述酬勞分派内容俟本年度股東會決議通過後才確定。

註2:本公司105年度實際給付退職退休金金額為0元:該欄退職退休金金額全數屬退職退休金費用化之提列(提撥)數。

註3:本欄位未包含財務報告所有公司員工認股權費用化之金額分別為新台幣9,776仟元。

酬金級距表

		董事	性名			
給付本公司各個董事酬金級距	前四項酬金總	思額(A+B+C+D)	前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)			
	本公司	財務報告内所有公司H	本公司	財務報告内所有公司		
低於2,000,000元	_	_	-	-		
2,000,000元(含)~5,000,000元	游勝福、徐大麟、何美玥	游勝福、徐大麟、何美玥	游勝福、徐大麟、何美玥	游勝福、徐大麟、何美玥		
5,000,000元(含)~10,000,000元	_	_	_	-		
10,000,000元(含)~15,000,000元	_	_	-	-		
15,000,000元(含)~30,000,000元	張虔生、張洪本、吳田玉、 董宏思、羅瑞榮、陳天賜、 陳昌益、張能傑	張虔生、張洪本、吳田玉、 董宏思、羅瑞榮、陳天賜、 陳昌益、張能傑	陳昌益、張能傑	張能傑		
30,000,000元(含)~50,000,000元	-	_	張洪本	-		
50,000,000元(含)~100,000,000元	-	_	吳田玉、董宏思、羅瑞榮、 陳天賜	張洪本、吳田玉、董宏思、 羅瑞榮、陳天賜、陳昌益		
100,000,000元以上	-	_	張虔生	張虔生		
總計	_		-			

(二) 監察人之酬金:無。

本公司於104年6月23日召開股東常會全面改選董事,選任之三位獨立董事於104年6月24日就任組成審計委員會取代監察人。

(三) 總經理及副總經理之酬金

105年12月31日 單位:仟股:新台幣仟元

		薪資(A	A)(註3)	退職退休	金(B)(註2)	獎金及特支費等(C)	
職稱	姓名	本公司	財務報告内 所有公司	本公司	財務報告内 所有公司	本公司	財務報告内 所有公司
執行長	張虔生						
總經理	張洪本						
營運長	吳田玉						
財務長	董宏思						81,154
高雄廠區總經理	羅瑞榮			8,796	9,120	76,519	
中壢分公司總經理	陳天賜						
上海總部總經理	陳昌益						
副總經理	俞旭濬						
副總經理	李世文	101,225	169,245				
副總經理	周光春	101,225	169,245				
副總經理	林國堂						
副總經理	莫煥華						
副總經理	葉清昆						
副總經理	鄭楨銘						
副總經理	洪松井						
副總經理	曹燕傑						
副總經理	洪志斌						
副總經理暨會計長	郭宏銘						

11 to 15 to	h# 47	員工酬勞金額(D) (註1)				A、B、 C及D等四項總額占稅後 純益之比例(%)		有無領取來自
職稱	姓名	本经	2司	財務報告内	財務報告内所有公司		財務報告内	子公司以外轉 投資事業酬金
		現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	所有公司	30 90 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
執行長	張虔生							
總經理	張洪本							
營運長	吳田玉							無
財務長	董宏思			269,270		1.89%	2.44%	
高雄廠區總經理	羅瑞榮				_			
中壢分公司總經理	陳天賜		0.40					
上海總部總經理	陳昌益							
副總經理	俞旭濬							
副總經理	李世文	222.040						
副總經理	周光春	222,940	_					
副總經理	林國堂							
副總經理	莫煥華							
副總經理	葉清昆							
副總經理	鄭楨銘							
副總經理	洪松井							
副總經理	曹燕傑							
副總經理	洪志斌							
副總經理暨會計長	郭宏銘							

註1:詳第15頁註1之說明。 註2:本公司105年度實際給付退職退休金金額為7,500仟元:該欄退職退休金金額其餘屬退職退休金費用化之提列(提撥)數。 註3:本欄位未包含本公司及財務報告所有公司員工認股權費用化之金額分別為新台幣508仟元及新台幣9,965仟元。

酬金級距表

——— 給付本公司各個總經理及	總經理及副總經理姓名				
副總經理酬金級距	本公司	財務報告内所有公司			
低於2,000,000元	-	-			
2,000,000元(含)~5,000,000元	李世文	李世文			
5,000,000元(含)~10,000,000元	俞旭濬、周光春、莫煥華、郭宏銘、林國堂、洪志斌、 葉清昆	周光春、莫煥華、郭宏銘、林國堂、洪志斌、葉清昆			
10,000,000元(含)~15,000,000元	鄭楨銘、洪松井、曹燕傑	鄭楨銘、俞旭濬、洪松井、曹燕傑			
15,000,000元(含)~30,000,000元	張洪本、陳昌益	_			
30,000,000元(含)~50,000,000元	吳田玉、董宏思、羅瑞榮、陳天賜	張洪本、陳昌益			
50,000,000元(含)~100,000,000元	張虔生	吳田玉、董宏思、羅瑞榮、陳天賜			
100,000,000元以上	_	張虔生			
總計	-	-			

(四) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

105年12月31日 單位:新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額(註1)	現金金額(註1)	總計	總額占稅後純益之比例%
	執行長	張虔生				
	總經理	張洪本				
	營運長	吳田玉				
	財務長	董宏思				
	高雄廠區總經理	羅瑞榮				
	中壢分公司總經理	陳天賜			222,940	
	上海總部總經理	陳昌益				
	副總經理	俞旭濬				
經理人	副總經理	李世文	_	222,940		1.03%
程连八	副總經理	周光春		222,940		1.03 %
	副總經理	林國堂				
	副總經理	莫煥華				
	副總經理	葉清昆				
	副總經理	鄭楨銘				
	副總經理	洪松井				
	副總經理	曹燕傑				
	副總經理	洪志斌				
	副總經理暨會計長	郭宏銘				

註1: 詳第15頁註1之說明。

(五) 分別比較說明本公司及財務報告内所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

年度 占稅後損益比例	105	年度	104年度		
項目	本公司	財務報告内所有公司	本公司	財務報告内所有公司	
董事酬金總額(註2)	2.26%	2.85%	2.32%	3.03%	
總經理及副總經理酬金總額(註2)	1.89%	2.44%	1.96%	2.44%	

本公司執行長及總經理之薪資係經本公司董事會決議通過,另副總經理之酬金則參照同業水準訂定支付之,每年定期檢視 與同業人才競爭廠商比較,確保薪酬的競爭性,其獎金之給付則視本公司盈餘多寡、個人經營績效優劣以達求才與留才之 目的。

董事酬勞之擬訂,係依有純益年度之分配順序,將酬勞明訂於本公司章程中。

註2:本公司董事會於106年3月30日決議,擬訂105年度提撥員工酬勞新台幣2,151,900仟元,全部以現金發放,惟截至刊印日止本次員工酬勞分派名單尚未決定,故酬金總額之計算員 工酬勞金額係以去年實際分派比例估算擬議分派數。

四、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形:

董事會運作情形資訊

最近年度截至年報刊印日止董事會開會16(A)次,董事出席情形如下:

職稱	姓名	實際出席次數B	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】(註)	備註
董事本人	張洪本(副董事長)	7	8	44%	
董事本人	張能傑	1	0	6%	
	張虔生(董事長)	11	5	69%	
	吳田玉	14	1	88%	
董事之法人 (香港商微電子國際公司)	董宏思	15	1	94%	
代表人	羅瑞榮	13	1	81%	
	陳昌益	12	3	75%	
	陳天賜	15	0	94%	
獨立董事	游勝福	16	0	100%	
獨立董事	徐大麟	11	5	69%	
獨立董事	何美玥	15	1	94%	

註:實際出席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

其他應記載事項:

- 一、證交法第14條之5所列事項暨其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項,應敘明董事會日期、期別、議案内容、審計委員會決議結果以 及公司對審計委員會意見之處理。
 - (一) 證交法第14條之5所列事項。
 - (二) 除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項。

董事會日期期別	- 第二三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三		公司對審計委員會意見之處理
無	無	無	無

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案内容、應利益迴避原因以及參與表決情形。

董事會日期期別	議案内容	董事會決議結果	公司對獨立董事陳述意見之處理
105.04.01	為擬修訂本公司獨立董事之薪資報酬案。	經主席徵詢出席董事,除游	不適用。
105年度第4次董事會議	董事對利害關係議案迴避之情形:	勝福獨立董事、徐大麟獨立	
	游勝福董事發言摘要-因本人與徐大麟董事、何美玥董事三人皆	董事及何美玥獨立董事迴避	
	為本公司之獨立董事,明顯與本案討論有關修訂獨立董事報酬	不參與討論及表決外,其餘	
	之會議内容有自身利害關係,為避免利益衝突,本人與徐大麟董	出席董事全體無異議照案通	
	事、何美玥董事三人將迴避不參與討論及表決本議案,請其餘出	過。	
	席董事自行討論。		
105.09.02	為擬訂定本公司一○四年度之董事酬勞分配明細案。	經其餘三席無利害關係之出	不適用。
105年度第11次董事會議	董事對利害關係議案迴避之情形:	席董事游勝福董事、徐大麟	
	董宏思董事發言摘要-因本人董宏思及張虔生董事、吳田玉董	董事及何美玥董事全體無異	
	事、羅瑞榮董事、陳天賜董事、陳昌益董事所代表之法人香港商	議照案通過。	
	微電子國際公司與張洪本董事均為本公司一〇四年度董事酬勞擬		
	配發之對象,明顯與本案之會議内容有利害關係,為避免利益衝		
	突,本人(含代理張虔生董事)、吳田玉董事、羅瑞榮董事、陳天賜		
	董事及陳昌益董事(含代理張洪本董事)均迴避不參與討論及表決本		
	議案,請其餘出席董事自行討論。		
105.09.02	為擬訂定本公司一○四年度之經理人員工酬勞分配明細案。	經其餘三席無利害關係之出	不適用。
105年度第11次董事會議	董事對利害關係議案迴避之情形:	席董事游勝福董事、徐大麟	
	董宏思董事發言摘要-因本人董宏思與張虔生董事、張洪本董	董事及何美玥董事全體無異	
	事、吳田玉董事、羅瑞榮董事、陳天賜董事、陳昌益董事均為本	議照案通過。	
	公司之經理人,明顯與本案討論有關訂定本公司一〇四年度經理		
	人員工酬勞分配明細之會議内容有自身利害關係,為避免利益衝		
	突,本人(含代理張虔生董事)、吳田玉董事、羅瑞榮董事、陳天賜		
	董事及陳昌益董事(含代理張洪本董事)均迴避不參與討論及表決本		
	議案,請其餘出席董事自行討論。		

董事會日期期別	議案内容	董事會決議結果	公司對獨立董事陳述意見之處理
106.01.13	為擬訂定本公司一〇五年度現金增資發行普通股其經理人得認購	經其餘三席無利害關係之出	不適用。
106年度第1次董事會議	股數分配明細案。	席董事游勝福董事、徐大麟	
	董事對利害關係議案迴避之情形:	董事及何美玥董事全體無異	
	董宏思董事發言摘要-因本人董宏思與張虔生董事、張洪本董	議照案通過。	
	事、吳田玉董事、羅瑞榮董事、陳天賜董事、陳昌益董事均為本		
	公司之經理人,明顯與本公司一○五年度現金增資發行普通股其		
	經理人得認購股數分配明細之會議内容有自身利害關係,為避免		
	利益衝突,本人(含代理張虔生董事)、吳田玉董事(含代理張洪本		
	董事)、羅瑞榮董事、陳天賜董事及陳昌益董事均迴避不參與討論		
	及表決本議案,請其餘出席董事自行討論。		

- 三、獨立董事與内部稽核主管及會計師之溝通情形(應包含就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)。
 - (一) 每月月底前,本公司内部稽核部門會將當月份之稽核報告及缺失回應彙總報告e-mail子各獨立董事參閱,同時内部稽核主管會定期於每季與獨立董事溝通稽核報告結果,並每季於董事會中作内部稽核報告。此外,平時若有特殊狀況時,稽核主管亦會即時向獨立董事報告,惟民國105年度並無上述特殊狀況。截至目前為止本公司獨立董事與内部稽核主管溝通狀況尚屬良好。
 - (二)本公司簽證會計師均定期於每季向獨立董事報告當季財務報表查核或核閱結果,以及其他相關法令要求之溝通事項。此外,平時若有特殊狀況時,簽證會計師亦會即時向獨立董事報告,惟民國105年度並無上述特殊狀況。截至目前為止本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況尚屬良好。

(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形:

本公司為建立良好審計委員會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰於民國104年6月24日依證券交易法第十四條 之四設立審計委員會。目前該委員會成員人數為三人,由全體獨立董事組成,並由全體成員互推一人擔任召集人及會議主席,對外代表該委員會。

審計委員會運作情形資訊

最近年度截至年報刊印日止審計委員會開會13次(A),獨立董事出列席情形如下:

職稱	姓名	實際出列席次數B	委託出席次數	實際列席率(%)(B/A)(註)	備註
獨立董事	游勝福	12	1	92%	
獨立董事	徐大麟	10	3	77%	
獨立董事	何美玥	12	1	92%	

註:實際列席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

其他應記載事項:

- 一、證交法第14條之5所列事項暨其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項,應敘明董事會日期、期別、議案内容、審計委員會決議結果以 及公司對審計委員會意見之處理:
 - (一) 證交法第14條之5所列事項。
 - (二) 除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項。

董事會日期期別	議案内容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
無	無	無	無

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案内容、應利益迴避原因以及參與表決情形:

董事會日期	議案内容	獨立董事姓名	應利益迴避原因	參與表決情形
105.04.01	為擬修訂本公司獨立董事之薪		因游勝福、徐大麟及何美玥三	
105年度第4次董事會議	資報酬。	徐大麟	位獨立董事就該案皆為有自身	獨立重事均迴避不參與討論及
		何美玥	利害關係之當事人。	表決該議案。

- 三、獨立董事與内部稽核主管及會計師之溝通情形(應包含就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)。
 - (一)每月月底前,本公司内部稽核部門會將當月份之稽核報告及缺失回應彙總報告e-mail子各獨立董事參閱,同時內部稽核主管會定期於每季與獨立董事溝通稽核報告結果,並每季於董事會中作內部稽核報告。此外,平時若有特殊狀況時,稽核主管亦會即時向獨立董事報告,惟民國105年度並無上述特殊狀況。截至目前為止本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況尚屬良好。
 - (二) 本公司簽證會計師均定期於每季向獨立董事報告當季財務報表查核或核閱結果,以及其他相關法令要求之溝通事項。此外,平時若有特殊狀況時,簽證會計師亦會即時向獨立董事報告,惟民國105年度並無上述特殊狀況。截至目前為止本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況尚屬良好。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因:

			運作情形	與上市上櫃公司治理
評估項目	是	否	摘要說明	實務守則差異情形及 原因
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則?	V		本公司於104年參酌「上市上櫃公司治理實務守則」訂定本公司之公司治理實務 守則,經董事會通過頒布並揭露於公司網站,請詳http://www.aseglobal.com。	與上市上櫃公司治理實 務守則無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定内部作業程序處 理股東建議、疑義、糾紛及訴 訟事宜,並依程序實施?	V		本公司設有法人關係、公共關係及法務等相關部門專人負責處理股務等相關事宜。	與上市上櫃公司治理實 務守則無重大差異。
(二)公司是否掌握實際控制公司之 主要股東及主要股東之最終控 制者名單?	V		本公司每月均經由董事及持股10%以上大股東之持股變動申報書,以確實掌握實際控制公司之主要股東名單,並與主要股東保持暢通管道密切聯繫,以掌握其最終控制者。	與上市上櫃公司治理實 務守則無重大差異。
(三)公司是否建立、執行與關係企 業間之風險控管及防火牆機 制?	V		本公司透過内部控制制度與相關辦法之制定執行控管,同時稽核單位亦定期監督 執行情形。	與上市上櫃公司治理實 務守則無重大差異。
(四)公司是否訂定内部規範・禁止公司内部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券?	V		本公司已訂定「防範內線交易之管理作業程序」,以避免公司内部人因未諳法規 規範誤觸内線交易,同時降低内部人無心之過或故意之誘因,達到促進證券交易 市場之公平性,進而維護投資大衆權益。	與上市上櫃公司治理實 務守則無重大差異。
三、董事會之組成及職責				
(一)董事會是否就成員組成擬訂多 元化方針及落實執行?	V		本公司於公司治理實務守則中訂定董事會成員組成多元化方針並據以執行。 本公司董事會由11位董事組成,包括3席獨立董事,其中1席獨立董事為女性。 董事所具備之專業知識技能涵蓋:工業工程、電子工程、機械工程、電腦工程、 物理學、財務學、經濟學、會計學、企管學及心理學等不同領域,已充分落實董 事會成員多元化方針。	與上市上櫃公司治理實 務守則無重大差異。
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會?	V		本公司業已依法設置審計委員會,由董事會指派符合1934年美國證交法規則 10A-3規定之沙賓法案及臺灣證券交易所上市規章定義,具備會計或相關財務管 理專長之獨立董事擔任本公司審計委員會之委員。 董事會依中華民國證券交易法設置薪資報酬委員會。根據中華民國證券法規,薪 資報酬委員會應至少包含一席符合中華民國證券法規定義之獨立董事。該委員會 目前有三位成員,其中包含兩席獨立董事。	與上市上櫃公司治理實 務守則無重大差異。
(三)公司是否訂定董事會績效評估 辦法及其評估方式,每年並定 期進行績效評估?	V		本公司於105年參酌「董事會自我評鑑或同儕評鑑參考範例」訂定本公司之董事會績效評估辦法,經董事會通過頒布並揭露於公司網站(網址同前),並定期於年度結束前,依據該辦法所訂定之評估程序進行當年度績效評估。本公司亦已將105年度董事會績效評估結果公開揭露於公司網站(同上)。	與上市上櫃公司治理實 務守則無重大差異。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師 獨立性 ?	V		本公司審計委員會每年定期取得會計師出具之獨立聲明書並評估簽證會計師之獨立性,再將評估結果提報董事會。 (一) 評估機制如下: (1) 本公司之簽證會計師與公司及董事均非關係人。 (2) 本公司依照美國沙賓法案規定,簽證會計師事務所於年度簽證及其他各案件委任前,均需取得審計委員會的事先核准。 (3) 本公司依照美國沙賓法案規定,簽證會計師每季向審計委員會彙報執行覆核/查核內容及獨立性等遵守情形。 (4) 本公司遵守公司治理實務守則規定辦理簽證會計師之輪替。 (二) 評估結果如下: (1) 簽證會計師與本公司問之獨立性符合美國SEC、PCAOB、中華民國會計師法及會計師職業道德規範等相關規定。 (2) 本公司未連續五年委任同一會計師簽證。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
四、上市上櫃公司是否設置公司治理專 (兼)職單位或人員負責公司治理相 關事務(包括但不限於提供董事、監 察人執行業務所需資料、依法辦理 董事會及股東會之會議相關事宜、 辦理公司登記及變更登記、製作董 事會及股東會議事錄等)?	V		本公司設置「公司治理團隊」,其隸屬於集團永續發展委員會,並偕同集團財務、會計、稽核、法務、財務長室等相關單位負責公司治理相關事務之處理與執行。	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並安適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	V		本公司責成相關單位專責處理股東、客戶及供應商等利害關係人之溝通事宜,亦設有企業工會及總經理信箱,以暢通員工意見溝通管道。本公司於公司網站(網址同前)設有利害關係人專區,提供利害關係人表達意見的管道,有利本公司瞭解利害關係人所關切之議題與做適度回應,並透過年度企業社會責任報告書及公司網站公開揭露相關利害關係人溝通資訊。	與上市上櫃公司治理實 務守則無重大差異。

			運作情形	與上市上櫃公司治理
評估項目	是	否	摘要說明	實務守則差異情形及 原因
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦 理股東會事務?	V		本公司委任統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。	與上市上櫃公司治理實 務守則無重大差異。
七、資訊公開				
(一) 公司是否架設網站,揭露財務 業務及公司治理資訊?	V		本公司已架設網站(網址同前),並責成相關部門負責公司財務業務及公司治理資訊之揭露與更新。	與上市上櫃公司治理實 務守則無重大差異。
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之	V		本公司已架設中英文網站,設有專責人員負責公司資訊蒐集及揭露,亦依規定設	與上市上櫃公司治理實
方式(如架設英文網站、指定			有發言人及代理發言人制度,以及專責聯絡窗口回覆股東之意見。相關資訊請詳	務守則無重大差異。
專人負責公司資訊之蒐集及揭			公司網站(同前)。	
露、落實發言人制度、法人說			本公司指定專人負責公開資訊觀測站之申報,包含各項定期及不定期財務、業務	
明會過程放置公司網站等)?			資訊並依相關規定發布重大訊息。 	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治	V		(一) 員工權益及僱員關懷:請參閱本年報「勞資關係」說明以及參考本公司企業	與上市上櫃公司治理實
理運作情形之重要資訊(包括但不限			社會責任報告書。	務守則無重大差異。
於員工權益、僱員關懷、投資者關			(二) 投資者關係、供應商關係及利害關係人之權利:請參考本公司網站(同前)之	
係、供應商關係、利害關係人之權			投資人關係以及利害關係人專區。	
利、董事及監察人進修之情形、風			(三)董事及經理人進修之情形:本公司105年董事及經理人進修情形如下附表1及	
險管理政策及風險衡量標準之執行			附表2。	
情形、客戶政策之執行情形、公司			(四) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:請參閱本年報「風險事項分析評	
為董事及監察人購買責任保險之情			估」說明及參考本公司企業社會責任報告書。	
形等) ?			(五) 客戶政策之執行情形:請參閱本年報「市場及產銷槪況」說明。	
			(六)公司為董事購買責任保險之情形:本公司已為董事購買責任保險(105年保險	
			金額約為新台幣12億9仟萬元)。	
			(七) 本公司會與供應商簽訂供應商保密條款/供應與承攬商社會責任承諾書,採購	
			合約中明定具法律效力的權利與義務,且明定供應商遴選制度,確保供應商	
			能符合本公司的品質政策、環境政策,並訂定供應商稽核制度以確保執行。	
			本公司體認與社會上利害關係各方進行長期對話之必要性。此方式能增進企	
			業對社會的瞭解,做出最佳決策,亦能減少企業與社會之衝突。	

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司 者無須填列)

本公司股東常會於105年6月修訂並通過公司章程,規定董事選舉全面採行提名制度。本公司董事會亦於105年12月通過董事會績效評估辦法,並依據該辦法所訂定 之評估程序進行105年度董事會績效評估。本公司亦已將105年度董事會績效評估結果公開揭露於公司網站(請詳http://www.aseglobal.com)。未來本公司將優先加 強提升董事會及薪資報酬委員會之出席率,以落實公司治理之精神。

附表1:最近年度及截至年報刊印日止之董事進修情形

	姓名	進修	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
400代刊	姓台	起	迄	土班丰山	珠性有性 	進修吋数	進修定首付口稅化
董事	張洪本	105/07/13	105/07/13	社團法人中華公司治理協會	2016綠色經濟與企業低碳創新的全球趨勢 與商機	3	是
(兼經理人)	邓小个	105/10/13	105/10/13	財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會	2017年經濟暨產業趨勢	3	是
董事	張能傑	105/07/13	105/07/13	社團法人中華公司治理協會	2016綠色經濟與企業低碳創新的全球趨勢 與商機	3	是
		105/12/06	105/12/06	社團法人中華公司治理協會	建置内控生態管理系統,以強化集團治理	3	是
法人董事代表人	張虔生	105/07/13	105/07/13	社團法人中華公司治理協會	2016綠色經濟與企業低碳創新的全球趨勢 與商機	3	是
(兼經理人)	派凌土	105/10/13	105/10/13	財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會	2017年經濟暨產業趨勢	3	是
法人董事代表人	吳田玉	105/07/13	105/07/13	社團法人中華公司治理協會	2016綠色經濟與企業低碳創新的全球趨勢 與商機	3	是
(兼經理人)	天田玉	105/10/13	105/10/13	財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會	2017年經濟暨產業趨勢	3	是
法人董事代表人	董宏思	105/07/13	105/07/13	社團法人中華公司治理協會	2016綠色經濟與企業低碳創新的全球趨勢 與商機	3	是
(兼經理人)	里么心	105/09/22	105/09/22	台灣董事學會	企業風險管理及台灣家族企業傳承現況與 挑戰	3	是
法人董事代表人	羅瑞榮	105/07/13	105/07/13	社團法人中華公司治理協會	2016綠色經濟與企業低碳創新的全球趨勢 與商機	3	是
(兼經理人)	北田川木	105/10/13	105/10/13	財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會	2017年經濟暨產業趨勢	3	是
法人董事代表人 (兼經理人)	陳昌益	105/07/13	105/07/13	社團法人中華公司治理協會	2016綠色經濟與企業低碳創新的全球趨勢 與商機	3	是
(兼程珪八)		105/12/06	105/12/06	社團法人中華公司治理協會	建置内控生態管理系統,以強化集團治理	3	是

 職稱	姓名	進修	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
邦 政作 月	姓台	起	迄	土班早山	床性 有 性	進修吋数	進修定首付口稅化
法人董事代表人	陳天賜	105/07/13	105/07/13	社團法人中華公司治理協會	2016綠色經濟與企業低碳創新的全球趨勢 與商機	3	是
(兼經理人)	州人物	105/10/13	105/10/13	財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會	2017年經濟暨產業趨勢	3	是
		105/07/13	105/07/13	社團法人中華公司治理協會	2016緑色經濟與企業低碳創新的全球趨勢 與商機	3	是
獨立董事	游勝福	游勝福 105/08/10	105/08/10	財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會	如何做好舞弊偵防及營業秘密保護,強化 公司治理	3	是
		105/10/13	105/10/13	財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會	2017年經濟暨產業趨勢	3	是
獨立董事	徐大麟	105/07/13	105/07/13	社團法人中華公司治理協會	2016綠色經濟與企業低碳創新的全球趨勢 與商機	3	是
烟山里爭	1小人配料	105/10/19	105/10/19	財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會	公司治理與證券法規	3	是
獨立董事	何美玥	105/07/20	105/07/20	財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會	企業併購之董監法律責任	3	是
烟	刊夫功	105/08/02	105/08/02	財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會	企業財務資訊之解析及決策運用	3	是

附表2:最近年度及截至年報刊印日止之經理人進修情形

T####	姓名	進修	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定	
40以作	職稱 姓名		迄	土辧早位	林性 白 円	進修吋数	進修定首付口稅化	
副總經理暨會計長	可物処理既命計長 前立物	耶宏銘 105/08/04	105/08/05	財團法人中華民國會計研究	發行人證券商證券交易所會計主管持續進	12	是	
則秘程建宣言可及	乳不可	103/06/04	103/06/03	發展基金會	修班	12	Æ	

(四) 薪資報酬委員會其組成、職責及運作情形:

本公司為落實公司治理,並健全公司董事及經理人薪資報酬制度,於民國100年9月29日爰依證券交易法第十四條之六及股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法設立薪資報酬委員會,本委員會成員人數為三人,由董事會決議委任之,其中至少一人為本公司獨立董事(本公司有兩位獨董擔任),並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席,對外代表本委員會。本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權:

- · 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- · 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

本屆薪資報酬委員會成員資料:

	條件	是召	5具有五年以上工作。 及下列專業資格		符合獨立性情形(註)							兼任其		
身分別	姓名		法律師與 東部 中 中 中 中 中 中 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門		1	2	3	4	5	6	7	8	他發司報員員 公行薪酬會家 數數	備註
獨立董事	游勝福	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	_	
獨立董事	徐大麟			V	V	V	V	V	V	V	V	V	_	
其他	谷小瑛			V	V	V	V	V	V	V	V	V	_	

- 註:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,於各條件代號下方空格中打勾。
 - (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
 - (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限。
 - (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
 - (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以内親屬或三親等以内直系血親。
 - (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
 - (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
 - (7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
 - (8) 未有公司法第30條各款情事之一。

委員會成員參與薪資報酬委員會運作情形資訊

本屆委員會任期:104年06月24日至107年06月23日,截至106年02月28日,已開會4次(A),委員出席情形如下:

職稱	身分別	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)	備註
召集人	獨立董事	游勝福	4	0	100%	_
委員	獨立董事	徐大麟	1	3	25%	
委員	其他	谷小瑛	4	0	100%	

(五)履行社會責任情形:(如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形。)

			運作情形	與上市上櫃公司
評估項目	是	否	摘要說明	企業社會責任實 務守則差異情形 及原因
一、落實公司治理				
(一)公司是否訂定企業社會責任政策或制度,以及檢討實施成效?	V		本公司訂有「日月光集團企業永續發展與企業公民政策」及「企業社會責任實務守則」,揭露於公司網站企業社會責任專區及企業社會責任報告書,並將依據政策而開展之企業社會責任推動計畫與實施成效,詳實揭露於此表中「二、發展永續環境」、「三、維護社會公益」及「六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊」,由董事會定期督促公司實踐社會責任及檢討實施成效。 詳細之本公司企業社會責任政策、制度或管理方針及具體推動計畫與實施成效之資訊,均揭露於日月光集團企業社會責任報告書,講詳http://www.aseglobal.com(公司網站)。	與上市上櫃公司企 業社會責任實務守 則無重大差異。
(二)公司是否定期舉辦社會責任教 育訓練?	V		本公司每年度制定相關社會責任訓練計畫,依計畫針對新進員工及在職人員定期提供社會責任相關教育訓練,協助員工了解企業社會責任之精神與做法。	與上市上櫃公司企 業社會責任實務守 則無重大差異。
(三)公司是否設置推動企業社會責任事(兼)職單位,並由董事會授權高階管理階層處理,及向董事會報告處理情形?	V		本公司成立由五位高階管理階層組成的「集團永續發展委員會」,負責指引及督導日月光集團在全球經濟、環境及社會策略上的發展,定期向董事會報告,並設置「集團企業永續中心」作為負責推動企業社會責任之專職單位,負責評估全集團的永續議題與永續績效、協調及促動集團目標之擬訂以及推動永續發展行動計畫之執行,並直接向該委員會報告。主要永續發展推動計畫分為六大主軸,分別為公司治理、環境永續、人力資本、供應鏈發展、企業公民與社會參與及利害關係人議合與資訊揭露,具體執行情形及實施成效如此表中「二、發展永續環境」、「三、維護社會公益」以及「六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊」所述。本公司之企業社會責任報告書係揭露本公司企業社會責任專職單位推動社會責任之執行績效,亦說明該專職單位之治理架構及執行運作情形。詳細之本公司企業社會責任專職單位之運作及執行資訊,請詳公司網站。	與上市上櫃公司企 業社會責任實務守 則無重大差異。
(四)公司是否訂定合理薪資報酬政策,並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合,及設立明確有效之獎勵與懲戒制度?	V		本公司定期依據當地法令與市場狀況調整薪資結構與福利,薪資絕不因性別、種族、國籍或年齡等因素而有差別待遇。 本公司依循性別平等法,對員工之任用、考績或升遷等,不會因性別而有差別待遇。 為維持員工高標準的工作紀律,本公司制定了員工管理須知,設立明確之獎勵與懲處辦法,作 為公司員工應遵循的最高道德標準及承諾。	與上市上櫃公司企 業社會責任實務守 則無重大差異。
、發展永續環境				
(一) 公司是否致力於提升各項資源 之利用效率,並使用對環境負 荷衝擊低之再生物料?	V		本公司規劃了電力、水資源與耗用材料的管理機制,並持續進行供應設施效率提升或模組最佳化的改善,以遵守「日月光集團企業永續發展與企業公民政策」以及「企業社會責任實務守則」及達到減少資源消耗的目標,包含:空調節能、照明節能、製程節能…等作為。本公司之包裝材料均為可回收之材料且符合歐盟包裝材料之規範,並透過內部的管理程序將廢棄物分類及資源回收,減少自然資源的浪費,降低對環境之衝擊。本公司依據「日月光集團企業永續發展與企業公民政策」以及「企業社會責任實務守則」建立管理系統,有計劃地執行各項能資源使用管理,對於能源、水資源進行最佳化利用與持續改善。	與上市上櫃公司企 業社會責任實務守 則無重大差異。
(二) 公司是否依其產業特性建立合 適之環境管理制度?	V		本公司於環境保護業務上的執行,除了符合法令及相關規範的規定外,同時並建立ISO14001環境管理系統。除定期查核符合法令要求外,每年訂定污染防治與設備改善推動計劃,以有效降低污染排放並適時檢討環境管理制度。	
(三)公司是否注意氣候變遷對營運 活動之影響,並執行溫室氣體 盤查、制定公司節能減碳及溫 室氣體減量策略?	V		本公司注意氣候變遷對營運活動之影響,推行ISO 14064溫室氣體管理系統,每年進行溫室氣體盤查,並訂定溫室氣體減量目標,進行溫室氣體排放減量。本公司亦已通過ISO 50001認證,為回應客戶及全球消費大衆對低碳產品的期待,導入產品碳足跡盤查,以減少產品碳足跡為目標。	業社會責任實務守
三、維護社會公益 (一)公司是否依照相關法規及國際	V		本公司已訂定「日月光集團企業永續發展與企業公民政策」、「商業行為與道德準則」及「企	
人權公約,制定相關之管理政 策與程序?			業社會責任實務守則」,承諾尊重基本勞動人權、遵守政府勞動法規、保障員工工作環境、健康安全等相關權益。為更進一步保護與促進人權,支持並尊重「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」第一與第二條原則、「聯合國企業與人權指導原則」、國際勞工組織「工作基本原則與權利宣言」與當地法令規範,本公司制定「日月光集團人權政策」以及人權保障管理原則來保護員工,並期許我們的供應商亦恪遵此原則以維護人權。	

			運作情形	與上市上櫃公司
評估項目	是	否	摘要說明	企業社會責任實 務守則差異情形 及原因
(二) 公司是否建置員工申訴機制及	V		本公司重視和諧的勞資關係,並訂定溝通與申訴管理政策,提供員工暢通、多元化的溝通管	與上市上櫃公司企
管道,並妥適處理?			道,包括勞資會議,總經理信箱、員工意見箱、座談會、信函投書、公佈欄、内部公告、教育	業社會責任實務守
			訓練、電子佈告欄、員工諮商專人及電子郵件等,傾聽員工的心聲和建議,並給予必要的回覆 及處理。	則無重大差異。
(三) 公司是否提供員工安全與健康	V		為提供員工符合安衛法規且健康的最佳作業場所,本公司導入OHSAS 18001與TOSHMS 職業	與上市上櫃公司企
之工作環境,並對員工定期實			安全衛生管理系統,定期進行風險鑑別及評估,採取適當的改善措施,降低工作環境的風險,	業社會責任實務守
施安全與健康教育?			並舉辦員工工作安全衛生教育訓練與健康促進活動。本公司亦設有員工診所,提供員工及眷屬 就診服務,並定期安排所有員工進行所需之健康檢查。其他工作環境與人身安全具體保護措施 請參閱本年報「勞資關係」說明。	則無重大差異。
(四) 公司是否建立員工定期溝通之	V		本公司依據新進人員、在職員工、部門別及勞工代表等類別,分別定期舉辦座談會或相關會	與上市上櫃公司企
機制,並以合理方式通知對員			議,透過定期的溝通交流,提供員工暢通的溝通管道。若任何工作有重大異動(如營運據點調動	業社會責任實務守
工可能造成重大影響之營運變 動?			等),皆事先與員工溝通並至少於兩週前通知,且無任何強迫勞動情況發生。	則無重大差異。
(五) 公司是否為員工建立有效之職	V		本公司依照各職務訓練需求及職涯能力發展需求進行年度訓練課程規劃,並依規畫進行課程舉	與上市上櫃公司企
涯能力發展培訓計畫?			辦:包括新人訓練、通識教育、專業培訓、基層管理、中階管理及人才發展等。	業社會責任實務守 則無重大差異。
(六) 公司是否就研發、採購、生	V		本公司為確保客戶的意見能有效的傳達與處理,以及促進與客戶的即時互動,制定設立客戶溝	與上市上櫃公司企
產、作業及服務流程等制定相			通的管理程序,設有客戶服務專業專責團隊,定期檢視客戶的滿意度,提供相關客戶的意見反	業社會責任實務守
關保護消費者權益政策及申訴程序?			應與溝通服務,並以網際網路為基礎,建置客戶線上服務平台,整合客戶簡易的服務網路,提供高效率服務。	則無重大差異。
(七) 對產品與服務之行銷及標示,	V		本公司遵循台灣貿易法相關條文包括輸出入戰略性高科技貨品之規定,對於服務之行銷及標	與上市上櫃公司企
公司是否遵循相關法規及國際 準則?			示,均依照客戶需求與法規運作。	業社會責任實務守 則無重大差異。
(八) 公司與供應商來往前,是否評	V		本公司於新供應商導入前的遴選機制中即針對供應商是否有影響環境與社會之紀錄進行評估與	與上市上櫃公司企
估供應商過去有無影響環境與			審查,爾後每年定期進行供應商「永續發展問卷」調查,並透過現場或文件稽核確保供應商符	業社會責任實務守
社會之記錄?			合本公司的要求。	則無重大差異。
(九) 公司與其主要供應商之契約是	V		本公司對主要供應商的合約中訂定供應商須遵守當地法規及符合本公司社會責任暨行為準則,	與上市上櫃公司企
否包含供應商如涉及違反其企			若察覺有違反環境與社會之具體事證,將立即展開調查處置,如情節重大即終止合作。	業社會責任實務守
業社會責任政策,且對環境與				則無重大差異。
社會有顯著影響時,得隨時終				
止或解除契約之條款?				
四、加強資訊揭露				
(一) 公司是否於其網站及公開資訊	V		本公司為讓社會大衆瞭解本公司在因應永續發展趨勢的思維與承諾,以及本公司在各項永續	與上市上櫃公司企
觀測站等處揭露具攸關性及			的相關議題上的努力與堅持,每年均定期公開發行企業社會責任報告書(中、英文版本),提供	業社會責任實務守
可靠性之企業社會責任相關資			PDF檔刊載於本公司網站,並同時揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊於公開資訊	則無重大差異。
訊 ?			觀測站。 守則 訂有木身之企業社會責任守則者,請敘明甘渾作與所訂守則之差異情形:	

五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形: 本公司已於104年參酌「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂定本公司企業社會責任實務守則,經本公司董事會通過頒布並揭露於公司網站,實際運作與守則 規定並無重大差異。

六、 其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊:

- ・ 其他企業社會責任運作情形之資訊,請詳閱本公司企業社會責任報告書(http://www.aseglobal.com)。
- 本公司長期致力於回饋社會,透過「日月之光慈善事業基金會」與「日月光文教基金會」,投入社區及參與各項社會公益活動。我們的員工慷慨地奉獻出時間、善款及專業技能,協助解決急難救助、學童教育等問題,是我們履行社會參與承諾的最大支柱。我們期望與廠區週邊的鄰居及社會大衆,藉由長期的合作及溝通,產生信任、互助及融洽的關係,創造積極正面並對社會有益的商業環境。
- 積極投入環保公益活動:本公司於102年12月20日已承諾並履行持續30年每年至少投入新台幣一億元,以長期規劃及多面向推動的角度,持續穩定地投入台灣環保相關工作。目前,已透過「日月光文教基金會」規劃並執行諸多環保公益活動,其中重要的規劃與執行項目如下:
 - 1. 推動環境教育(綠色教室建構暨環保理念宣導計畫/環境教育影音旗艦計畫/南區環境教育方案/環境技術之學術研究計畫/環保學術碩、博士論文獎助/登革熱防疫宣導短片/微笑台灣創意教學教案徵選競賽)。
 - 2. 提升環境品質(環願山林造林方案/楠梓加工區景觀綠圍籬/全球港灣城市論壇)。
 - 3. 降低環境衝擊(校園LED方案/楠梓加工區資源再生利用模型廠操作維護/綠色供應鏈推動方案/食蛇龜復育與保育推廣)。
 - 4. 推廣環保藝文(日月光美育生根計畫/鮭魚大王環保公益兒童劇等)。
- · 愛心參與慈善關懷活動:105年仍持續集結日月光集團員工們的愛心,投入超過新台幣1,500萬元,透過「日月之光慈善事業基金會」,關懷弱勢家庭兒童,並 擴大對社區的關懷,提供急難救助的服務,其中參與地區性公益主要活動如下:
 - 1. 弱勢家庭兒少照顧中心(學童課後安親照顧/課業輔導/品格教育/家庭訪視輔導/親職教育講座等服務)。
 - 2. 清寒學子補助(提供補助營養午餐/助學獎勵金於高雄廠與中壢廠鄰近國小、國中及高中生)。
 - 3. 急難救助金(對於高雄廠與中壢廠服務區域遭遇特殊急難或意外事故,致生活造成困境者提供救助金)。
 - 4. 贊助公益單位救助金(105年共贊助17個公益機構,包括弱勢醫療基金捐助及協辦公益活動)。
- · 促進產學合作專案:主要計劃有建教合作與企業實習、學術研究合作及獎助學金贊助,透過與諸多大學(東南科大/中原/中山/中興/成大/高師大/高雄大學/高雄第一科大/高應用科大/海科大/高苑科大等校)合作,不僅增加公司招募管道,亦促進在地學生就業機會、活絡公司與學校合作關係、精進學術研究與產業實務技術的提升。專案成果豐碩,日月光將會持續進行產學合作專案,達到三贏局面。
- ・本公司中壢廠設立員工托育中心,聘請優良的師資,關心及照顧員工孩童托育問題,並能即時掌握孩童在校狀況,作為員工工作的後盾。

七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準,應加以敘明:

本公司於2010年至2014年,每年均發行企業社會責任報告書,其內容係以全球永續性報告協會(GRI)指導綱領及AA1000 APS當責性原則標準撰寫,並自願取得第三方(BSI)查證聲明書,符合G3.1 A+ 應用等級(application level)。本公司於2015及2016年發行的企業社會責任報告書,其內容是依循GRI G4 永續性報告指南的核心選項進行編纂,並且自願取得勤業衆信聯合會計師事務所(Deloitte)確信聲明,其分別依據國際審計與認證準則 ISAE 3000以及財團法人中華民國會計研究發展基金會頒布之確信準則公報第一號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」,進行獨立有限確信(limited assurance)。

(六) 公司履行誠信經營情形及採行措施:

落實誠信經營情形

			運作情形	與上市上櫃公司
評估項目	是	否	摘要說明	誠信經營守則差 異情形及原因
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一)公司是否於規章及對外文件中 明示誠信經營之政策、作法・ 以及董事會與管理階層積極落 實經營政策之承諾?	V		本公司董事會已通過頒布誠信經營相關規章,包括「商業行為與道德準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等政策規範,並於年報、公司網站及企業社會責任報告書中詳細說明本公司誠信經營之政策、作法,以及董事會與管理階層積極落實經營政策之情形,請詳公司網站(http://www.aseglobal.com)。	與上市上櫃公司誠 信經營守則無重大 差異。
(二)公司是否訂定防範不誠信行為 方案,並於各方案內明定作業 程序、行為指南、違規之懲戒 及申訴制度,且落實執行?	V		本公司除訂定「商業行為與道德準則」、「誠信經營守則」及「公平競爭鳘反托拉斯法遵循政策」等政策外,亦訂有「誠信經營作業程序及行為指南」及「反貪腐防範辦法」等規範,明訂其作業程序、行為指南及申訴制度以防範不誠信行為,而在工作紀律倫理中亦訂定道德規範及違規之懲戒辦法,督促所有員工確實遵守。	與上市上櫃公司誠 信經營守則無重大 差異。
(三) 公司是否對「上市上櫃公司誠 信經營守則」第七條第二項各 款或其他營業範圍內具較高不 誠信行為風險之營業活動,採 行防範措施?	V		本公司於誠信經營守則明定嚴格禁止董事、經理人及受僱人等進行下列行為,並透過內部稽核程序查核及監控,藉以建立誠信之營業行為: 一、行賄及收賄。 二、提供非法政治獻金。 三、不當慈善捐贈或贊助。 四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。 五、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。 六、從事不公平競爭之行為。	與上市上櫃公司誠 信經營守則無重大 差異。
(一)公司是否評估往來對象之誠信 記錄,並於其與往來交易對象 簽訂之契約中明訂誠信行為條 款?	V		本公司於商業往來前,會先對商業往來對象進行徵信,排除有不誠信行為記錄之對象,並於商業契約中明訂誠信行為條款。	與上市上櫃公司誠 信經營守則無重大 差異。
(二)公司是否設置隸屬董事會之 推動企業誠信經營專(兼)職單 位,並定期向董事會報告其執 行情形?	V		本公司之「集團永續發展委員會」為商業行為與道德的最高管理組織,負責統籌集團誠信經營政策規範之制定、監督與執行,每年定期檢視其推動與遵循狀況,並向董事會報告。有關本公司誠信經營專職單位之運作及執行資訊,請詳http://www.aseglobal.com。	與上市上櫃公司誠 信經營守則無重大 差異。
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道,並落實執行?	V		本公司於「商業行為與道德準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」明定防止利益衝突政策,並依相關規範設置適當之陳述及諮詢管道。 此外,本公司董事秉持高度自律,對董事會議案與其自身有利害關係,致有害於公司利益之虞者,討論及表決時應予迴避,董事間亦不得不當相互支援。	與上市上櫃公司誠 信經營守則無重大 差異。
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度,並由內部稽核單位定期查核,或委託會計師執行查核?	V		本公司設有健全之會計制度及內部控制制度,不允許有外帳或保留秘密帳戶,為確保該制度之設計及執行持續有效,內部稽核人員不定期查核前項制度遵循情形。	與上市上櫃公司誠 信經營守則無重大 差異。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之 内、外部之教育訓練?	V		本公司每年舉辦對高階管理階層之誠信相關教育訓練以及對供應商之誠信商業行為進行宣導, 亦規劃商業行為與道德相關政策與規範之線上課程對員工展開教育訓練。	與上市上櫃公司誠 信經營守則無重大 差異。
三、公司檢舉制度之運作情形。				
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利檢舉管道, 及針對被檢舉對象指派適當之 受理專責人員?	V		本公司已設置檢舉管道(包括總經理信箱、商業行為與道德遵循舉報系統/信箱及違反會計、內控或審計事項舉報信箱等),並於誠信經營作業程序及行為指南中訂定具體檢舉制度。關於本公司檢舉管道與制度相關資訊,請詳公司網站。	與上市上櫃公司誠 信經營守則無重大 差異。
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之 調查標準作業程序及相關保密 機制?	V		本公司接獲檢舉後,將依誠信經營作業程序及行為指南第二十一條之處理程序調查及處分。	與上市上櫃公司誠 信經營守則無重大 差異。

			運作情形	與上市上櫃公司
評估項目	是	否	摘要說明	誠信經營守則差 異情形及原因
(三)公司是否採取保護檢舉人不因 檢舉而遭受不當處置之措施?	V		本公司誠信經營作業程序及行為指南第二十一條明定,公司處理檢舉情事之相關人員應對於檢舉人身分及檢舉内容予以保密,本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	與上市上櫃公司誠 信經營守則無重大 差異。
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊 觀測站,揭露其所訂誠信經營 守則内容及推動成效?	V		本公司已將誠信經營相關政策與規範公開揭露於公司網站,並於年報、公司網站及企業社會責任報告書中詳細說明本公司誠信經營之運作情形與推動成效,請詳公司網站。	與上市上櫃公司誠 信經營守則無重大 差異。

五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形: 本公司於104年參酌「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本公司誠信經營守則,經董事會通過頒布並揭露於公司網站,實際運作與守則規定並無重大差異。

- (七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者,應揭露其查詢方式:本公司訂有「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」等之相關規章,揭露於公司網站。
- (八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊:

永續發展是我們一貫堅持的理念,日月光集團高雄廠承諾做好綠色產品設計製造與本質安全流程規劃,致力降低營運中可能產生的環境衝擊、人員危害與經營風險,並提供員工一個安全舒適的工作環境。

我們的承諾:

- 1. 恪遵永續發展相關之法令規章、客戶標準與相關要求,並尊重國際條例及其解釋。
- 2. 在經營管理範疇,秉持著永續發展的理念及積極、互信、誠正、自省原則,創造長期且穩定的經濟價值。營運過程將保持彈性,以利害相關者權益為優先考量,並就交易洽談、合作締結和履約過程中所接收或交換之具機密性之資訊嚴守保密義務,禁止舞弊、貪腐、賄賂等行為,遵守廉潔陽光條款,有效貫徹誠信準則,並促進產業供應鏈的持續發展。
- 3. 在安防管理範疇,關鍵營運活動與所面臨的風險中,建立整體意識及資訊安全之各項行動原則,並盡到營運與法律要求及契約的安全義務,確保企業資訊的機密性、完整性及可用性。
- 4. 在綠色環保範疇,導入綠色設計、材料與製程,並營造在地多樣性的生態空間,建構低耗能、省資源、零污染的綠色環境與供應鏈,進而有效控制與降低產品對環境的衝擊。
- 5. 在職業安全衛生範疇,使員工從事合理可行之工作,提供安全健康的工作場所並採取必要之預防設備或措施,以防止事故傷害與職業疾病的發生,保障員工身心之安全健康。
- 6. 在勞工人權範疇,重視員工人權,提供多元化的員工溝通管道,使員工受到公平及合理對待。
- 7. 在社會責任範疇,秉持社會公平正義與良善道德的原則,有效整合與運用社會資源,主動關懷與協助員工及社區。
- 8. 妥善規劃教育訓練資源,建構分享平台與暢通溝通管道,傳達並凝聚利害相關者對永續發展的共識。
- 9. 持續改善永續發展管理機制以成就管理績效與永續供應鏈,確信所有經營風險均可透過完善管理系統運作達到控制, 進而保障利害關係人的權益,與利害相關者共創永續榮景。
- 10. 日月光集團於2010至2016年每年均發行企業社會責任報告書,對外揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關有效資訊,而2015及2016年報告書係依循GRI G4核心選項,並通過外部第三方(Deloitte)確信聲明。
- 11. 揭露溫室氣體排放及減量資訊:本公司編製公開揭露溫室氣體排放及減量資訊於日月光集團企業社會責任報告書中, 請詳本公司網站。

六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、檢討修正公司訂定之誠信經營 守則等情形):本公司參酌本公司商業行為與道德準則及電子行業公民聯盟之行為準則訂定「日月光集團供應商行為準則」,要求供應商於勞工、健康與安全、環境、商業道德及管理體系等各方面之商業行為確實符合本準則,並且完全遵守經營所在國家/地區的法律和法規,以確保供應鏈具備安全的工作環境,其員工受到尊重並享有尊嚴,且其營運對環境負責並符合商業道德。

(九)内部控制制度執行狀況

1. 内部控制聲明書



日期:一〇六年三月十三日

本公司民國一〇五年度之内部控制制度,依據自行評估的結果,謹聲明如下:

- 一、本公司確知建立、實施和維護内部控制制度係本公司董事會及經理人之責任,本公司業已建立此一制度。其目的係在 對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令 規章之遵循等目標的達成,提供合理的確保。
- 二、内部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之内部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保:而且,由於環境、情況之改變,内部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之内部控制制度設有自我監督之機制,缺失一經辨認,本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立内部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之内部控制制度有效性之判 斷項目,判斷内部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之内部控制制度判斷項目,係為依管理控 制之過程,將內部控制制度劃分為五個組成要素:1.控制環境,2風險評估,3.控制作業,4.資訊及溝通,及5.監督作 業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述内部控制制度判斷項目,評估内部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果,認為本公司於民國一〇五年十二月三十一日的内部控制制度(含對子公司之監督與管理), 包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效,其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事,將 涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一〇六年三月十三日董事會通過,出席董事十人中,有〇人持反對意見,餘均同意本聲明書 之内容,併此聲明。

日月光半導體製造股份有限公司

董事長: 張虔生



總經理: 張洪本



2. 委託會計師專案審查內部控制制度者,應揭露會計師審查報告:無。

- (十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其内部人員依法被處罰、公司對其内部人員違反内部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形:無。
- (十一) 最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議:

股東會之重要決議

召開日期	重要決議	執行情形
105.06.28 召開105年股東常會	1. 通過修訂本公司「公司章程」案。	1. 於105年7月20日經由經濟部加工出口區管理處准予登記並公告於公司網站。
	2. 通過承認本公司一〇四年度決算表冊案。	2. 不適用。
	3. 通過承認本公司一〇四年度盈餘分派案。	3. 訂定105年8月21日為除息基準日,105年9月9日為現金股利(新台幣12,476,779,033元)發放日。
	4. 通過提請股東會授權董事會以擇一或搭配之方式分次或同時辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、國內現金增資發行普通股、海外私募轉換公司債案。	4. 已依通過後之內容辦理相關程序。
	5. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。	5. 已依修訂後之辦法執行相關作業並公告於公司網站。

董事會之重要決議

開會日期	重要決議
105.01.14	1. 決議通過修訂本公司董事其薪資報酬政策中有關董事酬勞之提撥基礎及提撥比率案。
	2. 決議通過修訂本公司「公司章程」案。
	3. 決議通過本公司擬提撥新台幣1億元交由財團法人日月光文教基金會執行環保公益之捐贈作業案。
105.03.16	1. 決議通過本公司完成財務報告編製能力之評估結果。
	2. 決議通過本公司民國104年度合併財務報告暨個體財務報告。
	3. 決議通過出具本公司民國104年度内部控制制度聲明書。
105.03.24	1. 決議通過本公司擬購買矽品精密工業股份有限公司普通股及美國存託憑證案。
	2. 決議通過本公司擬以法令允許之任何途徑及方式,取得矽品精密工業股份有限公司三分之一以上,至多百分之百之有表決權股份,向台灣
	平交易委員會及其他國家或地區之相關主管機關申請本公司與矽品精密工業股份有限公司之結合案。
105.04.01	1. 決議通過修訂本公司之「員工紅利發放辦法」,並變更其名稱為「員工酬勞發放辦法」。
	2. 決議通過本公司民國104年度營業報告書。
	3. 決議通過承認本公司截至民國104年12月31日止之背書保證總額及資金貸與他人金額。
	4. 決議通過本公司民國104年股東常會通過授權董事會辦理之海外私募轉換公司債,於剩餘期間内擬不繼續辦理。
	5. 決議通過本公司民國104年度之員工酬勞分派金額。
	6. 決議通過本公司民國104年度之董監事酬勞分派金額。
	7. 決議通過本公司民國104年度盈餘分派議案。
	8. 決議通過本公司以擇一或搭配之方式分次或同時辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、國内現金增資發行普通股、海外私募較 公司債案。
	9. 決議通過修訂本公司獨立董事之薪資報酬案。
	10. 決議通過修訂本公司「公司章程」案。
	11. 決議通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
	12. 決議通過本公司民國105年股東常會召開之日期、地點及議程。
	13. 決議通過本公司繼續購買的品精密工業股份有限公司普通股及美國存託憑證案。
105.04.28	1. 決議通過本公司擬取得DECA TECHNOLOGIES INC.(下稱「DECA公司」)關於扇出型晶圓級封裝(Fan-Out WLP)製程之技術與專利之授權
	投資該公司股權案。
	2. 決議通過中壢分公司擬向子公司台灣福雷購入營業用資產乙批案。
105.05.13	1. 決議通過修訂本公司「内部控制制度」及「内部控制制度-其他控制作業管理辦法」案。
	2. 決議通過修訂本公司「内部稽核實施細則」案。
105.05.26	決議通過本公司與矽品精密工業股份有限公司簽訂「共同轉換股份備忘錄」案。
105.06.30	決議通過本公司與矽品精密工業股份有限公司簽訂「共同轉換股份協議」案。
105.07.13	決議通過訂定本公司發放現金股利之除息基準日案。
105.08.11	1. 決議通過本公司105年度第2季合併財務報告。
	2. 決議通過本公司擬出售機器設備乙批予子公司台灣福雷。
105.09.02	1. 決議通過本公司為配合高雄廠區整體空間規劃,並解決集團研發中心實驗單位分散之問題,擬向李長榮化學工業股份有限公司購入研發之
	案。
	2. 決議通過訂定本公司104年度之經理人員工酬勞分配明細案。
	3. 決議通過訂定本公司104年度之董事酬勞分配明細案。

開會日期	重要決議
105.12.08	1. 決議通過本公司擬採公開申購配售方式辦理國内現金增資發行普通股案。
	2. 決議通過本公司擬發行105年度無擔保普通公司債案。
105.12.27	1. 決議通過本公司内部稽核主管異動案。
	2. 決議通過訂定本公司106年度稽核計畫案。
	3. 決議通過修訂本公司及子公司會計政策(ASE and Subsidiaries Accounting Policy)案。
	4. 決議通過廢止本公司於南投縣草屯鎖太平路一段351巷135號設立之南投分公司登記案。
106.01.13	1. 決議通過本公司擬提撥新台幣1億元交由財團法人日月光文教基金會執行環保公益之捐贈作業案。
	2. 決議通過訂定本公司「105年度現金增資發行普通股員工認購辦法」案。
	3. 決議通過訂定本公司105年度現金增資發行普通股其經理人得認購股數分配明細案。

- (十二) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者, 其主要内容:無。
- (十三) 最近年度及截至年報刊印日止,公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、内部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總:

106年2月28日

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
内部稽核主管	吳坤煌	103/08/01	106/01/01	内部職務調整

五、會計師公費資訊:

會計師公費資訊級距表

會計師事務所名稱	會計	†師姓名	查核期間	備註
勤業衆信聯合會計師事務所	陳珍麗	江佳玲	105.01.01~105.12.31	無

單位:新台幣仟元

金額級	公費項目	審計公費	非審計公費	合 計
1	低於2,000千元	_	_	-
2	2,000千元(含)~4,000千元	_	_	_
3	4,000千元(含)~6,000千元	_	_	_
4	6,000千元(含)~8,000千元	_	7,450	7,450
5	8,000千元(含)~10,000千元	_	_	-
6	10,000千元(含)以上	41,018	_	41,018
	合計	41,018	7,450	48,468

(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者,應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務内容。

單位:新台幣仟元

會計師 事務所名稱	會計師姓名	審計公費	非審計公費					會計師查核期間	
		番司公賞	制度設計	工商登記	人力資源	其他(註)	小 計	智引即重核期间	備註
勤業衆信聯合 會計師事務所	陳珍麗/江佳玲	\$41,018	_	_	_	\$7,450	\$7,450	105.01.01~105.12.31	非審計公費之其他服務 内容,包括諮詢及其他 等。

註:非審計公費按服務項目分別列示,若非審計公費之「其他」達非審計公費合計金額25%者,應於備註欄列示其服務內容。

- (二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者,應揭露更換前後審計 公費減少金額及原因:不適用。
- (三) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者,應揭露審計公費減少金額、比例及原因:不適用。

六、更換會計師資訊:

(一) 關於前任會計師

更換日期	一〇五年十二月九日					
更換原因及說明	本公司簽證會計師原委由勤業衆信聯合會計師事務所陳珍麗及江佳玲兩位會計師為之,因該事務所為維持計師之獨立性,並落實內部輪調之機制,故改委由該所之江佳玲及吳秋燕兩位會計師續為之。					
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人 情 況	會計師	委任人			
	主動終止委任		(不淹田)			
	不再接受(繼續)委任	(不適用)				
最近兩年内簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無					
			會計原則或實務			
	有		財務報告之揭露			
與發行人有無不同意見	F		查核範圍或步驟			
央 發 1 八 肯 無 小 问 总 克			其他			
	無					
	說明:不適用					
其他揭露事項 (依公開發行公司年報應行記載事項準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	— 無					

(二) 關於繼任會計師

事務所名稱	勤業衆信聯合會計師事務所
會計師姓名	江佳玲、吳秋燕
委任之日期	一〇五年十二月九日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

- (三) 前任會計師對公開發行公司年報應行記載事項準則第10條第6款第1目及第2目之3事項復函:無。
- 七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會計師所屬 事務所或其關係企業者,應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之 期間:不適用。

八、董事、監察人、經理人及持股比例超過10%之股東股權移轉及股權質押變動情形

1. 持股及設質股數變動情形

職稱	姓名	− ○∄	年底止	一〇六年截至二月底止		
地特	姓在	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	
董事本人及大股東	香港商微電子國際公司	_	-	-		
董事本人	張洪本(副董事長兼總經理)	_	-	-		
董事本人	張能傑	-	-	-		
	張虔生(董事長及執行長)	-	-	-		
	吳田玉(營運長)	1,100,000	-	1,500,000		
董事之法人代表人	董宏思(財務長)	1,200,000	-	-		
里争之法人11农人	羅瑞榮(高雄廠區總經理)	1,000,000	-	-		
	陳昌益(上海總部總經理)	1,056,000	-	-		
	陳天賜(中壢分公司總經理)	900,000	-	800,000		
獨立董事	游勝福	-	-	-		
獨立董事	徐大麟	_	-	-		
蜀立董事	何美玥	_	-	-		
副總經理		100,000	-	100,000		
副總經理	李世文	380,000	-	-		
副總經理	周光春	_	-	-		
副總經理	林國堂	100,000	-	-		
副總經理	莫煥華	(109,000)	-	-		
副總經理	葉清昆	51,000	-	-		
副總經理	鄭楨銘	(114,000)	-	-		
副總經理	洪松井	170,000	-	-		
副總經理	曹燕傑	_	-	-		
副總經理	洪志斌	106,000	-	-		
副總經理暨會計長	郭宏銘	_	-	-		

- 2.股權移轉之相對人為關係人資訊:無。
- 3.股權質押之相對人為關係人資訊:無。

九、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以内之親屬關係之資訊:

持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料

106年1月23日(註1) 單位:股:%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人名義 合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或 為配偶、二親等以内之親屬關係 者,其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股 比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱 (或姓名)	關係	
未 并充地	1,327,202,773 16.705					馮美珍	馮美珍為該公司 董事之配偶		
香港商微電子國際公司		16.703					張洪本	張洪本為該公司 董事	_
花旗台灣商銀保管日月光存託憑證	627,589,985	7.899	-	_	_	_	-	_	_
匯豐商業銀行受託保管價值投資公 司投資專戶	321,454,196	4.046	-	-	_	_	-	_	_
國泰人壽保險股份有限公司	224,554,000	2.826	-	-	-	-	-	-	_
富邦人壽保險股份有限公司	155,510,000	1.957	-	_	-	_	_	-	_

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人名義 合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或 為配偶、三親等以内之親屬關係 者,其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股 比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱 (或姓名)	關係	
新制勞工退休基金	125,567,609	1.581	-	_	-	_	_	_	_
							張洪本	配偶	
馮美珍	121,929,346	1.535	_	_	-	_	香港商微電子	馮美珍為該公司	_
							國際公司	董事之配偶	
南山人壽保險股份有限公司	115,486,000	1.454	-	_	-	_	_	_	
							馮美珍	配偶	
張洪本	104,414,941	1.314	_	_	-	_	香港商微電子	張洪本為該公司	_
							國際公司	董事	
德銀保管大學退休股權基金投資專 戶	100,939,968	1.271	-	_	-	_	_	_	_

註1:持股比率總股數之計算基礎係以截至105年12月31日止計入本公司員工因行使員工認股權增加之股數(即106年1月23日辦理變更登記後之流通在外股數)。

十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數

綜合持股比例

105年12月31日 單位:股:%

轉投資事業(註2)	本公司	本公司投資		理人及直接或間接 養之投資	綜合投資		
	股 數	持股比例	股 數	持股比例	股數	持股比例	
J&R Holding Ltd.	435,128	100.00%	-	-	435,128	100.00%	
A.S.E. Holding Ltd.	243,966	100.00%	_	_	243,966	100.00%	
Omniquest Industrial Limited	250,504,067	70.63%	104,200,000	29.37%	354,704,067	100.00%	
Innosource Limited	86,000,000	100.00%	_	-	86,000,000	100.00%	
ASE MS Japan Co., Ltd.	1,200	100.00%	_	_	1,200	100.00%	
台灣福雷電子(股)公司	1,131,452,502	100.00%	-	=	1,131,452,502	100.00%	
環電(股)公司	1,112,236,706	99.17%	-	-	1,112,236,706	99.17%	
宏璟建設(股)公司	68,629,782	26.22%	63,580,928	24.29%	132,210,710	50.51%	
宏錦光(股)公司	35,497,273	27.31%	82,494,545	63.46%	117,991,818	90.77%	
陸竹開發(股)公司	131,961,457	67.11%	37,250,448	18.94%	169,211,905	86.05%	
日月暘電子(股)公司	76,500,000	51.00%	-	_	76,500,000	51.00%	
矽品精密工業(股)公司	1,037,300,000	33.29%	-	_	1,037,300,000	33.29%	
元隆電子(股)公司	33,308,452	10.47%	90,000,000	28.29%	123,308,452	38.76%	

註2:係公司採用權益法之長期投資。

肆、募資情形

一、資本及股份

股份種類

105年12月31日

			*****	促郊昌丁韧贮塘			
股份種類		流通在外股份		未發行股份	合計	轉換公司債可轉換 股份總數	保留員工認股權 憑證總數
	已上市	未上市	合計	个5过1JIXU		13×133 (1654×	/ENSIL NOSA
普通股	7,944,875,346股	O股	7,944,875,346股	2,055,124,654股	10,000,000,000股	600,000,000股	800,000,000股

(一)股本來源

單位:股/新台幣元

	25/=	核定	段本	實收				事似: 版/利口幣几
年月	發行 價格	股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財 產抵充股款者	核准日期與文號
73.03	_	17,200,000	172,000,000	10,000,000	100,000,000	設立(現金)	無	民國73年3月23日 經加處(73)設字第414號
73.05	_	20,000,000	200,000,000	20,000,000	200,000,000	現金增資100,000,000	無	民國73年5月10日 經加處(73)商字第3956號
73.06	_	23,520,000	235,200,000	23,520,000	235,200,000	現金增資35,200,000	技術股 35,200,000	民國73年6月20日 經加處(73)商字第5246號
75.08	_	33,121,625	331,216,250	33,121,625	331,216,250	現金增資96,016,250	無	民國75年8月12日 經加處(75)商字第7725號
77.06	_	39,495,000	394,950,000	39,495,000	394,950,000	盈餘增資63,733,750	無	民國77年6月14日 經加處(77)商字第5457號
77.09	_	50,000,000	500,000,000	50,000,000	500,000,000	盈餘增資105,050,000	無	民國77年9月20日 經加處(77)商字第8760號
79.01	_	62,000,000	620,000,000	62,000,000	620,000,000	盈餘增資120,000,000	無	民國79年1月31日 經加處(79)商字第0184號
80.01	_	75,024,000	750,240,000	75,024,000	750,240,000	盈餘及員工紅利增資 117,840,000 資本公積轉增資 12,400,000	無	民國80年1月7日 經加處(80)商字第000046號
80.08	_	125,000,000	1,250,000,000	105,607,373	1,056,073,730	盈餘及員工紅利增資 80,761,730 資本公積轉增資 225,072,000	無	民國80年8月15日 經加處(80)商字第006582號
81.05	38	125,000,000	1,250,000,000	125,000,000	1,250,000,000	現金增資193,926,270	無	民國81年5月18日 經加處(81)商字第004195號
81.10	_	150,600,000	1,506,000,000	150,600,000	1,506,000,000	盈餘及員工紅利增資 68,500,000 資本公積轉增資 187,500,000	無	民國81年10月24日 經加處(81)商字第009364號
82.09	_	165,660,000	1,656,600,000	165,660,000	1,656,600,000	資本公積轉增資 150,600,000	無	民國82年9月10日 經加處(82)商字第007782號
83.05	_	260,000,000	2,600,000,000	233,824,000	2,338,240,000	盈餘及員工紅利增資 491,131,000 資本公積轉增資 190,509,000	無	民國83年5月30日 經加處(83)商字第4655號
84.02	60	260,000,000	2,600,000,000	260,000,000	2,600,000,000	現金增資261,760,000	無	民國84年2月6日 經加處(84)商字第000907號
84.05	-	500,000,000	5,000,000,000	356,800,000	3,568,000,000	盈餘及員工紅利增資 760,000,000 資本公積轉增資 208,000,000	無	民國84年5月26日 經加處(84)商字第4553號
84.07	79.7	500,000,000	5,000,000,000	399,800,000	3,998,000,000	現金增資430,000,000	無	民國84年7月29日 經加處(84)商字第6711號

	發行	核定	2股本	實收		備註			
年月	質相	股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財 產抵充股款者	核准日期與文號	
85.06	-	1,000,000,000	10,000,000,000	729,000,000	7,290,000,000	盈餘及員工紅利增資 2,092,600,000 資本公積轉增資 1,199,400,000	無	民國85年6月14日 經加處(85)商字第5658號	
86.06	-	1,400,000,000	14,000,000,000	1,017,000,000	10,170,000,000	盈餘及員工紅利增資 1,640,700,000 資本公積轉增資 1,239,300,000	無	民國86年6月11日 經加處(86)商字第005745號	
87.05	-	2,200,000,000	22,000,000,000	1,780,000,000	17,800,000,000	盈餘及員工紅利增資 6,409,600,000 資本公積轉增資 1,220,400,000	無	民國87年5月8日 經加處(87)商字第4310號	
88.08	_	2,200,000,000	22,000,000,000	1,980,000,000	19,800,000,000	盈餘及員工紅利增資 1,483,800,000 資本公積轉增資 516,200,000	無	民國88年8月11日 經加處(88)三商字第8494號	
89.06	_	2,400,000,000	24,000,000,000	1,980,355,086	19,803,550,860	海外可轉換公司債轉換 普通股本3,550,860	無	民國89年6月1日 經加處(89)三商字第005552號	
89.09	_	3,200,000,000	32,000,000,000	2,652,000,000	26,520,000,000	盈餘及員工紅利增資 6,716,449,140	無	民國89年9月17日 經加處(89)三資字第09740號	
89.10	43.81	3,200,000,000	32,000,000,000	2,752,000,000	27,520,000,000	現金增資發行海外存託 憑證1,000,000,000	無	民國89年10月23日 經加處(89)三商字第011577號	
90.08	_	4,150,000,000	41,500,000,000	3,254,800,000	32,548,000,000	盈餘及員工紅利增資 5,028,000,000	無	民國90年8月10日 經加三資字第0900007451號	
92.09	-	5,150,000,000	51,500,000,000	3,580,280,000	35,802,800,000	盈餘轉增資97,644,000 資本公積轉增資 3,157,156,000	無	民國92年9月18日 經加三商字第09200088290號	
93.09	_	5,150,000,000	51,500,000,000	3,862,595,437	38,625,954,370	合併增資2,823,154,370	無	民國93年9月3日 經加三商字第09301027080號	
93.09	_	5,150,000,000	51,500,000,000	4,100,000,000	41,000,000,000	盈餘轉增資 2,219,773,600 員工紅利轉增資 154,272,030	無	民國93年9月15日 經加三商字第09300078780號	
94.01	_	5,150,000,000	51,500,000,000	4,100,660,600	41,006,606,000	員工認股權憑證轉換 6,606,000	無	民國94年1月 31 日 經加三商字第09400004370號	
94.04	_	5,150,000,000	51,500,000,000	4,111,728,800	41,117,288,000	員工認股權憑證轉換 110,682,000	無	民國94年4月 21 日 經加三商字第09400032410號	
94.07	_	5,150,000,000	51,500,000,000	4,113,744,200	41,137,442,000	員工認股權憑證轉換 20,154,000	無	民國94年7月 21 日 經加三商字第09400059920號	
94.09	_	6,300,000,000	63,000,000,000	4,550,532,800	45,505,328,000	盈餘轉增資 2,878,547,980 員工紅利轉增資 255,674,600 資本公積轉增資 1,233,663,420	無	民國94年9月 29 日 經加三商字第09400084400號	
94.10	_	6,300,000,000	63,000,000,000	4,557,372,300	45,573,723,000	員工認股權憑證轉換 68,395,000	無	民國94年10月 21 日 經加三商字第09400091660號	
95.01	_	6,300,000,000	63,000,000,000	4,563,877,540	45,638,775,400	員工認股權憑證轉換 65,052,400	無	民國95年01月 19 日 經加三商字第09500005220號	
95.04	_	6,300,000,000	63,000,000,000	4,573,895,020	45,738,950,200	員工認股權憑證轉換 100,174,800	無	民國95年04月 24 日 經加三商字第09500030630號	
95.07	_	6,300,000,000	63,000,000,000	4,577,568,780	45,775,687,800	員工認股權憑證轉換 36,737,600	無	民國95年07月 19 日 經加三商字第09500059250號	
95.10	_	6,300,000,000	63,000,000,000	4,592,508,620	45,925,086,200	員工認股權憑證轉換 149,398,400	無	民國95年10月 17 日 經加三商字第09500088730號	
96.01	_	6,300,000,000	63,000,000,000	4,611,311,450	46,113,114,500	員工認股權憑證轉換 188,028,300	無	民國96年01月 18 日 經加三商字第09600005130號	

-	2%/ -	核定	2股本	實收		備註			
年月	發行 價格	股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財 產抵充股款者	核准日期與文號	
96.04	_	6,300,000,000	63,000,000,000	4,629,639,544	46,296,395,440	海外無擔保可轉換公司 債轉換39,956,440 員工認股權憑證轉換 143,324,500	無	民國96年04月 20 日 經加三商字第09600034690號	
96.07	-	6,300,000,000	63,000,000,000	4,645,295,431	46,452,954,310	海外無擔保可轉換公司 債轉換85,688,270 員工認股權憑證轉換 70,870,600	無	民國96年07月 23 日 經加三商字第09600063120號	
96.09	-	8,000,000,000	80,000,000,000	5,392,899,352	53,928,993,520	盈餘轉增資 6,941,010,710 員工紅利轉增資 535,028,500	無	民國96年09月 12 日 經加三商字第09600079950號	
96.10	_	8,000,000,000	80,000,000,000	5,447,558,879	54,475,588,790	海外無擔保可轉換公司 債轉換251,542,070 員工認股權憑證轉換 295,053,200	無	民國96年10月 23 日 經加三商字第09600090450號	
97.01	-	8,000,000,000	80,000,000,000	5,466,030,849	54,660,308,490	海外無擔保可轉換公司 債轉換145,603,600 員工認股權憑證轉換 39,116,100	無	民國97年01月 22 日 經加三商字第09700004950號	
97.04	_	8,000,000,000	80,000,000,000	5,476,949,209	54,769,492,090	海外無擔保可轉換公司 債轉換19,863,200 員工認股權憑證轉換 89,320,400	無	民國97年04月 22 日 經加三商字第09700033570號	
97.07	_	8,000,000,000	80,000,000,000	5,484,848,118	54,848,481,180	海外無擔保可轉換公司 債轉換61,524,590 員工認股權憑證轉換 17,464,500	無	民國97年07月 24 日 經加三商字第09700063360號	
97.08	_	8,000,000,000	80,000,000,000	5,681,934,764	56,819,347,640	資本公積轉增資 1,094,938,940 員工紅利轉增資 383,205,000 盈餘轉增資492,722,520	無	民國97年08月 28 日 經加三商字第09700077400號	
97.10	-	8,000,000,000	80,000,000,000	5,690,427,734	56,904,277,340	海外無擔保可轉換公司 債轉換32,763,800 員工認股權憑證轉換 52,165,900	無	民國97年10月 21 日 經加三商字第09700094250號	
98.01	_	8,000,000,000	80,000,000,000	5,690,742,134	56,907,421,340	員工認股權憑證轉換 3,144,000	無	民國98年01月 19 日 經加三商字第09800005500號	
98.03	_	8,000,000,000	80,000,000,000	5,546,705,134	55,467,051,340	註銷庫藏股 1,440,370,000	無	民國98年03月 16 日 經加三商字第09800023510號	
98.04	_	8,000,000,000	80,000,000,000	5,547,064,694	55,470,646,940	員工認股權憑證轉換 3,595,600	無	民國98年04月 22 日 經加三商字第09800037010號	
98.07	_	8,000,000,000	80,000,000,000	5,473,127,694	54,731,276,940	註銷庫藏股739,370,000	無	民國98年07月 14 日 經加三商字第09800065960號	
98.07	_	8,000,000,000	80,000,000,000	5,473,529,914	54,735,299,140	員工認股權憑證轉換 4,022,200	無	民國98年07月 21 日 經加三商字第09800068350號	
98.10		8,000,000,000	80,000,000,000	5,479,878,254	54,798,782,540	員工認股權憑證轉換 63,483,400	無	民國98年10月 20 日 經加三商字第09800103260號	
99.01	_	8,000,000,000	80,000,000,000	5,488,458,214	54,884,582,140	員工認股權憑證轉換 85,799,600	無	民國99年01月 25 日 經加三商字第09900005410號	
99.04	_	8,000,000,000	80,000,000,000	5,495,212,494	54,952,124,940	員工認股權憑證轉換 67,542,800	無	民國99年04月 23 日 經加三商字第09900039480號	
99.07	-	8,000,000,000	80,000,000,000	5,499,659,994	54,996,599,940	員工認股權憑證轉換 44,475,000	無	民國99年07月 19 日 經加三商字第09900075180號	

	2%/=	核定	2股本	實收				
年月	發行 價格	股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財 產抵充股款者	核准日期與文號
99.08	-	8,000,000,000	80,000,000,000	6,049,157,072	60,491,570,720	資本公積轉增資 879,195,320 股東股息紅利轉增資 4,615,775,460	無	民國99年08月 09 日 經加三商字第09900084320號
99.10	_	8,000,000,000	80,000,000,000	6,051,987,182	60,519,871,820	員工認股權憑證轉換 28,301,100	無	民國99年10月 22 日 經加三商字第09900113120號
100.01	_	8,000,000,000	80,000,000,000	6,029,118,452	60,291,184,520	員工認股權憑證轉換 141,312,700 註銷庫藏股370,000,000	無	民國100年01月 19 日 經加三商字第10000006520號
100.04	-	8,000,000,000	80,000,000,000	6,050,060,512	60,500,605,120	員工認股權憑證轉換 209,420,600	無	民國100年04月 21 日 經加三商字第10000043460號
100.07	-	8,000,000,000	80,000,000,000	6,052,219,212	60,522,192,120	員工認股權憑證轉換 21,587,000	無	民國100年07月 21 日 經加三商字第10000083030號
100.08	-	9,500,000,000	95,000,000,000	6,747,954,872	67,479,548,720	股東股息紅利轉增資 6,957,356,600	無	民國100年08月 30 日 經加三商字第10000101280號
100.10	_	9,500,000,000	95,000,000,000	6,753,563,242	67,535,632,420	員工認股權憑證轉換 56,083,700	無	民國100年10月 19 日 經加三商字第10000124020號
101.01	_	9,500,000,000	95,000,000,000	6,650,130,772	66,501,307,720	員工認股權憑證轉換 20,425,300 註銷庫藏股 1,054,750,000	無	民國101年01月 19 日 經加三商字第10100007740號
101.04	_	9,500,000,000	95,000,000,000	6,654,716,832	66,547,168,320	員工認股權憑證轉換 45,860,600	無	民國101年04月 20 日 經加三商字第10100043500號
101.07	_	9,500,000,000	95,000,000,000	6,657,855,052	66,578,550,520	員工認股權憑證轉換 31,382,200	無	民國101年07月 24 日 經加三商字第10100081100號
101.09	-	9,500,000,000	95,000,000,000	7,589,454,606	75,894,546,060	股東股息紅利轉增資 9,315,995,540	無	民國101年09月 04 日 經加三商字第10100099460號
101.10	_	9,500,000,000	95,000,000,000	7,594,149,626	75,941,496,260	員工認股權憑證轉換 46,950,200	無	民國101年10月 18 日 經加三商字第10100117650號
102.01	_	9,500,000,000	95,000,000,000	7,602,121,666	76,021,216,660	員工認股權憑證轉換 79,720,400	無	民國102年01月 18 日 經加三商字第10200007680號
102.04	-	9,500,000,000	95,000,000,000	7,607,502,906	76,075,029,060	員工認股權憑證轉換 53,812,400	無	民國102年04月17日 經加三商字第10200044490號
102.07	_	9,600,000,000	96,000,000,000	7,609,816,206	76,098,162,060	員工認股權憑證轉換 23,133,000	無	民國102年07月17日 經加三商字第10200082280號
102.10	26.1	9,600,000,000	96,000,000,000	7,756,003,946	77,560,039,460	現金增資1,300,000,000 員工認股權憑證轉換 161,877,400	無	民國102年10月17日 經加三商字第10200118400號
103.01	_	9,600,000,000	96,000,000,000	7,787,159,546	77,871,595,460	員工認股權憑證轉換 311,556,000	無	民國103年01月21日 經加三商字第10300007950號
103.04	-	9,600,000,000	96,000,000,000	7,810,454,946	78,104,549,460	員工認股權憑證轉換 232,954,000	無	民國103年04月22日 經加三商字第10300046040號
103.07	_	10,000,000,000	100,000,000,000	7,824,220,046	78,242,200,460	員工認股權憑證轉換 137,651,000	無	民國103年07月18日 經加三商字第10300085480號
103.10	_	10,000,000,000	100,000,000,000	7,852,537,846	78,525,378,460	員工認股權憑證轉換 283,178,000	無	民國103年10月24日 經加三商字第10300125920號
104.01	-	10,000,000,000	100,000,000,000	7,860,491,546	78,604,915,460	員工認股權憑證轉換 79,537,000	無	民國104年01月20日 經加三商字第10400006750號
104.04	-	10,000,000,000	100,000,000,000	7,887,881,546	78,878,815,460	員工認股權憑證轉換 273,900,000	無	民國104年04月21日 經加三商字第10400040900號
104.07	-	10,000,000,000	100,000,000,000	7,893,157,596	78,931,575,960	員工認股權憑證轉換 52,760,500	無	民國104年07月16日 經加三商字第10400076760號
104.10	-	10,000,000,000	100,000,000,000	7,902,928,996	79,029,289,960	97,714,000 	無	民國104年10月19日 經加三商字第10400114270號
105.01	_	10,000,000,000	100,000,000,000	7,909,741,896	79,097,418,960	員工認股權憑證轉換 68,129,000	無	民國105年01月20日 經加三商字第10500008440號

	發行	核定股本		實收股本		備註		
年月	價格	股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財 產抵充股款者	核准日期與文號
105.04		10,000,000,000	100,000,000,000	7,918,272,896	79,182,728,960	員工認股權憑證轉換	無	民國105年04月26日
103.04		10,000,000,000	100,000,000,000	7,910,272,090	79,162,726,900	85,310,000	////	經加三商字第10500040560號
105.07		10 000 000 000	100 000 000 000	7 022 622 506	70 226 225 060	員工認股權憑證轉換	無	民國105年07月20日
105.07	_	10,000,000,000	100,000,000,000	7,923,622,596	79,236,225,960	53,497,000	////	經加三商字第10500071110號
105.10		10 000 000 000	100 000 000 000	7.026.472.546	70 264 725 460	員工認股權憑證轉換	無	民國105年10月20日
105.10	_	10,000,000,000	100,000,000,000	7,936,473,546	79,364,735,460	128,509,500	////	經加三商字第10500105140號
100.01		10,000,000,000	100 000 000 000	7.044.075.246	70 440 753 460	員工認股權憑證轉換	4111	民國106年01月23日
106.01	_	10,000,000,000	100,000,000,000	7,944,875,346	79,448,753,460	84,018,000	無	經加三商字第10600009350號

(二)股東結構

106年01月23日(註1)

股東結構數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構及外人	合計(註2)
人數(人)	4	2	366	169,978	1,310	171,660
持有股數(股)	199,812,127	117,226,000	1,234,764,734	844,394,333	5,548,678,152	7,944,875,346
持股比例(%)	2.515	1.475	15.542	10.628	69.840(註3)	100.000

(三)股權分散情形

1. 普通股股權分散情形

每股面額十元:106年01月23日(註4)

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例(%)
1~999	83,118	22,356,984	0.281
1,000~5,000	57,624	136,106,084	1.713
5,001~10,000	14,636	107,563,234	1.354
10,001~15,000	5,440	67,042,096	0.844
15,001~20,000	3,035	53,754,652	0.677
20,001~30,000	2,502	61,649,956	0.776
30,001~40,000	1,405	48,453,503	0.610
40,001~50,000	768	34,713,224	0.437
50,001~100,000	1,395	97,641,335	1.229
100,001~200,000	622	87,485,389	1.101
200,001~400,000	339	94,417,975	1.188
400,001~600,000	147	72,516,682	0.913
600,001~800,000	101	69,988,481	0.881
800,001~1,000,000	63	56,281,182	0.708
1,000,001以上	465	6,934,904,569	87.288
合計	171,660	7,944,875,346	100.000

註4:係股務代理機構所提供最近期之資料。

2. 特別股股權分散情形:不適用。

註1:係股務代理機構所提供最近期之資料。 註2:包含一〇五年十二月三十一日止,因員工行使認股權於一〇六年一月二十三日辦理變更登記後所發行之股數。 註3:其中陸資持股比例為0.018%。

(四)主要股東名單

106年01月23日(註)

股份 主要股東名稱	持有股數	持股比例(%)
香港商微電子國際公司	1,327,202,773	16.705
花旗台灣商銀保管日月光存託憑證	627,589,985	7.899
匯豐商業銀行受託保管價值投資公司投資專戶	321,454,196	4.046
國泰人壽保險股份有限公司	224,554,000	2.826
富邦人壽保險股份有限公司	155,510,000	1.957
新制勞工退休基金	125,567,609	1.581
馮美珍	121,929,346	1.535
南山人壽保險股份有限公司	115,486,000	1.454
張洪本	104,414,941	1.314
德銀保管大學退休股權基金投資專戶	100,939,968	1.271

註:持股比例總股數之基礎係依本公司員工截至105年12月31日止因行使員工認股權增加之股數(即以106年1月23日辦理變更登記後之流通在外股數)。

(五)每股市價、淨值、盈餘及股利資料

單位:新台幣元

項目		年度	一〇四年度	一〇五年度	一〇六年截至年報刊印日止
	追溯前	最高	48.05	39.90	39.10
	1年/朔刊	最低	29.75	28.10	32.60
每股市價	3D34074	最高	48.05	註1	註1
	追溯後	最低	29.75	註1	註1
	平均		39.22	35.37	36.39
每股淨值	分配前		20.21	20.17	註5
	分配後		18.60	註1	註5
	加權平均股數		8,250,064,481股	8,284,128,948股	8,334,173,591股
每股盈餘	(= 00.73 co.43 cm)	追溯前	2.44	2.37	註5
	每股盈餘(稀釋)	追溯後	2.41	註1	註5
	現金股利		1.59718596	註1	-
年 肌 肌 エリ	/m /☆ 乗 7 D.7.	盈餘配股	-	註1	-
每股股利	無償配股	資本公積配股	-	註1	-
	累積未付股利		-	-	-
	本益比(註2)		16.07	14.93	註5
投資報酬分析	本利比(註3)		24.56	註1	-
	現金股利殖利率(註4)		0.04	註1	-

註1: 俟股東會決議後定案。

(六)公司股利政策及執行狀況

1. 公司之股利政策:

本公司於民國九十八年六月二十五日經股東會通過修訂之股利政策如下:

本公司正處於企業穩定成長階段,為因應目前及未來業務擴展之資金需求,並滿足股東對現金流入之需求,本公司之股利政策係採取剩餘股利政策分派股利,其中現金股利發放之比例不低於股利總額百分之三十,餘額則配發股票股利,並由董事會擬具盈餘分派案,經股東會決議後辦理。

註2:本益比=當年度平均收盤價/每股盈餘。

註3:本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。

註4:現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。

註5:尚未完成盈餘結算。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形:

- (1) 本公司董事會於106年3月30日提議本次分派股東紅利新台幣11,415,197,564元,全部以現金發放,每股配發現金股利1.4元。有關上項股東紅利之配息率係依據本公司106年3月28日之股東名簿所記載之股數扣除本公司已買回之庫藏股後之股數8,153,712,546股計算,嗣後如因本公司發行海外可轉換公司債之債權人行使轉換、或因員工執行員工認股權憑證認購本公司新股、或因本公司辦理現金增資發行新股、或因買回本公司股份、或因本公司將庫藏股轉讓或註銷等因素,影響本公司可參與分配股利之股數,致股東之配息率發生變動而需修正時,擬提請股東會授權董事長全權處理並調整之。
- (2) 為配合兩稅合一實施,本次盈餘分派案優先分配最近年度盈餘。
- (3) 本次股東會擬議股利分配之情形俟股東常會通過並報請主管機關核准增資後,授權由董事會另訂除息基準日,屆時 將另行公告。
- 3. 預期股利政策將有重大變動時,應加以說明分配之情形:不適用。

(七) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響:

不適用。(依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定,本公司無需公開民國一〇六年度財務預測資訊。)

(八)員工、董事及監察人酬勞

本公司公司章程經民國一〇五年六月二十八日股東常會決議後所載員工、董事酬勞之成數或範圍如下:

依本公司章程第二十三條規定,本公司年度如有獲利,應提撥百分之五點二五(含)以上,百分之八點二五(含)以下為員工酬勞,並提撥百分之零點七五(含)以下為董事酬勞;但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。

前項提撥之員工酬勞,其中百分之五點二五部份係按員工酬勞發放辦法分配予全體員工,另其超過百分之五點二五部份 則授權董事會就特定員工之個別貢獻度另行訂定辦法分派之。

員工酬勞以股票或現金為之,應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報告股東 會。

前三項所稱之員工,其對象包括符合一定條件之從屬公司員工,其條件由董事會訂定之。

依本公司章程第二十三條之一規定,本公司每屆決算所得純益,依下列順序分派之。

- (1) 彌補虧損。
- (2) 提存百分之十為法定盈餘公積。
- (3) 依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。
- (4) 加計或減除保留盈餘中屬已實現之透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益。

其餘併同以前年度未分配盈餘,由董事會擬定盈餘分派案,提請股東會決議之。

2. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數 有差異時之會計處理。

一〇五年度應付員工酬勞及董事酬勞之估列金額分別為新台幣2,147,322,985元及195,211,182元,分別按稅後淨利(已扣除員工酬勞及董事酬勞之金額)之8.25%及0.75%計算。其差異金額之處理:差異金額已於董事會通過擬議時以會計估計變動認列。若董事會決議之發放金額有重大變動時,該變動調整原提列年度費用,財務報告通過日後若金額仍有變動,則依會計估計變動處理,於次一年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形:

本公司106年3月30日董事會決議通過105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形如下:

(1) 擬議分派員工酬勞新台幣2,151,900,000元(全數以現金發放)及董事酬勞金額新台幣148,000,000元。上述擬配發金額與原已費用化之員工酬勞2.147.322.985元及董事酬勞195.211.182元,差異數共計42.634.167元。差異金額之處

理:差異金額已於董事會通過擬議時以會計估計變動認列。若董事會決議之發放金額有重大變動時,該變動調整原 提列年度費用,財務報告通過日後若金額仍有變動,則依會計估計變動處理,於次一年度調整入帳。

- (2) 以股票分派之員工酬勞金額為0元,占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例為0%。
- 4. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形。

本公司105年6月28日股東常會通過104年度盈餘分派案及實際配發情形:

- (1) 實際配發員工酬勞新台幣2,033,800仟元及董事監察人酬勞金額新台幣140,000仟元。
- (2) 上述實際配發金額與原已費用化之員工酬勞2,033,500仟元,董事監察人酬勞184,500仟元,差異數共計44,200仟元。

差異原因:會計估計調整。

處理情形:差異金額已於董事會通過擬議時以會計估計變動認列。

(九)公司買回本公司股份情形: 公司最近年度及截至年報刊印日止並無買回本公司股份。

二、公司債辦理情形:

(一)公司債發行情形

106年截至年報刊印日止

	公司債種類	一〇四年度第1期無擔保普通公司債	一〇五年度第1期無擔保普通公司債		
發行	∃期	民國105年1月12日	民國106年1月13日		
面額		新台幣100萬元	新台幣100萬元		
發行.	 及交易地點	中華民國櫃檯買賣中心	中華民國櫃檯買賣中心		
	賈格	依票面金額十足發行	依票面金額十足發行		
總額		新台幣90億元(甲類70億元,乙類20億元)	新台幣80億元(甲類37億元,乙類43億元)		
利率		甲類: 固定年利率1.30% 乙類: 固定年利率1.50%	甲類: 固定年利率1.25% 乙類: 固定年利率1.45%		
期限		甲類5年,到期日:110年1月12日 乙類7年,到期日:112年1月12日	甲類5年,到期日:111年1月13日 乙類7年,到期日:113年1月13日		
保證	幾構	無	無		
受託.	Λ	台北富邦商業銀行股份有限公司信託部	台北富邦商業銀行股份有限公司信託部		
承銷	幾構	元大證券股份有限公司	元大證券股份有限公司		
簽證	津師	一誠法律事務所	翰辰法律事務所		
簽證	會計師	勤業衆信聯合會計師事務所	勤業衆信聯合會計師事務所		
償還:	方法	甲乙類均為到期一次還本	甲乙類均為到期一次還本		
提前	買回金額	無	無		
未償		新台幣90億元	新台幣80億元		
贖回	或提前清償之條款	無	無		
限制	条款	僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規 則所定之專業投資人	僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規 則所定之專業投資人		
	評等機構名稱、評等日 公司債評等結果	澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 評等日期:104年12月16日 評等等級:A+(twn)	澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 評等日期:105年12月09日 評等等級:A+(twn)		
門 其 他 #	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無	無		
權利	發行及轉換(交換或認股) 辦法	無	無		
法、	及轉換、交換或認股辦 發行條件對股權可能稀釋 及對現有股東權益影響	無	無		
交換	票的委託保管機構名稱	無	無		

(二) 轉換公司債資料

單位:新台幣元

公司債 種 類		海外第三次無擔保轉換公司	公司債(發行總額美金四億元) 海外第四次無擔保轉換公司債(發行總額美金.			
年底 項目		105年度 106年截至年報刊印日		105年度 106年截至年報刊印		
	最高	_	_	_	-	
轉換公司債市價	最低	_	_	_	-	
	平均	_	_	_	_	
轉換價格		28.	.96	49.48		
發行(辦理)日期及發行時轉換價格		發行日期: 102年9月5日 發行時轉換價格: 33.085		發行日期: 104年7月2日 發行時轉換價格: 54.5465		
履行轉換義務方式		公司債持有人行使轉換權者,發個營業日內,透過臺灣證券集中式交付新股。如請求轉換之本公轉換集保專戶,發行公司將俟持帳簿劃撥方式交付新股。	保管股份有限公司之帳簿劃撥方 司債持有人尚未開立海外公司債	發方 個營業日內,透過臺灣證券集中保管股份有限公司之帳 司債 式交付普通股。如請求轉換之本公司債持有人尚未開立		

三、特別股辦理情形:無。

四、海外存託憑證辦理情形:

106年截至年報刊的日止 單位:美金元

	7v./+1+T			106年截至年報刊印1日正 単位:美金元	
發行(辦理)日期項目		里)日期	89 年 9月	92 年 6 月	
發行(辦理)日	期		民國89年9月	民國92年6月	
發行及交易地	也點		美國紐約證券交易所	美國紐約證券交易所	
發行總金額			美金140,000仟元	美金86,808仟元	
單位發行價格	¥		每單位美金7元	每單位美金2.65元	
發行單位總數	攻		20,000,000單位,每單位表彰本公司普通股5股	32,757,600單位,每單位表彰本公司普通股5股	
表彰有價證券			本公司現金增資發行之普通股	本公司股東所持有本公司已發行之普通股	
表彰有價證券			本公司普通股100,000,000股,每股面額新台幣壹拾元整	本公司普通股163,788,000股,每股面額新台幣壹拾元整	
存託憑證持有	目人之權利與義務		享有與本公司普通股股東相同之權利義務		
受託人			無		
存託機構			花旗銀行		
保管機構			花旗銀行台北分行		
未兌回餘額			迄年報刊印日止,海外存託憑證流通在外餘額為122,142,846單位,表彰本公司普通股610,714,235股。		
發行及存續其	月間 相關費用之分攤方式		無		
存託契約及例	保管契約之重要約定事項		無		
		最高	6.23		
	105年度	最低	4.39		
每單位市價		平均	5.46		
		最高	6.21		
	106年截至年報刊印日止	最低	5.04		
		平均	5.95		

五、員工認股權憑證辦理情形(含限制員工權利新股):

- (一)本公司為吸引並留任公司所需之專業人才,激勵員工及提昇員工向心力,業經主管機關於九十六年十一月、九十九年四月及一〇四年四月分別核准發行第三次員工認股權憑證200,000,000單位、第四次員工認股權憑證200,000,000單位及第五次員工認股權憑證100,000,000單位,每單位得認購本公司普通股一股,並以發行日當日之普通股股票收盤價為認股價格。(第一、二次員工認股權憑證已到期)
- 1. 尚未屆期之員工認股權憑證截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響:

106年截至年報刊印日止

	第三次員工	第四次員工		第五次員工
員工認股權憑證種類	認股權憑證	第一次發行	第二次發行	認股權憑證
申報生效日期	96/11/22	99/	04/20	104/04/17
發行(辦理)日期	96/12/19	99/05/06	100/04/15	104/09/10
董事會決定發行單位數	200,000,000單位	200,000	,000單位	100,000,000單位
發行得認購股數占發行時已發行股份總數比率	3.66%	3.41%	0.20%	1.19%
認股存續期間	本認股權憑證之存續期間為一股權人不得再行主張其認股權	午,不得轉讓,但因繼承者 ² 耐。	· 下在此限。存續期間屆滿後,۶	未行使之認股權視同棄權,認
履約方式	由本公司發行普通股新股交付	j •		
限制認股期間及比率(%)	認股權人自被授予員工認股權 認股權憑證授予期間 屆滿2年 屆滿2.5年 屆滿3年 屆滿3.5年 屆滿4年 屆滿4.5年	灌憑證屆滿二年後,可按下列時 累積最高可行使認股比例 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%	程及比例行使認股。	
已執行取得股數	121,389,500股	94,718,600股	3,999,500股	0股
已執行認股金額	2,692,206,430元	1,933,083,620元	90,388,700元	0元
未執行認股數量	64,416,700股	93,000,900股	8,280,500股	94,270,000股
未執行認股者其每股認購價格(目前執行價格)	新台幣21.1元	新台幣20.4元	新台幣22.6元	新台幣36.5元
未執行認股數量占年報刊印日已發行股份總數 比率(%)	0.81%	1.17%	0.10%	1.19%
對股東權益影響	本認股權憑證於發行日屆滿二	年後,分三年執行,對原股東	權益逐年稀釋,其稀釋效果尚	屬有限。

2. 取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形

106年02月28日

					取得認							执行	J6#U2/J28口
	職稱	姓名	發行日	取得認股數量	股數量 占已發 行股份 總數比 率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量 占已發行 股份總數 比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量 占已發行 股份總數 比率
	執行長	張虔生											
	總經理	張洪本											
	營運長	吳田玉											
	財務長	董宏思											
	高雄廠區總經理	羅瑞榮											
	中壢分公司總經理	陳天賜											
	上海總部 總經理	陳昌益											
經	副總經理	俞旭濬	96.12.19 99.05.06										
理	副總經理	李世文	100.04.15	00.04.15 39,325,000 0.49	0.49%	% 9,946,000 21	5,000 21. 21 210,975,900	210,975,900	0.13%	29,379,000	20.86	612,876,600	0.37%
人	副總經理	周光春	104.09.10										
	副總經理	林國堂											
	副總經理	洪松井											
	副總經理	洪志斌											
	副總經理	莫煥華											
	副總經理	葉清昆											
	副總經理	鄭楨銘											
	副總經理	曹燕傑											
	副總經理 暨會計長	郭宏銘											
	ı	張能傑											
	取	李俊哲											
	侍 認 昖	張項青萍											
	權馬	潘士華	96.12.19										
	證	張能超	99.05.06	40 500 000		5 440 000	22.00	42424000	0.070/		20.70	405 252 000	0.050/
		李石松	100.04.15	10,500,000	0.13%	5,410,000	22.98	124,314,000	0.07%	5,090,000	20.70	105,362,000	0.06%
	數前	米瑞奇	104.09.10										
	十	李貴文	1										
	貝 工	張淡寧	1										
		張淡堯											

(二) 限制員工權利新股辦理情形:

- 1. 尚未全數達既得條件之限制員工權利新股截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響:無。
- 2. 取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大員工姓名及取得情形:無。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:

- (一) 最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股:無。
- (二) 最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者:無。

七、資金運用計畫執行情形:

截至年報刊印日止已募集完成但尚未執行完畢之計畫:無。

伍、營運概況

一、業務内容

(一) 業務範圍

1. 本集團所營業務主要為各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售

本集團主要提供客戶IC服務、電子製造服務及其他等三大類的業務範圍,包括:

• IC服務

封裝: 封裝及模組設計、IC封裝、多晶片封裝、微型及混合型模組、記憶體封裝。

測試:前段測試、晶圓針測、成品測試。

材料:基板設計、製造。

• 電子製造服務(EMS)

模組及主機板設計、產品及系統設計、系統整合、後勤管理。

其他

房地產開發、建設、房屋銷售物業管理及商場出租業務。

2. 目前產品項目及其營業比重:

單位:新台幣仟元

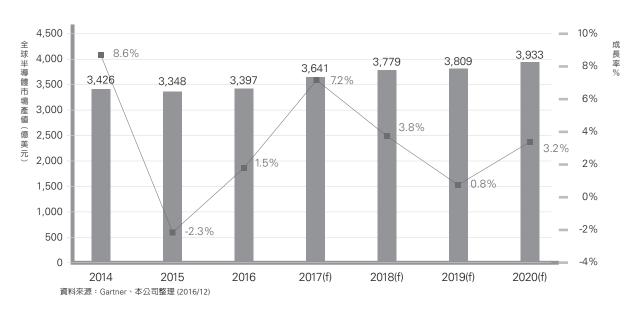
→ 而玄口 百口	105	
主要產品項目	營收金額	營業比重
封裝業務產品	112,838,646	41.05%
測試業務產品	26,065,195	9.48%
電子製造代工服務產品	114,425,790	41.63%
其他	21,554,476	7.84%
總計	274,884,107	100.00%

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

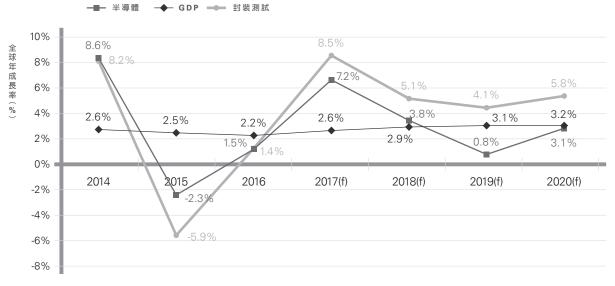
在過去全球系統性風險影響下,導致全球消費者信心不足,終端產品銷售不佳也使得其半導體供應鏈在過去一年半以來 呈現產能利用率降低及產值不分淡旺季一路下滑,至2016年第二季才逐漸回溫,並於第三季呈現兩位數成長狀態,此反 應全球已逐漸擺脫不景氣現象。

在總體經濟部分,預估2016年成長2.4%,而2017年全球GDP持續穩定成長2.6%,總值82.26兆美元。2016年下半年全球總體經濟走勢回穩,Gartner上修2016年全球半導體市場銷售值為3,397億美元,較2015年3,348億美元小幅成長1.5%,且未來五年的年複合成長率為3.3%,亦是長期看好的趨勢。預估2020年全球半導體市場規模可達3,933億美元,成長3.2%,未來幾年都呈現個位數成長率,2020年全球半導體市場產值並未突破4,000億美元大關。



全球無論是在GDP、半導體亦或專業封測代工領域,其成長率谷底已出現在2015年,而在專業封裝測試代工領域中,2016年由於上半年不景氣,下半年才開始逐漸回溫成長的情況之下,雖然2016年成長率僅1.5%,但未來五年的年成長率逐步回溫,顯示全球未來半導體專業封測代工景氣成長性佳。預估2017年全球半導體將成長7.2%,半導體專業封測代工成長8.5%,顯示全球半導體專業封測代工景氣成長性,優於平均。

全球GDP、半導體及專業封裝測試成長率



資料來源:Gartner、本公司整理 (2016/12)

台灣半導體產業景氣之動向:台灣半導體產業產值表現,2016年台灣整體IC產業產值(含設計、製造、封測)達新台幣 24,493億元,較2015年成長8.2%。

在台灣IC設計業方面,因通訊市場回溫,且受惠於中國大陸啓動4G商轉之效益,持續帶動手機相關晶片應用商機,整體較去年同期佳,IC設計業產值為新台幣6,531億元,較2015年成長10.2%。

台灣IC製造業產值為新台幣13,324億元,較2015年成長8.3%。在次產業之晶圓代工方面,受到終端產品推出帶動廠商

下單,晶圓代工產值達新台幣11,487億元,較2015年成長13.8%。記憶體製造方面,因全球標準型DRAM供不應求、大廠產品調整下帶動合約價格上漲,使得DRAM廠商營收成長,但因2016年記憶體大廠調整產品結構並進行併購協議,使整體產值與2016年的加總不同,因此記憶體製造產值達新台幣1,837億元,較2015年衰退16.8%。顯示記憶體製造在台灣的版圖將持續變小,轉為利基型與特殊應用為主的記憶體市場,未來可關注新興記憶體的發展是否可為台灣記憶體注入新活力,但研發成本的投入將是較大挑戰。

在台灣封測產業方面,其2016年產業產值達新台幣4,638億元,由於上半年成長性不佳,故當年僅成長5.1%。

展望2017年,台灣半導體產業產值預估為新台幣25,916億元,其中設計業產值為新台幣6,890億元,製造業為新台幣13,971億元。在次產業方面,預估晶圓代工產值為新台幣12,724億元,記憶體製造產值為新台幣1,247億元。封裝測試業為新台幣5,055億元,其中封裝業為新台幣3,482億元,測試業為新台幣1,573億元,年成長9.0%,略優於2017年全球專業封測代工成長率8.5%。

以下係 2016 年台灣 IC 設計、製造、封測業及 2017年預估營運表現,表列如下:

2017年台灣半導體產業產值預估

單位:新台幣億元

	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (e)
台灣IC產業產值	16,342	18,886	22,033	22,640	24,493	25,916
台灣IC設計業	4,115	4,811	5,763	5,927	6,531	6,890
台灣IC製造業	8,292	9,965	11,731	12,300	13,324	13,971
晶圓代工	6,483	7,592	9,140	10,093	11,487	12,724
記憶體製造	1,809	2,373	2,591	2,207	1,837	1,247
台灣IC封測業	3,935	4,110	4,539	4,413	4,638	5,055
IC封裝業	2,720	2,844	3,160	3,099	3,238	3,482
IC測試業	1,215	1,266	1,379	1,314	1,400	1,573

資料來源:TSIA、工研院 IEK、本公司整理 (2017/02)

2. 產業上、中、下游之關連性

細數近年來帶動半導體產業成長的終端產品,如智慧手機、NB、PC、Tablet等終端產品成長趨緩,廠商陷入過度競爭的 紅海中,也降低投資意願,因此半導體產業併購活動不斷,不論是IDM、IC設計、IC製造、IC封測產業,皆無法置身事 外,併購手段可讓競爭者變少,也讓併購者規模變大,促使市場逐漸回復到新的供需環境。可以看到各個國家或企業都 在積極尋求突破,也牽動版圖變化及競爭態勢。

綜觀2016年全球半導體產業併購案,諸多半導體廠商併購標的大多是人工智慧(AI)、車用電子、物聯網及再生能源等, 顯見智慧手機已經不是當紅炸子雞,取而代之的是半導體廠商開始布局垂直應用領域。半導體上下游供應鏈,已成為提 供客戶客製化的模組及封測系統,以達到客戶產品需求,未來在物聯網少量多樣及穿戴裝置朝輕薄短小趨勢發展下,此 商業模式在未來將具有良好利基,視切入物聯網消費性終端產品需求為最終目標。

整體來說,半導體產業的併購除了強化產品線競爭力,與鞏固既有市場領導力之外,更有擴大更多元應用的戰略意涵,不論是擁有晶圓/封裝廠的IDM廠,或是設計廠商,都很明白僅靠單一終端應用的營運風險極高,唯有分散布局並尋求成長,已是國際間基本共識!

台灣擁有完整的半導體產業鏈,從上游的 IC 設計到後段的 IC 製造與 IC 封測,專業分工模式獨步全球。台灣半導體產業不論是出口、產值、附加價值、就業人數、產業關聯效益,確實地支撐台灣經濟命脈,實屬國寶級產業。政府也刻不容緩地維護台灣半導體產業優勢,行政院將打造「數位國家、創新經濟」方案,做為鞏固「五加二」產業的大基盤,「五加二」產業是指亞洲矽谷、生技醫療、綠能科技、智慧機械及國防航太等五大創新產業,再加上新農業、循環經濟。半導體產業是台灣的「國家級產業」,若沒有半導體產業的支撐,物聯網(IoT)、智慧機械、新能源、生技和國防等產業都不可能真正成功。半導體的研發和製造能量,可以支持上述重點產業的發展。相對的,未來重點產業的發展,也會帶動半導體的應用需求。

在半導體產業供應鏈中,本公司之業務主要負責中游之封裝測試和下游之封裝材料供應。本公司提供客戶晶片封裝及測試 之半導體製造服務,主要晶圓大都為國際知名半導體公司所提供,長期與本公司保持良好的業務關係。本公司並透過策略 聯盟與合作夥伴藉由垂直及水平分工,進而提昇彼此的競爭實力。

在電子製造服務方面上游產業包括原材料、功率晶片設計公司、晶圓代工廠,中游產業包括關鍵零組件製造廠、封裝測試廠,下游產業包括系統整合廠、太陽能廠。

資金人力資源 設備儀器 服務支援 CAD 晶粒測試及切割 CAE 光罩 製造 封裝 設計 貨運 16 37 科學園區 基板 材料 晶圓 化學品 11 19 導線架

我國半導體產業結構圖

註:圖中數字代表台灣主要廠商家數

CAD: Computer Aided Design CAE: Computer Aided Engineering 督料來源: 丁研院 IFK (2015/05)

3. 產品之發展趨勢

電子終端產品從過去的個人電腦(PC)到智慧手機(Smartphone)的大量普及,致使成長力道放緩,僅呈現溫和成長態勢。 但市場仍期待2017年的iPhone 8的大亮點,驅動全球半導體產業鏈全面同步升級換代,帶來產業另一波成長動能,試圖 延續行動裝置的繁華前景。

面對行動裝置的輕薄短小、多功能且高速化的趨勢,業界皆一直在思考如何在更小的空間内裝入更多功能,使得近年來WLP、SiP等技術的相關模組產品導入與蓬勃發展,更快速地擴增智慧手機的強大功效性,尤其是蘋果在iPhone 7開始大量導入SiP技術,在手機中共內建6個SiP次系統模組,與iPhone 6中只內建3個SiP次系統模組相較,足足成長了一倍,以達到兼顧輕薄機身和強大功能性。

至於下一波殺手級應用為何?則可由世界級展會中窺知一二。在2016 Computex的四大主軸「物聯網科技應用」、「商業解決方案」、「創新與新創」、「電競」中,展會展示的AR/VR、車用電子與IoT等終端應用成為產業發展重點,而IoT已在更多領域落實商機,尤其是智慧家庭、智慧城市、車聯網。

再由2017 CES展會可知,人工智慧(AI)當道,5G應用為願景,國際半導體大廠強調生活應用和使用者體驗,其技術佈局將以自有優勢技術為核心,鎖定物聯網所需的三大技術方向發展:智慧運算(CPU、AP、GPU、FPGA…)、智慧感測(Sensor…)、智慧傳輸(5G晶片…)。物聯網帶動半導體元件技術走向製程微縮、次世代通訊、感測器融合與高階多視覺運算、記憶體內運算等,在物聯網的產品需求方面,必須具備多功能異質整合(Heterogonous Integration)及超低功耗等特性,此特性可拆解體積輕薄、電池續航力長、低功耗連線等元件整合趨勢。

為了要提升效能及降低功耗,業界傾向在封裝時將處理器與記憶體堆疊,這樣可以達到較少面積、較低功耗(路徑短阻抗小))及較高傳輸速度(電子傳輸路徑變短),因此3DIC及TSV技術便應運而生,為了連接堆疊的IC,進而達到垂直堆疊的異

質整合。另外,內埋式技術(Embedded Technology)亦可實現3D結構,其優點包括可提昇電性與運算速度、降低雜訊、縮小產品尺寸、降低成本等。就應用面來看,由於手機等行動裝置的價格壓力日趨增加,因此在體積小型化與成本價格的取捨權衡上,內埋式技術的優勢在已逐漸受到重視,可成為SiP時基板附加功能利用時的重要利器。

為達到萬物聯網的境界,必須倚賴雲端運算(Cloud Computing)來實現,然而雲端運算不再是單一運算架構,未來社群網絡媒體運算特性是快速、集中、卻難以預測。龐大的資料母體數據,必須迅速消化、即時反應、提出預測的運算機制,而高效能運算(High Performance Computing,HPC)的趨勢發展,使高階運算核心對半導體高階製程消耗,有機會接棒智慧手機,成為驅動下一波半導體產業成長的動力。

展會上另外一大亮點是智慧車應用,隨著汽車越趨智慧化,汽車電子在一台新車的成本佔比也越高,2010年為35%,未來上看50%,未來平均每台汽車的半導體內含量金額越來越高,預計2018年可達610美元。為因應此趨勢,在2017 CES 展會中以自駕技術相關參展的廠商也大幅增加。未來汽車將與萬物相連,包含駕駛、環境、行人、雲端、汽車,激盪出新的產業合作契機與物聯網商機,未來汽車走向智慧化、自動化、電動化與共享化。汽車電子化加速進行,規格持續朝「節能、安全與互連」配備的「智慧新能源車」演進,部分汽車零組件符合新技術與新產品從無到有的趨勢,未來具成長空間。

這些終端產品,無非是走向輕薄短小與智慧化趨勢,皆有高度整合晶片的需求,必然帶動系統級封裝(SiP)需求提升,因此SiP成為專業封測廠的主要發展目標。SiP範圍廣泛,扇出型封裝(Fan-Out)只是SiP其中一種封裝應用形式,具備Fan-Out技術的封裝廠,可藉由自身原有的封裝技術,為客戶提供各式SiP服務,並依照客戶需求給予客製化解決方案,推出符合物聯網趨勢的小尺寸、高性能與低成本,且能整合異質晶片的SiP封裝產品,並將封測廠與系統廠的技術做垂直整合,以完整自家SiP技術競爭力。

此外,智慧功率模組(Motion-Smart Power Module)是目前消費電器和普通工業應用中低功耗馬達驅動的發展趨勢。 Fairchild半導體業者推出廣泛全面的智慧功率模組產品組合,稱為Motion-SPM(Smart Power Module)模組,這種擴展線路卡讓設計人員能夠實現節能驅動。使用SPM的好處是性能更高、可靠性更強、耐久性更好。它們有多種不同封裝形式,適用於低至150瓦的輸出功率Tiny-DIP/SMD到中等輸出功率(3kW)的Mini-DIP封裝,最後到DIP封裝(小於7kW)。目前,運動控制的發展趨勢是效率更高、性能更佳。運動智慧功率模組可為三相電壓源逆變器提供增強舒適性和可靠性的額外功能。用於PFC的智慧功率模組可提高功率因數,讓功率在最大效率下分配工作。

4. 競爭情形

2016年終端電子產品需求成長放緩的趨勢仍在,加上中國近年IC產業以併購方式獲取高成長,中資企業質與量的提升使 台廠備感壓力。台灣發展半導體雖較中國大陸早,但隨著中國大陸以其市場優勢及政策補助模式,同時採取與國際大廠 策略聯盟、入股及併購等方式,快速取得客戶、技術等不足之處,超英趕美般跟上國際大廠水準,當半導體之供給廠商 變多,競爭便會加劇,半導體產業便容易陷入與中國大陸廠商殺價競爭之紅海,實為台廠需積極思考與其在競合方面之 差異化策略。

近年中國IC封測指標廠商江蘇長電於2015年以小併大,併購當時全球第四大廠星科金朋(STATS ChipPAC),除了營收直逼全球第三大廠矽品(SPIL),亦取得先進封裝技術WLP、Fan-Out、3D/2.5D IC(TSV)及高階封裝技術Flip Chip、WLCSP、PoP。而南通富士通則併購AMD封測廠,藉此提升高階封測技術自給率。

雖然受到中國封測廠的逐步進逼,台廠為維持長遠競爭力,除了繼續發展高階及先進封裝技術之外,亦看好未來扇出型封裝應用潛力,因為在大面積底的扇出型封裝製程下,每個晶片的封裝成本可大幅度下降,因為大面積的方形載具可以乘載較多的晶片進行封裝,進而可以有較低成本。因此會持續擴增面板級扇出型(Panel Level Fan-Out)封裝產能,帶動先進封測技術由晶圓級(Wafer Level)走向低成本面板級(Panel Level)製程,雖然各家大廠都有自己的技術見解,但低成本與高效能及高整合度的趨勢,仍是不變的大原則。

總體而言,主力廠商與產品群在新年度展現溫和且穩健成長。今年智慧手機登頂後,將開啓世代交替,新科技有如萬馬 奔騰,台灣廠商應持續保持研發動能,才能搶得先機。

(三)技術及研發概況

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用:

單位:新台幣仟元

年度 項目	104年度	105年度	106年截至2月底
營業收入	283,302,536	274,884,107	43,782,629
研發支出金額	10,937,566	11,391,147	1,835,366
研發支出佔營業收入之比率	3.86%	4.14%	4.19%

2. 開發成功之技術或產品:

A. 開發成功之新產品

封裝技術

	New Package
3D系統封裝 (3D SiP)	1. 2.5D晶圓穿導孔矽材基板系統封裝(2.5D Through Silicon Via Interposer System in Package) 2. 3D晶圓穿導孔堆疊系統封裝(3D Through Silicon Via Stacking System in Package) 3. Panel Level覆晶PoP(aMAP Flip Chip PoP) 4. Panel Level銲線PoP(aMAP Wire Bond PoP) 5. 整合被動元件QFN封装(Integrated Passive Device Integrated QFN Package) 6. 基板内埋主被動元件技術(Embedded Active/ Passive Laminate Substrate) 7. 微間距晶片-晶圓堆疊系統技術(Fine Pitch Die-to-Wafer Stacking Technology)
玻璃基材封裝 (PoG)	 晶圓穿導孔玻璃基板封裝(PoG Package with Through Glass Via Solution) 晶圓穿導孔玻璃基板堆疊焊線封裝(PoG Package with Through Glass Via Die Stacking & Wire Bond Technology)
光電封裝 (OEP)	 品圖級微機電/影像感測器封裝(Wafer Level MEMS / CIS Package) 裸晶封膠之指紋感應器封裝技術(Exposed Die Molding Solution for Finger Print Sensor) 微光機電微顯示器封裝(Optical MEMS Microdisplay Package) 高功率LED構裝(High Power LED Package) 電子羅盤磁感應器封裝技術(eCompass Magnetic Sensor Package)
晶圓級 封裝 WLCSP)	 7. 矽晶圓間層封裝(Si Interposer Package) 2. 整合電阻被動元件技術(Integrated Resistor Passive Device) 3. 雙層PI晶圓RDL電鏡銅技術(2-layer PI, Cu-Plated RDL Technology) 4. 疊層晶圓之薄化技術(Bonded Wafer Thinning Technology) 5. 線路重部製程與保護層疊層技術開發(BOT aCSP) 6. 線路重佈製程線寬線距5um/5um技術開發(RDL 5/5um)
覆晶封裝 Flip Chip)	 20奈米銅製程/超低介電係數晶圓之無鉛覆晶封裝(20 nm Cu/ELK Lead Free FC Solution) 40微米微間距覆晶及銲線混合堆疊(40 um Fine Pitch FC & WB Hybrid Stacked Chips Package) 超高密度條狀基板排列製程(Ultra High Density Substrate Strip) 覆晶封裝之封膠Only產品(Flip Chip Package with Mold Only Process) 覆晶封裝之穿越封膠層孔產品(Flip Chip Through Mold Via Package) 單層板内嵌式線路基版封裝研發(1 Layer Embedded Trace Package)
桿線封裝 (Wire Bond Package)	 20奈米銅製程/超低介電係數晶圓之銲線封裝(20 nm Cu/ULK Wafer Wire Bond Package) 銅線BGA/ Lead Frame封裝開發(Cu Wire Bond BGA/ Lead Frame Package) 鋁墊對鋁墊銅線打線技術(Cu Wire Pad to Pad Bonding) 低成本、高效能aS3 / aQFN封裝方案(Low Cost & High Performance aS3 / aQFN) 四方平面無引腳產品於車用電子(FC QFN For ATV) 高散熱材料評估(High Thermal HS Evaluation)
微機電封裝 (MEMS Packaging)	晶圓級微機電封裝技術(Wafer Level MEMS Packaging)
無線射頻模組 Wireless Module)	 低功耗藍芽系統與加速度模組完整方案(BTLE+Accelerator SiP Module Application Solution) 高頻寬Wi-Fi系統模組完整方案(Wi-Fi 11n 2x2 Channel SiP Module Total Solution) 非圓柱覆晶式功率放大器封裝結構(Irregular FC Cu-Pillar PA SiP Module Solution) Advanced Conformal /Compartment式電磁干擾遮蔽方案(Conformal / Compartment EMI Shielding Solution)
無線通訊模組 (Wireless Communication Module)	 高整合度多模多頻3G通訊模組完整方案(Highly Integrated Multi- Modes Multi-Bands Communication Module Solution) 高整合度SiP封裝通訊LTE模組方案(Highly Integrated SiP Module Packaged LTE Module Solution)

	Bumping
電鍍製程 (Plating)	低銀之錫銀無鉛電鍍晶圓凸塊技術(Low Ag of Sn/Ag Lead-Free Bump Plating Technology)

新測試產品

	New Test Product
	1. 高通道密度4線式VI source模組(High Channel Density 4-wire VI Source Module)
	2. 數位I/O & per-pin可程式化量測模組(Digital I/O & PPMU Module)
晶圓測試	3. 光纖模組控制卡(Fiber Module Control Card)
	4. 低壓高速基板Open/Short測試機(Low Voltage & High Speed Substrate Oper/Short Tester)
(Wafer Probing)	5.
	6. 多片晶圓堆疊測試分佈地圖分析軟體(Multiple Wafer Stacked Map Analysis Tool)
	7. 光通訊雷射二極體模塊老化測試
	1. 測試資料分析軟體系統(Test Data Analysis System)
	2. 測試良率監控軟體系統(Yield Monitor System)
	3. Envelop Tracking Module
	4. 高整合型WWAN SiP
後段測試	5. LTE 收發機Module
(Final Testing)	6. Zigbee SiP
	7. GNSS Module
	8. 心律偵測模組
	9. DCT開短路測試機(DCT Open/Short Tester)
	10. 線上即時不良品自動分析報告產生系統(Online Real-time Fail Bin Analysis Report Generation System)
測試設備開發	1. 高密度通道共用轉換板(High Density Channel Sharing Board)
(Test Equipment Development)	2. 高動態時域量測模組(High Swing Time Measurement Module)

測試技術

New Test Technology		
	1. 麥克風晶片(Microphone Device)	
後段測試	2. 光感控制元件(ALS+Prox.Sensor)	
(Final Testing)	3. 微機電震盪器元件(MEMS Oscillator)	
	4. 壓力感測器(Bro-Meter Sensor)	

IGBT標準模組封裝製程技術

IGDI保华侯祖到农委任权例			
	EMS製程技術(New Process Technology)		
晶片焊錫組裝 (Solder Die Bond)	1. 13mm以下晶片焊錫ln-Line組裝能力提高UPH 2. 焊錫介面空隙小於3%		
晶片錫線LF焊錫組裝 (Soft Solder Die Bond to Lead Frame)	1. 5mm以上晶片焊錫ln-Line組裝能力提高UPH 2. 焊錫介面孔洞單個小於2%		
晶片銀膠LF組裝 (Epoxy Die Bond to Lead Frame)	3mm以上晶片焊錫In-Line組裝能力提高UPH		
銅打線LF組裝 (Cu Wire Bonding to Lead Frame)	5um 銅打線In-Line 組裝能力提高UPH		
相變導熱材料印刷 (PCM Printing)	印刷圖案之間距小於0.6mm		
自動點膠製程 (Automation Glue Dispense)	1. 可程式自動偵測housing高度並塗佈均匀 2. 可程式設定各區間之塗佈速度以符合不同設計之housing		
真空灌膠製程 (Vacuum Gel Potting)	 灌注面積33mmx40mm,一次生產32pcs,不會有Void 膠量控制可在+/-0.17g内 		

IGBT標準模組產品全自動Pick & Place測試技術

New Test Technology		
靜態測試技術 (Static Tests Technology) 測試電壓能力: 3KV: 電流能力: 600A		
動態測試技術 (Dynamic Tests Technology)	VD 電壓能力10V~1200V:ID電流能力20A~1200A	

B. 開發成功之新技術

封裝技術

	Advanced Technology
	1. 2.5維晶圓穿導孔晶片堆疊封裝技術(2.5D TSV Stacking)
	2. 3維晶圓穿導孔晶片堆疊封裝技術(3D TSV Stacking)
	3. 整合被動元件封裝技術(Integrated Passive Device)
	4. 薄基板核層覆晶PoP堆疊技術(Thin Core FC PoP Technology)
D系統封裝	5. 微間距晶片-晶圓堆疊系統技術(Fine Pitch Die-to-Wafer Stacking Technology)
3D SiP)	6. 65奈米SRAM晶圓穿孔功能驗證(65 nm SRAMTSV Qualification)
	7. 分段式屏蔽技術(Compartment Shielding Technology)
	8. 選擇性區域封膠技術(Selective Molding Solution)
	9. 晶粒貼合晶圓製程技術(SiP COW)
	10. 晶圓級微機電露晶粒露錫球封裝(Wafer Level MEMS with Exposed Die & Solder Balls)
	1. 雙面電磁屏蔽鏡層技術(EMI Conformal Shielding)
無線通訊模組	2. 雙面模組封裝結構技術(Double Sided molding SiP Module)
Wireless Communication	3. 隔間式屏蔽技術(Compartment Shielding Technology)
Module)	4. 雙面選擇性區域封膠技術(Selective Molding Solution)
光電封裝	1. 微型投影機顯示器功能驗證(Pico Projector Microdisplay Qualification) 2. 高深寬比晶圓穿孔電鏡技術(High Aspect Ratio TSV Plating Technology)
OEP)	
	3. 低成本矽晶圓穿孔技術(Low Cost TSV Technology)
	1. FC PoP雷射燒結技術(FC PoP w/ Laser Ablation Technology)
	2. 雙面RDL電鏡厚銅技術(Double-sided Thick Cu Plated RDL Technology)
	3. 矽材基板内埋主動元件技術(Embedded Active Si Substrate)
	4. 200mm晶圓穿導孔晶圓50微米厚度CMP研磨技術(50 um Wafer CMP Grind Technology for 200mm TSV Wafer)
	5. 200mm穿導孔晶圓50微米厚度分離載具技術(50 um Wafer Carrier Release Technology for 200mm TSV Wafer)
晶圓級封裝	6. 大尺寸(8x8毫米)晶圓級晶片尺寸封裝之可靠度研究與優化
WLCSP)	7. 線路重佈製程和無鉛錫銀電鍍製程疊層技術開發(RDL LF Bump)
	8. 線路重佈製程和銅柱製程疊層技術開發(RD Cu pillar)
	9. 晶背貼合材料技術開發(IR Through BSL)
	10. 薄片晶背貼合能力技術開發(Advanced BSL)
	11. 降低切割製程風險技術開發(Advanced Laser Dicing)
	12. aWLPI(InFO-like) 類InFo 結構
	1. 微間距非導電覆晶薄膜底材(Fine Pitch NCF Under-Fill Technology)
	2. 28奈米超低介電係數晶圓,40 um Bump Pitch之覆晶封裝(40 um Pitch FC Solution for 28 nm ELK Wafer)
	3. 300mm晶圓50微米厚度研磨技術(300mm Wafer 50um Backgrind Technology)
= = ±++#±	4. 壓合式晶圓級覆晶封裝技術(Laminated FC CSP)
夏晶封裝 Elia Chia)	5. 28奈米超低介電系數晶圓與基板內埋式線路封裝產品(28nm Wafer Tech with Embedded Pattern Plating)
Flip Chip)	6. 高頻寬層疊封裝技術
	7. 晶圓級覆晶封裝產品凸塊間距細微化結構發展研究計畫
	8. 2.5D先進封裝製程(2.5D Advanced IC Assembly)
	9. 銀合金線於混合式覆晶球格陣列式封裝技術(Silver Alloy Wire for Hybrid Flip Chip BGA Technology)
	1. 20奈米銅製程/超低介電係數晶圓之銲線封裝(20 nm Ultra Low K Cu Wafer Wire Bond Package)
	2. 18微米線徑銅線打線封裝技術(18 um Cu Wire Bond Technology)
	3. 鋁墊對鋁墊銅線打線技術(Cu Wire Pad to Pad Bonding)
銲線封裝	4. 銅銲線封裝技術(Cu Wire Bond Packaging Technology)
Wire Bond Package)	5. 内埋式線路之基板其開發與應用
	6. 高階四方平面無引腳封裝與測試技術
	7. 細微間距銲線技術
	1. QC080000 緑色環保系統認證(QC080000 Green System Certification) 2. 化學實驗容通過TAC認識(Polls Cortification on Chamical Lab)
Green Package)	2. 化學實驗室通過TAF認證(RoHS Certification on Chemical Lab)

Bumping		
電鍍製程 (Plating)	 40微米微間距銅柱凸塊技術(40 um Fine Pitch Cu Pillar Bumping) 高深寬比銅柱電鍍凸塊技術(High Aspect Ratio Cu Pillar Bumping Plating) 15微米穿導孔填孔技術(15um TSV Filling Plating) 	

測試技術

	New Test Technology
	1. 濕度感測器瓣切帶狀底座測試方法(RHSensor Half Cut Test Method)
	2. 低成本觸控感應元件測試轉換解決方案(Low Cost Touch Sensor Test Conversion)
晶圓測試	3. WLCSP RF-Switch 高效率多工通道阻抗量測技術(High Efficiency Parallel Test of Multi-Channels' Resistance of WLCSP RF-
(Wafer Probing)	Switch)
	4. 低成本電源管理元件晶圓測試技術(Low Cost PMIC Wafer Probing Testing Technology)
	5. 雷射Kink偵測Algorithm
	1. 低成本觸控感應元件測試轉換解決方案(Low Cost Touch Sensor Test Conversion)
	2. 微小封裝元件測試技術(Tiny Package Testing Solutions)
	3. 光感控制元件測試方案(ALS+Prox.SensorTest Solution)
	4. 802.11ac射頻收發器最佳測試解決方案(Test Optimization of 802.11ac Transceiver)
	5. 觸控感測試晶片高產出及低成本開斷路測試解決方法(Touch Sensor IC High UPH and Low Cost O/S Test Solution)
	6. 自動學習崁入式元件產生開短路測試程式技術(Auto-Lean Embedded IC & Generate the Open/Short Test Program Technology)
	7. 電源管理元件高產出平行測試方法(PMIC High UPH Test Methodology)
後段測試	8. 穿戴式裝置系統級封裝模組測試技術(Wearable Device SiP Module Test Technology)
(Final Testing)	9. 高整合度SiP for 穿戴式裝置之測試方案
	10. Golden Unit Test Solution for Zigbee SiP
	11. Simulation-aided Matching Tuning for RF Devices
	12. 低成本測試方法for Envelop Tracking Module
	13. Heart Rate Sensor Testing Algorithm
	14. Univeral Wireless/RF Modular Test System
	15. 物聯網/穿戴式元件之低成本(Non-ATE)測試技術開發(Low Cost Non-ATE Test Methodology For Low I/O Count Device Test,IoT/
	Wearable Devices)
	1. 非同步式指令傳遞自動化測試控制系統(Asynchronous Command Sending Auto-Testing Control System)
測試設備開發	2. 多模組共用整合系統(Multiple Functions and Modules Integration System)
测武权闸用线 (Test Equipment Development)	3. 可程式化V-I 量測模組混用控制介面(Programmable Combo Source-Meter Control Interface)
	4. 串接式模組擴充整合架構(Cascade Data-stream Extended Control Unit in the Integration Core System)
	5. 可程式化數位通道相位對準技術(Programmable I/O Channels Phase Delay Technology)
測試資料分析	1. Substrate疊圖分析-重心偏移偵出演算法(Center of Gravity Offset Detection Algorithm)
(Test Data Analysis)	2. Fast Shmoo-鄰近搜尋演算法(Nearby Searching Algorithm)
	, and the second

IGBT標準模組封裝製程技術

新製程技術(New Process Technology)		
晶片印刷銲錫及LF組裝	1. 5mm以上晶片焊錫ln-Line組裝能力提高UPH	
(Solder Paste Print Die Bond to	 311111及工銀門	
Lead Frame)	2. リープリングに 170	
被動元件印刷銲錫及LF組裝	1. 銲錫一次性印刷及零件組裝至Lead-Frame提高UPH	
(Solder Paste Print Passive	2. 被動元件銲錫組裝至Lead-Frame技術	
Component Bond to Lead Frame)	 ────────────────────────────────────	
鋁打線LF組裝	5mils以上鋁打線In-Line 組裝能力提高UPH	
(Al Wire Bonding to Lead Frame)	SIIIIS以上如分录III-LIIIE 相表化力症同UPT	
LF背面銅散熱片露出及被動元件		
封裝	1. 50µm間隙之被動元件封裝無空隙	
(Passive Component & Expose	2. 背面金屬散熱片露出之封裝技術	
Cu Heatsink Molding)		

COB 模組製程技術

新製程技術(New Process Technology)		
焊線在軟性電路板 1. Ball Bond在120μm板厚的軟性電路板之焊線技術		
(Wire Bonding on FPC) 2. 0.9 mil金線在軟性電路板上焊線良率提升		

IGBT標準模組產品全自動Pick & Place測試技術

New Test Technology		
靜態測試技術	測試電壓能力:3KV:電流能力:600A	
(Static Tests Technology)		
動態測試技術		
(Dynamic Tests Technology)	VD 電壓能力10V~1200V ; ID電流能力20A~1200A	

(四)長、短期業務發展計劃

1. 短期計畫

- 鞏固既有客戶,並爭取更多IDM客戶
- 落實集團生產策略,取得最具優勢之配置
- 争取高階封裝訂單,提昇實質獲利
- 提昇資源運用率並減少資源耗用與浪費
- 提昇環保產品之生產技術,加速產品轉換速度,以提昇市場機會
- 藉由試製開發達到量產

2. 長期計畫

- 整合集團資源,提供客戶更趨完整之服務
- 改善成本結構,提供客戶更具競爭力之價格
- 落實客戶區隔,強化客戶滿意擴大整體生產規模,追求成本優勢,讓價格更具競爭力
- 確保技術領先以提高市佔率

二、市場及產銷槪況

(一) 市場分析

1. 一〇五年度本公司主要商品之銷售地區

單位:新台幣仟元

銷售地區	銷售金額	%
美國	180,745,837	65.75
台灣	38,868,679	14.14
歐洲	23,275,732	8.47
亞洲及其他	31,993,859	11.64
合計	274,884,107	100.00

2. 全球半導體委外封測服務市場占有率2015-2016

	營收(單位:美金百萬元)		
	2015年	2016年	
日月光半導體封測營収	4,769.3	4,878.6	
Outsourced Packaging and Test Market (SATS) 全球半導體委外封裝及測試服務市場	25,529.9	25,882.9	
市場占有率	18.7%	18.8%	

資料來源: 本公司根據Gartner 研究報告自行製表: Forecast: Semiconductor Assembly and Test Services, Worldwide, 4Q16 Update, Analyst(s): Jim Walker, Maria Valenzuela and Barbara Van.

The Gartner Report(s) described herein, (the "Gartner Report(s)") represent(s) data, research opinion or viewpoints published, as part of a syndicated subscription service, by Gartner, Inc. ("Gartner"), and are not representations of fact. Each Gartner Report speaks as of its original publication date (and not as of the date of this Annual Report) and the opinions expressed in the Gartner Report(s) are subject to change without notice.

2016年全球半導體整體委外封測服務市場營收呈小幅成長,ASE市場占有率略為上升至18.8%。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

根據Gartner¹ 近期的研究報告 "Forecast: Semiconductor Assembly and Testing Services, Worldwide, 4Q16 Update",2016年封裝及測試市場,因受全球景氣影響,整體規模49,770.8百萬美元,較2015年僅微幅成長0.8%,預估2017年可大幅成長至53,260.2百萬美元,預測2020年整體營收提升至60,132.9百萬美元。其中,IDM封裝及測試整體規模2016年達23,887.8百萬美元,佔封裝及測試市場整體規模比率為48.0%,預估2017年營收為25,185.2百萬美元,預測2020年將提升至27,603.8百萬美元,佔市場整體規模比率降為45.9%。專業代工封裝及測試市場規模(SATS)方面,封裝及測試市場整體規模2016年達25,882.9百萬美元,佔封裝及測試市場整體規模比率為52.0%,預估2017年將成長至28,075.0百萬美元,預測2020年將持續提升至32,529.1百萬美元,佔市場整體規模比率將高達54.1%。由此數據顯示,國際性IDM廠的封裝及測試委外代工的比率正逐年增加,主要影響因素為消費性電子化所帶來的產品多樣化,使得客製化的封測設計越來越複雜;系統電路板微縮的速度無法與越來越精細的製程同步,而兩者之間僅能靠封裝技術做為橋樑;再加上封裝與測試技術成本及技術層次越來越高,促使封測研發費用隨著上升,因此晶片製造商為了降低成本,更加使得封測外包需求逐漸增加。同時也突顯出IDM大廠越來越不可能自行投入高階封測設備,委外代工趨勢勢必越來越明顯。

全球封裝及測試營收市場預測(單位:美金百萬元)2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
IDM封裝及測試市場規模*	23,887.8	25,185.2	25,796.3	26,744.0	27,603.8
IDM封裝市場規模	19,012.9	19,956.8	20,534.4	21,289.6	21,889.8
IDM測試市場規模	4,874.9	5,228.4	5,261.9	5,454.4	5,714.0
專業代工封測市場規模 (SATS)	25,882.9	28,075.0	29,514.8	30,737.6	32,529.1
專業代工封裝市場規模	20,412.5	22,141.3	23,021.6	23,975.3	25,372.7
專業代工測試市場規模	5,470.5	5,933.8	6,493.3	6,762.3	7,156.4
全球封裝及測試市場整體規模	49,770.8	53,260.2	55,311.1	57,481.6	60,132.9
封裝及測試市場整體規模成長率	0.8%	7.0%	3.9%	3.9%	4.6%
全球封裝市場整體規模	39,425.4	42,098.1	43,556.0	45,264.9	47,262.5
專業代工比率(封裝)	51.8%	52.6%	52.9%	53.0%	53.7%
全球測試市場整體規模	10,345.4	11,162.1	11,755.2	12,216.7	12,870.4
專業代工比率(測試)	52.9%	53.2%	55.2%	55.4%	55.6%
專業代工比率(封裝及測試)	52.0%	52.7%	53.4%	53.5%	54.1%
專業代工市場成長率	1.4%	8.5%	5.1%	4.1%	5.8%

^{*} Equivalent market value if 100% of IDM/OEM in-house packaging and test were outsourced

Note: Numbers may not add to totals shown because of rounding.

Source: Gartner (December 2016)

The Gartner Report(s) described herein, (the "Gartner Report(s)") represent(s) data, research opinion or viewpoints published, as part of a syndicated subscription service, by Gartner, Inc. ("Gartner"), and are not representations of fact. Each Gartner Report speaks as of its original publication date (and not as of the date of this Annual Report) and the opinions expressed in the Gartner Report(s) are subject to change without notice.

此外,近年來隨著工業電器電子技術及數據產業的發展,以及分布式供電系統的推廣,工業電器DC-DC轉換器的應用越來越廣,面對新世代的電子器件和負載,電源業要面對重大的挑戰,產品除了能在工業電器低電壓輸出大電流外,還要做到體積小、重量輕、動態反應快,噪聲小和價錢相宜。

DC-DC轉換器模組市場之發展驅力與DC-DC轉換器IC市場不同。前者為中高功率工業應用,如工具機。後者為低功率消費性產品應用。此兩種產品有其個別之應用範圍,全球DC-DC轉換器模組市場將持續穩定成長。

IGBT下游應用領域非常廣闊,從IGBT的耐壓範圍上來分,600V-1200V的IGBT主要用於電磁爐、壓縮機、馬達、變頻家電等產品,現階段這部分市場的IGBT用量最大:低於600V的IGBT主要用於數位相機閃光燈和汽車點火器上:電壓大於1200V的IGBT主要以1700V的IGBT為主,這部分產品主要用在高壓變頻器等工業產品上。

未來推動IGBT市場增長的最主要領域是變頻器、變頻家電、軌道交通產業、太陽能及風能可再生能源、混合動力車和純電動車。

變頻器產業:變頻器對電機轉速和轉矩進行實時調節,由此可以節約不必要的能源浪費。應用變頻器的電動機節能效

¹ Source: Forecast: Semiconductor Assembly and Test Services, Worldwide, 4Q15 Update, Published: 17 December 2015, Analyst(s): Jim Walker, Maria Valenzuela and Barbara Van.Source: Forecast: Semiconductor Assembly and Test Services, Worldwide, 4Q15 Update, Published: December 2015, A

果明顯,一般節能率在20%-30%,較高的可以超過50%,節能潛力巨大。由於變頻器廣泛應用到機械、油氣鑽採、冶金、石化、電力和市政等領域,具有廣泛的下游應用需求,未來市場將有望保持持續增長,其中,我們預計高壓變頻器未來三年將保持40%以上的增速,而中低壓變頻器未來三年也將保持20%以上的增速。變頻器市場快速的增長,將保證作為變頻器主要原材料的IGBT的需求快速增長。

4. 競爭利基

2017年後整體市場為上揚的趨勢,基於持續精進的信念,本集團更加強及重視内部營運機制,也更著重於先進技術開發 能力提升,期許未來能再創佳績,我們所依賴之各項競爭優勢分析如下:

A. 持續技術研發, 高階產品技術及品質居領導地位

隨著半導體專業代工產業鏈模式,日月光也跟著台積電、聯電等主要晶圓代工不斷往高階產品研發,在技術上能夠日月精進,創造多贏之局面。為了因應產品應用的功能越趨繁多、尺寸越來越小及最佳成本效益等市場需求,本公司在高階封測技術2.5D & 3D IC 、 SiP、CSP、Flip Chip、Bumping、Optical Package及WLP等領域研究多有著墨。

在原有技術精進及先進產品研發方向,本集團每年提撥3~5%的營收在技術研發上,每年獲得超過百項專利,期許保持產業之領先地位及競爭優勢,除了在市佔率領先業界,也必須在技術研發上維持領先同業。

B. 積極佈局, 適時掌握IDM大廠委外代工之商機

目前國際性IDM大廠為維持半導體經營之效率,降低成本,必須朝向Fab Lite型態發展,奠定委外代工比例增加的趨勢。本集團為迎合不斷升溫的半導體委外代工趨勢,多年來的營運策略更為積極,西進大陸佈局,接近客戶,接近市場,以爭取潛在商機。所有的國際大廠都想在中國大陸佔有一席之地,又無法找到較具規模的合作夥伴。如今本公司的佈局,將可能使更多大廠陸續將封測業務外包,不僅不會影響到台灣的基礎,還將帶進更多的商機。

5. 發展遠景之有利/不利因素與因應對策

(1) 有利因素

- 市場對新產品、新技術的需求逐漸增加,對一向在研發創新具備優勢的本公司而言是一大利多機會。
- IDM廠商的經營趨勢,持續釋出封測訂單,未來將持續帶給IC封裝測試產業更大的發揮空間與更多商機。
- 因應未來產品輕薄短小、高性能及高效率的需求,2.5D & 3D IC是非常重要的技術,而本公司早在幾年前已投入非常多的資源進行研發,相關的封裝技術更是領先同業。
- 身為台灣擁有基板產線的封測廠,擁有高階基板穩健的製造能力,不但可掌握高階封裝材料之關鍵,更可有效降低IC的整體製造成本,提高獲利能力。
- 除傳統之BGA、QFP、QFN封裝產品外,更多高階產品如晶片組、繪圖晶片、光電產品、無線通訊模組等相關晶片,以及潛在顧客等皆具有更大更深之市場可供開發。
- 未來幾年中國大陸對積體電路的需求仍會有大幅成長,基於群聚效應、供應鏈原則,本公司已在地理位置及資源運用方面之佈局作好準備,迎接這波成長及搶先商機。
- 卓越的研發技術:卓越的研發技術攸關高科技公司未來之發展,有鑑於此,本公司致力於研發人員之培育,引進先進技術並累積多年經驗,使其研發成果符合客戶的期許:本公司並已取得ISO 9001 品質系統認證及美國軍規認證(MIL -PRF -38534)。
- 管理系統完善:本公司從訂單處理、物料管理、生產管制、現場管理、倉儲系統、出貨作業皆已納入電腦化管理, 充分掌握各項製程數據,並大量採用自動化設備來提升產量,降低生產成本,增加產品競爭力。

(2) 不利因素

- 本土同業競争者對爭取本公司的客戶相當積極:另外,競爭者的聯盟機制亦有可能對本公司產生影響。
- 新技術的門檻逐漸下降,競爭者的模仿能力逐漸提升且產品的獲利週期逐漸縮短,對一向以技術取得優勢的本公司 是一項外在威脅:由於新技術的研發需投入大量的資金與人力,因此在後續價格上的變動彈性相對較弱,在微利時 代下,實為一項挑戰。
- 客戶端對於IC後段封裝、測試之要求水準日益嚴苛,本公司業務成長如要有顯著的表現就必須超越競爭對手及客戶的期待。

- 半導體後段的封裝、測試屬高資本密集產業,因而受到半導體市場景氣影響甚巨,營運的優劣易受景氣所影響;IC 封裝與測試產業需審慎評估投資計畫及人員、機台、資金與技術的規劃,以彈性因應景氣繁榮時所帶來大量的訂單 以及不景氣時訂單減少的衝擊。
- 功率電子領域主要負責DC-DC轉換、AC-DC轉換、電機驅動等工作,需要更輕更小更高效率更便宜,目前有4種技術來對應這些要求,分別是SiliconIGBT、SuperJunction(SJ)MOSFETs、GalliumNitride(GaN) and SiliconCarbide(SiC)-baseddevices.
- GaN和SiC對功率電子市場來說還不成熟,前者要求在製造技術上做技術改進,特別是外延厚度:而後者,目前是一種昂貴的材料,不適合在消費類市場使用。
- 由於大量熱錢進入市場,也促成不少GaN新進業者冒出頭來搶市,積極切入市場。一般來說,發展與測試一種新半 導體材料的時間相當長,但隨著世界各地大廠紛紛投入,很有可能在未來2~3年內就大量出現商用化的GaN產品。
- IGBT功率芯片模組競爭者多目競爭激烈,易形成削價競爭,毛利日益薄利化的趨勢。為減緩因競爭增加所造成公司 獲利下滑的影響,首要增加合作客戶分散風險,並加強成本控制及擴大生產經濟規模為當務之策。

(3) 因應對策

- 利用整合優勢以提供一元化服務、整合集團資源、技術互享以創造更多附加價值及更大的經濟效益,強化競爭優勢 以爭取未來市場蓬勃時更多商機。
- 藉由本公司特有的先進製程與彈性產能以及多元的生產線,滿足客戶更多新產品、新技術以及大量、即時的需求。
- 穩健的財務結構對於發展新技術、新產品所需的資金提供穩定及充足的資源。
- 利用技術優勢改進設計缺失,建立最佳化製程,提升製程穩定性,強化本公司在成本和品質方面的競爭力,爭取最大的市場契機。
- 憑藉本公司先進技術的優勢、資本優勢、資源整合優勢來深耕現有客戶以及爭取更多潛在客源,擴大業務版圖。
- 確切發揮跨廠區先進技術交流及跨部門協調之功能,提高綜效。
- 本公司在材料、封裝、測試及系統方面的垂直整合及橫向鏈結合作,除可鞏固競爭力、提供更完善的服務外,更具備最佳彈性以隨時調整與迎接外在多變的挑戰。
- 持續強化技術優勢,依客戶不同特性提供與滿足客戶多元的需求,提升服務品質的競爭力,同時建立專利防護網, 鞏固競爭利基。
- 提升客戶對本公司一元化服務的訂單比例,加快解決方案整合速度,以最完整的架構提供客戶最快速與滿意的服 發。
- 客製化之行銷服務系統,加強與客戶間策略聯盟之依存關係,以公司現有的研發實力、產品產銷開拓能力,積極架構更具競爭優勢的產、銷、研專業分工之供應鏈體,使公司常保產業關鍵優勢之地位。
- 積極透過製程及設計之改良來提昇品質,滿足客戶多樣化需求,縮短交期,提昇產品競爭力,同時對新市場之客戶 積極開發。
- 除持續深耕於功率芯片模組封裝測試開發,並堅持以高標之技術及產品品質構築同業競爭門檻,以長駐優勢並維持 獲利。
- 供應商(鏈)管理的改善規劃與落實,希望藉由整合上、下游產業價值鏈和合作廠商共同分攤資訊成本,以達成利益 共享,利潤分享,來降低相關產銷成本,提升產品競價力。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途:

封裝技術

主要產品	重要用途
● 塑膠立體型積體電路(PDIP)	• 主要用途在於家電用品、通訊設備、汽車元件、飛機、武器和太空梭等電腦遙控資訊系統、導航 設備。
 塑膠晶粒承載器積體電路(PLCC) 平面型塑膠晶粒承載器積體電路(QFP) 凸塊晶片承載器積體電路(BCC) 覆晶(Flip Chip)封裝技術 超薄平面型塑膠晶粒承載器積體電路(LQFP、TQFP) 球型陣格承載器積體電路(BGA、TFBGA、LBGA) 覆晶式球型陣格承載器積體電路(FC BGA、HFC BGA) 散熱增益球型陣格承載器積體電路(FC BGA、HFC BGA) 超薄球型陣格承載器積體電路(VF BGA) 無引腳型陣格承載器積體電路(LGA) 外露晶片四邊平面形積體電路(Exposed Pad QFP) 散熱增益球型閘車列承載器積體電路(HSBGA) 扁平式無引腳型陣格承載器積體電路(QFN) 	 主要用途在微處理機、通訊設備、自動汽車元件、個人電腦、智慧手機、平板電腦、智慧型手持式裝置等。 無線通訊網路、PDA、數位相機、資訊家電與大哥大等。 個人電腦與筆記型電腦等。 電視遊樂器、DVD、機上盒等。 個人電腦、筆記型電腦、無線通訊網路、PDA、數位相機、資訊家電與智慧手機、智慧型手持式裝置等。 電腦一繪圖/晶片卡、雲端運算伺服器、PCS & 伺服器微處理器、電壓調節器、快速記憶卡、硬碟等週邊產品。 網路通訊產品一廣域(WAN)與區域網路(LAN)伺服器、轉換器、交換器、路由器、蜂巢式基地台。 消費性產品一攝錄影機、數位相機、DVD、電視遊樂器、數位電視機上盒、PDA、MID。 其他產品一自動汽車元件、Telematics。
 種品式晶片尺寸封裝(Flip Chip CSP) 小型晶粒承載器積體電路(SOP、SOJ) 超薄小型晶粒承載器積體電路(TSOP) 晶片尺寸堆疊式球型陣格承載器積體電路(SCSP) 立體式晶片模組承載器積體電路(3D Package) 立體式晶片模組承載器積體電路(2.5D Package) 晶片堆疊式球狀陣格承載器積體電路(Stacked BGA) 多晶片模組球狀陣格承載器積體電路(MCM BGA) 	主要用途在於記憶體積體電路。 個人電腦與週邊裝備等。 主要用途在於記憶體積體電路。 主要用途在於記憶體積體電路。 主要用途在於各種可移動式的資訊產品,例如:手機、PDA、數位相機等。 主要用途在於高階與雲端運算伺服器,例如:圖形處理器、網路處理器等。 筆記型電腦與個人電腦之硬碟等。
 晶圓級晶片尺寸封裝(Wafer Level CSP) 覆晶式晶片尺寸封裝(Flip Chip CSP) 晶圓穿導孔技術(TSV Technology) 整合被動元件(IPD) 矽質基板(Si Interposer) 晶圓級微機電(Wafer level MEMS) 微間距晶片堆疊系統技術(Fine Pitch 3D Chip Stacking Technology) 異質晶片整合系統封裝(Heterogeneous Chip Integration SiP) 微間距面對面堆疊系統封裝(Fine Pitch CoC SiP Solution) 基板内埋主、被動元件技術(Embedded Active / Passive Substrate) 電子羅盤磁感應應器封裝技術(eCompass Magnetic Sensor Package) 	主要應用手機、PDA、數位相機等。 主要應用手機、NB、數位相機等。 主要應用手機、NB/Network、數位相機等。 主要應用穿戴式/可攜式消費性電子,NB/IOT。 主要應用在可攜式消費電子。 主要應用在手機、NB、Network Server。 主要應用在可攜式消費電子。 主要應用在可攜式消費電子。 主要應用在不够、Server、生醫照護。 主要應用在手機、Game Console遊戲機。 主要應用在可攜式消費電子。
 微機電型微顯示器(MEMS-based Micro Display) 安控感測元件 DDR2 800 記憶體(DDR2 800 Memory) 外引腳式Map PoP堆疊技術(Fan-out Map PoP Technology) 外引腳式WLP(Fan-out WLP) 無線通訊模組(Wireless Connectivity SiP Module) 無線通訊模組(Wireless Communication SiP Module) 光通訊模組 	主要應用在投影機(Projector)、高解析數位電視(HDTV)。 主要應用在個人電腦、筆記型電腦、網路商業等安全辨識裝置。 主要應用在3C產品之記憶體。 主要應用在3C產品之系統封裝產品(ASIC + MCP Memory、BB+SDRAM)。 主要應用在可攜式消費電子。 主要應用在可攜式消費電子。 主要應用在3C產品之無線通訊模組包括BT、WiFi、GPS、DVB-H/T。 主要應用在筆記型電腦、個人平板、網通產品、IoT工業產品裝置之通訊應用。 主要應用在光收發模組、雲端伺服器、資料中心及高速運算伺服器之通訊應用。

測試技術

主要產品	重要用途
• 平面型塑膠晶粒承載器積體電路(QFP)	• 主要用途在微處理機、通訊設備、自動汽車元件、個人電腦、手持式通訊模組、晶片組等。
• 凸塊晶片承載器積體電路(BCC)	• 無線通訊網路、數位相機、資訊家電、液晶電視與智慧型行動電話等。
• 覆晶(Flip Chip)封裝技術	• 個人電腦與筆記型電腦等。
超薄平面型塑膠晶粒承載器積體電路(LQFP、TQFP)	• 電視遊樂器、DVD、機上盒等。
球型陣格承載器積體電路(BGA、TFBGA、LBGA)	• 個人電腦、筆記型電腦、無線通訊網路、數位相機、資訊家電與智慧型行動電話等。
• 覆晶式球型陣格承載器積體電路(FC BGA、HFC BGA)	• 手機晶片組、MP3 Processor。
• 散熱增益球型陣格承載器積體電路(TE BGA)	• 消費性產品—攝錄影機、數位相機、DVD、電視遊樂器、機上盒、PDA、MID。
● 超薄球型陣格承載器積體電路(VF BGA)	● 智慧型手機。
• 無引腳型陣格承載器積體電路(LGA)	• 穿戴式隨身產品。
 外露晶片四邊平面形積體電路(Exposed Pad QFP) 	• 平板電腦。
• 散熱增益球型閘陣列承載器積體電路(HSBGA)	• 健康管理系統,醫療應用。
扁平式無引腳型陣格承載器積體電路(QFN)	• 商務應用 NoT 物聯網相關產品。
 進階陣格扁平式無引腳型陣格承載器積體電路(aQFN) 	• 車用安全系統。
• 單層基板(Advance Single Sided Substrate)	• 工業感測元件。
• 系統級封裝(System In Package)	
小型晶粒承載器積體電路(SOP、SOJ)	• 主要用途在於記憶體積體電路。
• 超薄小型晶粒承載器積體電路(TSOP)	• 個人電腦與週邊裝備等。
• 晶片尺寸堆疊式球型陣格承載器積體電路(SCSP)	Power Management IC & Portable Device

電子構裝應用

主要產品	重要用途
DC/DC Converter Module IGBT、IPM標準模組封裝	用於軍事用途的航空器或載具上之電力系統,對於產品品質及可靠度上有較高的要求:產製 過程則以Die bond & Wire bond之電子構裝應用為主。
• COB模組封裝	 用於電動車,智能家電產業,產製過程則以SMT、Die Bond、Wire bond、PressFIT Insertion及灌膠之封裝技術為主。 用於各種產業包括通訊、醫療、光電或需要微小化產品等;產製過程則以 SMT、Die Bond、Wire Bond、Encapsulation之封裝技術為主。

2. 產製過程:

封裝技術

• 釘架類產品:

晶圓切割→粘晶粒→打金線→封模→正印→外腳成型→外觀檢驗→包裝

• 球陣列類產品:

晶圓切割→粘晶粒→打金線→封模→正印→植錫球→切割成型→外觀檢驗→包裝

• 覆晶類產品:

晶圓凸塊→晶圓切割→覆晶式粘晶粒→底膠充填→正印→植錫球→外觀檢驗→包裝

• 晶圓穿導孔類產品:

晶圓穿導孔→穿導孔絶緣層→穿導孔銅電鍍充填→穿孔晶圓薄化→雙面佈銅導線→植錫球→堆疊→外觀檢驗→包裝

• 無線通訊模組 (Wireless Connectivity SiP Module):

錫膏印刷→元件置放→高溫迴焊→封膠製程→雷射正印→切割成型→抗電磁鍍膜→外觀檢驗→包裝

測試技術

• 釘架類產品/球陣列類產品:

IC測試→產品老化測試(依客戶需求)→烘烤→產品外觀檢驗→捲帶包裝→成品包裝

• 高頻模組產品/電源管理模組產品:

測試系統選擇→開發程式→驗證及除錯→試產→量產

電子構裝應用

• DC/DC converter模組

材料準備→錫膏/銀膠印刷→晶片黏著→基片黏著(回銲)→打線→零件置放→手銲→清洗→雷射修整→上蓋材料準備→外 觀檢驗→銲封→高低溫循環→離心測試→異物測試→功能測試→燒機→浸錫→包裝出貨

• IGBT標準模組

材料準備→晶片貼合→晶片切割→錫膏印刷(Reflow)→晶粒置放→零件置放(Soldering)→真空回銲→清洗→打線→中間 測試→插端子Preparation →外蓋組裝→烘烤→注膠→烘烤→最後測試Detection (PIND) TEST →散熱膏印刷→烘烤→包 裝出貨

• IPM標準模組

材料準備→晶片貼合→晶片切割→晶粒置放(Solder Die)→晶粒置放(Epoxy Die)→烘烤→銅打線→灌膠→烘烤→最後測試→烘烤→包裝出貨

• COB標準模組

材料準備→錫膏印刷→零件置放→回銲(Reflow) →清洗→晶片切割→晶粒置放(Epoxy Die)→烘烤→清洗→打線→封膠→烘烤→功能測試→包裝出貨

(三)主要原料之供應狀況

本公司係代客封裝之半導體製造業,主要晶圓由客戶提供,客戶大都為國際知名半導體公司,長期與本公司保持良好的業 務關係。

主要封裝材料如: 釘架、基板、金線、銅線、膠餅等,供應商皆為本公司品管審查合格之績優廠商,尤其基板的主要供應來源為子公司日月光半導體(上海)有限公司(ASEMTL SH)及日月光電子(股)公司(ASEE),使得材料的取得可完全掌握。

主要原物料名稱	供應來源	市場狀況	採購策略
基板 Substrate	ASEMTL SH/ ASEE /A公司/B公司/C公司/D公司	供需平衡	長期配合廠商
釘架 Lead Frame	E公司/F公司/G公司	供需平衡	長期配合廠商
金線 Gold Wire	H公司/I公司/J公司	供需平衡	長期配合廠商
銅線 Copper Wire	K公司/J公司	供需平衡	長期配合廠商
膠餅 Compound	E公司/L公司/D公司	供需平衡	長期配合廠商

南投分公司係代客組裝之電子產品製造業,90%以上的材料均由客戶提供,主要客戶為M公司、N公司及O公司,長期與本公司保持良好的業務關係。

- M公司主要組裝材料如下:
- 1.90%以上主要材料:金屬封裝盒、基板、DICE、CHIP C、CHIP R等材料由客戶提供,物料供應則為客戶直接供應,使得材料的交期及品質可完全掌握。
- 2. 10% 自購料: 膠材、包裝材料、金線、金額由本公司視客戶訂單需求採購。

主要原物料名稱	供應來源	市場狀況	採購策略
基板 Substrate	M公司	良好	由客戶自行備料
金屬盒Metal Package	M公司	良好	由客戶自行備料
DICE	M公司	良好	由客戶自行備料
CHIP C \ CHIP R	M公司	良好	由客戶自行備料

• N公司主要組裝材料如下:

99%以上主要材料: 基板、LCP substrate、Flex PCB、膠材、塑膠件等材料均由客戶直接供應,使得材料的交期及品質可完全掌握。包材部份由本公司視客戶需求購買。

主要原物料名稱	供應來源	市場狀況	採購策略
基板LCP Substrate	N公司	供需平衡	由客戶自行備料
膠材Die Attach Film	N公司	供需平衡	由客戶自行備料
DICE	N公司	供需平衡	由客戶自行備料
Flex PCB	N公司	供需平衡	由客戶自行備料
Plastic Parts	N公司	供需平衡	由客戶自行備料

• O公司主要組裝材料如下:

- 1. 20%以上主要材料: 晶圓包括DICE、CHIP、IGBT材料由客戶直接供應,使得材料的交期及品質可完全掌握。
- 2.80%自購料:陶瓷基板、塑膠殼、金屬端子、銅柱、錫膏、膠材、鋁線、包裝材料,供應商乃客戶指定,由本公司視客 戶訂單需求採購。

主要原物料名稱	供應來源	市場狀況	採購策略
晶圓 Wafer	O公司	良好	由客戶自行備料
陶瓷基板 DBC	P公司	良好	長期配合廠商
塑膠殼Case	Q公司	良好	長期配合廠商
鋁線Al wire	R公司	良好	長期配合廠商
膠材Silicone gel	S公司	良好	長期配合廠商

(四)最近二年度任一年度曾佔進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例

1. 佔銷貨百分之十以上之客戶名稱

單位:新台幣仟元

	105年度					104年度			
排名	名稱	金額	佔全年度銷貨 淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	佔全年度銷貨 淨額比率(%)	與發行人之關係	
1	甲公司	66,554,659	24.2	無	甲公司	88,311,697	31.2	無	
	其他	208,329,448	75.8		其他	194,990,839	68.8		
	銷貨淨額	274,884,107	100.0		銷貨淨額	283,302,536	100.0		

增減變動原因:銷貨金額與比率變動主要隨客戶市佔率變化而異。

2. 佔進貨百分之十以上之進貨廠商

單位:新台幣仟元

		105	 年度			104	年度	
排名	名稱	金額	佔全年度進貨 淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	佔全年度進貨 淨額比率(%)	與發行人之關係
1	AA公司	15,258,798	11.0	無	AA公司	22,842,407	14.5	無
	其他	124,014,121	89.0		其他	135,158,159	85.5	
	進貨淨額	139,272,919	100.0		進貨淨額	158,000,566	100.0	

(五)最近二年度生產量值表

單位:仟個/新台幣仟元

年度		105年度		104年度			
生產量值主要商品	產能	產量	產值	產能	產量	產値	
先進封裝及積體電路	33,418,693	31,526,461	87,111,435	36,603,997	27,604,076	76,764,334	
測試服務(註1)	-	-	16,447,138	-	_	15,495,568	
電子產品構裝技術暨製造服務	689,769	454,547	103,326,488	708,773	595,142	128,007,739	
其他(註2)	_	-	14,804,827	-	_	12,899,667	
合計	34,108,462	31,981,008	221,689,888	37,312,730	28,199,218	233,167,308	

註1:係以測試時間為計價基礎,故擬不揭露數量。

註2:因數量單位不一致,亦不揭露數量。

(六)最近二年度銷售量值表

單位:仟個/新台幣仟元

年度		105	 年度			10/1	 年度	
銷售量値				***	104年度			
	内	銷	外 銷		内 銷		外 銷	
主要商品	量	値	量	値	量	値	量	値
先進封裝及積體電路打線服務	7,146,182	27,619,935	24,380,279	85,218,711	4,494,130	22,859,220	23,109,946	80,876,366
測試服務(註1)	_	2,670,055	-	23,395,140	_	1,650,805	_	22,485,594
電子產品構裝技術暨製造服務	64,650	7,493,851	389,897	106,931,939	56,610	7,350,445	538,532	129,996,914
其他(註2)	_	1,084,838	-	20,469,638	_	770,679	_	17,312,513
合計	7,210,832	38,868,679	24,770,176	236,015,428	4,550,740	32,631,149	23,648,478	250,671,387

三、從業員工資料

(一)組織

本集團基於能維持有利的競爭市場,培育優秀的工程人力資源,健全集團組織職能制度、確定組織功能及培養職務生涯等是刻不容緩的首要策略。

(二)最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料:

î	 	104年度	105年度	106年2月28日
	技術職人員	17,198	17,422	17,447
	管理職人員	3,698	3,824	3,785
員工人數	事務職人員	6,201	5,811	5,822
	作業員	38,692	39,654	38,871
	合計	65,789	66,711	65,925
平均年歲		31.1	32.2	32.4
平均服務年資		5.2	5.6	5.7
	博士	0.2	0.2	0.2
	碩士	6.8	6.9	7.0
學歷分布比率	大專	46.3	46.5	47.6
	高中	38.9	37.1	35.8
	高中以下	7.8	9.3	9.4

四、環保支出資訊

- (一)說明最近年度及截至年報刊印日止,公司因污染環境所受損失(包括賠償)、處分之總額、未來因應對策及可能之支出。
 - 106年度:截至年報刊印日止,本公司無重大環境污染事件發生。
 - 105年度:

A.高雄總公司

高雄K15廠:

於105年4月12日因高雄市政府環保局於105年3月10日依違反水汙染防治法第21條第2項之規定,茲依法裁罰罰鍰新臺幣1萬2千元整。改善措施與未來因應對策:立即將專責人員調派,全職於掛證廠區及專責人員出勤E化管制,未依規定出勤系統派報提醒。

高雄K7廠:

於105年6月22日因高雄市政府環保局於103年6月19日依違反水汙染防治法第7條第1項之規定,茲依法裁罰罰鍰新臺幣14萬元整。改善措施與未來因應對策:廢水處理功能提升,水質符合放流水標準及設置放流水水質連線傳輸監測。

高雄K22廠:

於105年7月22日因高雄市政府環保局於105年6月28日依違反空氣污染防治法第24條第2項之規定,茲依法裁罰 罰鍰新臺幣10萬元整。改善措施與未來因應對策:建立空污連續監測系統判讀及法規認知說明宣導。

高雄K11廠:

於105年1月26日因高雄市環保局於104年12月18日依違反毒性化學物質許可登記核可辦法第8條第2項之規定,茲依法裁罰罰鍰新臺幣6萬元整。改善措施與未來因應對策:環保許可系統建立財務資訊與基本資料比對功能,即時回饋變更資訊,以通知廠區做許可變更。(同上年度年報104年度高雄K11廠之揭露)

高雄K22廠:

於105年7月19日因高雄市環保局於105年7月7日依違反毒性化學物質許可登記核可辦法第8條第2項之規定,茲依法裁罰罰鍰新臺幣6萬元整。改善措施與未來因應對策:環保許可系統建立財務資訊與基本資料比對功能,即時回饋變更資訊,以通知廠區做許可變更。

高雄K11廠:

於105年11月29日因高雄市環保局於105年8月18日依違反廢棄物清理法第12條之規定,茲依法裁罰罰鍰新臺幣 2,400元整。改善措施與未來因應對策:要求各廠區嚴格落實垃圾分類,避免資源回收物混入生活垃圾中。

B.中壢分公司

中壢分公司:

於105年3月28日因桃園縣政府環保局於105年3月25日函文,中壢分公司因違反水污染防治法第7條第1項,茲依 法裁罰罰鍰新臺幣14.7萬元整。未來因應對策: 凡環保局入廠採樣,即同步採樣並送第三方公正單位進行比測。

105年度處分之總額計52.14萬元。

(二) 說明目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競争地位及資本支出之影響及其未來年度預計之重大環保資本支出。 出。

項目	一〇六年度	一〇七年度
—————————————————————————————————————		
37.5110 07.1131001170	1. ISO14001環境管理系統持續驗證	1. ISO14001環境管理系統持續驗證
	2. 持續配合ISO14064溫室氣體管理系統運作,進行溫室氣體減量	2. 持續配合ISO14064溫室氣體管理系統運作,進行溫室氣體減量
	3. 推動本公司產品生態化設計(eco-design)	3. 推動本公司產品生態化設計(eco-design)
	4. 持續推行 ISO 50001 能源管理系統	4. 持續推行 ISO 50001 能源管理系統
	 5. 持續推行產品碳足跡及水足跡之盤查及查證	5. 持續推行產品碳足跡及水足跡之盤查及查證
	6. 結合台灣永續創新論壇,持續致力推動本公司永續發展	6. 結合台灣永續創新論壇,持續致力推動本公司永續發展
	7. 持續推動搭乘大衆捷運系統減少耗能與CO2減量	7. 持續推動搭乘大衆捷運系統減少耗能與CO2減量
	8. 節能產品導入與節能工程改善	8. 節能產品導入與節能工程改善
	9. 廢水防治設備清理與改善,並強化廢水回收量與效益	9. 廢水防治設備清理與改善,並強化廢水回收量與效益
	10. 提升中水回收廠回收率及回收	10. 提升中水回收廠回收率及回收
	11. 廢水處理砂塔、活性碳塔濾料更換	11. 廢水處理砂塔、活性碳塔濾料更換
	12. 高效率污染防制設施建置	12. 高效率污染防制設施建置
	13. 集塵設備濾材更換	13. 集塵設備應材更換
	14. 廢氣防制設備填充料更換與VOC減量	14. 廢氣防制設備填充料更換與VOC減量
	15. 廢棄物減廢、減量與回收再利用	15. 廢棄物減廢、減量與回收再利用
	16. 污泥減重、減量與金屬成份回收再利用	16. 污泥減重、減量與金屬成份回收再利用
(1) 改善計劃	17. 化學品使用量最佳化 18. 周界臭味防範	17. 化學品使用量最佳化 18. 周界臭味防範
	18. 向乔夹体的影	18. 闷乔吴咻奶呢 19. 緊急應變訓練與演練
	20. 噪音防制強化	20. 噪音防制強化
	21. 2017年工安環保月活動	21.2018年丁安環保月活動
	22. 新設廢氣洗滌塔	22. 新設廢氣洗滌塔
	23. 新設集塵機	23. 新設集塵機
	24. 既設高級氧化處理設備保養	24. 既設高級氧化處理設備保養
	25. 考量新設空污防制最佳可行處理設備	25. 考量新設空污防制最佳可行處理設備
	26. 新設廢水回收系統	26. 新設廢水回收系統
	27. 包裝材重複使用	27. 包裝材重複使用
	28. 汙水收集系統	28. 汙水收集系統
	29. 排氣收集系統	29. 排氣收集系統
	30. 污泥減量計劃導入	30. 污泥減量計劃導入
	31. 既設廢氣洗滌塔填充料更換	31. 既設廢氣洗滌塔填充料更換
	32. 既設沸石轉輸設備保養	32. 既設沸石轉輪設備保養
	33. 新設製程廢水處理系統	33. 新設製程廢水處理系統
	34. 相關設施維護保養	34. 相關設施維護保養
	1. 各部門自發性改善方案推動	1. 各部門自發性改善方案推動
	2. 廢水/廢氣防治設備新增與改善	2. 廢水/廢氣防治設備新增與改善
	3. 低頻噪音防制工程	3. 低頻噪音防制工程
	4. 環保設備汰換	4. 環保設備汰換
	5. 週遭環境線美化	5. 週遭環境級美化
	6. 廢棄物回收推動及減量設備建置	6. 廢棄物回收推動及減量設備建置
(2) 未來二年預計環保資本	7. 使用省電燈具及綠色能源導入 8. 能源管理監控系統設置	7. 使用省電燈具及綠色能源導入
支出擬購置之污染設備	8. 能源音连监控光机故画 9. 中水回收系統改善及擴充	8. 能源管理監控系統設置 9. 中水回收系統改善及擴充
或支出内容	9. 中小凹収光机以普及頒允	10. 廢氣洗滌塔
	11. 高級氧化處理設備	11. 高級氧化處理設備
	12. 最佳空污防制可行處理設備	12. 最佳空污防制可行處理設備
	13. 集塵機	13. 集塵機
	14. 廢水回收、過濾、蒸餾設備	14. 廢水回收、過濾、蒸餾設備
	15. 污泥乾燥設備	15. 污泥乾燥設備
	16. 既設沸石轉輪設備	16. 既設沸石轉輪設備
	1. 減少耗能與CO2減量	1. 減少耗能與CO2減量
	2. 防範周界臭味	2. 防範周界臭味
	3. 延長設備使用壽命	3. 延長設備使用壽命
		4. 廢水/廢棄物/空污污染減量及資源回收
五十九 ≠ ⊯ π/	4. 廢水/廢棄物/空污污染減量及資源回收	4. 殷小/殷果彻/王/7/7未减重义复添单以
預計改善情形	4. 廢水/廢棄物/空污污染減量及資源回收5. 降低周界噪音	5. 降低周界噪音
預計改善情形		
預計改善情形	5. 降低周界噪音	5. 降低周界噪音
預計改善情形	5. 降低周界噪音 6. 減少能源耗用	5. 降低周界噪音 6. 減少能源耗用
預計改善情形	5. 降低周界噪音 6. 减少能源耗用 7. 提昇作業環境舒適度	5. 降低周界噪音6. 减少能源耗用7. 提昇作業環境舒適度

項目	一〇六年度	一〇七年度
(3) 改善後之影響		
對淨利之影響	約增加NT\$45,490仟元	約增加NT\$45,490仟元
對競爭地位之影響	企業社會責任與永續發展。對環境友善的環保政策提昇公司之企業 形象,符合廣大投資人對於公司永續發展的目標。	企業社會責任與永續發展。對環境友善的環保政策提昇公司之企業 形象,符合廣大投資人對於公司永續發展的目標。
未採取因應對策部分	不適用	不適用

五、勞資關係

(一)員工福利措施

本公司體認勞資一體的關係,於民國105年6月28日股東會決議,除自每年所得盈餘中提撥5.25%~8.25%作為員工酬勞外,另全面改善福利文康設施,舉凡圖書館、社團活動、年度旅遊、文康競賽等,使得全廠員工均有調劑身心的機會,並加強有關員工福利及勞資關係的措施如下:

- 全面改善廠房的安全衛生以保持清潔舒適的環境。
- 定期或不定期勞資溝通會議。
- 成立廠區環境安全衛生委員會。
- 成立福利委員會辦理各項員工福利。
- 自助餐廳及福利社。
- 結婚禮金、喪葬津貼、住院慰問金及獎助學金。
- 完善的退休制度。
- 員工健康檢查。
- 股票及現金紅利。
- 三節福利金發放。
- 員工旅遊及多元商品選購。
- 因公出差員工享有旅行平安保險1,500萬元。
- 國定假日趸費供餐。
- 設有職工休閒健身中心。
- 設有員工健康診所及健檢中心。
- 員工認股權憑證。
- 女性員工集乳室。
- 多元社團活動。

(二)員工進修及其實施情形

- 員工在職進修取得相關科系學歷者,可參加學歷升級考試,並予以實質調薪鼓勵。
- 提供員工建教合作學校管道,辦理「職訓局」雙軌訓練旗艦計劃。

(三)員工訓練及其實施情形

- 提供新進員工職前引導訓練、專業訓練及新人評鑑。
- 設計與執行主管管理技能訓練與職能發展。
- 設計與執行工程師專業技術訓練。
- 提供在職人員專業技能與第二專長訓練(OJT)。

- 培育公司内部專業講師與訓練師。
- 設計與執行工安環保相關訓練。
- 提供員工參與外訓或研討會。
- 本公司訂定「外訓暨證照補助管理辦法」,提供員工外訓(部門派外受訓)以及證照(個人自主學習補助)之補助,目的為提高員工素質且鼓勵員工自主學習,於工作之餘進修培養專業技術,強化個人專業職能,充實業務相關技能,並利用外部訓練資源提升技能以彌補内訓之不足。除訂定審核與課後回饋機制,結合外訓與出差電子申請系統,以達有效管理與外訓制度之推行。
- 自主學習補助每人兩年內依職等補助金額最多2~10萬元,採課後補助原則。證照需求提出並核可後,員工考取證照即可檢具相關證明申請補助。
- 日月光於104年正式加入電子產業公民聯盟(Electronic Industry Citizenship Coalition, EICC) ,公司秉持著EICC準則及永續經營的理念,也為推動日月光與供應商共創永續供應鏈,105年度持續執行人員供應鏈教育訓練,落實EICC準則。目前日月光高雄廠區受過EICC訓練之人員已超過2萬人,並已建立每年至少複訓一次的機制,定期更新最新法規訊息予員工。
- 日月光自104年成立第一屆企業大學,結合各領域頂尖專家與教授,提供高階主管一流的教學團隊。105年提供訓練課程包含策略發展、經營管理、團隊管理等方向,培育50名高階主管,總訓練人時積3,241小時。
- 本公司105年度員工訓練費用合計新台幣21,597,350元。
- 本公司與財務資訊透明有關人員,其取得主管機關指明之相關證照情形如下:本公司內部稽核人員取得會計師考試及格證書計有二人、國際內部稽核師協會所核發之國際內部稽核師證書者計有一人,國際電腦稽核協會所核發之國際電腦稽核師證書者計有一人。
- 本公司105年度舉辦之課堂訓練開班數達 1,400班次以上(含數位課程),參與訓練總人次約145,000人,訓練總人時積 400.000/小時。
- 本公司105年度提供之訓練課程類別如下:

新進人員訓練:包括新進人員到職前之訓練、基礎訓練及到職引導。

通識性訓練:係指政府法令規定、公司政策要求等之訓練課程。

職能別訓練:係指公司各單位所需之專業技能之訓練。

(四)退休制度及實施情形

- 本公司自民國七十五年十一月起即遵照勞動基準法訂定勞工退休辦法,並設立勞工退休準備金監督委員會,為選擇舊制退休金辦法之員工及選擇適用新制退休金辦法之原有員工的舊制保留年資,按原員工退休辦法退休金給付標準計算提撥適額之退休準備金至台灣銀行專戶。符合退休資格人員之退休金計算方式,悉由勞工退休準備金監督委員會依勞基法之規定辦理。
- 本公司自民國九十四年七月起即遵照勞工退休金條例訂定之勞工新制退休辦法,每月依員工薪資6%提撥退休金至勞工 保險局之個人專戶中,另員工亦得在每月薪資6%範圍內,個人自願另行提繳退休金,勞工個人自願提繳部分,得自當 年度個人綜合所得總額中全數扣除。勞工於年滿60歲即可於個人退休金專戶請領退休金。
- 退休條件:工作滿十五年以上,年齡與工作年資合計滿七十以上者,得自請退休。
- 為退休員工精心製作之退休紀念品,表達對員工多年貢獻的感謝之意。

(五)勞資協議情形

 本公司遵循相關法規,維護員工權益,設有書面及電子化員工溝通管道,且各廠均定期召開員工座談會,員工可透過上 述管道與公司進行雙向溝通,以維持勞資雙方良好和諧之互動,並確保員工之各項權益獲得公平合理的處理,無重大勞 資糾紛之情事。

(六)各項員工權益維護措施

- 本公司均依勞基法及各項勞動法規執行員工管理政策,並隨時依據法令更新內部管理規定,保障員工權益。
- 依性別工作平等法,提供性別平權及無性騷擾的工作環境。
- 建立各項員工定期溝通機制,以維持勞資雙方良好之關係。
- 本公司105年度平均薪酬調整情形:本公司政策為每年持續穩定地為直間接員工年度調薪。

(七)工作環境與員工人身安全之保護措施(本公司為保護員工免於受職業傷害所做之措施)

- OHSAS18001及TOSHMS台灣職安衛管理系統持續驗證。
- 持續運作廠區安全衛生績效評核,辦理年度安全衛生優良廠區頒獎。
- 落實各部門危害鑑別與風險評估及強化各部門安全衛生改善方案。
- 推動高風險機台安全防護全面符合SemiS2標準。
- 新建廠主/被動式消防系統設計導入FM(Factory Mutual)規定,提升廠房消防安全防護能力。
- 強化承攬商協議組織運作,成立協議組織委員會提升雙向溝通,結合承攬商安全衛生評核機制,辦理年度優良承攬商頒獎。
- 承攬商中央門禁安全管理系統全面導入。
- 輔導主要及高風險作業承攬商建構自主安全衛生管理系統,並全面通過OHSAS18001查證。
- 建構環境友善設計與物流人因工程評估,改善搬運及精密作業人因性傷害。
- 提升廠區整體母性安心氛圍,溫馨舒適環境營造。
- 中央供藥與廢液清運作業安全防護提升。
- 強化作業安全防護,人員安全防護器具舒適性全面提升。
- 廠區工安/環保緊急應變鑑測。
- 封測產業SDS(物質安全資料表)標準化推動。
- 持續推動EICC電子電機產業社會行為準則管理規範並完成查證。
- 舉辦健康促進活動及廠區主要出入口AED全面設置。
- 舉辦機台安全及消防/緊急應變工安月活動。

(八)各項員工工作守則及倫理原則

- 與主管有不同看法時,以「對事不對人」的態度,選擇適當時間、地點,與主管誠懇的溝通,勿在訪客或他人面前強烈的表示不同的意見。
- 會議須準時參加,不克出席應事先請代理人出席,並說明需準備之文件資料,並同時知會會議主持人。
- 與廠商開會若有跨越中晚餐時間,可以幫廠商代訂便當,再向公司報帳,勿與廠商外出交際應酬。
- 嚴禁私自攜帶公司產品、零件、貨品出加工區,出廠區物品務須配合保稅放行單,未依規定辦理者,經查獲依相關法令 處理。
- 尊重公司名譽,凡涉及公司任何事項,未經許可,不得擅自對外發佈個人意見。
- 培養誠實與負責任的文化,在公司所有的營業活動上應遵循最高道德標準的承諾。
- (九)最近年度及截至年報刊印日止公司因勞資糾紛所遭受之損失(包括目前及未來可能發生之估計金額及因應措施):無。

六、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要内容	限制條款
聯貸契約	花旗銀行等16家銀行	2013.07-2018.07	美金長借契約	財務比率限制等
專利契約	FUJITSU LIMITED	1998.04.13-2017.04.12	專利授權	於合約終止或取消五年內,不得洩露本合約條款和 條件予第三者(保密條款)
專利契約	FLIP CHIP INTERNATIONAL, LLC. (FOC/RDL)(ULCSP)	2008.03.07-所授權專利技術屆期為止	專利授權	於合約期滿前,不得洩露本合約條款和條件予第三 者(保密條款)
專利契約	Mitsui High-tec, Inc.	2007.06.25-2017.06.24	專利授權	於合約期滿前,不得洩露本合約條款和條件予第三 者(保密條款)
專利契約	Infineon Technologies AG	2007.11.06-2017.11.05	專利授權	於合約期滿前,不得洩露本合約條款和條件予第三 者(保密條款)
專利契約	Infineon Technologies AG	2013.04.11-所授權專利屆期為止	專利授權	不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
專利契約	矽品精密工業股份有限公司暨其關係 企業	2009.05.10-所授權專利屆期為止	專利授權	不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
專利契約	STATs Chippac Ltd.	2012.01.01-2016.12.31	專利授權	不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
土地租賃契約	經濟部加工出口區管理處	2013.02.01-2035.12.31	土地租賃	於租約有效期間内,不得轉作與業務不相關之用, 且依約執行付款
技術與專利契約	TDK Corporation	2015.12.3-與TDK SESUB技術相關之 專利權與專門知識均消滅為止	技術與專利契 約	不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
技術移轉與授權 契約	DECATECHNOLOGIES INC.	2016.01.13-2026.01.13	技術與專利契 約	不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

1. 簡明資產負債表及綜合損益表資料-IFRSs

(1)合併簡明資產負債表

單位:新台幣仟元

	年度		E E	最近五年度財務資料(註1)	
順		105年 (2013年版IFRSs)	104年 (2013年版IFRSs)	103年 (2013年版IFRSs)	102年 (2010年版IFRSs)	101年 (2010年版IFRSs)
流動資產		142,789,659	156,732,840	159,955,190	132,176,482	97,495,577
備供出售金融資產-非	非流動	1,028,338	924,362	941,105	1,140,329	1,096,709
採權益法之投資		49,824,896	37,141,552 (註2)	1,492,441	1,216,201	1,177,871
不動產、廠房及設備		143,880,241	149,997,075	151,587,115	131,497,331	127,197,774
無形資產		12,119,867	11,888,612	11,913,286	11,953,644	12,361,269
其他資產		8,300,078	8,321,759	8,095,630	8,829,919	8,380,569
資產總額		357,943,079	365,006,200 (註2)	333,984,767	286,813,906	247,709,769
流動負債	分配前	104,475,866	120,502,072	111,199,467	100,835,276	84,668,133
派勤 貝頂	分配後	(註3)	132,978,851	126,789,292	110,991,281	92,656,107
非流動負債		84,119,837	76,365,603	64,347,296	58,813,671	52,089,877
負債總額	分配前	188,595,703	196,867,675	175,546,763	159,648,947	136,758,010
具具秘観	分配後	(註3)	209,344,454	191,136,588	169,804,952	144,745,984
歸屬於母公司業主之權	霍益	157,355,206	156,634,647 (註2)	150,218,907	123,020,621	107,430,340
股本		79,568,040	79,185,660	78,715,179	78,180,258	76,047,667
資本公積		22,265,049	23,757,099	16,013,058	7,908,870	5,262,129
保留盈餘	分配前	64,698,204	55,902,712(註2)	52,381,238	38,993,154	30,938,400
休 再 益 助	分配後	(註3)	43,425,933	36,791,413	28,837,149	22,950,426
其他權益		(1,883,574)	5,081,689	5,068,539	(102,554)	(2,858,749)
庫藏股票		(7,292,513)	(7,292,513)	(1,959,107)	(1,959,107)	(1,959,107)
非控制權益		11,992,170	11,503,878	8,219,097	4,144,338	3,521,419
權益總額	分配前	169,347,376	168,138,525(註2)	158,438,004	127,164,959	110,951,759
1年1117市公司	分配後	(註3)	155,661,746	142,848,179	117,008,954	102,963,785

註1:a.最近五年度財務報告均由會計師查核簽證。

b.最近五年度均未曾辦理資產重估。

註2:截至105年12月31日止,本公司已完成投資成本與所享有矽品公司可辨認資產及負債之淨公允價值份額間差額之辨識,並追溯調整104年度財務報告。

註3:截至年報刊印日止,本公司一〇六年股東常會尚未召開,是以分配後金額暫不填列。

(2)個體簡明資產負債表

單位:新台幣仟元

	 年度		Ē	曼近五年度財務資料(註1)	
項目	+皮	105年 (2013年版IFRSs)	104年 (2013年版IFRSs)	103年 (2013年版IFRSs)	102年 (2010年版IFRSs)	101年 (2010年版IFRSs)
流動資產		29,936,189	32,132,019	41,483,018	37,009,050	17,849,645
備供出售金融資產-非	流動	285,359	473,107	542,147	592,557	521,999
採權益法之投資		201,327,705	189,712,813(註2)	139,053,527	117,942,583	109,255,920
不動產、廠房及設備		78,375,027	80,375,695	77,640,995	63,122,172	58,271,665
無形資產		1,978,879	1,614,309	1,444,812	1,352,379	1,338,972
其他資產		1,131,758	1,353,638	1,562,646	1,327,293	1,629,169
資產總額		313,034,917	305,661,581(註2)	261,727,145	221,346,034	188,867,370
流動負債	分配前	79,681,924	91,305,117	68,567,745	49,159,136	42,827,937
加到兵員	分配後	(註3)	103,781,896	84,157,570	59,315,141	50,815,911
非流動負債		75,997,787	57,721,817	42,940,493	49,242,041	38,609,093
負債總額	分配前	155,679,711	149,026,934	111,508,238	98,401,177	81,437,030
只良秘的	分配後	(註3)	161,503,713	127,098,063	108,557,182	89,425,004
股本		79,568,040	79,185,660	78,715,179	78,180,258	76,047,667
資本公積		22,265,049	23,757,099	16,013,058	7,920,220	5,262,129
保留盈餘	分配前	64,698,204	55,902,712(註2)	52,381,238	38,906,102	30,938,400
体用甾邸	分配後	(註3)	43,425,933(註2)	36,791,413	28,750,097	22,950,426
其他權益		(1,883,574)	5,081,689	5,068,539	(102,616)	(2,858,749)
庫藏股票		(7,292,513)	(7,292,513)	(1,959,107)	(1,959,107)	(1,959,107)
權益總額	分配前	157,355,206	156,634,647(註2)	150,218,907	122,944,857	107,430,340
1年11年11年11年11年11年11日	分配後	(註3)	144,157,868(註2)	134,629,082	102,788,852	99,442,366

註1:a.最近五年度財務報告均由會計師查核簽證。

b.最近五年度均未曾辦理資產重估。

註2:截至105 年12 月31 日止,本公司已完成投資成本與所享有矽品公司可辨認資產及負債之淨公允價值份額間差額之辨識,並追溯調整104 年度財務報告。

註3:截至年報刊印日止,本公司一〇六年股東常會尚未召開,是以分配後金額暫不填列。

(3)合併簡明綜合損益表

單位:新台幣仟元

年度	最近五年度財務資料(註1)							
順	105年 (2013年版IFRSs)	104年 (2013年版IFRSs)	103年 (2013年版IFRSs)	102年 (2010年版IFRSs)	101年 (2010年版IFRSs)			
營業收入	274,884,107	283,302,536	256,591,447	219,862,446	193,972,392			
營業毛利	53,194,219	50,135,228	53,588,529	42,813,744	36,619,812			
營業淨利	26,708,503	24,884,622	29,645,869	22,044,323	17,687,085			
營業外收入及支出	1,332,769	122,274 (註2)	(1,097,658)	(2,687,631)	(1,102,770)			
稅前淨利	28,041,272	25,006,896 (註2)	28,548,211	19,356,692	16,584,315			
繼續營業單位本期淨利	22,949,899	20,167,650 (註2)	24,281,585	16,155,040	13,523,583			
本年度淨利	22,949,899	20,167,650 (註2)	24,281,585	16,155,040	13,523,583			
本年度其他綜合損益(稅後淨額)	(7,959,259)	(147,547)	5,503,510	3,238,026	(3,823,690)			
本年度綜合損益總額	14,990,640	20,020,103(註2)	29,785,095	19,393,066	9,699,893			
淨利歸屬於母公司業主	21,680,339	19,197,516(註2)	23,636,522	15,689,074	13,066,075			
淨利歸屬於非控制權益	1,269,560	970,134	645,063	465,966	457,508			
綜合損益總額歸屬於母公司業主	14,312,892	19,124,449 (註2)	28,802,296	18,798,923	9,301,863			
綜合損益總額歸屬於非控制權益	677,748	895,654	982,799	594,143	398,030			
每股盈餘(稀釋)	2.37	2.41(註2)	2.96	2.03	1.71			

註1: a.最近五年度財務報告均由會計師查核簽證。

(4)個體簡明綜合損益表

單位:新台幣仟元

年度	最近五年度財務資料(註1)						
順	105年 (2013年版IFRSs)	104年 (2013年版IFRSs)	103年 (2013年版IFRSs)	102年 (2010年版IFRSs)	101年 (2010年版IFRSs)		
營業收入	99,190,777	94,206,807	96,678,100	82,329,117	72,926,652		
營業毛利	24,141,551	25,147,806	29,376,669	22,264,748	18,324,545		
營業淨利	12,071,310	13,892,786	18,278,988	12,936,797	10,653,147		
營業外收入及支出	11,669,820	8,259,209(註2)	7,882,138	4,458,346	3,906,755		
稅前淨利	23,741,130	22,151,995(註2)	26,161,126	17,395,143	14,559,902		
繼續營業單位本期淨利	21,680,339	19,197,516(註2)	23,636,522	15,689,074	13,066,075		
本年度淨利	21,680,339	19,197,516(註2)	23,636,522	15,689,074	13,066,075		
本年度其他綜合損益(稅後淨額)	(7,367,447)	(73,067)	5,165,774	3,109,849	(3,764,212)		
本年度綜合損益總額	14,312,892	19,124,449(註2)	28,802,296	18,798,923	9,301,863		
每股盈餘(稀釋)	2.37	2.41(註2)	2.96	2.03	1.71		

註1:a.最近五年度財務報告均由會計師查核簽證。

最近五年度會計師查核意見

年度	會計師姓名	會計師姓名	查核意見
一○五	陳珍麗	江佳玲	無保留意見
一○四	陳珍麗	江佳玲	修正式無保留意見
-0≡	陳珍麗	江佳玲	無保留意見
-0=	陳珍麗	龔俊吉	無保留意見
-0-	陳珍麗	龔俊吉	無保留意見

b.最近五年度均未曾辦理資產重估。

註2:截至105年12月31日止,本公司已完成投資成本與所享有矽品公司可辨認資產及負債之淨公允價值份額間差額之辨識,並追溯調整104年度財務報告。

b.最近五年度均未曾辦理資產重估。

註2:截至105年12月31日止,本公司已完成投資成本與所享有矽品公司可辨認資產及負債之淨公允價值份額間差額之辨識,並追溯調整104年度財務報告。

二、最近五年度財務分析

1. 最近五年度合併及個體財務分析-IFRSs

(1)合併財務分析

		最近五年度合併財務分析(註1)						
分析項目	中 辰	105年 (2013年版IFRSs)	104年 (2013年版IFRSs)	103年 (2013年版IFRSs)	102年 (2010年版IFRSs)	101年 (2010年版IFRSs)		
D-17/7/0+1## (0/)	負債占資產比率	52.69	53.94(詿2)	52.56	55.66	55.21		
財務結構(%)	長期資金占不動產、廠房及設備比率	176.17	156.25(註2)	141.05	141.43	128.18		
	流動比率	105年	115.15					
償債能力(%)	速動比率	91.53	87.09	101.06	93.47	73.86		
	利息保障倍數	13.65	12.02(註2)	13.28	9.58	9.27		
	應收款項週轉率(次)	5.72	5.79	5.34	5.45	5.70		
	平均收現日數	64	63	68	67	64		
	存貨週轉率(次)	4.69	5.01	5.14	5.29	5.06		
經營能力	應付款項週轉率(次)	6.34	6.71	6.30	6.65	6.93		
	平均銷貨日數	78	73	71	69	72		
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	1.87	1.88	1.81	1.70	1.62		
	總資產週轉率(次)	0.76	0.81	0.83	0.82	0.82		
	資產報酬率(%)	6.86	6.31(註2)	8.44	6.75	6.42		
	權益報酬率(%)	13.60	12.35(註2)	17.01	13.57	12.76		
獲利能力	税前純益占實收資本比率(%)	35.24	31.58(註2)	36.27	24.76	21.81		
	純益率(%)	8.35	7.12(註2)	9.46	7.35	6.97		
	每股盈餘(元)(稀釋)	2.37	2.41(註2)	2.96	2.03	1.71		
	現金流量比率	49.88	47.76	41.25	40.95	39.02		
現金流量(%)	現金流量允當比率	99.85	90.08	84.73	84.88	85.05		
	現金再投資比率	8.42	9.39	8.80	9.56	9.27		
現金流量(%)	營運槓桿度	2.15	2.24	1.94	2.21	2.38		
1共1千/支	財務槓桿度	1.09	1.10	1.09	1.11	1.13		

說明最近二年度各項財務比率變動原因:(若增減變動未達20%者可発分析)

最近二年度各項財務比率增減變動未達20%,故免分析變動原因。

註1:請詳P74~75之註1~註7。

註2:截至105年12月31日止,本公司已完成投資成本與所享有矽品公司可辨認資產及負債之淨公允價值份額間差額之辨識,並追溯調整104年度財務報告。

(2)個體財務分析

	年度	最近五年度個體財務分析(註1)						
分析項目			104年 (2013年版IFRSs)	103年 (2013年版IFRSs)	102年 (2010年版IFRSs)	101年 (2010年版IFRSs)		
D+7/74++#(0/)	負債占資產比率	49.73	48.76	42.60	44.44	43.12		
財務結構(%)	長期資金占不動產、廠房及設備比率	289.11	258.78	241.94	264.50	243.78		
	流動比率	37.57	35.19	60.50	75.28	41.68		
償債能力(%)	速動比率	31.48	30.70	53.66	67.45	32.89		
	利息保障倍數	15.44	20.49	27.36	22.64	21.29		
	應收款項週轉率(次)	5.53	4.98	5.37	6.48	7.05		
	平均收現日數	66	73	68	56	52		
	存貨週轉率(次)	17.79	17.07	16.90	16.73	15.99		
經營能力	應付款項週轉率(次)	8.97	8.69	8.68	8.06	7.43		
	平均銷貨日數	21	21	22	22	23		
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	1.27	1.17	1.25	1.30	1.25		
	總資產週轉率(次)	0.31	0.33	0.37	0.37	0.39		
	資產報酬率(%)	7.45	7.10	10.13	7.97	7.60		
	權益報酬率(%)	13.81	12.51	17.31	13.62	12.63		
獲利能力	税前純益占實收資本額比率(%)	29.84	27.97	33.24	22.25	19.15		
	純益率(%)	21.86	20.38	24.45	19.06	17.92		
	每股盈餘(元)(稀釋)	2.37	2.41(註7)	2.96	2.03	1.71		
	現金流量比率	38.10	36.26	36.53	40.73	49.20		
現金流量(%)	現金流量允當比率	87.33	89.33	89.77	100.88	108.02		
	現金再投資比率	5.37	5.81	5.54	5.06	8.20		
槓桿度	營運槓桿度	2.32	2.11	1.73	1.86	1.85		
1月1千1文	財務槓桿度	1.16	1.09	1.06	1.07	1.07		

註1:最近年度財務報告均由會計師查核簽證。

註2: 財務分析項目之計算公式如下:

計算公式:

- 1. 財務結構
 - (1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。
 - (2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債) / 不動產、廠房及設備淨額。
- 2. 償債能力
 - (1)流動比率=流動資產/流動負債。
 - (2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
 - (3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。
- 3. 經營能力
 - (1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)遇轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
 - (2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。
 - (3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
 - (4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
 - (5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。
 - (6)不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。
 - (7)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。
- 4. 獲利能力
 - (1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/平均資產總額。
 - (2)權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。
 - (3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。
 - (4)每股盈餘=(歸屬與母公司業主之損益-特別股股利) / 加權平均已發行股數。(註3)
- 5. 現金流量
- (1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
- (2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。
- (3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利) / (不動產、顧房及設備毛額+長期投資+其他非流動資產+營運資金)。(註4)
- 6. 槓桿度:
 - (1)營運槓桿度 = (營業收入淨額-變動營業成本及費用) / 營業利益(註5)。
 - (2)財務槓桿度=營業利益 / (營業利益-利息費用)。

註3:上開每股盈餘之計算公式,在衡量時應特別注意下列事項:

- 1. 以加權平均普通股股數為準,而非以年底已發行股數為基礎。
- 2. 凡有現金增資或庫藏股交易者,應考慮其流通期間,計算加權平均股數。
- 3. 凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者,在計算以往年度及半年度之每股盈餘時,應按增資比例追溯調整,無庸考慮該增資之發行期間。
- 4. 若特別股為不可轉換之累積特別股,其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質,在有稅後淨利之情況,特別股股利應自稅後淨利減除;如為虧損,則不必調整。

- 註4:現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項:
 - 1. 營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
 - 2. 資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
 - 3. 存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入,若年底存貨減少,則以零計算。
 - 4. 現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
 - 5 .不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。
- 註5:發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動,如有涉及估計或主觀判斷,應注意其合理性並維持一致。
- 註6:公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者,前開有關占實收資本比率計算,則改以資產負債表歸屬於母公司業主之權益比率計算之。
- 註7:截至105 年12 月31 日止,本公司已完成投資成本與所享有矽品公司可辨認資產及負債之淨公允價值份額間差額之辨識,並追溯調整104年度財務報告。追溯調整後每股盈餘為 2.41元。

三、最近年度財務報告之監察人或審計委員會審查報告

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一〇五年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等,其中財務報表業經委託勤業衆信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上,敬請鑒核。

日月光半導體製造股份有限公司

審計委員會召集人:

清洁~~



中華民國一〇六年三月三十日

四、最近年度財務報告:

關係企業合併財務報告聲明書

本公司民國105年度(自105年1月1日至12月31日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第10號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同,且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露,爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱:日月光半導體製造股份有限公司

董事長:張虔生





中華民國一〇六年三月十三日

會計師查核報告

日月光半導體製造股份有限公司 公鑒:

查核意見

日月光半導體製造股份有限公司及其子公司(以下稱「日月光集團」)民國105年及104年12月31日之合併資產負債表,暨民國105及104年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表,以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段),上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製,足以允當表達日月光集團民國105年及104年12月31日之合併財務狀況,暨民國105及104年1月1日至12月31日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範,與日月光集團保持超然獨立,並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據,以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對日月光集團民國105年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已 於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應,本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對日月光集團民國105年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下:

商譽減損評估

日月光集團於民國105年12月31日商譽為新台幣(以下同)10,558,878千元,佔合併資產總額3%。管理階層依照國際會計準則公報第36號「資產減損」規定每年底進行商譽減損測試,即比較包含受攤商譽之現金產生單位其帳面價值是否有重大超過其可回收金額之情形。

日月光集團之商譽主要來自測試部門,管理階層於評估商譽是否減損時,估計包含受攤商譽之現金產生單位之可回收金額係以使用價值為計算基礎。為計算使用價值,公司需估計未來5年現金流量及以持平之成長率1.5%外推其後之現金流量,並使用加權平均資金成本率予以折現計算而得。由於該等假設涉及管理階層之主觀判斷,且可能受未來半導體測試產業市場景氣影響,具有估計之高度不確定性。因是,本會計師將日月光集團測試部門商譽之減損評估考量為本年度關鍵查核事項之一。

商譽之減損評估相關揭露資訊,請參閱合併財務報告附註四(十)、五及十五。

本會計師針對管理階層評估商譽是否減損時,所估計之未來營運現金流量及加權平均資金成本率使用之重大會計判斷、估計及假設,執行主要查核程序如下:

- 詢問並檢視相關文件,以了解管理階層估計測試部門未來營運展望所預測之營收成長率、利潤率及預估現金流量之過程 及依據。
- 2. 計算以前年度營收估列與實際達成情形、比較管理階層估列之未來營收成長率與相關產業預測報告之差異,以評估管理 階層估計之未來營收成長率是否合理。
- 3. 採用本所財務顧問專家以協助評估管理階層於估計使用價值時所採用之加權平均資金成本率,包括無風險報酬利率、波動性及風險溢酬該等假設,是否與公司現行及所屬產業情況相符,並重新執行與驗算。
- 4. 針對重要假設,包括營收成長率及加權平均資金成本率,查詢管理階層執行敏感度分析之流程及文件資料並重新計算, 以評估該等重要假設之變動是否有相當可能使測試部門之帳面價值重大超過其可回收金額。

取得重大之關聯企業其無形資產之辨認及評價

日月光集團陸續取得矽品精密工業公司(矽品)共33.29%股權,計48,790,498千元;民國105年12月31日對矽品採用權益法 之投資餘額為45,884,727千元,占合併資產總額13%,對整體合併財務報告係屬重大。管理階層依據國際財務報導準則規 定,於收購日起一年內完成投資成本與所享有矽品可辨認資產及負債之淨公允價值份額間差額之辨識。

管理階層於辨識投資成本與所享有矽品可辨認資產及負債之淨公允價值份額間差額,需評估有形資產之公允價值、可能產生之無形資產類型及該等無形資產未來可能產生之營運現金流量或節省之費用支出等。由於該等假設涉及管理階層之主觀判斷,可能受未來半導體產業景氣之影響,具有高度不確定性,且該等無形資產依照估計經濟效益年限攤銷會影響日月光集團採用權益法認列關聯企業損益之份額。因是,本會計師考量上述差額辨識過程中有關無形資產之辨認及評價為關鍵查核事項之一。

與投資矽品相關會計政策、會計估計及假設之不確定性估計與攸關揭露資訊,請參閱附註四(八)、五及十三。

本會計師除了解管理階層辨認及評價無形資產之過程外,尚執行之主要查核程序如下:

- 1. 針對管理階層於辨認及評價無形資產過程中所使用之外部評價專家,詢問並評估其專業能力、適任能力及客觀性。
- 2. 採用本所財務顧問專家執行攸關程序以評估管理階層所使用之外部評價專家出具之收購價格分攤報告内所辨認出矽品應有之無形資產項目、使用之評價方法與所採用假設(包括未來營業收入、折現率及估計耐用年限),及評價模型計算過程與結果之合理性。
- 3. 評估所辨識出無形資產之耐用年限衡量依據並核算本年度採用權益法認列關聯企業綜合損益之份額其調整數之允當性, 並查核合併財務報告是否依循國際財務報導準則規範已適當調整以前年度比較報表及揭露相關資訊。

其他事項

列入上開合併財務報告中,有關採用權益法之被投資公司矽品之合併財務報告係由其他會計師查核。因此,本會計師對上開合併財務報告出具之查核報告中,有關矽品合併財務報告所列金額及揭露資訊,係依據其他會計師之查核報告。民國105年及104年12月31日對矽品採用權益法之投資餘額分別為45,884,727千元及35,141,701千元,占合併資產總額分別為13%及10%;民國105及104年度對矽品採用權益法認列關聯企業損益之份額分別為1,755,091千元及129,580千元,占各年度合併淨利分別為8%及1%。

日月光半導體製造股份有限公司業已編製民國105及104年度之個體財務報告,並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案,備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際 會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告,且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制,以確保合併 財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時,管理階層之責任亦包括評估日月光集團繼續經營之能力、相關事項之揭露、以及繼續經營會計基礎之採用,除非管理階層意圖清算日月光集團或停止營業,或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

日月光集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的,係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信,並 出具查核報告。合理確信係高度確信,惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重 大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所 作之經濟決策,則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時,運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作:

- 1. 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所評估之風險設計及執行適當之因應對策;並取得 足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或逾越内部控制,故 未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 對於查核攸關之內部控制取得必要之了解,以設計當時情況下適當之查核程序,惟其目的非對日月光集團內部控制之有效性表示意見。

- 3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4. 依據所取得之香核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性,以及使日月光集團繼續經營之能力可能產生重大 疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性,作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性,則須於查核 報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露,或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之 結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致日月光集團不再具有繼續經營之能力。
- 5. 評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及内容,以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6. 對於集團内組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件 之指導、監督及執行,並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制 顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明, 並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對日月光集團民國105年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查 核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定 事項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公衆利益。

勤業衆信聯合會計師事務所

會計師 陳珍麗



金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第1010028123號

會計師 江佳玲





證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第0920123784號

中華民國106年3月13日

日月光半導體 一方 合併資產負債 民國105年及104年12月3

		105年12月31	日	104年12月31日(調整後)		
代碼	資產	金額	%	金額	%	
	流動資產					
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 38,392,524	11	\$ 55,251,181	15	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動(附註四及七)	3,069,812	1	3,833,701	1	
1125	備供出售金融資產-流動(附註四及八)	266,696	_	30,344	_	
1170	應收帳款淨額(附註四及九)	51,145,557	14	44,931,487	13	
1200	其他應收款(附註四)	665,480	_	429,541	_	
1220	本期所得稅資產(附註四及二四)	471,752	_	168,717	_	
1310	存貨(附註四及十)	21,438,062	6	23,258,279	6	
1320	存貨-營建房地(附註四、十一、二三及三四)	24,187,515	7	25,713,538	7	
1476	其他金融資產-流動(附註四、十二及三四)	558,686	_	301,999	_	
1479	其他流動資產	2,593,575	1	2,814,053	1	
11XX	流動資產合計	142,789,659	40	156,732,840	43	
	非流動資產					
1523	備供出售金融資產-非流動(附註四及八)	1,028,338	1	924,362	_	
1550	採用權益法之投資(附註四、五及十三)	49,824,896	14	37,141,552	10	
1600	不動產、廠房及設備(附註四、、十四、二三及三五)	143,880,241	40	149,997,075	41	
1805	商譽(附註四、五及十五)	10,558,878	3	10,506,519	3	
1821	其他無形資產(附註四、十六、二三及三三)	1,560,989	_	1,382,093	_	
1840	遞延所得稅資產(附註四及二四)	4,536,924	1	5,156,515	2	
1980	其他金融資產-非流動(附註四、十二及三四)	1,320,381	_	345,672	_	
1985	長期預付租金(附註十七)	2,237,033	1	2,556,156	1	
1990	其他非流動資產	205,740		263,416		
15XX	非流動資產合計	215,153,420	60	208,273,360	57	

 1XXX
 資產總計
 \$ 357,943,079
 100
 \$ 365,006,200
 100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。 (參閱勤業衆信聯合會計師事務所民國106年3月13日查核報告)

單位:新台幣干元

		105年12月31	н	104年12月31日(調整後)	
代碼	負債及權益	金額	" %	金額	% %
1 4 200	流動負債				
2100	短期借款(附註十八)	\$ 20,955,522	6	\$ 32,635,321	9
2110	應付短期票券(附註十八)	=	_	4,348,054	1
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債 - 流動(附註四及七)	1,763,660	_	3,005,726	1
2170	應付帳款	35,803,984	10	34,138,564	9
2219	其他應付款(附註二十)	21,522,034	6	19,194,818	5
2230	本期所得稅負債(附註四及二四)	4,352,642	1	4,551,785	1
2312	預收房地款(附註四)	60,550	_	2,703,706	1
2321	一年內到期之應付公司債(附註四及十九)	9,658,346	3	14,685,866	4
2322	一年内到期之長期借款(附註十八及三四)	6,567,565	2	2,057,465	1
2399	其他流動負債	3,791,563	1	3,180,767	1
21XX	流動負債合計	104,475,866	29	120,502,072	33
	非流動負債				
2530	應付公司債(附註四及十九)	27,341,557	8	23,740,384	7
2540	長期借款(附註十八及三四)	46,547,998	13	42,493,668	12
2570	遞延所得稅負債(附註四及二四)	4,856,549	2	4,987,549	1
2640	淨確定福利負債(附註四及二一)	4,172,253	1	4,072,493	1
2670	其他非流動負債	1,201,480	_	1,071,509	_
25XX	非流動負債合計	84,119,837	24	76,365,603	21
2XXX	負債總計	188,595,703	53	196,867,675	54
	歸屬於本公司業主之權益(附註四及二二)				
	股本				
3110	普通股股本	79,364,735	22	79,029,290	22
3140	預收股本	203,305	_	156,370	_
3100	股本總計	79,568,040	22	79,185,660	22
3200	資本公積	22,265,049	6	23,757,099	7
	保留盈餘(附註十三)				
3310	法定盈餘公積	14,597,032	4	12,649,145	3
3320	特別盈餘公積	3,353,938	1	3,353,938	1
3350	未分配盈餘	46,747,234	13	39,899,629	11
3300	保留盈餘總計	64,698,204	18	55,902,712	15
3400	其他權益	(1,883,574)		5,081,689	1
3500	庫藏股票	(7,292,513)	(2)	(7,292,513)	(2)
31XX	歸屬於本公司業主之權益總計	157,355,206	44	156,634,647	43
36XX	非控制權益(附註四及二二)	11,992,170	3	11,503,878	3
3XXX	權益總計	169,347,376	47	168,138,525	46
3X2X	負債及權益總計	\$ 357,943,079	100	\$ 365,006,200	100





單位:新台幣干元,惟每股盈餘為新台幣元

氏國105及1	大図105反104年1月1日 至12月 月日		单位: 新古幣十元,惟母版甾畴局新百 105年度 104年度(調整後)				
代碼					_	金額	%
4000	營業收入(附註四)	\$	274,884,107	100	\$	283,302,536	100
5000	營業成本(附註十及二三)		221,689,888	81		233,167,308	82
5900	營業毛利		53,194,219	19		50,135,228	18
	巡坐 建口()::						
6100	營業費用(附註二三) 推銷費用		3,432,487	1		3,588,472	1
6200	管理費用		11,662,082	4		10,724,568	4
6300	研究發展費用			4			
			11,391,147	9		10,937,566	9
6000	營業費用合計		26,485,716			25,250,606	9
6900	營業淨利		26,708,503	10		24,884,622	9
	營業外收入及支出						
7010	其他收入(附註二三)		640,843	_		876,008	_
7020	其他利益(損失)(附註二三)		1,424,657	1		1,437,036	1
7050	財務成本(附註二三)	(2,261,075)	(1)	(2,312,143)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益份額(附註四)		1,528,344	_		121,373	_
7000	營業外收入及支出合計		1,332,769			122,274	
7900	稅前淨利		28,041,272	10		25,006,896	9
7950	所得稅費用(附註四及二四)		5,091,373	2		4,839,246	2
8200	本年度淨利		22,949,899	8		20,167,650	7
	其他綜合損益						
8310	不重分類至損益之項目:						
8311	確定福利計畫之再衡量數	(417,181)	_	(62,911)	_
8320	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	(49,794)	_	(37,748)	_
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	,	73,637	_	,	11,002	_
8310	六 1 主力 私た 坂口 II 開た II I I II II I I I I I I I I I I	(393,338)		(89,657)	
8360	後續可能重分類至損益之項目						
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(6,445,643)	(2)	(63,509)	_
8362	備供出售金融資產未實現評價(損)益	(248,599)	_		10,451	_
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	(871,679)		(4,832)	
8360		(7,565,921)	(2)	(57,890)	
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)		7,959,259)	(2)		147,547)	
8500	本年度綜合損益總額	\$	14,990,640	6	\$	20,020,103	7
8600	淨利歸屬於:						
8610	本公司業主	\$	21,680,339	8	\$	19,197,516	7
8620	非控制權益		1,269,560	_		970,134	_
8600		\$	22,949,899	8	\$	20,167,650	7
-		_	,2		_	,,	

		 105年度		104年度(調整後)		後)
代碼		 金額	%		金額	%
8700	綜合損益總額歸屬於:					
8710	本公司業主	\$ 14,312,892	6	\$	19,124,449	7
8720	非控制權益	677,748			895,654	
8700		\$ 14,990,640	6	\$	20,020,103	7
	每股盈餘(附註二五)					
9750	基本每股盈餘	\$ 2.83		\$	2.51	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 2.37		\$	2.41	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(參閱勤業衆信聯合會計師事務所民國106年3月13日查核報告)

董事長:張虔生



會計主管:郭宏銘





歸屬於本公司業主之權益

		普通股	股本		保	留盈餘
代碼	·	股數(千股)	金額	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積
A1	104年1月1日餘額	7,861,725	\$ 78,715,179	\$ 16,013,058	\$ 10,289,878	\$ 3,353,938
C5	發行可轉換公司債認列權益組成部分(附註					
	十九)		_	214,022		
C7	採用權益法認列關聯企業及合資之變動數		_	150		
D1	104年度淨利(調整後)	-	_	_	_	_
D3	104年度稅後其他綜合損益	_	_	_	_	_
D5	104年度綜合損益總額	_	_	_	_	
	103年度盈餘指撥及分配					
B1	提列法定盈餘公積	_	_	_	2,359,267	_
B5	普通股現金股利	_	_	_	_	_
	-					
L1	庫藏股買回		_		2,359,267	
M1	發放予子公司股利調整資本公積			292,351		
M5	取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額					
	(附註二八)			7,197,510		
M7	對子公司所有權權益變動	-	_	(564,344)	_	
N1	股份基礎給付交易	48,703	470,481	604,352	_	_
01	子公司股東現金股利	_	_	_	_	_
01	子公司員工認股權	_	_	_	_	_
A1	104年12月31日餘額(調整後)					
	(附註十三)	7,910,428	79,185,660	23,757,099	12,649,145	3,353,938
C7	採用權益法認列關聯企業及合資之變動數			51,959		
D1	105年度淨利	_	_	_	_	-
D3	105年度稅後其他綜合損益					
D5	105年度綜合損益總額		_			
	104年度盈餘指撥及分配					
B1	提列法定盈餘公積	_	_	-	1,947,887	-
B5	普通股現金股利					
		_	_	_	1,947,887	
M1	發放予子公司股利調整資本公積		_	233,013		
M5	取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額					
	(附註二八)			(20,552)		
M7	對子公司所有權權益變動(附註二八)			(1,912,887)		
N1	股份基礎給付交易	35,756	382,380	600,737		
01	取得子公司所增加之非控制權益(附註二七)					
01	子公司股東現金股利					
01	子公司員工認股權			(444,320)		
Z1	105年12月31日餘額	7,946,184	\$ 79,568,040	\$ 22,265,049	\$ 14,597,032	\$ 3,353,938

後附之附註係本合併財務報告之一部分。 (參閱勤業衆信聯合會計師事務所民國106年3月13日查核報告)

歸屬於本公司業主之權益

保留盈餘 財務報表換算 :	61,341 61,341	合計 \$ 5,068,539 13,150 13,150	(\$	車藏股票 1,959,107) 5,333,406)	((((總計 155,942,087 214,022 150 19,197,516 73,067) 19,124,449 — 15,589,825) 15,589,825) 5,333,406) 292,351	\$	#控制權益 8,219,097 ————————————————————————————————————	((((權益總額 158,438,004 214,022 150 20,167,650 147,547) 20,020,103 15,589,825) 15,589,825) 5,333,406) 292,351
未分配盈餘 合計 之兌換差額 未 \$38,737,422 \$52,381,238 \$4,541,761 \$ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	*實現損益 526,778 - - - 61,341 61,341 - - - - - -	\$ 5,068,539 13,150 13,150	_	1,959,107)	(((()	155,942,087 214,022 150 19,197,516 73,067) 19,124,449 — 15,589,825) 15,589,825) 5,333,406) 292,351		8,219,097 — — 970,134 74,480)	((((158,438,004 214,022 150 20,167,650 147,547) 20,020,103 — 15,589,825) 15,589,825) 5,333,406)
\$38,737,422 \$52,381,238 \$ 4,541,761 \$	5 526,778 61,341 61,341	\$ 5,068,539 13,150 13,150	_	1,959,107)	((((155,942,087 214,022 150 19,197,516 73,067) 19,124,449 — 15,589,825) 15,589,825) 5,333,406) 292,351		8,219,097 — — 970,134 74,480)	((((158,438,004 214,022 150 20,167,650 147,547) 20,020,103 — 15,589,825) 15,589,825) 5,333,406)
	61,341 61,341		(\$	- - - - - - - -	(((()	214,022 150 19,197,516 73,067) 19,124,449 — 15,589,825) 15,589,825) 5,333,406) 292,351	(970,134 74,480)	((((214,022 150 20,167,650 147,547) 20,020,103 — 15,589,825) 15,589,825) 5,333,406)
(86,217) (86,217) (48,191) 19,111,299 19,111,299 (48,191) (2,359,267) — — (15,589,825) — — (17,949,092) (15,589,825) — — —	61,341	13,150 - - - - - - -		- - - - - - 5,333,406)	((((((((((((((((((((150 19,197,516 73,067) 19,124,449 — 15,589,825) 15,589,825) 5,333,406) 292,351	(74,480)	((((150 20,167,650 147,547) 20,020,103 — 15,589,825) 15,589,825) 5,333,406)
(86,217) (86,217) (48,191) 19,111,299 (48,191) (2,359,267) — — (15,589,825) (15,589,825) — (17,949,092) (15,589,825) — — — — <td>61,341</td> <td>13,150 - - - - - - -</td> <td></td> <td></td> <td>((((((((((((((((((((</td> <td>150 19,197,516 73,067) 19,124,449 — 15,589,825) 15,589,825) 5,333,406) 292,351</td> <td>(</td> <td>74,480)</td> <td>((</td> <td>150 20,167,650 147,547) 20,020,103 — 15,589,825) 15,589,825) 5,333,406)</td>	61,341	13,150 - - - - - - -			((((((((((((((((((((150 19,197,516 73,067) 19,124,449 — 15,589,825) 15,589,825) 5,333,406) 292,351	(74,480)	((150 20,167,650 147,547) 20,020,103 — 15,589,825) 15,589,825) 5,333,406)
(86,217) (86,217) (48,191) 19,111,299 (48,191) (2,359,267) — — (15,589,825) (15,589,825) — (17,949,092) (15,589,825) — — — — <td>61,341</td> <td>13,150 - - - - - - -</td> <td>(</td> <td>- - - - - 5,333,406)</td> <td>((((((((((((((((((((</td> <td>19,197,516 73,067) 19,124,449 — 15,589,825) 15,589,825) 5,333,406) 292,351</td> <td>(</td> <td>74,480)</td> <td>(((</td> <td>20,167,650 147,547) 20,020,103 — 15,589,825) 15,589,825) 5,333,406)</td>	61,341	13,150 - - - - - - -	(- - - - - 5,333,406)	((((((((((((((((((((19,197,516 73,067) 19,124,449 — 15,589,825) 15,589,825) 5,333,406) 292,351	(74,480)	(((20,167,650 147,547) 20,020,103 — 15,589,825) 15,589,825) 5,333,406)
(86,217) (86,217) (48,191) 19,111,299 19,111,299 (48,191) (2,359,267) — — (15,589,825) — — (17,949,092) (15,589,825) — — —	61,341	13,150 - - - - - - -	(5,333,406)	(((()	73,067) 19,124,449 - 15,589,825) 15,589,825) 5,333,406) 292,351	(74,480)	(147,547) 20,020,103 — 15,589,825) 15,589,825) 5,333,406)
19,111,299 19,111,299 (48,191) (2,359,267) — — (15,589,825) (15,589,825) — (17,949,092) (15,589,825) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 39,899,629 55,902,712 4,493,570 — — — 21,680,339 21,680,339 — (402,184) (6,136,294) (6,136,294)	61,341	13,150 - - - - - - -	(5,333,406)	((19,124,449 — 15,589,825) 15,589,825) 5,333,406) 292,351	(((20,020,103 — 15,589,825) 15,589,825) 5,333,406)
(2,359,267)	- - - - - - - -	- - - - - - -	(5,333,406)	((15,589,825) 15,589,825) 5,333,406) 292,351		895,654 - - - - -	(15,589,825) 15,589,825) 5,333,406)
(15,589,825) (15,589,825) — (17,949,092) (15,589,825) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 39,899,629 55,902,712 4,493,570 — — — 21,680,339 — — (402,184) (6,136,294) (6,136,294)	- - - - - - - - - -		(5,333,406) —	(15,589,825) 5,333,406) 292,351		- - - - -	(15,589,825) 5,333,406)
(17,949,092) (15,589,825) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 39,899,629 55,902,712 4,493,570 — — — 21,680,339 21,680,339 — (402,184) (402,184) (6,136,294) ((5,333,406) — — —	(15,589,825) 5,333,406) 292,351		_ _ _ _	(15,589,825) 5,333,406)
(17,949,092) (15,589,825) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 39,899,629 55,902,712 4,493,570 — — — 21,680,339 21,680,339 — (402,184) (6,136,294) (6,136,294)			(5,333,406) — — —	(15,589,825) 5,333,406) 292,351		- - -	(15,589,825) 5,333,406)
39,899,629 55,902,712 4,493,570 21,680,339 21,680,339 - (402,184) (402,184) (6,136,294) ((5,333,406) — — —	(292,351			(
39,899,629 55,902,712 4,493,570 21,680,339 21,680,339 - (402,184) (402,184) (6,136,294) (292,351				
39,899,629 55,902,712 4,493,570 21,680,339 21,680,339 - (402,184) (402,184) (6,136,294) (_	7.197.510				
39,899,629 55,902,712 4,493,570 21,680,339 21,680,339 - (402,184) (402,184) (6,136,294) (_			/.19/.510				
39,899,629 55,902,712 4,493,570 21,680,339 21,680,339 - (402,184) (402,184) (6,136,294) (1,712,836	_	8,910,346
39,899,629 55,902,712 4,493,570 21,680,339 21,680,339 - (402,184) (402,184) (6,136,294) (_			-(564,344)		564,344		
39,899,629 55,902,712 4,493,570 21,680,339 21,680,339 - (402,184) (402,184) (6,136,294) (1,074,833			_	1,074,833
					_			232,148)	(232,148)
								344,095	_	344,095
(402,184) (402,184) (6,136,294) (588,119	5,081,689	(7,292,513)		156,634,647		11,503,878		168,138,525
(402,184) (402,184) (6,136,294) (_		51,959				51,959
				_		21,680,339		1,269,560		22,949,899
21,278,155 21,278,155 (6,136,294) (828,969)	(6,965,263)		_	(7,367,447)	(591,812)	(7,959,259)
	828,969)	(6,965,263)				14,312,892		677,748		14,990,640
(1,947,887) – –	_	_		_		_		_		_
(12,476,779) (12,476,779) —	_	_		_	(12,476,779)		_	(12,476,779)
(14,424,666) (12,476,779) —						12,476,779)				12,476,779)
						233,013				233,013
					_	233,013			_	233,013
(5,884) (5,884) —					(26,436)		26,436		
				_	(1,912,887)	(912,886)	(2,825,773)
						983,117				983,117
								7,021		7,021
							(237,850)	(237,850)
					(444,320)		927,823		483,503
\$46,747,234 \$64,698,204 (\$1,642,724) (\$		(\$1,883,574)	(\$	7,292,513)	\$	157,355,206	\$	11,992,170	\$	169,347,376

董事長:張虔生





會計主管:郭宏銘



第105及104年1月1日至1月1日至1月1日 第位: 新台幣千元 **七個** 105年度 104年度(調整後)

代碼		105年度	104年度(調整後)
	營業活動之現金流量		_
A10000	本年度稅前淨利	\$ 28,041,272	\$ 25,006,896
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	28,961,614	28,938,770
A20200	攤銷費用	460,690	579,894
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(447,559) (2,472,835)
A20900	財務成本	2,261,075	2,312,143
A21200	利息收入	(230,067) (242,084)
A21300	股利收入	(26,411) (396,973)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	470,788	133,496
A22300	採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	(1,528,344) (121,373)
A23500	金融資產減損損失	91,886	8,232
A23600	金融資產減損迴轉利益	(28,022	_
A23700	非金融資產減損損失	1,340,01	610,140
A29900	匯兌損益	(407,160) (1,358,777)
A29900	其他項目	1,031,422	1,411,599
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31110	持有供交易之金融資產	1,052,111	4,162,522
A31150	應收帳款	(6,184,873	7,982,736
A31180	其他應收款	(211,755	
A31200	存貨	3,156,759	
A31240	其他流動資產	(24,517	
A32110	持有供交易之金融負債	(2,952,116	
A32150	應付帳款	1,665,420	
A32180	其他應付款項	1,380,205	
A32210	預収房地款	(2,643,156	
A32230	其他流動負債	295,557	
A32990	其他營業負債	(407,143	
A33000	營運產生之現金流入	55,117,687	
A33100	収取之利息	228,509	
A33200	收取之股利	4,043,644	
A33300	支付之利息	(2,043,870	
A33500	支付之所得稅	(5,238,103	
AAAA	營業活動之淨現金流入	52,107,867	
	机次注射力再合法量		
B00100	投資活動之現金流量 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	(64,853,336) (100,842,813)
B00200	處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	66,472,870	
B00300	取得備供出售金融資產	(1,590,928	
B00300	家分備供出售金融資產價款	867,336	
B00500	備供出售金融資產減資退回股款	28,927	
B01800	取得採用權益法投資之關聯企業及合資	(16,041,463	
B02200	對子公司之收購(扣除所取得之現金)	(73,437	
B02200	取得不動產、廠房及設備		
B02700 B02800	以何小	(26,714,163	
B02800 B04500	成刀小割库、	670,200 (513,893	
B04600	成分無形資產		
B04600 B06500	處刀無形員產 其他金融資產減少(增加)	25,646 (1,231,186	
B06700	其他非流動資產增加	(206,031	
BBBB	投資活動之淨現金流出	(43,159,458	
מטטט	1×5/1441/17/ナッル北川に口	43,133,430	(03,331,429)

代碼		105年度		104年度(調整	챁後)
	籌資活動之現金流量				
C00100	短期借款減少	(\$	10,640,229)	(\$	8,532,792)
C00600	應付短期票券(減少)增加	(4,348,054)		4,348,054
C01200	發行公司債		9,000,000		6,136,425
C01300	償還公司債	(10,365,135)		_
C01600	舉借長期借款		62,282,917		39,887,570
C01700	償還長期借款	(52,924,902)	(22,926,660)
C04500	發放現金股利	(12,243,766)	(15,297,474)
C04800	員工執行認股權		995,832		1,285,102
C04900	庫藏股票買回成本		_	(5,333,406)
C05500	處分子公司股權		_		8,910,346
C05800	非控制權益變動	(3,063,623)	(232,148)
C09900	其他籌資活動		219,940		391,322
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(21,087,020)		8,636,339
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(4,720,046)		723,556
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加(減少)	(16,858,657)		3,556,771
E00100	年初現金及約當現金餘額		55,251,181		51,694,410
E00000	在中心中心	•	20 202 524	•	55 354 404
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$	38,392,524	\$	55,251,181

後附之附註係本合併財務報告之一部分。 (參閱勤業衆信聯合會計師事務所民國106年3月13日查核報告)





會計主管:郭宏銘



日月光半導體製造股份有限公司及子公司

合併財務報告附註

民國105及104年1月1日至12月31日

(除另註明外, 金額以新台幣干元為單位)

一、公司沿革

日月光半導體製造股份有限公司(以下稱本公司或日月光)於73年3月設立於高雄楠梓加工出口區:93年8月吸收合併子公司日月欣半導體公司及日月宏科技公司並設立中壢分公司,95年8月將材料事業部分割讓與日月光電子公司(日月光電子):100年1月經核准設立南投分公司,已於106年1月廢止:101年5月吸收合併子公司日月鴻科技公司:102年8月吸收合併子公司洋鼎科技公司。本公司及子公司(以下統稱本集團)所營業務主要為半導體、基板、電腦週邊設備及電子零配件之製造、組合、加工、測試及銷售。

本公司股票於78年7月在台灣證券交易所掛牌上市買賣,股票代碼為2311;另於89年9月發行美國存託憑證(ADR)在紐約證券交易所掛牌上市,代號為ASX。又子公司環旭電子公司於101年2月在上海證券交易所掛牌上市,股票代碼為601231。 本合併財務報告係以本公司之功能性貨幣新台幣表達。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告於106年3月13日經董事會通過後發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一) 尚未生效之證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會(以下稱「金管會」)認可將於106年適用之國際財務報導準則(IFRS)、國際會計準則(IAS)、解釋(IFRIC)及解釋公告(SIC)

依據金管會發布之金管證審字第1050050021號及金管證審字第1050026834號函,本集團將自106年度開始適用業經國際會計準則理事會(IASB)發布且經金管會認可106年適用之IFRS、IAS、IFRIC及SIC(以下稱「IFRSs」)及相關證券發行人財務報告編製準則修正規定。

新發布/修正/修訂準則及解釋	IASB發布之生效日(註1)
「2010~2012週期之年度改善」	2014年7月1日或交易於2014年7月1日及以後
「2011~2013週期之年度改善」	2014年7月1日
「2012~2014週期之年度改善」	2016年1月1日(註2)
IFRS 10、IFRS 12及IAS 28之修正「投資個體:適用合併報表之例外規定」	2016年1月1日
IFRS 11之修正「聯合營運權益之取得」	2016年1月1日
IAS 1之修正「揭露倡議」	2016年1月1日
IAS 16及IAS 38之修正「可接受之折舊及攤銷方法之闡釋」	2016年1月1日
IAS 19之修正「確定福利計畫:員工提撥金」	2014年7月1日
IAS 36之修正「非金融資產可回收金額之揭露」	2014年1月1日
IAS 39之修正「衍生工具之約務更替與避險會計之持續適用」	2014年1月1日
IFRIC 21「公課」	2014年1月1日

註1:除另註明外,上述新發布/修正/修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度期間生效。

除下列說明外,適用上述修正後之證券發行人財務報告編製準則及106年適用之IFRSs規定將不致造成本集團會計政策之重大變動:

1. IAS 36之修正「非金融資產可回收金額之揭露」

IAS 36之修正係釐清本集團僅須於認列或迴轉資產或現金產生單位減損損失當期揭露其可回收金額。已認列或迴轉減損之不動產、廠房及設備之可回收金額若以公允價值減處分成本衡量,本集團將揭露公允價值層級,對屬第2或3等級公允

註2:除IFRS 5之修正推延適用於2016年1月1日以後開始之年度期間外,其餘修正係追溯適用於2016年1月1日以後開始之年度期間。

價值衡量,並將額外揭露衡量公允價值之評價技術及每一關鍵假設。若以現值法衡量公允價值減處分成本,須增加揭露 所採用之折現率。前述修正將於106年追溯適用。

2. 證券發行人財務報告編製準則之修正

該修正除配合106年適用之IFRSs新增若干會計項目及非金融資產減損揭露規定外,另配合國内實施IFRSs情形,強調若 干認列與衡量規定,並新增關係人交易及商譽等揭露。

該修正規定,其他公司或機構與本集團之董事長或總經理為同一人,或具有配偶或二親等以内關係者,除能證明不具控制或重大影響者外,係屬實質關係人。此外,該修正規定應揭露與本集團進行重大交易之關係人名稱及關係,若單一關係人交易金額或餘額達本集團各該項交易總額或餘額10%以上者,應按關係人名稱單獨列示。

此外,若被收購公司於合併後之實際營運情形與收購時之預期效益有重大差異者,該修正規定應附註揭露。

106年追溯適用前述修正時,將增加關係人交易及商譽減損之揭露。

(二) IASB已發布但尚未經金管會認可之IFRSs

本集團未適用下列業經IASB發布但未經金管會認可之IFRSs。截至本合併財務報告通過發布日止,除IFRS 9及IFRS 15應自 107年度開始適用外,金管會尚未發布其他準則生效日。

新發布 /	修正 /	修訂準則及解釋

IASB發布之生效日(註1)
-------------	-----

「2014-2016週期之年度改善」	註2
IFRS 2之修正「股份基礎給付交易之分類與衡量」	2018年1月1日
IFRS 9「金融工具」	2018年1月1日
IFRS 9及IFRS 7之修正「強制生效日及過渡揭露」	2018年1月1日
IFRS 10及IAS 28之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	未定
IFRS 15「客戶合約之收入」	2018年1月1日
IFRS 15之修正「IFRS 15之闡釋」	2018年1月1日
IFRS 16「租賃」	2019年1月1日
IAS 7之修正「揭露倡議」	2017年1月1日
IAS 12之修正「未實現損失之遞延所得稅資產之認列」	2017年1月1日
IAS 40之修正「投資性不動產之轉換」	2018年1月1日
IFRIC 22「外幣交易與預收付對價」	2018年1月1日

註1:除另註明外,上述新發布/修正/修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度期間生效。

1. IFRS 9「金融工具」

金融資產之認列及衡量

就金融資產方面,所有原屬於IAS 39「金融工具:認列與衡量」範圍内之金融資產後續衡量係以攤銷後成本衡量或以公允價值衡量。IFRS 9對金融資產之分類規定如下:

本集團投資之債務工具,若其合約現金流量完全為支付本金及流通在外本金金額之利息,分類及衡量如下:

- (1) 以收取合約現金流量為目的之經營模式而持有該金融資產,則該金融資產係以攤銷後成本衡量。此類金融資產後續係按有效利率認列利息收入於損益,並持續評估減損,減損損益認列於損益。
- (2) 藉由收取合約現金流量與出售金融資產而達成目的之經營模式而持有該金融資產,則該金融資產係以透過其他綜合 損益按公允價值衡量。此類金融資產後續係按有效利率認列利息收入於損益,並持續評估減損,減損損益與兌換損 益亦認列於損益,其他公允價值變動則認列於其他綜合損益。於該金融資產除列或重分類時,原先累積於其他綜合 損益之公允價值變動應重分類至損益。

本集團投資非屬前述條件之金融資產,係以公允價值衡量,公允價值變動認列於損益。惟本集團得選擇於原始認列時, 將非持有供交易之權益投資指定為透過其他綜合損益按公允價值衡量。此類金融資產除股利收益認列於損益外,其他相 關利益及損失係認列於其他綜合損益,後續無須評估減損,累積於其他綜合損益之公允價值變動亦不重分類至損益。

金融資產之減損

IFRS 9改採用「預期信用損失模式」認列金融資產之減損。以攤銷後成本衡量之金融資產、強制透過其他綜合損益按公

註2:IFRS 12之修正係追溯適用於2017年1月1日以後開始之年度期間:IAS 28之修正係追溯適用於2018年1月1日以後開始之年度期間。

允價值衡量之金融資產、應收租賃款、IFRS15「客戶合約之收入」產生之合約資產或放款承諾及財務保證合約,係認列 備抵信用損失。若前述金融資產之信用風險自原始認列後並未顯著增加,則其備抵信用損失係按未來12個月之預期信用 損失衡量。若前述金融資產之信用風險自原始認列後已顯著增加且非低信用風險,則其備抵信用損失係按剩餘存續期間 之預期信用損失衡量。但未包括重大財務組成部分之應收帳款必須按存續期間之預期信用損失衡量備抵信用損失。

此外,原始認列時已有信用減損之金融資產,本集團考量原始認列時之預期信用損失以計算信用調整後之有效利率,後續備抵信用損失則按後續預期信用損失累積變動數衡量。

一般避險會計

IFRS 9在一般避險會計之主要改變,係調整避險會計之適用條件,以使適用避險會計之財務報表更能反映企業實際進行的風險管理活動。與IAS 39相較,其主要修正内容包括:(1)增加可適用避險會計之交易型態,例如放寬非財務風險適用避險會計之條件;(2)修改避險衍生工具之損益認列方式,以減緩損益波動程度;及(3)避險有效性方面,以避險工具與被避險項目間的經濟關係取代實際有效性測試。

過渡規定

IFRS 9生效時,首次適用日前已除列之項目不得適用。金融資產之分類、衡量與減損應追溯適用,惟本集團無須重編比較期間,並將首次適用之累積影響數認列於首次適用日。一般避險會計應推延適用,惟避險選擇權之損益認列則須追溯適用。

2. IFRS10及IAS 28之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」

該修正規定,若本集團出售或投入資產予關聯企業(或合資),或本集團喪失對子公司之控制,但保留對該子公司之重大 影響(或聯合控制),若前述資產或前子公司符合IFRS 3「業務」之定義時,本集團係全數認列該等交易產生之損益。

此外,若本集團出售或投入資產予關聯企業(或合資),或本集團在與關聯企業(或合資)之交易中喪失對子公司之控制,但保留對該子公司之重大影響(或聯合控制),若前述資產或前子公司不符合IFRS 3「業務」之定義時,本集團僅在與投資者對該等關聯企業(或合資)無關之權益範圍內認列該交易所產生之損益,亦即,屬本集團對該損益之份額者應予以銷除。

3. IFRS15「客戶合約之收入」及相關修正

IFRS15係規範來自客戶合約之收入認列原則,該準則將取代IAS18「收入」、IAS11「建造合約」及相關解釋。 本集團於適用IFRS15時,係以下列步驟認列收入:

- (1) 辨認客戶合約;
- (2) 辨認合約中之履約義務;
- (3) 決定交易價格;
- (4) 將交易價格分攤至合約中之履約義務;及
- (5) 於滿足履約義務時認列收入。

於辨認履約義務時,IFRS15及相關修正規定,若商品或勞務能被區分(例如,經常單獨銷售某一商品或勞務),且移轉商品或勞務之承諾依合約之内涵係可區分(亦即,合約承諾之性質係為個別移轉每一商品或勞務,而非移轉組合產出),則該商品或勞務係可區分。

IFRS15及相關修正生效時,本集團得選擇追溯適用至比較期間或將首次適用之累積影響數認列於首次適用日。

4. IFRS16「租賃」

IFRS16係規範租賃之會計處理,該準則將取代IAS17「租賃」及相關解釋。

於適用IFRS16時,若本集團為承租人,除小額租賃及短期租賃得選擇採用類似IAS17之營業租賃處理外,其他租賃皆應 於合併資產負債表上認列使用權資產及租賃負債。合併綜合損益表應分別表達使用權資產之折舊費用及租賃負債按有效 利息法所產生之利息費用。在合併現金流量表中,償付租賃負債之本金金額表達為籌資活動,支付利息部分則列為營業 活動。

對於本集團為出租人之會計處理預計無重大影響。

IFRS16生效時,本集團得選擇追溯適用至比較期間或將首次適用之累積影響數認列於首次適用日。

除上述影響外,截至本合併財務報告通過發布日止,本集團仍持續評估其他準則、解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響,相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

(一) 遵循聲明

本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可之IFRSs編製。

(二)編製基礎

除按公允價值衡量之金融工具外,本合併財務報告係依歷史成本基礎編製。

公允價值衡量依照相關輸入值之可觀察程度及重要性分為第1等級至第3等級:

- 1. 第1等級輸入值:係指於衡量日可取得之相同資產或負債於活絡市場之報價(未經調整)。
- 2. 第2等級輸入值:係指除第1等級之報價外,資產或負債直接(亦即價格)或間接(亦即由價格推導而得)之可觀察輸入值。
- 3. 第3等級輸入值:係指資產或負債之不可觀察之輸入值。

(三) 資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括現金及約當現金、主要為交易目的而持有之資產及預期於資產負債表日後12個月內實現之資產,但不包括於 資產負債表日後逾12個月用以交換或清償負債而受有其他限制者。流動負債包括主要為交易目的而持有之負債、預期於資 產負債表日後12個月內到期清償之負債,以及不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少12個月之負債。非屬上述 流動資產或流動負債者,係分類為非流動資產或非流動負債。

另從事房地產開發之子公司,其營業週期長於1年,是以與房地產開發相關之資產及負債,係按正常營業週期作為劃分流 動或非流動之標準。

(四) 合併基礎

本合併財務報告係包含本公司及由本公司所控制個體(子公司)之財務報告。合併綜合損益表已納入被收購或被處分子公司 於當期自收購日起或至處分日止之營運損益。子公司之財務報告已予調整,以使其會計政策與本集團之會計政策一致。於 編製合併財務報告時,各個體間之交易、帳戶餘額、收益及費損已全數予以銷除。子公司之綜合損益總額係歸屬至本公司 業主及非控制權益,即使非控制權益因而成為虧損餘額。

當本集團對子公司所有權權益之變動未導致喪失控制者,係作為權益交易處理。本集團及非控制權益之帳面金額已予調整,以反映其於子公司相對權益之變動。非控制權益之調整金額與所支付或收取對價之公允價值間之差額,係直接認列為權益目歸屬於本公司業主。

子公司明細、持股比例及營業項目如下:

	1## 1 1	
本集團持有之股	(權白分比(%)	

子公司名稱	主要業務	設立及營運地點	105年12月31日	104年12月31日
A.S.E. Holding Limited	控股公司	百慕達	100.0	100.0
J & R Holding Limited (J&R Holding)	控股公司	百慕達	100.0	100.0
Innosource Limited	控股公司	英屬維京群島	100.0	100.0
Omniquest Industrial Limited	控股公司	英屬維京群島	100.0	100.0
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	從事市場行銷及客戶服務業務	日本	100.0	100.0
台灣福雷電子公司(台灣福雷)	從事半導體測試服務	楠梓加工區	100.0	100.0
環電公司(環電)	投資公司	南投縣	99.2	99.2
陸竹開發公司	從事房地產開發業務	台北市	86.1	86.1
笛林傑國際科技公司(笛林傑)	從事資訊軟體服務業務,於105年5月 由子公司台灣福雷收購其60%股權	台北市	60.0	-
Alto Enterprises Limited	控股公司	英屬維京群島	100.0	100.0
Super Zone Holdings Limited	控股公司	香港	100.0	100.0

本集團持有之股權百分比(%)

子公司名稱	主要業務	設立及營運地點	105年12月31日	104年12月31日
—————————————————————————————————————	從事半導體封裝測試業務	中國大陸昆山	100.0	100.0
日月光投資(昆山)有限公司	控股公司	中國大陸昆山	100.0	100.0
日月光集成電路製造(中國)有限公司	將從事半導體封裝測試業務	中國大陸上海	100.0	100.0
ASE Investment (Labuan) Inc.	控股公司	馬來西亞	100.0	100.0
ASE Test Limited (ASE Test)	控股公司	新加坡	100.0	100.0
ASE (Korea) Inc.	從事半導體封裝測試業務	韓國	100.0	100.0
日月瑞公司	從事租賃及投資業務	楠梓加工區	100.0	100.0
ASE Japan Co., Ltd.	從事半導體封裝測試業務	日本	100.0	100.0
ASE (U.S.) Inc.	從事市場行銷支援及客戶服務業務	美國	100.0	100.0
Global Advanced Packaging Technology Limited	控股公司	英屬開曼群島	100.0	100.0
日月光半導體(威海)有限公司	從事半導體封裝測試業務	中國大陸山東	100.0	100.0
蘇州日月新半導體有限公司	從事半導體封裝測試業務	中國大陸蘇州	60.0	60.0
Anstock Limited	從事專業性理財活動	英屬開曼群島	100.0	100.0
Anstock II Limited	從事專業性理財活動	英屬開曼群島	100.0	100.0
日月光電子元器件(上海)有限公司	清算中	中國大陸上海	100.0	100.0
日月光半導體(上海)有限公司	從事半導體材料製造業務	中國大陸上海	100.0	100.0
ASE Corporation	控股公司	英屬開曼群島	100.0	100.0
ASE Mauritius Inc.	控股公司	模里西斯	100.0	100.0
ASE Labuan Inc.	控股公司	馬來西亞	100.0	100.0
上海鼎匯房地產開發有限公司	從事房地產開發、建設及房屋銷售物 業管理	中國大陸上海	100.0	100.0
上海鼎祺物業管理有限公司	從事房地產物業管理服務	中國大陸上海	100.0	100.0
日月光半導體(香港)有限公司	貿易公司	香港	100.0	100.0
上海鼎威房地產開發有限公司	從事房地產開發、建設及商場出租業 務	中國大陸上海	100.0	100.0
上海鼎裕房地產開發有限公司	從事房地產開發、建設及商場出租業 務	中國大陸上海	100.0	100.0
上海鼎凡百貨有限公司	將從事百貨貿易,設立於105年7月	中國大陸上海	100.0	_
昆山鼎悦房地產開發有限公司	從事房地產開發、建設及商場出租業 務	中國大陸昆山	100.0	100.0
昆山鼎泓房地產開發有限公司	從事房地產開發、建設及商場出租業 務	中國大陸昆山	100.0	100.0
日月光電子	從事半導體材料製造業務	楠梓加工區	100.0	100.0
ASE Test Holdings, Ltd.	控股公司	英屬開曼群島	100.0	100.0
ASE Holdings (Singapore) Pte Ltd	控股公司	新加坡	100.0	100.0
ASE Singapore Pte. Ltd.	從事半導體封裝測試業務	新加坡	100.0	100.0
ISE Labs, Inc.	從事半導體測試服務	美國	100.0	100.0
ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	從事半導體封裝測試業務	馬來西亞	100.0	100.0
日月光封裝測試(上海)有限公司(日月 光上海封測)	從事半導體封裝測試業務	中國大陸上海	100.0	100.0
日月光貿易(上海)有限公司	貿易公司	中國大陸上海	100.0	100.0
無錫通芝微電子有限公司	從事半導體封裝測試業務	中國大陸無錫	100.0	100.0
Huntington Holdings International Co. Ltd.	控股公司	英屬維京群島	99.2	99.2
Unitech Holdings International Co. Ltd.	控股公司	英屬維京群島	99.2	99.2
Real Tech Holdings Limited	控股公司	英屬維京群島	99.2	99.2
Universal ABIT Holding Co., Ltd.	清算中	英屬開曼群島	99.2	99.2
Rising Capital Investment Limited	控股公司	英屬維京群島	99.2	99.2
Rise Accord Limited	控股公司	英屬維京群島	99.2	99.2

本集團持有之股權百分比(%)

子公司名稱	主要業務	設立及營運地點	105年12月31日	104年12月31日
環銓電子(昆山)有限公司	生產電腦輔助系統、週邊設備及銷售 自產產品	中國大陸昆山	99.2	99.2
USI Enterprise Limited(環誠)	投資諮詢服務及倉儲管理服務	香港	97.0	96.7
環旭電子公司(環旭上海)	提供各種電子產品設計、製造及銷售	中國大陸上海	75.1	75.7
Universal Global Technology Co., Limited	控股公司	香港	75.1	75.7
環鴻電子(昆山)有限公司	提供電子產品設計及製造服務	中國大陸昆山	75.1	75.7
環維電子(上海)有限公司	電子產品、通訊產品及零配件之加工 及銷售,及貨物及技術之進出口業 務	中國大陸上海	75.1	75.7
環豪電子(上海)有限公司	電子元器件、計算機軟硬體、通訊設 備及配件之銷售	中國大陸上海	75.1	75.7
環旭科技有限公司	製造、貿易及投資公司	香港	75.1	75.7
環鴻科技公司(環鴻科技)	電子通信器材、汽車及其零件製造、 產品設計及研究發展服務	南投縣	75.1	75.7
USI America Inc.	新型主機板組裝與製作、無線通訊產 品製作及維修服務	美國	75.1	75.7
Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V.	主機板及電腦系統組裝	墨西哥	75.1	75.7
USI Japan Co., Ltd.	電腦資訊之週邊設備、積體電路、電 子零件等之製造買賣	日本	75.1	75.7
環勝電子(深圳)有限公司	主機板和相關電腦週邊設備及通訊和 工業控制等產品之設計、製造及銷 售	中國大陸深圳	75.1	75.7
環隆電氣公司(環隆電氣)	從事各種電腦及周邊設備之製造、加 工維修及銷售	南投縣	74.4	99.0

(五)企業合併

企業合併係採收購法處理。收購相關成本於成本發生及勞務取得當年度列為費用。

商譽係按移轉對價之公允價值、被收購者之非控制權益金額以及收購者先前已持有被收購者之權益於收購日之公允價值之總額,超過收購日所取得可辨認資產及承擔負債之淨額衡量。倘於重評估後,收購日所取得可辨認資產及承擔負債之淨額仍超過移轉對價、被收購者之非控制權益以及收購者先前已持有被收購者之權益於收購日公允價值之總數,則該差額為廉價購買利益,並立即認列為損益。

分階段達成之企業合併係以收購日之公允價值再衡量本集團先前已持有被收購者之權益,若因而產生任何利益或損失,則認列為損益或其他綜合損益。因先前已持有被收購者之權益而於收購日前已認列於其他綜合損益之金額,係按與本集團若直接處分其先前已持有權益之相同基礎認列。

因本集團企業合併所取得可辨認資產及承擔負債之衡量若尚未完成,於資產負債表日係以暫定金額認列,並於衡量期間進行追溯調整或認列額外之資產或負債,以反映所取得有關收購日已存在事實與情況之新資訊。

本集團未採用收購法處理組織重組下之企業合併,而係採用帳面價值法,並視為自始合併而重編前期比較資訊。

(六) 外幣

各個體編製財務報告時,以個體功能性貨幣以外之貨幣(外幣)交易者,依交易日匯率換算為功能性貨幣記錄。

外幣貨幣性項目於每一資產負債表日以收盤匯率換算。因交割貨幣性項目或換算貨幣性項目產生之兌換差額,於發生當期 認列於損益。

以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目係以決定公允價值當日之匯率換算,所產生之兌換差額列為當期損益,惟屬公允價值 變動認列於其他綜合損益者,其產生之兌換差額列於其他綜合損益。

以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目係以交易日之匯率換算,不再重新換算。

於編製合併財務報告時,本集團國外營運機構之資產及負債以每一資產負債表日匯率換算為新台幣:收益及費損項目係以當年度各月份之平均匯率換算並累計,所產生之兌換差額認列於其他綜合損益,並分別歸屬予本公司業主及非控制權益。

若本集團處分國外營運機構之所有權益,或處分國外營運機構之子公司部分權益但喪失控制,所有可歸屬於本公司業主且與該國外營運機構相關之累計兌換差額將重分類至損益。

若部分處分國外營運機構之子公司未導致喪失控制,係按比例將累計兌換差額重新歸屬予該子公司之非控制權益,而不認 列為損益。在其他任何部分處分國外營運機構之情況下,累計兌換差額則按處分比例重分類至損益。

(七) 存貨及存貨 - 營建房地

存貨包括原料(不包括受託加工之晶圓)、物料、在製品、製成品及在途原物料。存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量,比較成本與淨變現價值時除同類別存貨外係以個別項目為基礎。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投入及完成出售所需之估計成本後之餘額。原料及物料成本按移動平均法計價,在製品及製成品成本按標準成本計價。

存貨-營建房地包括待售房地、在建房地及營建用地。預計開發之土地於取得所有權後列為營建用地:在建房地於積極進行土地開發及建造房屋期間,就已支付在建房地成本所必須負擔之利息,予以資本化列為在建房地成本,俟工程完工則轉列為待售房地。待售房地、在建房地及營建用地以成本與淨變現價值孰低衡量,比較成本與淨變現價值係以個別項目為基礎。待售房地及在建房地預售所收取之款項先列入預收房地款。俟工程完工後,就已銷售房地交付予客戶且不再承擔顯著風險部分,轉列當年度營建收入,待售房地依出售面積比例轉為當年度營業成本。

(八) 投資關聯企業及合資

本集團對投資關聯企業及合資係採用權益法。關聯企業係指本集團具有重大影響,但非屬子公司之企業。合資係本集團與 他公司具有聯合控制且對淨資產具有權利之聯合協議。

權益法下,投資關聯企業及合資原始依成本認列,取得日後帳面金額係隨本集團所享有之關聯企業及合資損益及其他綜合 損益份額與利潤分配而增減。此外,針對關聯企業權益及合資之變動係按持股比例認列。

取得成本超過本集團於取得日所享有關聯企業及合資可辨認資產及負債淨公允價值份額之數額列為商譽,該商譽係包含於該投資之帳面金額且不得攤銷。

本集團與關聯企業及合資間之逆流、順流及側流交易所產生之損益,僅在與本集團對關聯企業權益及對合資權益無關之範 圍內,認列於合併財務報告。

(九) 不動產、廠房及設備

除土地以成本計價外,土地以外之不動產、廠房及設備係以成本認列,後續以成本減除累計折舊及累計減損後之金額衡量。

建造中之不動產、廠房及設備係以成本減除累計減損後之金額認列。成本包括專業服務費用及符合資本化條件之借款成本。該等資產於完工並達預期使用狀態時,分類至不動產、廠房及設備之適當類別並開始提列折舊。

自有土地不提列折舊。

本集團之不動產、廠房及設備(包含融資租賃所持有之資產)於耐用年限内按直線基礎,對於每一重大部分單獨提列折舊。若租賃期間較耐用年限短者,則於租賃期間内提列折舊。本集團至少於每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及折舊方法進行檢視,並推延適用會計估計變動之影響。

不動產、廠房及設備除列時,淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於損益。

(十) 商譽

企業合併所取得之商譽係依收購日所認列之商譽金額作為成本,後續以成本減除累計減損後之金額衡量。

為減損測試之目的,商譽分攤至本集團預期因該合併綜效而受益之各現金產生單位或現金產生單位群組(簡稱「現金產生單位」)。

受攤商譽之現金產生單位每年(及有跡象顯示該單位可能已減損時)藉由包含商譽之該單位帳面金額與其可回收金額之比較,進行該單位之減損測試。若分攤至現金產生單位之商譽係當年度企業合併所取得,則該單位應於當年度結束前進行減損測試。若受攤商譽之現金產生單位之可回收金額低於其帳面金額,減損損失係先減少該現金產生單位受攤商譽之帳面金額,次就該單位內其他各資產帳面金額之比例減少各該資產帳面金額。任何減損損失直接認列為當年度損失。商譽減損損失不得於後續期間迴轉。

(十一) 其他無形資產

單獨取得之有限耐用年限無形資產原始以成本衡量,後續係以成本減累計攤銷及累計減損後之金額衡量。無形資產於耐用 年限内按未來經濟效益之預期消耗型態或以直線基礎進行攤銷,並且至少於每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及攤銷 方法進行檢視。並推延適用會計估計變動之影響。

企業合併所取得之無形資產係以收購日之公允價值認列,並與商譽分別認列。後續衡量方式與單獨取得之無形資產相同。 無形資產除列時,淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於常年度指益。

(十二) 有形及無形資產(商譽除外)之減損

本集團於每一資產負債表日評估是否有任何跡象顯示有形及無形資產(商譽除外)可能已減損。若有任一減損跡象存在,則估計該資產之可回收金額。倘無法估計個別資產之可回收金額,本集團估計該資產所屬現金產生單位之可回收金額。共用資產係依合理一致基礎分攤至個別現金產生單位。可回收金額為公允價值減出售成本與其使用價值之較高者,個別資產或現金產生單位之可回收金額若其低於帳面金額時,則將該資產或現金產生單位之帳面金額調減至其可回收金額,減損損失係認列於損益。

當減損損失於後續迴轉時,該資產或現金產生單位之帳面金額調增至修訂後之可回收金額,惟增加後之帳面金額以不超過該資產或現金產生單位若未於以前年度認列減損損失時所決定之帳面金額(減除折舊或攤銷)。減損損失之迴轉係認列於損益。

(十三) 金融工具

金融資產與金融負債於本集團成為該工具合約條款之一方時認列於合併資產負債表。原始認列時,若金融資產或金融負債非屬透過損益按公允價值衡量者,係按公允價值加計直接可歸屬於取得或發行金融資產或金融負債之交易成本衡量。直接可歸屬於取得或發行透過損益按公允價值衡量之金融資產或金融負債之交易成本,則立即認列為損益。

金融資產

金融資產之慣例交易係採交割日會計認列及除列。

1. 衡量種類

本集團所持有之金融資產分類係於原始認列時視其性質及目的而決定。

(1) 透過損益按公允價值衡量之金融資產

透過損益按公允價值衡量之金融資產包括持有供交易及指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產。

本集團於下列情況下,係將金融資產於原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量:

- A. 該指定可消除或重大減少衡量或認列不一致;或
- B. 一組金融資產、金融負債或兩者,依書面之風險管理或投資策略,以公允價值基礎管理並評估其績效,且本集團內部提供予管理階層之該投資組合資訊,亦以公允價值為基礎;或
- C. 將包含一個或多個嵌入式衍生工具之混合(結合)合約整體進行指定。

透過損益按公允價值衡量之金融資產係按公允價值衡量,其再衡量產生之利益或損失(包含該金融資產所產生之任何 股利或利息)係認列於損益。

公允價值之決定方式請參閱附註=_。

(2) 備供出售金融資產

備供出售金融資產係非衍生金融資產被指定為備供出售,或未被分類為放款及應收款、持有至到期日投資或透過損益按公允價值衡量之金融資產。

備供出售金融資產係按公允價值衡量,備供出售貨幣性金融資產帳面金額之變動中屬外幣兌換損益與以有效利息法計算之利息收入,以及備供出售權益投資之股利,係認列於損益。其餘備供出售金融資產帳面金額之變動係認列於其他綜合損益,於投資處分或確定減損時重分類為損益。

備供出售權益投資之股利於本集團收款之權利確立時認列。

(3) 放款及應收款

放款及應收款主要包括現金及約當現金、應收帳款、其他應收款及其他金融資產,係採用有效利息法按攤銷後成本減除減損損失後之金額衡量,惟短期應收款項之利息認列不具重大性之情況除外。

約當現金包括自取得日起3個月内,高度流動性、可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之定期存款,係用於 滿足短期現金承諾。

2. 金融資產之減損

除透過損益按公允價值衡量之金融資產外,本集團係於每一資產負債表日評估其他金融資產是否有減損客觀證據,當有客觀證據顯示,因金融資產原始認列後發生之單一或多項事項,致使金融資產之估計未來現金流量受損失者,該金融資產即已發生減損。

按攤銷後成本列報之金融資產,如應收帳款及其他應收款,該資產經個別評估未有客觀減損證據後,再以組合就過去收 款經驗以及與應收款項違約有關之可觀察因素評估減損。

按攤銷後成本列報之金融資產之減損損失金額係該資產帳面金額與估計未來現金流量按該金融資產原始有效利率折現之現值間之差額。於後續期間減損損失金額減少,且經客觀判斷該減少與認列減損後發生之事項相連結,則先前認列之減損損失直接或藉由調整備抵帳戶予以迴轉認列於損益,惟該迴轉不得使金融資產帳面金額超過若未認列減損情況下於迴轉日應有之攤銷後成本。

當備供出售權益投資之公允價值低於成本且發生大幅或持久性下跌時,係為客觀減損證據。當備供出售金融資產發生減損時,原先已認列於其他綜合損益之累計損失金額將重分類至損益。備供出售權益工具投資已認列於損益之減損損失不得透過損益迴轉。任何認列減損損失後之公允價值回升金額係認列於其他綜合損益。備供出售債務工具之公允價值若於後續期間增加,而該增加能客觀地連結至減損損失認列於損益後發生之事項,則減損損失予以迴轉並認列於損益。

所有金融資產之減損損失係直接自金融資產之帳面金額中扣除,惟應收帳款係藉由備抵帳戶調降其帳面金額。當判斷應收帳款無法收回時,係沖銷備抵帳戶。原先已沖銷而後續收回之款項則貸記備抵帳戶。除因應收帳款無法收回而沖銷備抵帳戶外,備抵帳戶帳面金額之變動認列於損益。

3. 金融資產之除列

本集團僅於對來自金融資產現金流量之合約權利失效,或已移轉金融資產目該資產所有權之幾乎所有風險及報酬已移轉予其他企業時,始將金融資產除列。除列時,其帳面金額與所收取對價加計已認列於其他綜合損益之任何累計利益或損失之總和間之差額係認列於損益。

權益工具

本集團發行之債務及權益工具係依據合約協議之實質與金融負債及權益工具之定義分類為金融負債或權益。

本公司發行之權益工具係以取得之價款扣除直接發行成本後之金額認列。

再取回本公司本身之權益工具係於權益項下認列與減除。購買、出售、發行或註銷本公司本身之權益工具不認列於損益。

金融負債

金融負債係以有效利息法計算之攤銷後成本或透過損益按公允價值衡量。透過損益按公允價值衡量之金融負債係持有供交易之金融負債。

透過損益按公允價值衡量之金融負債係按公允價值衡量,其再衡量產生之利益或損失係認列於損益,包含所支付之股利或利息。公允價值之決定方式請參閱附註三二。

本集團僅於義務解除、取消或到期時,始將金融負債除列。除列時,其帳面金額與所支付對價間之差額認列為損益。

衍生工具

衍生工具於簽訂合約時,原始以公允價值認列,後續於資產負債表日按公允價值再衡量,後續衡量產生之利益或損失直接 列入損益,然指定且為有效避險工具之衍生工具,其認列損益之時點則將視避險關係之性質而定。當衍生工具之公允價值 為正值時,列為金融資產:公允價值為負值時,列為金融負債。

嵌入式衍生工具之風險及特性與主契約之風險及特性並非緊密關聯,且主契約非屬透過損益按公允價值衡量之金融資產或 金融負債時,該衍生工具係視為單獨衍生工具。

可轉換公司債

1. 可轉換公司債包含之轉換權屬權益性質

本集團發行之複合金融工具(可轉換公司債)係依據合約協議之實質與金融負債及權益工具之定義,於原始認列時將其組成部分分別分類為金融負債及權益。

原始認列時,負債組成部分之公允價值係以類似之不可轉換工具當時市場利率估算,並於執行轉換或到期日前,以有效利息法計算之攤銷後成本衡量。屬嵌入非權益衍生工具之負債組成部分則以公允價值衡量。

分類為權益之轉換權係等於該複合工具整體公允價值減除經單獨決定之負債組成部分公允價值之剩餘金額,經扣除所得稅影響數後認列為權益,後續不再衡量。於該轉換權被執行時,其相關之負債組成部分及於權益之金額將轉列股本及資本公積—股票發行溢價。可轉換公司債之轉換權若於到期日仍未被執行,該認列於權益之金額將轉列資本公積—股票發行溢價。

發行可轉換公司債之相關交易成本,係按分攤總價款之比例分攤至該工具之負債(列入負債帳面金額)及權益組成部分(列入權益)。

2. 可轉換公司債包含之轉換權屬負債性質

本集團發行之可轉換公司債所含轉換權組成部分,如非透過以固定金額現金或其他金融資產交換固定數量之本集團之權 益工具交割之轉換權,則分類為衍生性金融負債。

原始認列時,可轉換公司債之衍生性金融負債部分係以公允價值衡量,非衍生性金融負債部分之原始帳面金額則為分離 嵌入式衍生工具後之餘額。於後續期間,非衍生性金融負債係採有效利息法按攤銷後成本衡量,衍生性金融負債係按公 允價值衡量,且公允價值變動認列於損益。

發行可轉換公司債之相關交易成本,係按相對公允價值之比例分攤至該工具之非衍生性金融負債部分(列入負債帳面金額)及衍生性金融負債部分(列入損益)。

(十四) 避險會計

本集團指定部分避險工具進行現金流量避險。

指定且符合現金流量避險之避險工具,其公允價值變動屬有效避險部分係認列於其他綜合損益:屬無效避險部分則立即認 列於損益。

當被避險項目認列於損益時,原先認列於其他綜合損益之金額將於同一期間重分類至損益,並於合併綜合損益表認列於與被避險項目相關之項目下。然而,當預期交易之避險將認列非金融資產或非金融負債時,原先認列於其他綜合損益之金額,將自權益轉列為該非金融資產或非金融負債之原始成本。

當本集團取消指定避險關係、避險工具到期、出售、解約、執行或不再符合避險會計時,即推延停止避險會計。先前於避險有效期間已認列於其他綜合損益之金額,於預期交易發生前仍列於權益。當預期交易不再預期會發生時,先前認列於其他綜合損益之金額將立即認列於損益。

(十五) 收入認列

收入係按已收或應收對價之公允價值衡量,並扣除估計之客戶退貨、折扣及其他類似之折讓。

1. 商品及房地之銷售

銷售商品及房地係於下列條件完全滿足時認列收入:

- (1) 本集團已將商品及房地所有權之重大風險及報酬移轉予買方;
- (2) 本集團對於已經出售之商品及房地既不持續參與管理,亦未維持有效控制;
- (3) 收入金額能可靠衡量;
- (4) 與交易有關之經濟效益很有可能流入本集團;及
- (5) 與交易有關之已發生或將發生之成本能可靠衡量。

2. 勞務之提供

勞務收入係於勞務提供時予以認列。

3. 股利收入及利息收入

投資所產生之股利收入及金融資產之利息收入係於經濟效益很有可能流入本集團,且收入金額能可靠衡量時認列。利息收入係依時間之經過按流通在外本金與所適用之有效利率採應計基礎認列。

(十六) 租賃

當租賃條款係移轉附屬於資產所有權之幾乎所有風險與報酬予承租人,則將其分類為融資租賃。所有其他租賃則分類為營業租賃。

1. 本集團為出租人

營業租賃之租賃收益係按直線基礎於租賃期間内認列為收益。

2. 本集團為承和人

融資租賃係以各期最低租賃給付現值總額或租賃開始日租賃資產公允價值較低者作為成本入帳,並同時認列應付租賃款負債。

營業租賃給付係按直線基礎於租賃期間内認列為費用。

(十七) 借款成本

直接可歸屬於取得、建造或生產符合要件之資產之借款成本,係作為該資產成本之一部分,直到該資產達到預定使用或出售狀態之幾乎所有必要活動已完成為止。

特定借款如於符合要件之資本支出發生前進行暫時投資而賺取之投資收入,係自符合資本化條件之借款成本中減除。除上述外,其他借款成本係於發生當年度認列為損益。

(十八) 政府補助

政府補助僅於可合理確信本集團將遵循政府補助所附加之條件,且將可收到該項補助時,始予以認列。

政府補助係於其意圖補償之相關成本於本集團認列為費用之期間內,按有系統之基礎認列於損益。以本集團應購買、建造或其他方式取得非流動資產為條件之政府補助係認列為遞延收入,並以合理且有系統之基礎於相關資產耐用年限期間轉列損益。

若政府補助係用於補償已發生之費用或損失,或係以給與本集團立即財務支援為目的且無未來相關成本,則於其可收取之期間認列於損益。

(十九) 退職後福利

確定提撥退休計畫之退休金係於員工提供服務期間將應提撥之退休金數額認列為費用。

確定福利退休計畫之確定福利成本(含服務成本、淨利息及再衡量數)係採預計單位福利法精算。服務成本(含當期服務成本及前期服務成本)及淨確定福利負債(資產)淨利息於發生時認列為員工福利費用。再衡量數(含精算損益及扣除利息後之計畫資產報酬)於發生時認列於其他綜合損益並列入保留盈餘,後續期間不重分類至損益。

淨確定福利負債(資產)係確定福利退休計畫之提撥短絀(剩餘)。淨確定福利資產不得超過從該計畫退還提撥金或可減少未來 提撥金之現值。

(二十) 股份基礎給付協議

對員工之員工認股權,係以給與日權益工具之公允價值與預期既得之最佳估計數量,於既得期間內以直線基礎認列費用,並同時調整資本公積一員工認股權及非控制權益。若其於給與日立即既得,係於給與日全數認列費用。

本集團於每一資產負債表日修正預期既得之員工認股權估計數量。若有修正原估計數量,其影響數係認列為損益,使累計 費用反映修正之估計數,並相對調整資本公積—員工認股權及非控制權益。

(二一) 所得稅

所得稅費用係當期所得稅及遞延所得稅之總和。

1. 當期所得稅

依所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵10%所得稅列為股東會決議年度之所得稅費用。 以前年度應付所得稅之調整,列入當期所得稅。

2. 遞延所得稅

遞延所得稅係依本集團內各個體之帳載資產及負債帳面金額與計算課稅所得之課稅基礎二者所產生之暫時性差異計算。 遞延所得稅負債一般係就所有應課稅暫時性差異予以認列,而遞延所得稅資產則於很有可能有課稅所得以供可減除暫時 性差異、虧損扣抵或購置機器設備等支出所產生之所得稅抵減使用時認列。

與投資子公司相關之應課稅暫時性差異皆認列為遞延所得稅負債,惟本集團若可控制暫時性差異迴轉之時點,且該暫時 性差異很有可能於可預見之未來不會迴轉者除外。

遞延所得稅資產之帳面金額於每一資產負債表日予以重新檢視,並針對已不再很有可能有足夠之課稅所得以供其回收所 有或部分資產者,調減帳面金額。原未認列為遞延所得稅資產者,亦於每一資產負債表日予以重新檢視,並在未來很有 可能產生課稅所得以供其回收所有或部分資產者,調增帳面金額。

遞延所得稅資產及負債係以預期負債清償或資產實現當期之稅率衡量,該稅率係以資產負債表日已立法或已實質性立法 之稅率及稅法為基礎。遞延所得稅負債及資產之衡量係反映本集團於資產負債表日預期回收或清償其資產及負債帳面金 額之方式所產生之租稅後果。

3. 本年度當期及遞延所得稅

當期及遞延所得稅係認列於損益,惟與認列於其他綜合損益或直接計入權益之項目相關之當期及遞延所得稅係分別認列於其他綜合損益或直接計入權益。若當期所得稅或遞延所得稅係自企業合併所產生,其所得稅影響數納入企業合併之會計處理。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本集團於採用附註四所述之會計政策時,對於不易自其他來源取得相關資訊者,管理階層必須基於歷史經驗及其他攸關之因素作出相關之判斷、估計及假設。實際結果可能與估計有所不同。

管理階層將持續檢視估計與基本假設。若會計估計之修正僅影響當年度,則於修正當年度認列。若會計估計之修正同時影響當年度及未來年度,則於修正當年度及未來年度認列。

(一) 商譽減損評估

決定商譽是否減損時,須估計分攤到商譽之現金產生單位之使用價值。為計算使用價值,管理階層應估計預期自現金產生單位所產生之未來現金流量,並決定計算現值所使用之適當折現率。若實際現金流量少於預期,可能會產生重大減損損失。

(二) 取得重大之關聯企業

本集團對取得採用權益法之關聯企業,將取得成本超過各取得日所享有關聯企業可辨認資產及負債淨公允價值份額之數額認列為商譽,並列入該投資之帳面金額中,其中,可辨認資產及負債之公允價值之評價涉及重大會計判斷及估計。本集團管理階層聘請獨立外部評價專家針對關聯企業所有可辨認之有形及無形資產與負債進行辨識及評價,主要評價範圍及假設包含有形資產之現時重置成本、無形資產之種類及其依預期未來經濟效益、成長率及折現率而採用現金流量折現等,所辨認之有形及無形資產公允價值與各取得日之帳面價值差額則依照原剩餘耐用年限或預期未來經濟效益年限提列折舊或攤銷。本集團管理階層認為相關評價及假設已適當反映取得關聯企業可辨認資產及負債淨公允價值。

六、現金及約當現金

	105年12月3	31日	104年12月3	1日
庫存現金	\$	6,856	\$	8,806
銀行支票存款及活期存款		28,823,763		50,291,823
約當現金	_	9,561,905		4,950,552
	\$	38,392,524	\$	55,251,181

約當現金包括自取得日起3個月内、高度流動性、可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之定期存款,係用於滿足短期現金承諾。

七、透過損益按公允價值衡量之金融工具

	105年12月31日	104年1	104年12月31日		
指定透過損益按公允價值衡量之金融資產					
上櫃公司私募可轉換公司債	\$ 10	0,583	\$ 100,500		
結構式定期存款		_	1,646,357		
小清十	10	0,583	1,746,857		
持有供交易之金融資產					
上市(櫃)公司股票	1,85	5,073	37,058		
基金受益憑證	58	4,945	573,242		
換匯合約	46	2,339	1,452,611		
遠期外匯合 約	6	6,872	18,913		
外幣選擇權合約			5,020		
小計	2,96	9,229	2,086,844		
透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動	\$ 3,06	9,812	\$ 3,833,701		
持有供交易之金融負債					
可轉換公司債轉換、贖回與賣回權(附註十九)	\$ 1,21	3,890	\$ 2,632,565		
換匯合約	42	2,934	290,176		
遠期外匯合約	10	8,912	69,207		
外幣選擇權合約	1	7,924	13,659		
利率交換合約			119		
透過損益按公允價值衡量之金融負債一流動	\$ 1,76	3,660	\$ 3,005,726		

(一) 本集團與銀行簽訂之結構式定期存款以及本公司投資之私募可轉換公司債,皆包括非與主契約緊密關聯之 嵌入式衍生工具,於原始認列時將前述合約整體指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產。

(二) 於資產負債表日未適用避險會計且尚未到期之換匯合約如下:

幣別	到期期間	合約金額(千元)
105年12月31日		
新台幣兌美金	106.01~106.12	NTD59,797,499 / USD1,871,000
美金兌人民幣	106.03	USD49,904 / CNY349,800
美金兌日幣	106.02	USD77,153 / JPY8,600,000
美金兌新台幣	106.01	USD61,000 / NTD1,958,908
104年12月31日		
新台幣兌美金	105.01~105.12	NTD57,554,138 / USD1,802,834
美金兌人民幣	105.01~105.03	USD353,881 / CNY2,255,872
美金兌日幣	105.03	USD67,125 / JPY8,240,000
美金兌新台幣	105.01	USD91,750 / NTD3,005,494

(三) 於資產負債表日未適用避險會計且尚未到期之遠期外匯合約如下:

幣別	幣別 到期間 到期間		
105年12月31日			
新台幣兌美金	106.01~106.02	NTD2,842,330 / USD90,000	
美金兌人民幣	106.01~106.02	USD70,000 / CNY484,805	
美金兌日幣	106.01~106.02	USD43,877 / JPY5,063,820	
美金兌韓圜	106.01	USD35,000 / KRW41,012,700	
美金兌馬幣	106.01~106.02	USD19,000 / MYR84,544	
美金兌新台幣	106.01~106.03	USD190,000 / NTD6,099,400	
美金兌新加坡幣	106.01~106.03	USD12,900 / SGD18,080	
美金兌歐元	106.01	USD281 / EUR270	
104年12月31日			
新台幣兌美金	105.02	NTD325,400 / USD10,000	
美金兌人民幣	105.01~105.03	USD121,000 / CNY780,252	
美金兌日幣	105.01	USD14,000 / JPY1,713,388	
美金兌韓圜	105.01	USD8,000 / KRW9,420,350	
美金兌馬幣	105.01~105.02	USD6,000 / MYR25,525	
美金兌新台幣	105.01~105.03	USD155,000 / NTD5,088,230	
美金兌新加坡幣	105.01~105.02	USD11,400 / SGD16,079	

(四) 於資產負債表日未適用避險會計且尚未到期之外幣選擇權合約如下:

合約内容	到期期間	每期合約金額(千元)
105年12月31日		
Buy USD Call / CNY Put	106.08(註)	USD2,000 / CNY13,800
Sell USD Put / CNY Call	106.08(註)	USD1,000 / CNY6,900
104年12月31日		
Buy USD Call / CNY Put	106.08(註)	USD2,000 / CNY13,800
Buy USD Put / CNY Call	105.03	USD20,000 / CNY131,600
Sell USD Put / CNY Call	106.08(註)	USD1,000 / CNY6,900

註:上述合約約定每月進行交割,惟交易對手有權利提前終止合約,或當符合約定條件時合約將提前終止或交易雙方均無交割義務。

(五)於104年12月31日未適用避險會計且尚未到期之利率交換合約如下:

到期期間	名目本金(千元)	支付利率區間	收取利率區間
105.10	NTD1,000,000	4.6%	0.0%~5.0%

八、備供出售金融資產

	105年12月31日		104年12		
非上市(櫃)公司普通股	\$	553,350		\$	249,217
有限合夥		273,372			476,612
基金受益憑證		243,458			16,037
上市(櫃)公司普通股		146,786			197,580
非上市(櫃)公司特別股		78,068	_		15,260
備供出售金融資產		1,295,034			954,706
減:列為流動資產		266,696	_		30,344
列為非流動資產	\$	1,028,338		\$	924,362

九、應收帳款淨額

	105年12月3	1日	104年12月3	81日
應收帳款	\$	51,199,266	\$	45,014,393
減:備抵呆帳		53,709		82,906
	\$	51,145,557	\$	44,931,487

(一) 應收帳款

本集團之主要授信期間為30~90天。於評估應收帳款備抵呆帳時,本集團考量應收帳款之帳齡分析、歷史經驗及客戶財務 狀況等。

截至105年及104年12月31日止,前五大客户之應收帳款餘額占本集團應收帳款餘額之百分比分別為30%及26%,其餘應收帳款之信用集中風險相對並不重大。

應收帳款以逾期天數為基準之帳齡分析如下:

	105年12月31日	3	104年12月31日		
未逾期	\$	45,959,876	\$ 40,409	,227	
1至30天		4,467,435	3,901	,300	
31至90天		700,122	495	,664	
91天以上		71,833	208	3,202	
合計	\$	51,199,266	\$ 45,014	1,393	

已逾期但未減損應收帳款之逾期帳齡分析如下:

	105年12月3	104年12	104年12月31日			
1至30天	\$	4,449,479		\$	3,086,796	
31至90天		596,647	_		344,265	
合計	\$	5,046,126		\$	3,431,061	

於資產負債表日上述已逾期但本集團尚未認列備抵呆帳之應收帳款,因其信用品質並未重大改變,本集團管理階層認為仍可回收其金額。本集團對該等應收帳款並未持有任何擔保品或其他信用增強保障。

應收帳款之備抵呆帳變動資訊如下:

	個別評估減損損失		個別評估減損損失 群組評估減損損失		合計	
105年1月1日餘額	\$	39,046	\$	43,860	\$	82,906
本年度迴轉呆帳費用	(21,501)	(6,521)	(28,022)
外幣換算差額	(1,092)	(83)	(1,175)
105年12月31日餘額	\$	16,453	\$	37,256	\$	53,709
104年1月1日餘額	\$	28,305	\$	55,840	\$	84,145
本年度提列(迴轉)呆帳費用		18,816	(10,584)		8,232
本年度實際沖銷	(7,617)	(209)	(7,826)
外幣換算差額	(458)	(1,187)	(1,645)
104年12月31日餘額	\$	39,046	\$	43,860	\$	82,906

(二) 金融資產之移轉

本公司讓售應收帳款之相關資訊如下:

交易對象	本年度讓	本年度讓售金額(千元)		本年度已收現金額(千元) 截至年底已預支金額(千元) 已預支金額年利率(%		本年度已收現金額(千元)		現金額(千元) 截至年底已預支金額(千元) 🗄		額度(千元)
105年度										
花旗銀行	USD	_	USD	41,849	USD	_	_	USD 66,000		
104年度										
花旗銀行	USD	78,804	USD	36,955	USD	41,849	1.30	USD 92,000		

上述額度可循環使用,另依讓售合約之規定,因商業糾紛(如銷貨退回或折讓等)而產生之損失由本公司承擔,因信用風險而產生之損失則由該銀行承擔。本公司於105年及104年12月31日分別提供美金2,000千元及5,000千元之商業本票予銀行用以補償商業糾紛損失。截至105年12月31日止,本公司並未發生重大商業糾紛,於可預見之未來亦預期不會發生重大商業糾紛。

十、存貨

	105年12月31日		104年12月]31日
製成品	\$	6,519,465	\$	10,012,182
在製品		2,822,687		1,692,346
原料		10,850,062		9,672,894
物料		795,093		852,251
在途原物料		450,755	_	1,028,606
	\$	21,438,062	\$	23,258,279

105及104年度與存貨相關之營業成本分別為219,623,236千元及233,165,722千元,其中分別包括存貨損失451,780千元及352,011千元。

十一、存貨-營建房地

	105年12月31日		104年12月3	1日
待售房地	\$	263,526	\$	5,431
在建房地		22,236,464		23,956,678
營建用地		1,687,525		1,751,429
	\$	24,187,515	\$	25,713,538

待售房地主係位於昆山干燈及上海張江並已陸續完工出售:在建房地主係位於上海漕寶路段與滬太路段及昆山利都路段與 新虹路段:利息資本化資訊請參閱附註二三。

截至105年及104年12月31日,預期超過12個月以後回收之存貨分別為12.076.154千元及24.837.046千元。

本集團設定抵押作為借款擔保之存貨-營建房地金額,請參閱附註三四。

十二、其他金融資產

	105年12月31日	1()4年12月31日	
無擔保次順位公司債	\$ 1,0	000,000	\$	_
3個月以上到期之定期存款	4	480,736		220,545
質押之定期存款(附註三四)		206,530		207,359
存出保證金		178,103		197,513
其他(附註三四)		13,698		22,254
其他金融資產	1,8	879,067		647,671
減:列為流動資產	<u>.</u>	558,686		301,999
列為非流動資產	\$ 1,3	320,381	\$	345,672

上述無擔保次順位公司債係本集團於105年6月認購之無到期日累積次順位公司債1,000張,每張面額1,000千元,105年12 月31日年利率為3.5%。

十三、採用權益法之投資

	105年12月31日		105年12月31日 104年12月31日 104年12月31日		B
投資關聯企業	\$	49,154,346	\$	36,527,711	
投資合資		670,550		613,841	
	\$	49,824,896	\$	37,141,552	

(一) 投資關聯企業

1. 本集團採用權益法之關聯企業投資列示如下:

被投資公司名稱	主要業務	營運地點	105年12月31日		1	04年12月31日 (調整後)
具重大性之關聯企業						
矽品精密工業公司(矽品)	各項積體電路構裝之製造、加工、買 賣及測試等業務	台灣	\$	45,884,727	\$	35,141,701
個別不重大之關聯企業						
Deca Technologies Inc.(Deca)	控股公司,集團從事半導體之製造、 組合、加工、測試及銷售	英屬開曼群島		1,820,329		_
宏璟建設公司(宏璟)	委託營造廠商興建大樓及出租業務等	台灣		1,162,234		1,313,499
宏錦光公司(宏錦光)	經營辦公大樓及攤位出租業務	台灣		321,120		332,444
元隆電子公司(元隆)	晶圓積體電路代工	台灣		266,085		40,216
				49,454,495		36,827,860
	減:以土地作價投資宏錦光之未實現			300,149		300,149
	利益		\$	49,154,346	\$	36,527,711

2. 資產負債表日對關聯企業持有之股權百分比如下:

被投資公司名稱	105年12月31日	104年12月31日
矽品	33.29%	24.99%
Deca	22.07%	_
宏璟	26.22%	26.22%
宏錦光	27.31%	27.31%
元隆	38.76%	18.24%

3. 本公司於104年9月收購矽品股權24.99%,對矽品具重大影響。本公司復於105年3月至4月間陸續以現金13,735,498 干元於公開市場上取得矽品普通股及海外存託憑證(每單位表彰普通股5股)258,300干股,致持股比例由24.99%上升至 33.29%。

截至105年12月31日止,本公司已完成投資成本與所享有矽品可辨認資產及負債之淨公允價值份額間差額之辨識,並追 溯調整財務報表。104年12月31日資產負債表調整項目如下:

	追溯調整前			追溯調整後		
採用權益法之投資-矽品	_	\$	35,423,058		\$	35,141,701
保留盈餘	_	\$	56,184,069		\$	55,902,712

另,本公司於105年6月經董事會通過並與矽品簽署共同轉換股份協議,請參閱附註三七。

- 4. 本公司於105年7月以每股美金0.608元投資Deca發行之特別股98,490千股共計1,934,062千元(美金59,882千元),投資後持股比例為22.07%,取得對Deca重大影響力。截至105年12月31日止,本公司尚未完成投資成本與所享有Deca可辨認資產及負債之淨公允價值份額間差額之辨識。
- 5. 台灣福雷於105年11月以現金225,000千元認購元隆私募之普通股90,000千股,私募後加計本公司原持有元隆之股數,截至105年12月31日止,對元隆之持股比例為38.76%。截至105年12月31日止,本集團尚未完成投資成本與所享有元隆可辨認資產及負債之淨公允價值份額間差額之辨識。

6. 關聯企業具公開市場報價之第1級公允價值資訊如下:

	105年12月31日		104年12月31日		3	
矽品	\$		49,634,805		\$	40,741,700
宏璟	\$		1,310,829		\$	1,149,549
元隆	\$		307,038		\$	104,255

7. 本集團重大關聯企業之彙整性財務資訊

以下彙總性財務資訊係矽品依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可之IFRSs編製之合併財務報告,本集團投資帳面金額已反映採權益法時所做之調整。另,本集團於105及104年度自矽品收取之股利分別為3,941,740千元及0元。

	105年12月31日		104年12月31日(調整後)		
流動資產	\$	50,451,295	\$	48,785,212	
非流動資產		107,606,186		112,547,467	
流動負債	(41,088,439)	(30,677,239)	
非流動負債	(16,484,482)	(21,967,349)	
權益	\$	100,484,560	\$	108,688,091	
本集團持股比例		33.29%		24.99%	
本集團享有之權益	\$	33,451,310	\$	27,161,154	
商譽		12,433,417		7,980,547	
投資帳面金額	\$	45,884,727	\$	35,141,701	
	105年度		104年度		
營業收入	\$	85,111,913	\$	82,839,922	
營業毛利	\$	15,027,247	\$	20,483,422	
稅前淨利	\$	7,362,092	\$	9,264,979	
本年度淨利	\$	5,610,685	\$	7,636,379	
本年度其他綜合損益	(2,504,310)	(906,053)	
本年度綜合損益總額	\$	3,106,375	\$	6,730,326	

8. 本集團個別不重大之關聯企業彙總資訊

	105年長		104年度	
本集團享有之份額				
本年度淨利(損失)	(\$	153,268)	\$	115,857
其他綜合損益	(115,650)	_(2,916)
綜合損益總額	(\$	268,918)	\$	112,941

9. 採用權益法之關聯企業及本集團對其所享有之損益及其他綜合損益份額,係依據各關聯企業同期間經會計師查核之財務 報告計算。

(二)投資合資

1. 本集團採用權益法之個別不重大之合資投資為日月陽電子公司(日月陽),係於104年5月與日商TDK Corporation簽署合資協議共同出資成立。本集團於104年8月以現金投資618,097千元,復於105年9月按持股比例參與日月陽現金增資案,投資金額為146,903千元,105年及104年12月31日之持股比率均為51.00%。日月陽位於台灣,主要從事電子零組件製造。依據聯合協議,由出資雙方共同主導日月陽相關營運活動,因此本集團對日月陽不具控制力,對日月陽之投資採用權益法。

2. 本集團個別不重大之合資之彙總性財務資訊

	105年度	104年度
本集團享有之本年度淨損及綜合損益份額	(\$ 90,478)	(\$ 4,274)

3. 採用權益法之合資及本集團對其所享有之損益及其他綜合損益份額,係依據該合資公司同期間經會計師查核之財務報告 認列。

十四、不動產、廠房及設備

不動產、廠房及設備每一類別之帳面金額如下:

	105年12月31日		104年12月31日		
土地	\$	3,365,013	\$	3,381,300	
建築物及附屬設備		58,028,631		59,801,054	
機器設備		72,700,762		78,715,309	
其他設備		2,089,581		1,814,994	
未完工程及待驗設備		7,696,254		6,284,418	
	\$	143,880,241	\$	149,997,075	

105年度

	建築物及						未完工程及					
		土地		附屬設備	機器設備		其他設備		待驗設備		合計	
成本			_									
105年1月1日餘額	\$	3,381,300	9	\$ 94,447,932	\$	243,283,607	\$	7,722,408	\$	6,397,760	\$ 3	55,233,007
增添		_		22,341		94,480		470,901		27,093,140		27,680,862
處分		_	(684,698)	(5,956,179)	(159,822)	(268,782)	(7,069,481)
重分類		_		5,110,102		19,661,732		691,276	(:	25,463,285)	(175)
由企業合併取得		_		_		_		1,159		_		1,159
淨兌換差額	(16,287)	(2,637,502)	(8,882,884)	(251,261)	(45,291)	(11,833,225)
105年12月31日餘額	\$	3,365,013	-	96,258,175	\$	248,200,756	\$	8,474,661	\$	7,713,542	\$ 3	64,012,147
			_									
累計折舊及減損												
105年1月1日餘額	\$	_	9	34,646,878	\$	164,568,298	\$	5,907,414	\$	113,342	\$ 2	05,235,932
折舊費用		_		5,114,263		22,983,290		864,061		_		28,961,614
減損損失		_		620		876,123		5,564		5,924		888,231
處分		_	(449,198)	(5,544,489)	(151,875)	(100,049)	(6,245,611)
重分類		_	(5,123)		9,660	(4,537)		_		_
由企業合併取得		_		_		_		824		_		824
淨兌換差額		_	(1,077,896)	(7,392,888)	(236,371)	(1,929)	(8,709,084)
105年12月31日餘額	\$		-	38,229,544	\$	175,499,994	\$	6,385,080	\$	17,288	\$ 2	20,131,906
	_		_		_		_		_		_	

104年度

				建築物及					Ħ	卡完工程及		
		土地		附屬設備		機器設備		其他設備	待驗設備		合計	
成本												
104年1月1日餘額	\$	3,348,018	\$	86,725,254	\$	233,669,627	\$	7,182,574	\$	5,862,217	\$ 3	336,787,690
增添		_		132,584		553,496		401,417		27,193,324		28,280,821
處分		_	(405,040)	(8,041,933)	(232,555)	(20,711)	(8,700,239)
重分類		_		8,579,472		18,054,712		389,783	(:	26,893,158)		130,809
淨兌換差額		33,282	(584,338)	(952,295)	(18,811)		256,088	(1,266,074)
104年12月31日餘額	\$	3,381,300	\$	94,447,932	\$	243,283,607	\$	7,722,408	\$	6,397,760	\$ 3	355,233,007
	-		-				-		-			
累計折舊及減損												
104年1月1日餘額	\$	_	\$	30,329,544	\$	149,497,980	\$	5,365,887	\$	7,164	\$ 1	85,200,575
折舊費用		_		4,790,646		23,372,408		775,716		_		28,938,770
減損損失		_		120,424		31,116		_		106,589		258,129
處分		_	(308,895)	(7,838,937)	(224,509)		_	(8,372,341)
重分類		_		5,704	(11,920)		3,008		_	(3,208)
淨兌換差額		_	(290,545)	(482,349)	(12,688)	(411)	(785,993)
104年12月31日餘額	\$	_	\$	34,646,878	\$	164,568,298	\$	5,907,414	\$	113,342	\$ 2	205,235,932

由於本集團考量封裝及測試部門未來營運計畫並評估現有產能規劃,或部分廠房及設備不符本集團生產需求,本集團於 105及104年度分別認列減損損失888,231千元及258,129千元,並列入合併綜合損益表之其他利益(損失)項下。本集團評估 已減損之廠房及設備之可回收金額,係依據市場中相似狀況之資產報價減處分成本衡量,因該市場之交易並非活絡,故該 資產報價屬於第三級之公允價值;餘以該資產之使用價值衡量且本集團預期該等資產已無未來現金流入。

本集團之不動產、廠房及設備係以直線基礎按下列耐用年數計提折舊:

建梁》	刎攵	LIA.	屬	訍	惼

廠房主建物	10至40年
無塵室工程	10至20年
其他	3至20年
機器設備	2至10年
其他設備	2至20年

利息資本化資訊請參閱附註二三。

十五、商譽

		成本	累計減損		帳面價值
105年1月1日餘額	\$	12,495,515	\$ 1,988,996	\$	10,506,519
由企業合併取得		83,892	_		83,892
淨兌換差額	(31,533)	_	(31,533)
105年12月31日餘額	\$	12,547,874	\$ 1,988,996	\$	10,558,878
104年1月1日餘額	\$	12,434,411	\$ 1,988,996	\$	10,445,415
淨兌換差額		61,104	_		61,104
104年12月31日餘額	\$	12,495,515	\$ 1,988,996	\$	10,506,519

(一)分攤商譽至現金產生單位

進行減損測試時,商譽係分攤至封裝部門、測試部門、電子組裝部門及其他部門等四個現金產生單位。分攤至現金產生單位之商譽帳面金額如下:

現金產生單位	105年12月31日	104年12月31日
測試部門	\$ 7,868,961	\$ 7,890,525
其他	2,689,917	2,615,994
	\$ 10,558,878	\$ 10,506,519

(二) 減損評估

本集團於各年度結束日對商譽之可回收金額進行減損評估,並以使用價值作為可回收金額之計算基礎,預估未來5年現金流量及以持平之成長率1.5%外推超過5年後之現金流量,使用年折現率折算而得。基於此分析結果,本集團105及104年度皆未認列任何商譽之減損損失。

本集團用以計算現金產生單位之使用價值之關鍵假設包括營收成長率及折現率。營收成長率係參考本集團及相關行業增長預測及歷史經驗予以評估,而105年及104年12月31日所使用之折現率分別為9.09%~10.49%及8.67%~10.71%。

有關現金產生單位之使用價值評估,本集團管理階層相信前述關鍵假設之變動並無相當可能使各該現金產生單位之帳面金 額重大超過其可回收金額。

十六、其他無形資產

其他無形資產每一類別之帳面金額如下:

	105年12月31	日	104年12月31日			
客戶關係	\$	194,089	\$	274,402		
電腦軟體		943,527		953,322		
專利權及專門技術		302,955		15,696		
其他		120,418		138,673		
	\$	1,560,989	\$	1,382,093		

105年度

	客戶關係		電腦軟體		專利權 及專門技術		其他		合計
成本									
105年1月1日餘額	\$ 915,636	\$	3,338,360	\$	154,082	\$	193,338	\$	4,601,416
增添(附註三三)	_		372,188		301,351		1,605		675,144
處分	_	(80,537)	(1,310)		_	(81,847)
重分類	_		_		786		_		786
由企業合併取得	_		_		1,074		30		1,104
淨兌換差額	 	(77,782)	(4,846)	(2,581)	(85,209)
105年12月31日餘額	\$ 915,636	\$	3,552,229	\$	451,137	\$	192,392	\$	5,111,394
累計攤銷									
105年1月1日餘額	\$ 641,234	\$	2,385,038	\$	138,386	\$	54,665	\$	3,219,323
攤銷費用	80,313		345,836		17,120		17,421		460,690
處分	_	(58,765)	(1,310)		_	(60,075)
重分類	_		_		786		_		786
由企業合併取得	_		_		483		23		506
淨兌換差額		(63,407)	(7,283)	(135)	(70,825)
105年12月31日餘額	\$ 721,547	\$	2,608,702	\$	148,182	\$	71,974	\$	3,550,405

104年度

						專利權				
	客戶關係		電腦軟體		及專門技術		其他		合計	
成本										
104年1月1日餘額	\$	1,579,015	\$	2,882,932	\$	2,139,138	\$	184,409	\$	6,785,494
增添		_		481,412		209		9,514		491,135
處分或除列	(663,379)	(8,426)	(1,983,914)	(204)	(2,655,923)
重分類		_		12,360		_		_		12,360
淨兌換差額			(29,918)	(1,351)	(381)	(31,650)
104年12月31日餘額	\$	915,636	\$	3,338,360	\$	154,082	\$	193,338	\$	4,601,416
累計攤銷										
104年1月1日餘額	\$	1,077,514	\$	2,084,805	\$	2,118,254	\$	37,050	\$	5,317,623
攤銷費用		227,099		325,856		9,461		17,478		579,894
處分或除列	(663,379)	(7,402)	(1,983,914)		_	(2,654,695)
重分類		_		3,190		_		_		3,190
淨兌換差額			(21,411)	(5,415)		137	(26,689)
104年12月31日餘額	\$	641,234	\$	2,385,038	\$	138,386	\$	54,665	\$	3,219,323

上述無形資產除部分客戶關係係依據未來經濟效益之預期消耗型態計提攤銷費用外,其餘係以直線基礎按下列耐用年數計提攤銷費用:

客戶關係	11年
電腦軟體	2至5年
專利使用權及專門技術	5至15年
甘州	5至37年

十七、長期預付租金

長期預付租金主要係中國大陸之土地使用權,使用期限為50至70年。

十八、借款

(一) 短期借款

主係無擔保之銀行週轉性借款,105年及104年12月31日年利率分別為0.70%~8.99%及0.57%~5.78%。

(二) 應付短期票券 - 僅104年12月31日

面額	\$	4,350,000
減:未攤銷折價		1,946
	\$	4,348,054
年利率(%)		0.78

(三) 長期借款

1. 銀行借款

本集團105年及104年12月31日之長期銀行借款中屬固定利率之週轉性借款均為1,500,000千元,將於107年12月到期, 年利率分別為1.20%及1.17%。餘皆係浮動利率之長期銀行借款,包括:

	105年12月31日	104年12月31日
(1) 週轉性借款		
銀行團聯貸-將陸續於106年1月至107年7月償還,年 利率105年及104年12月31日分別為2.55%及1.56%~ 1.92%	\$ 9,223,500	\$ 12,159,037
其他-將陸續於106年1月至108年11月償還,年利率105年及104年12月31日分別為0.74%~4.48%及0.90%~3.98%	36,009,917	25,660,638
(2) 質抵押借款		
將陸續於106年7月至112年6月償還,年利率105年及104		
年12月31日均為 4.95%~5.39%	4,390,003	3,251,139
	49,623,420	41,070,814
減:未攤銷遞延主辦費	7,198	18,670
	49,616,222	41,052,144
减:一年内到期之銀行借款	6,567,565	2,057,465
銀行借款	\$ 43,048,657	\$ 38,994,679

上述銀行團聯合融資合約,除其他有關規定外,尚規定本集團以經會計師查核或核閱之年度或半年度合併財務報告或子公司經會計師查核之年度個體財務報告為計算基礎,於貸款存續期間內,應維持約定流動比率、負債比率、有形淨值金額及利息償付能力。本集團及子公司於105年及104年12月31日均符合上述規定。

本集團預計可將部分一年內到期之長期借款再融資至104年12月31日後至少12個月,是以截至104年12月31日止有2,105,883千元未列入一年內到期部分。

2. 長期應付票券

	105年12月31日		104年12月31日		
面額	\$	2,000,000	\$	2,000,000	
減:未攤銷折價		659		1,011	
	\$	1,999,341	\$	1,998,989	
年利率(%)		1.00		1.03	

係本公司與大慶票券金融公司於104年12月簽訂發行3年期循環冤保證票券2,000,000千元。

十九、應付公司債

_	105年12月31日	104年12月31日
國内無擔保公司債		
期間5年,將於110年1月到期一次償還,每年付息,年利率 1.30%	\$ 7,000,000	\$ -
期間7年,將於112年1月到期一次償還,每年付息,年利率 1.50%	2,000,000	_
海外無擔保轉換公司債		
美金400,000千元	12,900,000	13,130,000
美金200,000千元(新台幣計價)	6,185,600	6,185,600
海外有擔保公司債-由本公司提供擔保		
美金 300,000千元,期間3年,將於106年7月到期一次償還,每半年付息,年利率2.125%	9,675,000	9,847,500
人民幣 500,000千元,期間5年,已於105年9月到期一次償還,年利率4.25%	-	2,527,489
國内有擔保公司債-由銀行提供擔保期間5年,已於105年8月到 期償還,年利率1.45%		8,000,000

	105年12月31日		104年	104年12月31日		
		\$	37,760,600		\$	39,690,589
減:應付公司債折價	_		760,697			1,264,339
			36,999,903			38,426,250
減:一年內到期之應付公司債	_		9,658,346			14,685,866
應付公司債	_	\$	27,341,557		\$	23,740,384

本集團於104年12月31日預計可將部分一年內到期之應付公司債再融資至資產負債表日後至少12個月,是以截至104年12月31日止尚有8,000,000千元仍列為非流動。

(一)本公司於102年9月發行海外第三次無擔保轉換公司債,發行總額計美金400,000千元,每張面額為美金200千元或其整數倍數,票面利率為0%,發行期限5年。每單位公司債持有人有權於發行日後第41日起至到期日前10日止,除依法令規定停止過戶期間外,請求按固定匯率美金1元對新台幣29.956元及轉換當時每股轉換價格轉換為本公司之普通股。發行時轉換價格為33.085元,後續轉換價格遇有本公司因反稀釋條款之情況,將依轉換辦法規定予以調整,105年及104年12月31日轉換價格分別為28.99元及30.28元。

發行滿3年後,如本公司普通股於台灣證券交易所連續20個交易日之收盤價格依當時市場匯率換算為美金後,均達轉換價格之130%;或90%之公司債業已贖回、買回並經註銷或經債券持有人行使轉換權利;或因法令變更致使本公司因此公司債負擔稅賦增加時,本公司得提前贖回部分或全部債券。

公司債持有人亦得於此公司債發行屆滿3年當日:或本公司控制權發生變動:或本公司普通股下市時,要求本公司贖回 部分或全部債券。

於發行日此可轉換公司債包括主債務契約(列入應付公司債項下)及轉換權、贖回權及賣回權(列入透過損益按公允價值衡量之金融負債項下),主債務契約原始認列之有效利率為3.16%,轉換權、贖回權與賣回權原始認列之公允價值為1.667.950千元。

(二)本公司於104年7月發行海外第四次無擔保轉換公司債,發行總額計美金200,000千元,每張面額為美金200千元或其整數倍數,票面利率為0%,發行期限2.75年。償還、賣回及贖回金額將按固定匯率美金1元對新台幣30.928元換算為新台幣,並以該新台幣金額按償還、賣回及贖回當時之匯率換算為美金計算。每單位公司債持有人有權於發行日後第41日起至到期日前10日止,除依法令規定停止過戶期間外,請求按固定匯率美金1元對新台幣30.928元及轉換當時每股轉換價格轉換為本公司之普通股,本公司庫藏股可供轉換股權之用。發行時轉換價格為54.55元,後續轉換價格遇有本公司因反稀釋條款之情況,將依轉換辦法規定予以調整,105年及104年12月31日轉換價格分別為49.52元及51.73元。發行滿2.72年後,如本公司普通股於台灣證券交易所連續30個營業日中有20個交易日之收盤價格依當時市場匯率換算為美金後,均達轉換價格之130%;或90%之公司債業已贖回、買回並經註銷或經債券持有人行使轉換權利;或因法令變更致使本公司因此公司債負擔稅賦增加時,本公司得提前贖回部分或全部債券。

公司債持有人亦得於本公司控制權發生變動:或本公司普通股下市時,要求本公司贖回部分或全部債券。

於發行日此可轉換公司債包括主債務契約(列入應付公司債項下)及轉換權(列入資本公積項下)。主債務契約原始認列之 有效利率為1.58%,轉換權原始認列之金額為214,022千元。

(三) 另本公司秉持永續發展的精神,為進一步落實對於環境保護及節約能源的承諾,本公司間接持股100%之子公司 Anstock II Limited於103年7月發行總額美金300,000千元,票面利率2.125%之3年期海外公司債,由本公司提供擔保,並用於本集團所推行各項環境保護及節約能源之計畫支出。

本公司於106年1月發行無擔保普通公司債,發行總額計8,000,000千元,分為甲類3,700,000千元及乙類4,300,000千元, 將分別於111年1月及113年1月到期一次償還,每年付息,年利率分別為1,25%及1,45%。

二十、其他應付款

	105年12月31日	3	104年12]31日	
應付薪資及獎金	\$	6,606,406	:	5	5,826,982
應付設備款		5,605,528			4,782,357
應付員工酬勞及董事酬勞		2,400,778			2,270,608
應付員工保險費		617,419			599,218
應付水電費		410,796			466,956
應付專利權及專門技術(附註三三)		120,938			_
其他		5,760,169	_		5,248,697
	\$	21,522,034	:	\$	19,194,818

二一、 退職後福利計畫

(一) 確定提撥計畫

- 本集團中之本公司及國内子公司所適用「勞工退休金條例」之退休金制度,係屬政府管理之確定提撥退休計畫,依員工 每月薪資6%提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。
- 2. 大陸、美國、馬來西亞、新加坡及墨西哥等地之子公司,亦依當地法令規定,提撥並繳付相關單位。

(二)確定福利計畫

- 1. 本集團中之本公司及國内子公司所適用我國「勞動基準法」辦理之退休金制度係屬政府管理之確定福利退休計畫。員工退休金之支付,係根據服務年資及核准退休日前6個月平均工資計算。本公司及國内子公司按員工每月薪資總額之一定比率按月提撥員工退休基金,交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入台灣銀行之專戶,年度終了前,若估算專戶餘額不足給付次一年度內預估達到退休條件之勞工,次年度3月底前將一次提撥其差額。該專戶係委託勞動部勞動基金運用局管理,本公司及國内子公司並無影響投資管理策略之權利。
- 2. ASE Japan Co., Ltd.規定服務滿10年以上之員工,得按服務年資及其退休時薪資之一定比率領取退休金: ASE (Korea) Inc.亦規定服務滿1年以上之員工及董事得按服務年資及其離職或退休時薪資之一定比率領取資遣費或退休金,且按員工薪資一定比率提撥至以員工名義並受公司管理之外部財務機構之帳戶。
- 3. 本公司、台灣福雷及日月光電子另提列委任經理人退休金準備,105及104年度分別認列退休金成本6,872千元及2,302 千元(列入淨確定福利負債項下),並分別支付經理人退休金0元及2,549千元。截至105年及104年12月31日止,屬委任經 理人之應計退休金負債分別為206,467千元及199,595千元。
- 4. 除經理人退休金外,本集團列入合併資產負債表之確定福利計畫金額列示如下:

	105年12月	31日		104年1	12月31日	<u> </u>
確定福利義務之現值	\$		8,389,884		\$	7,973,676
計畫資產之公允價值	(4,417,367)		(3,973,729)
提撥短絀			3,972,517			3,999,947
列入其他應付款	(22,273)		(138,959)
列入預付退休金			15,542			11,910
淨確定福利負債	\$		3,965,786		\$	3,872,898

淨確定福利負債變動如下:

	確定	福利義務現值	計畫資	資產公允價值	淨確定	福利負債(資產)
105年1月1日	\$	7,973,676	(\$	3,973,729)	\$	3,999,947
服務成本						
當期服務成本		329,838		_		329,838
利息費用(收入)		167,111	(109,080)		58,031
認列於損益		496,949	(109,080)		387,869
再衡量數						
計畫資產報酬(除包含於淨利息之金額外)		_		54,549		54,549
精算損失						
財務假設變動		156,193		_		156,193
經驗調整		200,723		_		200,723
人口統計假設變動		5,716	-		·	5,716
認列於其他綜合損益		362,632		54,549		417,181
雇主提撥		_	(807,232)	(807,232)
福利支付數						
計劃資產	(308,471)		308,471		_
雇主	(36,033)		_	(36,033)
企業合併承擔之負債		535	(535)		_
國外退休計劃之兌換差額	(99,404)		110,189		10,785
105年12月31日	\$	8,389,884	(\$	4,417,367)	\$	3,972,517
104年1月1日	\$	7,674,293	(\$	3,502,487)	\$	4,171,806
服務成本						
當期服務成本		335,655		_		335,655
利息費用(收入)		183,889	(108,356)		75,533
認列於損益		519,544	(108,356)		411,188
再衡量數 計畫資產報酬(除包含於淨利息之金額外)		=		12,426		12,426
精算(利益)損失				.2, .20		.2,.20
財務假設變動		309,695		_		309,695
經驗調整	(243,363)		_	(243,363)
人口統計假設變動	(15,847)		_	(15,847)
認列於其他綜合損益		50,485		12,426		62,911
雇主提撥		_	(611,581)	(611,581)
福利支付數						
計劃資產	(192,928)		192,928		_
雇主	(43,088)		_	(43,088)
國外退休計劃之兌換差額	(34,630)		43,341		8,711
104年12月31日	\$	7,973,676	(\$	3,973,729)	\$	3,999,947

5. 計畫資產之主要類別於資產負債表日之公允價值如下:

	105年12月	31日	104年12月	31日
現金	\$	2,232,367	\$	2,090,399
債務工具		1,030,384		823,496
權益工具		1,071,777		1,020,532
其他		82,839		39,302
	\$	4,417,367	\$	3,973,729

6. 本公司及國内子公司因「勞動基準法」之退休金制度暴露於下列風險:

(1) 投資風險

勞動部勞動基金運用局透過自行運用及委託經營方式,將勞工退休基金分別投資於國内(外)權益證券與債務證券及銀行存款等標的,惟本公司及國内子公司之計畫資產得分配金額係以不低於當地銀行2年定期存款利率計算而得之收益。

(2) 利率風險

政府公債之利率下降將使確定福利義務現值增加,惟計畫資產之債務投資報酬亦會隨之增加,兩者對淨確定福利負債之影響具有部分抵銷之效果。

(3) 薪資風險

確定福利義務現值之計算係參考計畫成員之未來薪資。因此計畫成員薪資之增加將使確定福利義務現值增加。

- 7. ASE (Korea) Inc.依法規定應管理基金資產及決定投資策略,並負有基金資產不足支付確定福利義務時之責任;其計畫資產投資於銀行存單及信用良好之債券。
- 8. 確定福利退休計畫應認列之確定福利成本及淨確定福利負債係使用預計單位福利法進行精算評價。本集團之確定福利 義務現值(不含經理人),係由合格精算師進行精算。衡量日之重大假設如下:

	105年12月31日	104年12月31日
折現率	0.06%~3.58%	0.15%~3.48%
薪資預期增加率	2.00%~4.42%	2.00%~4.57%

若重大精算假設分別發生合理可能之變動,在所有其他假設維持不變之情況下,將使確定福利義務現值增加(減少)之金額如下:

	105年12月31日		104年12月31日		
折現率					
增加0.5%	(\$	464,647)	(\$	444,132)	
减少0.5%	\$	508,862	\$	497,046	
薪資預期增加率					
增加0.5%	\$	500,051	\$	476,378	
减少0.5%	(\$	452,956)	(\$	426,130)	

由於精算假設可能彼此相關,僅單一假設變動之可能性不大,故上述敏感度分析可能無法反映確定福利義務現值實際 變動情形。

9. 未折現之退休金福利支付到期分析

	105年12月3	1⊟	104年12	2月31日	<u> </u>
1年内	\$	292,100		\$	247,030
超過1年但未超過5年		1,673,549			1,616,804
超過5年		17,129,585			17,674,518
	\$	19,095,234		\$	19,538,352

本集團於105年及104年12月31日預期1年內對確定福利計畫提撥之金額分別為521,324千元及705,384千元。 截至105年及104年12月31日,本集團確定福利義務平均到期期間分別為8年~15年及8年~16年。

二二、權益

(一) 股本

普通股股本

	105年12月31日	104年12月31日
額定股數(干股)	10,000,000	10,000,000
保留股數(干股)		
員工認股權	800,000	800,000
額定股本	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000
保留股本		
員工認股權	\$ 8,000,000	\$ 8,000,000
已登記股數(千股)	7,936,473	7,902,929
預收股數(干股)	9,711	7,499
已發行且已收足股款之股數(干股)	7,946,184	7,910,428

本公司已發行之普通股每股面額為10元,每股享有一表決權(子公司持有之本公司股票除外)及收取股利之權利。105年及104年12月31日額定股數中均尚有500,000千股暫無須辦理變更登記。

本公司董事會於105年12月決議辦理現金增資發行普通股300,000千股,業經金管會於106年1月4日核准申報生效,並以106年2月15日為增資基準日,每股34.3元溢價發行。

發行海外存託憑證

本公司發行ADR,每單位表彰本公司普通股5股,截至105年及104年12月31日止,流通在外之ADR分別為125,518千單位及115,240千單位,折合普通股分別約627,590千股及576,198千股。

(二) 資本公積

	105年12月31日	104年12月31日
得用以彌補虧損、發放現金或撥充股本(註1)		
股票發行溢價	\$ 5,844,397	\$ 5,479,616
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	7,176,958	7,197,510
僅得用以彌補虧損		
認列對子公司所有權權益變動數(註2)	6,132,777	8,489,984
庫藏股票交易	950,368	717,355
員工認股權執行	630,411	544,112
員工認股權失效	3,626	3,626
採權益法認列關聯企業資本公積之變動數	82,243	30,284
不得作為任何用途		
員工認股權	1,230,247	1,080,590
發行可轉換公司債認列權益組成部分	214,022	214,022
	\$ 22,265,049	\$ 23,757,099

註1:此頻資本公積得用以彌補虧損,亦得於公司無虧損時,用以發放現金或撥充股本,惟撥充股本時每年以實收股本之一定比率為限。

註2:此類資本公積係本公司未實際取得或處分子公司股權時,因子公司權益變動認列之權益交易影響數,或本公司採權益法認列子公司資本公積之調整數。

(三) 保留盈餘及股利政策

依104年5月公司法之修正,股息及紅利之分派限於股東,員工非屬盈餘分派之對象。配合上述法規,本公司業已於105年度之股東常會決議修改公司章程。員工酬勞及董事酬勞估列基礎及實際配發情形,請參閱稅前淨利之員工福利費用(附註二三(五))。

依本公司105年6月修正後之章程規定,每年度有純益時,依下列順序分派之:

- 1. 彌補虧損。
- 2. 提存百分之十為法定盈餘公積。
- 3. 依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。
- 4. 加計或減除保留盈餘中屬已實現之透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益。

本公司正處於企業穩定成長階段,為因應目前及未來業務擴展之資金需求,並滿足股東對現金流入之需求,本公司之股利政策係採取剩餘股利政策分派股利,其中現金股利發放之比例不低於股利總額30%,餘額則配發股票股利,並由董事會擬具盈餘分配案,經股東會決議後辦理。

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止。法定盈餘公積得用以彌補虧損。公司無虧損時,法定盈餘公積超過實收股本總額25%之部分除得撥充股本外,尚得以現金分配。

本公司依金管證發字第1010012865號函、金管證發字第1010047490號函及「採用國際財務報導準則(IFRSs)後,提列特別 盈餘公積之適用疑義問答」規定提列及迴轉特別盈餘公積。

分配未分配盈餘時,除屬非中華民國境内居住者之股東外,其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣 抵稅額。

本公司於105年及104年6月舉行股東常會,決議通過104及103年度盈餘分配案如下:

	盘餘分配案 ————————————————————————————————————				每股股	(利(元)			
		104年度		103年度	104年度			103年度	
法定盈餘公積	\$	1,947,887	\$	2,359,267					
現金股利		12,476,779		15,589,825	\$	1.60	\$		2.00
	\$	14,424,666	\$	17,949,092					

(四) 其他權益項目

1. 國外營運機構財務報表換算之兌換差額

	105年	度		104	年度	
年初餘額		\$	4,493,570		\$	4,541,761
換算國外營運機構財務報表所產生之兌換差額		(5,843,856)			11,459
採用權益法之關聯企業或合資之換算差額之份額	_	(292,438)		(59,650)
年底餘額	_	(\$	1,642,724)		\$	4,493,570

2. 備供出售金融資產未實現損益

_	105年度		104年度	
年初餘額	\$	588,119	\$	526,778
備供出售金融資產未實現損失	(257,240)	(4,304)
處分備供出售金融資產累計損益重分類至損益		7,512		10,827
採用權益法之關聯企業或合資之備供出售金融資產未實現損益 之份額		579,241)	_	54,818
年底餘額	(\$	240,850)	\$	588,119

(五) 庫藏股票

	年初股數 (千股)	本年度增加 (千股)	本年度減少 (千股)	年底股數 (千股)
105年度				
子公司持有本公司股票	145,883	_	_	145,883
買回供轉換公司債股權轉換之用	120,000			120,000
合計	265,883			265,883
104年度				
子公司持有本公司股票	145,883	_	_	145,883
買回供轉換公司債股權轉換之用		120,000		120,000
合計	145,883	120,000		265,883

本公司董事會於104年2月通過買回庫藏股120,000千股,俾供本公司海外無擔保轉換公司債股權轉換之用,並已於104年3月間執行完畢,實際買回股份占本公司已發行股份總數1.53%,實際買回平均價格為每股44.45元。

子公司於資產負債表日持有本公司股票之相關資訊如下:

	持有股數(千股)	帳面金額	公允價值
105年12月31日			
ASETest	88,200	\$ 1,380,721	\$ 2,915,026
J&R Holding	46,704	381,709	1,543,559
台灣福雷	10,979	196,677	362,849
	145,883	\$ 1,959,107	\$ 4,821,434
104年12月31日			
ASE Test	88,200	\$ 1,380,721	\$ 3,351,618
J&R Holding	46,704	381,709	1,774,743
台灣福雷	10,979	 196,677	417,193
	145,883	\$ 1,959,107	\$ 5,543,554

上述公允價值係屬具公開市場報價之第1級公允價值。

子公司持有本公司股票係本公司因吸收合併及收購子公司,而將子公司持有本公司股票之帳面價值依本公司對子公司持股 比例計算之金額轉列庫藏股票。

本公司持有之庫藏股票,依證券交易法規定不得質押,亦不得享有股利之分派及表決權等權利。子公司持有本公司股票視同庫藏股票處理,除不得參與本公司之現金增資及無表決權外,其餘與一般股東權利相同。

(六) 非控制權益

	105年度	Ę	104年度	₹
年初餘額	\$	11,503,878	\$	8,219,097
歸屬於非控制權益之份額				
本年度淨利		1,269,560		970,134
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(601,787)	(74,968)
備供出售金融資產未實現利益		1,129		3,928
確定福利計劃精算損益		8,846	(3,440)
取得子公司所增加之非控制權益(附註二七)		7,021		_
處分子公司部分權益(附註二八)		26,436		1,712,836
子公司買回已發行流通在外之股數(附註二八)	(912,886)		-
子公司分割		-		3,535
子公司員工持有之流通在外既得認股權相關非控制權益		927,823		904,904
發放予非控制權益之現金股利	(237,850)	(232,148)
年底餘額	\$	11,992,170	\$	11,503,878

二三、稅前淨利

(一) 其他收入

	105年度		104年度	
補助款收入	\$	332,758	\$	176,721
利息收入		230,067		242,084
租金收入		51,607		60,230
股利收入		26,411		396,973
	\$	640,843	\$	876,008

(二) 其他利益

	105年度	E	104年度	
持有供交易之金融工具利益	\$	224,446	\$	1,657,093
指定透過損益按公允價值衡量之金融工具利益		223,113		815,742
外幣兌換利益(損失)		1,928,384	(713,213)
減損損失	(980,117)	(258,129)
其他		28,831	(64,457)
	\$	1,424,657	\$	1,437,036

(三) 財務成本

	105年度		104年度	
以攤銷後成本衡量之金融負債之利息費用總額	\$	2,510,197	\$	2,514,208
減:列入符合要件資產成本之金額				
列入存貨-營建房地項下	(238,469)	(197,287)
列入不動產、廠房及設備項下	(54,191)	(48,135)
		2,217,537		2,268,786
其他財務成本		43,538		43,357
	\$	2,261,075	\$	2,312,143

利息資本化年利率如下:

	105年度	104年度
存貨-營建房地	4.35%~6.00%	4.35%~6.77%
不動產、廠房及設備	1.15%~4.42%	0.75%~6.15%

(四) 折舊及攤銷

	105年度		104年度	
不動產、廠房及設備	\$	28,961,614	\$	28,938,770
無形資產		460,690		579,894
合計	\$	29,422,304	\$	29,518,664
折舊費用依功能別彙總				
營業成本	\$	26,948,106	\$	27,023,957
營業費用		2,013,508		1,914,813
	\$	28,961,614	\$	28,938,770
攤銷費用依功能別彙總				
營業成本	\$	145,953	\$	124,235
營業費用		314,737		455,659
	\$	460,690	\$	579,894

(五) 員工福利費用

105年度		104年原	Ę	
\$	2,356,416	\$	2,3	324,737
	394,741		4	113,490
	2,751,157		2,7	738,227
	470,788		1	133,496
	43,491,243		41,9	985,329
	6,034,697		5,8	398,135
\$	52,747,885	\$	50,7	755,187
\$	35,588,529	\$	34,7	720,359
	17,159,356		16,0	34,828
\$	52,747,885	\$	50,7	755,187
	\$ \$	\$ 2,356,416 394,741 2,751,157 470,788 43,491,243 6,034,697 \$ 52,747,885 \$ 35,588,529 17,159,356	\$ 2,356,416 \$ 394,741	\$ 2,356,416 \$ 2,3 394,741 2 2,751,157 2,7 470,788 41,5 43,491,243 41,5 6,034,697 5,8 \$ 52,747,885 \$ 50,7 \$ 35,588,529 \$ 34,7 17,159,356 16,6

依104年5月修正後公司法及105年6月經股東會決議之修正後章程,本公司係按當年度扣除分派員工及董事酬勞前之稅前利益分別以5.25%~8.25%及0.75%以下提撥員工及董事酬勞。105及104年度係分別按前述稅前利益之8.25%及0.75%估列員工酬勞及董事酬勞如下:

	105年度	Ę	104年度	
員工酬勞	\$	2,147,323	\$	2,033,500
董事酬勞		195,211		184,500

年度合併財務報告通過發布日後若金額仍有變動,則依會計估計變動處理,於次一年度調整入帳。

本公司於105年4月舉行董事會及104年6月舉行股東常會,分別決議通過104年度員工酬勞(以現金配發)及董事酬勞與103年度員工紅利(以現金配發)及董監事酬勞如下。104年度員工酬勞及董事酬勞已於105年6月召開之股東常會決議修正章程後,報告股東會。

	104年度		103年度	103年度			
員工酬勞/紅利	\$	2,033,800	\$	2,335,600			
董事酬勞/董監事酬勞		140,000		211,200			

上述104年度員工酬勞及董事酬勞及103年度員工紅利及董監事酬勞與前一年度財務報告估列金額之差異分別為44,200千元及1,330千元,主要係因估計改變,分別調整為105及104年度之損益。

有關本公司董事會及股東會決議之員工酬勞(紅利)及董(監)事酬勞資訊,請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢。

二四、所得稅

(一) 認列於損益之所得稅主要組成項目

	105年度	104年度
當期所得稅		
當年度產生者	\$ 4,177,900	\$ 4,029,076
未分配盈餘加徵	529,874	474,076
以前年度之調整	28,160	(20,719)
	4,735,934	4,482,433
遞延所得稅		
當年度產生者	574,541	432,580
稅率變動	14,184	3,794
以前年度之調整	(26,498)	(20,890)
兌換差額	(206,788)	(58,671)
	355,439	356,813
認列於損益之所得稅費用	\$ 5,091,373	\$ 4,839,246

會計所得與所得稅費用之調節如下:

	105年度		104	年度	
杞 前淨利	\$	28,041,272		\$	25,006,896
稅前淨利按法定稅率計算之所得稅費用	\$	8,646,523		\$	6,306,316
稅上不可減除之費損	(48,290)			161,362
 受稅所得	(700,274)		(537,987)
未分配盈餘加徵		529,874			624,564
所得稅抵減	(898,700)		(1,044,954)
暫時性差異之產生及迴轉有關之遞延所得稅	(2,797,673)		(688,584)
以前年度所得稅調整		28,160		(20,719)
扣繳稅款		81,543			39,248
土地增值稅		249,210			
認列於損益之所得稅費用	\$	5,091,373		\$	4,839,246

於105及104年度,本集團中適用中華民國所得稅法之個體所適用之稅率為17%;中國地區子公司所適用之稅率為25%; 其他轄區所產生之稅額係依各相關轄區適用之稅率計算。

由於106年度股東會盈餘分配情形尚具不確定性,故105年度未分配盈餘加徵10%所得稅之潛在所得稅後果尚無法可靠決定。

(二) 直接認列於權益之所得稅

	105年度	104年度
遞延所得稅 與員工認股權有關	(\$ 204)	(\$ 33)
(三) 認列於其他綜合損益之所得稅		
	105年度	104年度
遞延所得稅		
與確定福利計畫再衡量數有關	\$ 73,637	\$ 11,002

(四) 本期所得稅資產與負債

	105年12月31日		104年12月31日		
本期所得稅資產				_	
應收退稅款	\$	260,559	\$	10,984	
預付所得稅		211,193		157,733	
	\$	471,752	\$	168,717	
本期所得稅負債					
應付所得稅	\$	4,352,642	\$	4,551,785	

(五) 遞延所得稅資產與負債

本集團將若干符合互抵條件之遞延所得稅資產及負債予以互抵。

遞延所得稅資產及負債之變動如下:

105年度

	年初餘額	認	別於損益_	 別於其他 综合損益	_	直接認列 於權益	気	〕換差額	_	日企業 併取得	年底餘額
遞延所得稅資產(負債)											
暫時性差異	-										
不動產、廠房及設備	(\$3,504,458)	(\$	182,291)	\$ _	\$	_	(\$	72,098)	\$	_	(\$3,758,847)
確定福利計劃	845,939	(48,601)	73,637		_		2,509		_	873,484

				認	列於其他	直	妾認列			庄	企業	
	年初餘額	認	列於損益	綺	合損益	於	權益	5	竞換差額	合	并取得	年底餘額
透過損益按公允價值衡量之金融商品	(\$ 232,198)	\$	212,737	\$	_	\$	_	(\$	1,902)	\$	_	(\$ 21,363)
其他	1,384,987	(283,179)		_	(204)	(21,780)		_	1,079,824
	(1,505,730)	(301,334)		73,637	(204)	(93,271)		_	(1,826,902)
虧損扣抵	1,323,577	(110,967)		_		_	(91,008)		2,939	1,124,541
投資抵減	351,119		56,862					(25,245)		_	382,736
	\$ 168,966	(\$	355,439)	\$	73,637	(\$	204)	(\$	209,524)	\$	2,939	(\$ 319,625)
		_										

104年度

	年初餘額		訊	羽於損益	列於其他 宗合損益		直接認列 於權益	Ę	党換差額	1	年底餘額
遞延所得稅資產(負債)											
暫時性差異											
不動產、廠房及設備	(\$	2,431,855)	(\$	1,083,273)	\$ _	\$	_	\$	10,670	(\$	3,504,458)
確定福利計劃		796,642		20,398	11,002		_		17,897		845,939
透過損益按公允價值衡量之金融商品	(170,059)	(62,152)	_		_		13	(232,198)
其他		1,166,297		229,799		(33)	(11,076)		1,384,987
	(638,975)	(895,228)	11,002	(33)		17,504	(1,505,730)
虧損扣抵		519,898		812,217	-		-	(8,538)		1,323,577
投資抵減		694,082	(274,655)	-		-	(68,308)		351,119
其他	(853)		853							
	\$	574,152	(\$	356,813)	\$ 11,002	(\$	33)	(\$	59,342)	\$	168,966

(六) 未於合併資產負債表中認列遞延所得稅資產之可減除暫時性差異、未使用虧損扣抵及未使用投資抵減金額

	105年12	月31日		104年1	2月31日	
虧損扣抵		\$	652,593		\$	666,373
投資抵減			280,068			387,480
可減除暫時性差異			904,441			1,007,105
	_	\$	1,837,102		\$	2,060,958

未認列之虧損扣抵將陸續至119年度到期,未認列之投資抵減將陸續至107年度到期。

(七) 未使用虧損扣抵與投資抵減、 冤稅及其他租稅減免之相關資訊

截至105年12月31日止,虧損扣抵相關資訊如下:

尚未扣:	抵餘額	最後扣抵年度
	\$ 241,278	106年
	255,577	107年
	291,521	108年
	766,478	109年
	222,279	110年及以後
	\$ 1,777,133	

截至105年12月31日止,依各國相關租稅獎勵法規享有之投資抵減相關資訊如下:

抵減項目	尚未抵減餘額	最後抵減年度
機器設備	\$ 647,923	107年
其他	14,881	106年
	\$ 662,804	_

截至105年12月31日止,本公司及部分子公司之下列增資擴展產生之所得可享受5年冤稅:

公司名稱	增資擴展案	
日月光	93年增資擴展案	101.01~105.12
	94年增資擴展案	101.01~105.12
	96年增資擴展案	105.01~109.12
	97年增資擴展案	103.01~107.12
台灣福雷	97年增資擴展案	103.01~107.12
	98年增資擴展案	107.01~111.12
日月光電子	94年分割案	101.01~105.12
	97年增資擴展案	105.01~109.12

另部分中國子公司依據當地稅法規定享有高新技術企業15%優惠稅率及課稅所得扣除研發費用若干倍數等之所得稅優惠。

(八) 與投資相關日末認列遞延所得稅負債之暫時性差異量總金額

截至105年及104年12月31日止,與投資子公司有關且未認列為遞延所得稅負債之應課稅暫時性差異分別為14,417,873千元及12,676,347千元。

(九) 兩稅合一資訊

105年及104年12月31日本公司之未分配盈餘均屬87年度(含)以後產生,股東可扣抵稅額帳戶餘額105年及104年12月31日分別為3,328,374千元及1,913,243千元。

105及104年度盈餘分配適用之稅額扣抵比率分別為9.31%(預計)及9.65%(實際)。

(十) 所得稅核定情形

本公司截至101年度及台灣子公司分別截至102至103年度之營利事業所得稅結算申報案件,業經台灣稅捐稽徵機關核定。惟本公司及部分台灣子公司對93至97及99至101年度核定内容不服,已依法提起行政救濟並於104年第2季達成和解。上述相關所得稅影響數已分別估列於核定年度所得稅費用項下。

二五、每股盈餘

用以計算每股盈餘之盈餘及普通股加權平均股數如下:

本年度淨利

	105年度		104年度(調整後)		
歸屬於本公司業主之淨利	\$	21,680,339	\$	19,197,516	
具稀釋作用潛在普通股之影響					
子公司發行員工認股權憑證	(374,359)	(210,126)	
關聯企業潛在普通股之影響	(494,388)		_	
可轉換公司債	(1,165,506)		901,187	
用以計算稀釋每股盈餘之淨利	\$	19,646,086	\$	19,888,577	

股數

		單位:干股
	105年度	104年度
用以計算基本每股盈餘之普通股加權平均股數	7,662,870	7,652,773
具稀釋作用潛在普通股之影響		
轉換公司債	515,295	455,671
員工認股權	59,218	86,994
員工酬勞	46,746	54,626
用以計算稀釋每股盈餘之普通股加權平均股數	8,284,129	8,250,064
員工酬勞	59,218 46,746	86,994 54,626

本集團得選擇以股票或現金發放員工酬勞,於計算稀釋每股盈餘時,須假設員工酬勞將採發放股票方式,並於該潛在普通 股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數,以計算稀釋每股盈餘。於次年度董事會決議員工酬勞發放股數前計算稀釋 每股盈餘時,亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

二六、股份基礎給付協議

(一) 本公司及子公司員工認股權計畫

本公司為吸引並留任公司所需之專業人才,激勵員工並提昇員工向心力,業經主管機關核准發行5次員工認股權憑證(其中104年4月核准發行100,000千單位),每單位得認購本公司普通股1股,並以等於或不低於給與日當日之普通股股票收盤價為行使價格。該認股權憑證給與對象包含本集團之全職正式員工,且存續期間為10年,不得轉讓,持有認股權憑證之員工自被給與後屆滿2年才可行使被給與之一定比例之認股權。認股權發行後,遇有本公司普通股股份發生變動時,認股權行使價格依規定公式予以調整。

本公司

本公司發行之員工認股權憑證相關資訊如下:

		105年度			104年度			
認股權憑證		單位(千) 加權平均行使價格(元)			單位(千)	加權平均行使價格(元)		
年初流通在外		252,607	\$	26.6		209,745	\$	20.7
本年度給與		_		_		94,270		36.5
本年度沒收	(6,056)		34.6	(1,975)		30.3
本年度逾期失效		_		_	(730)		11.1
本年度行使	(35,756)		20.9	(48,703)		20.6
年底流通在外		210,795		27.3		252,607		26.6
年底可行使		123,007		20.8		158,103		20.8
本年度給與之認股權加權平均公允價值(元)	\$				\$	7.18~7.39		

105及104年度執行之本公司員工認股權,其於執行日之加權平均股價分別為36.2元及38.8元。

截至資產負債表日止,本公司發行之流通在外之員工認股權憑證相關資訊如下:

	執行價格。	之範圍(元)	加權平均剩餘合約期限(年)		
105年12月31日	\$	20.4~22.6	2.5		
		36.5	8.7		
104年12月31日	\$	20.4~22.6	3.5		
		36.5	9.7		

ASE Mauritius Inc.

ASE Mauritius Inc.於96年12月發行員工認股權憑證30,000千單位,每單位得認購ASE Mauritius Inc.普通股1股。給與對象包含本集團員工,存續期間10年,不得轉讓,持有認股權憑證之員工自被給與後屆滿2年才可行使被給與之一定比例之認股權。

上述員工認股權憑證相關資訊揭露如下:

	105年度			104年度			
認股權憑證	單位(千)		行使價格(美金元)		單位(千)		行使價格(美金元)
年初流通在外	28,470	\$	1.7		28,545	\$	1.7
本年度沒収			-	(75)		1.7
年底流通在外	28,470		1.7		28,470		1.7
年底可行使	28,470		1.7		28,470		1.7

截至105年及104年12月31日止,上述認股權憑證預期剩餘存續期限分別為1年及2年。

環誠

環誠發行員工認股權憑證之發行條件與本公司相同,相關資訊如下:

	1	105年度	104年度		
認股權憑證	單位(千) 加權平均行使價格(美金元)		單位(千)	加權平均行使價格(美金元)	
年初流通在外	29,695	\$ 2.1	34,159	\$ 2.1	
本年度沒収	_	-	(84)	2.8	
本年度行使	(3,762)	2.0	(4,380)	1.9	
年底流通在外	25,933	2.2	29,695	2.1	
年底可行使	25,933	2.2	28,106	2.1	

截至資產負債表日止,環誠發行之流通在外之員工認股權憑證相關資訊如下:

	執行(賈格之範圍(美金元)	加權平均剩餘合約期限(年)
105年12月31日	\$	1.5	4.0
		2.4~2.9	3.9
104年12月31日	\$	1.5	5.0
		2.4~2.9	4.9

另105及104年度子公司環誠之員工認股權持有人執行轉換,致使本公司對其持股比例降低。此交易並未改變本公司對子公司環誠之控制,本公司採權益交易處理之,並分別認列資本公積減少444,320千元及564,344千元。

環旭上海

環旭上海於104年11月經股東會決議發行員工認股權憑證,每單位得認購環旭上海普通股1股。該認股權憑證給與對象為該公司員工,存續期間10年,不得轉讓,持有認股權憑證之員工自被給與後屆滿2年及達到特定之績效目標後方可行使被給與之一定比例之認股權。認股權發行後,遇有環旭上海流通在外普通股股份發生變動時,認股權行使價格依規定公式予以調整。相關資訊如下:

		105年度			104年度			
認股權憑證	單位(千)		單位(千) 加權平均行使價格(人民幣元)		單位(千)		加權平均行使價格(人民幣元	
年初流通在外		26,627	\$	15.5		_	\$	_
本年度給與		_		_		26,640		15.5
本年度沒收	(1,630)		15.5	(13)		15.5
年底流通在外		24,997		15.5		26,627		15.5
年底可行使				-				_
本年度給與之認股權加權平均公允價值(人民幣元)	\$				\$	5.95~7.14		

截至105年及104年12月31日止,上述認股權憑證預期剩餘存續期限分別為8.9年及9.9年。

(二) 認股權公允價值資訊

本公司及環旭上海於104年度發行之員工認股權憑證分別係採用Hull & White(2004)結合Ritchken(1995)三項樹模型及Black-Scholes選擇權評價模型以估計給與日認股權憑證之公允價值,評價模型所採用之參數分別如下:

	本公司	環旭上海
給與日股價	36.5元	人民幣 15.2元
行使價格	36.5元	人民幣 15.5元
預期股價波動率	27.02%	40.33%~45.00%
合約期間	10年	10年
預期股利率	4.00%	0.87%
無風險利率	1.34%	3.06%~3.13%

預期股價波動率係分別基於本公司及環旭上海之同業過去10年歷史股票價格波動情形,且在Hull & White(2004)結合 Ritchken(1995)三項樹模型下,為將提早執行之效果納入考量,係假設於既得期間屆滿後之股票價格為行使價格1.88倍時,員工將執行認股權。

另,環誠於104年12月修改96年度發行之員工認股權憑證辦法,將存續期間自12年再延長為13年。因係於既得日後修改員工認股權憑證辦法,增額之公允價值13,721千元立即認列為104年度酬勞成本。

105及104年度認列之員工認股權之酬勞成本分別為470,788千元及133,496千元。

二七、企業合併

(一) 收購子公司

被收購公司	主要營運活動	收購日	股權收購比例(%)	移轉	專對價-現金	
笛林傑	從事資訊軟體服務業務	105年5月3日	60	\$	89,998	
(二) 收購日取得之資產	及承擔之負債及取得子名	公司之淨現金流出				
流動資產				\$	16,645	
非流動資產					4,081	
流動負債				(7,599)	
					13,127	
非控制權益				(7,021)	
商譽					83,892	
併購總價款					89,998	
減:併購日取得之現金及約當現金	Ì			(16,561)	
取得子公司股權之淨現金流出				\$	73,437	

本公司之子公司台灣福雷於105年5月收購笛林傑60%股權,併購總價款係參酌獨立專家之價格合理意見書議定之,其中向主要管理階層等關係人取得之價款為41,739千元。截至105年12月31日止尚未完成投資成本與所享有笛林傑可辨認資產及負債之淨公允價值份額間差額之辨識,故將該差額暫列入商譽項下。

二八、與非控制股權之權益交易

104年4月本集團之子公司環誠以人民幣1,992,060千元出售其持有之環旭上海股權54,000千股,致本集團對環旭上海之持股比例由82.1%降至77.2%。此交易並未改變本集團對子公司環旭上海之控制,本集團係採權益交易處理之,並於104年第2季認列資本公積增加7.197.510千元。

105年2月子公司環誠買回已發行流通在外之普通股計4,501干股,致本集團對環誠之持股比例由96.7%上升至98.8%。此交易並未改變本集團對子公司環誠之控制,本集團係採權益交易處理之,並於105年第1季認列資本公積減少1,912,887千元。

105年2月本公司以每股20元處分子公司環隆電氣股權39,603干股予本集團之子公司環鴻科技,交易總金額為792,064千元,致本集團對環隆電氣之持股比例由99.0%降至76.5%。此交易並未改變本集團對子公司環隆電氣之控制,本集團係採權益交易處理之,並認列資本公積減少20,552千元。

二九、 非現金交易

本集團於105及104年度進行下列非現金交易之投資活動:

	105年度		104年度	
同時影響現金及非現金項目之投資活動	'			_
不動產、廠房及設備增加數	\$	27,680,862	\$	28,280,821
預付設備款減少(列入其他非流動資產項下)	(89,337)	(267,334)
應付設備款(增加)減少	(823,171)		2,314,772
支付之資本化利息	(54,191)	(48,135)
購買不動產、廠房及設備支付現金數	\$	26,714,163	\$	30,280,124
購買不動產、廠房及設備支付現金數	\$	26,714,163	\$	30,280,124

	105年度	104年度	
出售不動產、廠房及設備價款	\$ 692,8.	26 \$	201,766
其他應收款(增加)減少	(22,62	(6)	41,265
出售不動產、廠房及設備收取現金數	\$ 670,2	00 \$	243,031
同時影響現金及非現金項目之投資活動 無形資產增加數 其他應付款增加 其他非流動負債增加	\$ 675,1. (120,93 (40,31	38)	491,135 - -
購買無形資產支付現金數	\$ 513,8	93 \$	491,135

三十、營業租賃協議

除附註十七所述外,本公司及台灣福雷之廠房用地係向政府租用,其租期將陸續於124年6月底前屆滿。租期屆滿時得予續約,但政府得於該土地公告地價增高時調整租金,並得於若干條件下終止租約。此外本集團亦簽有建築物及機器設備之營業租賃合約。

其他子公司於美國、日本等之辦公室係向他人承租,租期將陸續於106年至112年間到期,到期時可再續約。 105及104年度認列之租金費用分別為1,411,533千元及1,390,821千元。

三一、資本風險管理

本集團資本結構係由淨債務及權益組成,而資本管理的目標是保障本集團能夠持續經營,並進而藉由將債務及權益餘額最適化,以使股東報酬極大化,是以定期檢視內容包括考量各類資本之成本及相關風險,並藉由支付股利、發行新股、買回股份及發行新債或償付舊債等方式平衡其整體資本結構。

除附註十八所述外,本集團尚無須遵循之其他外部資本規定。

三二、金融工具

(一) 公允價值資訊 - 非按公允價值衡量之金融工具

1. 帳面金額與公允價值有重大差異之金融負債

除以攤銷後成本衡量之應付公司債外,本集團管理階層認為非按公允價值衡量之金融資產及金融負債之帳面金額趨近其公允價值。105年及104年12月31日應付公司債之帳面金額及公允價值如下:

資產負債表日	 帳面金額	 公允價值
105年12月31日	\$ 36,999,903	\$ 37,300,356
104年12月31日	38,426,250	38,465,355

2. 公允價值衡量層級

上述應付公司債之公允價值屬第3等級公允價值衡量,係按現金流量折現分析或最近一次交易價格決定之。

(二) 公允價值資訊 - 按公允價值衡量之金融工具

1. 公允價值層級

105年12月31日

	第1	等級	第2等級	第	3等級	合計
透過損益按公允價值衡量之金融資產			 _			_
指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	-					
私募可轉換公司債	\$	_	\$ 100,583	\$	_	\$ 100,583

		第1等級	第2等級	第3等級	合計
衍生金融資產					
換匯合約	\$	_	\$ 462,339	\$ _	\$ 462,339
遠期外匯合約		_	66,872	_	66,872
持有供交易之非衍生金融資產					
上市(櫃)公司股票		1,855,073	_	_	1,855,073
基金受益憑證		584,945	_	_	584,945
合計	\$	2,440,018	\$ 629,794	\$ 	\$ 3,069,812
備供出售金融資產					
非上市(櫃)公司股票	\$	_	\$ _	\$ 631,418	\$ 631,418
有限合夥		_	_	273,372	273,372
基金受益憑證		243,458	_	_	243,458
上市(櫃)公司股票		146,786	_	_	146,786
合計	\$	390,244	\$ _	\$ 904,790	\$ 1,295,034
透過損益按公允價值衡量之金融負債					
衍生金融負債					
可轉換公司債轉換、贖回與賣回權	\$	_	\$ 1,213,890	\$ _	\$ 1,213,890
換匯合約		_	422,934	_	422,934
遠期外匯合約		_	108,912	-	108,912
外幣選擇權合約		_	17,924	_	17,924
合計	\$		\$ 1,763,660	\$ 	\$ 1,763,660
透過損益按公允價值衡量之金融資產 指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	_				
結構式定期存款	\$	_	\$ 1,646,357	\$ _	\$ 1,646,357
私募可轉換公司債		_	100,500	_	100,500
衍生金融資產					
換匯合約		_	1,452,611	_	
遠期外匯合約		_	10.013	_	1,452,611
外幣選擇權合約		_	18,913		1,452,611 18,913
持有供交易之非衍生金融資產			5,020	_	
基金受益憑證				_	18,913
		573,242		_	18,913
上市(櫃)公司股票		573,242 37,058		- - -	18,913 5,020
上市(櫃)公司股票 合計	\$		\$	\$ - - - -	\$ 18,913 5,020 573,242
	\$	37,058	\$ 5,020 _ _	\$ - - - -	\$ 18,913 5,020 573,242 37,058
合計	\$ \$	37,058	\$ 5,020 _ _	\$ - - - - 476,612	\$ 18,913 5,020 573,242 37,058
合計 備供出售金融資產		37,058	5,020 _ _	476,612 264,477	18,913 5,020 573,242 37,058 3,833,701
合計 備供出售金融資產 有限合夥		37,058	5,020 _ _		18,913 5,020 573,242 37,058 3,833,701
合計 備供出售金融資產 有限合夥 非上市(櫃)公司股票		37,058 610,300 — —	5,020 _ _		18,913 5,020 573,242 37,058 3,833,701 476,612 264,477
有限合夥 非上市(櫃)公司股票 上市(櫃)公司股票		37,058 610,300 — — — — 197,580	5,020 _ 		18,913 5,020 573,242 37,058 3,833,701 476,612 264,477 197,580
有計 備供出售金融資產 有限合夥 非上市(櫃)公司股票 上市(櫃)公司股票 基金受益憑證	\$	37,058 610,300 — — — 197,580 16,037	\$ 5,020 _ 	\$ 264,477 - -	\$ 18,913 5,020 573,242 37,058 3,833,701 476,612 264,477 197,580 16,037
合計 備供出售金融資產 有限合夥 非上市(櫃)公司股票 上市(櫃)公司股票 基金受益憑證 合計	\$	37,058 610,300 — — — 197,580 16,037	\$ 5,020 _ 	\$ 264,477 - -	\$ 18,913 5,020 573,242 37,058 3,833,701 476,612 264,477 197,580 16,037
合計 備供出售金融資產 有限合夥 非上市(櫃)公司股票 上市(櫃)公司股票 基金受益憑證 合計 透過損益按公允價值衡量之金融負債	\$	37,058 610,300 — — — 197,580 16,037	\$ 5,020 _ 	\$ 264,477 - -	\$ 18,913 5,020 573,242 37,058 3,833,701 476,612 264,477 197,580 16,037
合計 備供出售金融資產 有限合夥 非上市(櫃)公司股票 上市(櫃)公司股票 基金受益憑證 合計 透過損益按公允價值衡量之金融負債 衍生金融負債	\$	37,058 610,300 — — — 197,580 16,037	\$ 5,020 - - 3,223,401 - - - -	\$ 264,477 - -	\$ 18,913 5,020 573,242 37,058 3,833,701 476,612 264,477 197,580 16,037 954,706
合計 備供出售金融資產 有限合夥 非上市(櫃)公司股票 上市(櫃)公司股票 基金受益憑證 合計 透過損益按公允價值衡量之金融負債 衍生金融負債 可轉換公司債轉換、贖回與賣回權	\$	37,058 610,300 — — — 197,580 16,037	\$ 5,020 3,223,401	\$ 264,477 - -	\$ 18,913 5,020 573,242 37,058 3,833,701 476,612 264,477 197,580 16,037 954,706
(備供出售金融資産) 有限合夥 非上市(櫃)公司股票 上市(櫃)公司股票 上市(櫃)公司股票 基金受益憑證 合計 透過損益按公允價值衡量之金融負債 で生金融負債 可轉換公司債轉換、贖回與賣回權 換匯合約	\$	37,058 610,300 — — — 197,580 16,037	\$ 5,020 3,223,401 2,632,565 290,176	\$ 264,477 - -	\$ 18,913 5,020 573,242 37,058 3,833,701 476,612 264,477 197,580 16,037 954,706
(情供出售金融資産) 有限合夥 非上市(櫃)公司股票 上市(櫃)公司股票 上市(櫃)公司股票 基金受益憑證 合計 透過損益按公允價值衡量之金融負債 で生金融負債 可轉換公司債轉換、贖回與賣回權 換匯合約 遠期外匯合約	\$	37,058 610,300 — — — 197,580 16,037	\$ 5,020 3,223,401 2,632,565 290,176 69,207	\$ 264,477 - -	\$ 18,913 5,020 573,242 37,058 3,833,701 476,612 264,477 197,580 16,037 954,706 2,632,565 290,176 69,207

3,005,726 \$

105及104年度無第1等級與第2等級公允價值衡量間移轉之情形。

合計

3,005,726

2. 金融資產以第3等級公允價值衡量之調節

本集團以第3等級公允價值衡量之金融資產,係列入備供出售金融資產-非流動項下之無公開報價之權益工具投資,105 及104年度之調節如下:

	105年度		104年度		
年初餘額	\$	741,089	\$	778,866	
購買		495,928		2,010	
認列於損益	(100,734)	(15,891)	
認列於其他綜合損益	(202,565)		21,195	
處分	(28,928)	(45,091)	
年底餘額	\$	904,790	\$	741,089	

3. 衡量公允價值所採用之評價技術及假設

(1) 第2等級公允價值衡量之評價技術及輸入值

金融工具類別	評價技術及輸入值
衍生工具一換匯合約、遠期外匯合約、外幣選擇 權合約及利率交換合約	現金流量折現法:按資產負債表日之可觀察遠期匯率或利率及合約所訂匯率或利率估計未來現金流量,並以可反 映各交易對方信用風險之折現率分別折現。
衍生工具-可轉換公司債轉換、贖回與賣回權	選擇權定價模式:納入現值技術並反映選擇權之時間價值及內含價值。
結構式定期存款及私募可轉換公司債	現金流量折現法:按資產負債表日之可觀察遠期匯率或股價,及合約所訂之利率區間或轉換價格估計未來現金流量,並以可反映各交易對方信用風險之折現率分別折現。

(2) 第3等級公允價值衡量之評價技術及輸入值

無活絡市場之非上市(櫃)公司股票係以市場法估計公允價值,其判定係參考公司近期籌資活動、技術發展情形、同種 類公司評價、市場狀況及其他經濟指標等。

有限合夥投資係依預計處分價款減除處分成本後之未來現金流量估計公允價值。105年度並認列90,000千元之減損損失,列入合併綜合損益表之其他利益(損失)項下。

(三) 金融工具之種類

	105年12月31日	104年12月31日
金融資產		
透過損益按公允價值衡量		
指定為透過損益按公允價值衡量	\$ 100,583	\$ 1,746,857
持有供交易	2,969,229	2,086,844
備供出售金融資產	1,295,034	954,706
放款及應收款(註1)	92,082,628	101,259,880
金融負債		
透過損益按公允價值衡量		
持有供交易	1,763,660	3,005,726
以攤銷後成本衡量(註2)	168,397,006	173,294,140

註1:餘額係包含現金及約當現金、應收帳款、其他應收款及其他金融資產等以攤銷後成本衡量之放款及應收款。

(四) 財務風險管理目的與政策

本集團從事衍生商品交易之經營避險策略,主要係以確保公司穩健、安全經營為原則。從事衍生金融商品交易時,應依其 交易目的區分為「避險性」及「非避險性」兩種交易,除依規定分別適用不同部位限制外,以避險為目的之交易其商品的 選擇應以規避本集團業務經營所產生之收入、支出、資產或負債等風險為主,持有之幣別必須與公司實際進出口交易之外 幣需求相符。

風險管理部門係為專責監督風險以減輕暴險之單位,每月就持有部位、交易餘額及損益狀況對財務長提出報告。

1. 市場風險

本集團之營運活動使本集團承擔之主要財務風險為外幣匯率變動風險以及利率變動風險。從事各式衍生金融工具以管理

註2:餘額係包含短期借款、應付短期票券、應付帳款、其他應付款、應付公司債及長期借款等以攤銷後成本衡量之金融負債。

所承擔之外幣匯率及利率風險,因此匯率變動產生之損益大致會與被避險項目之損益相抵銷,而利率風險亦因預期之資 金成本已固定,故市場價格風險並不重大。

本集團有關金融工具市場風險之暴險及其對該等暴險之管理與衡量方式並無改變。

(1) 匯率風險

本集團從事外幣計價之進銷貨交易及融資活動,因而產生匯率變動暴險。為避免因匯率變動造成外幣資產或負債價值波動,本集團使用衍生金融工具來規避匯率風險。此類衍生金融工具之使用,可協助本集團減少但仍無法完全排除外幣匯率變動所造成之影響。

本集團於資產負債表日具重大影響之非功能性貨幣計價之金融資產及負債(包含合併財務報告中已沖銷之非功能性貨幣項目)以及具匯率風險暴險之衍生工具外幣合約金額,參閱附註三六。

本集團主要受到美金及日幣兌新台幣或人民幣匯率波動之影響。本集團内部向主要管理階層報告匯率風險時所使用之敏感度比率為1%,敏感度分析之範圍包括主要之金融資產、金融負債,及集團内部交易所產生之應收應付款項。 當資產負債表日美金及日幣兌新台幣或人民幣變動1%時,105及104年度稅前淨利影響數將分別約為69,000千元及 18,000千元。上述稅前淨利影響數業已考量避險合約及被避險項目之影響,惟資產負債表日之外幣暴險無法反映期中暴險情形。

(2) 利率風險

本集團除發行固定利率之公司債及舉借固定利率之借款外,主係以浮動利率借入資金,因而產生利率暴險,市場利率變動將使借款之有效利率隨之變動,而產生未來現金流量之波動。

本集團於資產負債表日受利率暴險之金融資產及金融負債帳面金額如下:

	105年12月3	1日	104年12月	31日
具公允價值利率風險金融負債	\$	30,243,887	\$	18,030,482
具現金流量利率風險				
金融資產		29,977,709		53,475,994
金融負債		65,800,323		65,213,083

對於浮動利率之資產及負債,本集團內部向主要管理階層報告利率風險時所使用之變動率為100個基點,若資產負債表日利率變動100個基點(1%),在所有其他變數維持不變之情況下,本集團105及104年度之稅前淨利將分別增減約358,000千元及117,000千元。

(3) 其他價格風險

本集團持有透過損益按公允價值衡量之金融資產(上櫃公司私募可轉換公司債、上市(櫃)公司股票及基金受益憑證)及備供出售金融資產受權益及債券價格暴險之影響。若資產負債表日權益及債券價格變動1%,105及104年度稅前淨利將分別增減約26,000千元及7,100千元,稅前其他綜合損益將分別增減約13,000千元及10,000千元。

此外,本公司於102年發行之海外無擔保轉換公司債亦受本公司股票價格暴險之影響。本集團內部向主要管理階層報告價格風險時所使用之敏感度比率為7%,若資產負債表日本公司股票價格增加或減少7%,105及104年度稅前淨利將分別減少約510,000千元及605,000千元或分別增加約445,000千元及638,000千元。

2. 信用風險

信用風險係指交易對方拖欠合約義務而造成本集團財務損失之風險。本集團之信用風險,主要係來自於現金及約當現金、應收款項、其他應收款及其他金融資產等。最大之信用風險暴險與合併資產負債表上之金融資產帳面價值相同。

本集團主係與信譽卓著之對象進行交易,並訂有授信政策及應收帳款管理程序以確保應收款項之回收及評價。另交易對 象涵蓋衆多客戶及銀行,除附註九所述外,並無重大集中的信用暴險。

3. 流動性風險

本集團透過管理適當之營運資金及融資額度以支應集團營運及資本支出之現金流量需求,另亦監督銀行融資額度使用狀況並確保借款合約條款之遵循,故未有因無法籌措資金以履行合約義務之流動性風險。

本集團可被要求立即清償之金融負債,係列於下表中最早之期間內,不考慮交易對手立即執行該權利之機率;其他非衍生金融負債到期分析係依照約定之還款日編製。

以浮動利率支付之利息現金流量,其未折現之利息金額係依據資產負債表日之利率做為估計未來利息現金流量之基礎。

105年12月31日

	要求民	们付或短於1個月	1至3個月		3個月至1年		1至5年		超過5年	
非衍生性金融負債										
無附息負債	\$	23,907,221	\$	20,553,395	\$	4,360,322	\$	42,285	\$	190,941
浮動利率工具		9,733,727		5,232,407		6,634,931		44,504,416		1,728,448
固定利率工具		5,360,644		1,019,221		10,549,983		28,553,095		2,062,500
	\$	39,001,592	\$	26,805,023	\$	21,545,236	\$	73,099,796	\$	3,981,889

104年12月31日

	要求問	们付或短於1個月	1至3個月 3個		3個月至1年	1至5年		超過5年		
非衍生性金融負債										
無附息負債	\$	19,393,406	\$	19,626,026	\$	6,493,504	\$	1,926	\$	194,346
浮動利率工具		6,617,050		5,677,129		10,582,324		39,202,454		775,273
固定利率工具		16,168,484		2,463,617		24,787,238		18,078,920		
	\$	42,178,940	\$	27,766,772	\$	41,863,066	\$	57,283,300	\$	969,619

上述非衍生金融負債之浮動利率工具金額,將因浮動利率與資產負債表日所估計之利率不同而改變。

下表詳細說明本集團針對衍生金融工具所作之流動性分析,就採淨額交割之衍生金融工具,係以未折現之合約淨現金流入及流出為基礎編製:就採總額交割之衍生金融工具,係以未折現之總現金流入及流出為基礎編製。當應付或應收金額不固定時,揭露之金額係依資產負債表日殖利率曲線所推估之預計利率決定。

105年12月31日

\$	22,680	\$	13,320	\$	_
(\$	344)	\$	_	\$	_
_					
\$	5,134,196	\$	912,213	\$	=
(5,245,724)	(915,900)		_
(111,528)	(3,687)		_
	5,345,159		17,399,695		43,537,500
(5,439,190)	(17,540,927)	(42,882,201)
(94,031)	(141,232)		655,299
(\$	205,559)	(\$	144,919)	\$	655,299
-	\$ ((\$ 5,134,196 (5,245,724) (111,528) 5,345,159 (5,439,190) (94,031)	\$ 5,134,196 \$ (5,245,724) (111,528) (5,345,159 (5,439,190) (94,031) (\$ 5,134,196 \$ 912,213 (5,245,724) (915,900) (1111,528) (3,687) 5,345,159 17,399,695 (5,439,190) (17,540,927) (94,031) (141,232)	\$ 5,134,196 \$ 912,213 \$ (5,245,724) (915,900) (111,528) (3,687) 5,345,159 17,399,695 (5,439,190) (17,540,927) (94,031) (141,232)

104年12月31日

	要求即付		1至3個月		 3個月至1年
淨額交割				_	
遠期外匯合約	(\$	230)	\$	3,435	\$ _
外幣選擇權合約	\$	2,054	\$	8,735	\$ _
總額交割					
遠期外匯合約					
流入	\$	2,822,265	\$	2,421,602	\$ _
流出	(2,836,080)	(2,429,050)	_
	(13,815)	(7,448)	

	要求即]付或短於1個月		1至3個月	3個月至1年		
換匯合約							
流入	\$	16,561,521	\$	22,476,799	\$	36,796,825	
流出	(16,564,549)	(22,007,274)	(35,813,527)	
	(3,028)		469,525		983,298	
利率交換合約							
流入		12,603		12,466		25,069	
流出	(11,595)	(11,469)	(23,063)	
		1,008		997		2,006	
	(\$	15,835)	\$	463,074	\$	985,304	

三三、 關係人交易

本集團間之交易、帳戶餘額、收益及費損於合併時已銷除,故未揭露於本附註。本集團與其他關係人間之重大 交易如下:

- (一)公司於105及104年度皆提撥100,000千元由財團法人日月光文教基金會執行環保公益之捐贈作業,以協助國内環保相關工作之推動及公益活動(附註三五)。
- (二) 本公司於105年度向關聯企業取得專利權及專門技術計403,543千元,係參酌專業機構出具之鑑價報告議定之。截至105年12月31日止,尚有161,250千元未支付(列入其他應付款及其他非流動負債項下)。
- (三)本公司於104年度向關聯企業購入不動產,價款為2,466,000千元,係參酌專業機構出具之鑑價報告議定之,業已付訖。
- (四)本公司委託關聯企業於現有租地興建女子員工宿舍,105及104年度累計投入金額分別為875,000千元及504,600千元,係參酌專業機構出具之鑑價報告議定之。截至105年12月31日止,尚有228,500千元未支付(列入其他應付款項下)。
- (五) 子公司環誠於105年2月買回已發行流通在外之普通股,其中向本集團管理階層買回共計1,801千股,約1,130,650千元。

(六) 對主要管理階層之獎酬

	105年度		1042	F度	
短期員工福利	\$	790,460		\$	812,002
退職後福利		4,790			3,944
股份基礎給付		11,547			17,937
	\$	806,797	-	\$	833,883
			=		

董事及其他主要管理階層之薪酬係依照個人績效及市場趨勢決定。

三四、質抵押之資產

除附註九所述外,本集團已提供下列資產,作為銀行借款之擔保品、進口原物料之關稅擔保品、履約擔保品或保證金:

	105年12月31	∃	104年12月	104年12月31日			
存貨-營建房地	\$	16,813,023	\$	16,312,519			
其他金融資產(流動與非流動)		220,228		229,613			
	\$	17,033,251	\$	16,542,132			

三五、重大或有負債及未認列之合約承諾

除已於其他附註所述者外,本集團於資產負債表日有下列重大承諾事項及或有事項:

(一) 重大承諾

- 1. 截至105年及104年12月31日止,本集團已開立未使用之信用狀金額分別約97,000千元及93,000千元。
- 2. 截至105年及104年12月31日止,本集團已承諾購置之不動產、廠房及設備金額分別約6,630,957千元及8,089,200千元,其中已支付金額分別為668,509千元及1,756,990千元。另截至105年及104年12月31日止,本集團因房地產開發建設業務已簽約尚未支付之工程款金額分別約1,574,822千元及2,745,400千元。
- 3. 本公司為善盡環境保護之社會責任,於102年12月經董事會決議通過預計未來將捐獻每年至少1億元、至少30年、總金額至少30億元以推動台灣環保相關工作。

本公司於106年1月經董事會決議提撥100,000千元交由財團法人日月光文教基金會繼續執行環保相關捐贈作業,以持續協助國内環保相關工作之推動及公益活動。

(二) 不可取消之營業租賃承諾

	1052	年12月31日
1年内	\$	284,214
超過1年但未超過5年		355,668
超過5年		438,545
	\$	1,078,427

三六、具重大影響之外幣資產及負債資訊

以下資訊係按本集團各個體功能性貨幣以外之外幣彙總表達,所揭露之匯率係指該等外幣換算至功能性貨幣之匯率。具重 大影響之外幣金融資產及負債如下:

	外幣(千元)	匯率	新台幣(千元)
105年12月31日			
貨幣性金融資產			
美金	\$ 3,106,557	USD1=NTD32.25	\$ 100,186,466
美金	1,020,769	USD1=CNY6.9370	32,919,814
日幣	4,976,309	JPY1=NTD0.2756	1,371,471
日幣	9,277,760	JPY1=USD0.0085	2,556,951
貨幣性金融負債			
美金	3,013,288	USD1=NTD32.25	97,178,536
美金	891,487	USD1=CNY6.9370	28,750,462
日幣	5,881,716	JPY1=NTD0.2756	1,621,001
日幣	9,543,756	JPY1=USD0.0085	2,630,259
104年12月31日			
貨幣性金融資產			
美金	2,926,597	USD1=NTD32.825	96,065,552
美金	1,008,097	USD1=CNY6.4936	33,090,795
日幣	3,380,683	JPY1=NTD0.2727	921,912
日幣	8,467,689	JPY1=USD0.0083	2,309,139
貨幣性金融負債			
美金	2,988,953	USD1=NTD32.825	98,112,393
美金	995,195	USD1=CNY6.4936	32,667,265
日幣	3,747,333	JPY1=NTD0.2727	1,021,898
日幣	8,775,382	JPY1=USD0.0083	2,393,047

具重大影響之外幣兌換損益如下:

	105	105年度			104年度					
功能性貨幣	功能性貨幣兌表達貨幣	生貨幣兌表達貨幣 淨兌換利益		功能性貨幣兌表達貨幣	淨兌換(損)益					
新台幣		\$	1,494,044		(\$	695,510)				
人民幣	CNY1=NTD4.649		224,393	CNY1=NTD5.0550	(271,358)				
美元	USD1=NTD32.25		203,258	USD1=NTD32.825		136,795				
		\$	1,921,695		(\$	830,073)				

三七、其他

- (一)本公司於104年11月收到臺灣高雄地方法院所送達之起訴書狀,係矽品訴請法院確認本公司請求於矽品股東名簿記載為股東之請求權不存在。因矽品未於期限内補正裁判費,臺灣高雄地方法院已依法於105年6月27日裁定駁回本件訴訟,故對本集團合併財務狀況及財務績效並無重大影響。
- (二) 高雄市政府環境保護局(以下稱「環保局」)於102年12月20日以本公司違反水污染防治法科處本公司102,014 千元之罰鍰(以下稱「罰鍰處分」)。嗣本公司對該罰鍰處分提起訴願並於訴願遭高雄市政府駁回後依法向高 雄高等行政法院提起行政訴訟,請求撤銷訴願決定與該罰鍰處分並請求環保局返還本公司已繳交之罰鍰。高 雄高等行政法院審理後於105年3月22日判決訴願決定及該罰鍰處分均撤銷,原告其餘之訴(即請求返還罰鍰 之部分)駁回。本公司已於105年4月14日針對該判決不利於本公司之部分提出上訴,案件現由最高行政法院 審理中。另因前述事件,高雄地方法院檢察署於103年1月間依違反廢棄物清理法等法對本公司提起公訴並 經高雄地方法院以本公司違反廢棄物清理法第47條規定判處3,000千元罰金。嗣經本公司依法提出上訴後, 高雄高等法院業於104年9月29日判決本公司無罪確定。
- (三)本公司為半導體產業之未來發展及永續經營,於105年6月經董事會通過與矽品簽署共同轉換股份協議,將由本公司申請設立日月光投資控股公司,並與矽品共同以股份轉換方式由日月光投資控股公司取得本公司與矽品100%股權。股份轉換對價係以本公司每1股普通股換發日月光投資控股公司普通股0.5股,及矽品每1股普通股換發現金新台幣55元(矽品分派105年度盈餘後調整為新台幣51.2元)。

截至本合併財務報告通過發布日止,股份轉換案尚未完成。依共同轉換股份協議約定,股份轉換案須待全部 先決條件(包括本公司及矽品股東會之核准、取得相關主管機關就本交易所為之核准或同意等)均成就(或被免 除)始得完成。除經本公司及矽品另行協議,若上述條件於106年12月31日前無法成就或被免除,此協議將 自動終止。

另因上述共同轉換股份協議,本公司持有之庫藏股及已發行具股權性質之轉換公司債處理原則如下:

- 1. 本公司發行之海外第三次無擔保轉換公司債尚流通在外者,除於股份轉換基準日前經贖回、購回並經註銷或債券持有人行使轉換權利情況外,持有人於本公司取具相關主管機關核准後,得依相關法令、該海外無擔保轉換公司債受託契約約定以及換股比例,於股份轉換基準日後轉換為日月光投資控股公司新發行之普通股。
- 2. 本公司為配合發行海外第四次無擔保轉換公司債,於股份轉換基準日前已買回供轉換之庫藏股,將依換股比例轉換 為日月光投資控股公司股份並由本公司繼續持有,並將依股份轉換協議所訂之換股比例調整該海外無擔保轉換公司 之轉換價格。
- 3. 本公司於共同轉換股份協議簽署前,業經主管機關核准所發行之認股權憑證,於股份轉換基準日起,將由日月光投資控股公司承受本公司之履行義務,除執行價格及數量應依共同轉換股份協議之換股比例調整且履約之執行標的改為日月光投資控股公司之普通股新股外,其餘發行條件與原發行條件相同,惟具體執行方式則由日月光投資控股公司依相關法令規定及主管機關之核示辦理。

三八、附註揭露事項

(一) 重大交易事項及(二)轉投資事業相關資訊:

- 1. 資金貸與他人:詳附表一。
- 2. 為他人背書保證:詳附表二。
- 3. 期末持有有價證券情形: 詳附表三。
- 4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣3億元或實收資本額20%以上者:詳附表四。
- 5. 取得不動產之金額達新台幣3億元或實收資本額20%以上者:詳附表五。
- 6. 處分不動產之金額達新台幣3億元或實收資本額20%以上者:無。
- 7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣1億元或實收資本額20%以上者:詳附表六。
- 8. 應收關係人款項達新台幣1億元或實收資本額20%以上者:詳附表七。
- 9. 從事衍生工具交易:詳附註七。
- 10.其他:母子公司間及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額:詳附表十。
- 11.被投資公司資訊(對非屬大陸地區之被投資公司直接或間接具重大影響、控制或聯合控制者):詳附表八。

(三) 大陸投資資訊

- 1. 大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入情形、持股比例、本年度損益及認列之投資 損益、年底投資帳面價值、已匯回投資損益及赴大陸地區投資限額:詳附表九。
- 2. 與大陸被投資公司直接或間接經由第三地區所發生下列之重大交易事項,及其價格、付款條件、未實現損益:
 - (1) 進貨金額及百分比與相關應付款項之年底餘額及百分比:詳附表六。
 - (2) 銷貨金額及百分比與相關應收款項之年底餘額及百分比:無。
 - (3) 財產交易金額及其所產生之損益數額:無重大交易。
 - (4) 票據背書保證或提供擔保品之年底餘額及其目的:詳附表二。
 - (5) 資金融通之最高餘額、年底餘額、利率區間及當年度利息總額:無。
 - (6) 其他對當年度損益或財務狀況有重大影響之交易事項,如勞務之提供或收受等:無。

三九、 部門資訊

本集團應報導部門分為封裝部門、測試部門、電子組裝部門,分別從事半導體封裝服務、測試服務暨電子產品、通訊產品 及主機板等設計、組裝、製造及銷售。另有未達量化門檻之其他部門,主要從事半導體材料製造與房地產開發及銷售等業 務。

本集團營運部門之會計政策與附註四所述之重要會計政策彙總說明並無重大不一致。營運部門損益係以部門稅前淨利衡量,並作為評估績效之基礎。

(一) 部門收入與營運結果

			測試部門		電子組裝部門		其他			合併
105年度										
來自外部客戶收入	\$	125,282,829	\$	27,031,750	\$	115,395,130	\$	7,174,398	\$	274,884,107
部門間收入(註)		4,929,897		243,980		47,721,424		9,186,359		62,081,660
部門收入		130,212,726		27,275,730		163,116,554		16,360,757		336,965,767
利息收入		32,499		41,405		130,659		25,504		230,067
利息費用	(1,727,127)	(5,980)	(44,433)	(439,997)	(2,217,537)
折舊與攤銷	(18,706,891)	(6,566,936)	(2,759,298)	(1,389,179)	(29,422,304)
採用權益法認列之關聯企業及合資之損益之份額		1,536,177	(7,833)		_		_		1,528,344
減損損失	(974,095)	(4,136)	(1,886)		_	(980,117)
部門稅前淨利		13,944,423		7,228,182		4,626,263		2,242,404		28,041,272
部門之資本支出		17,561,135		8,247,003		906,042		966,682		27,680,862

		封裝部門		測試部門	Ē	電子組裝部門		其他		合併
105年12月31日										
採用權益法認列之關聯企業及合資之投資餘額	\$	49,595,750	\$	229,146	\$	_	\$	-	\$	49,824,896
部門資產		200,602,666		42,964,294		73,915,639		40,460,480		357,943,079
104年度										
來自外部客戶收入		116,607,314		25,191,916		138,242,100		3,261,206		283,302,536
部門間收入(註)		9,454,671		191,608		58,451,996		7,659,282		75,757,557
部門收入		126,061,985		25,383,524		196,694,096		10,920,488		359,060,093
利息收入		53,235		12,536		149,385		26,928		242,084
利息費用	(1,520,118)	(5,821)	(147,792)	(595,055)	(2,268,786)
折舊與攤銷	(18,946,460)	(6,516,912)	(2,738,722)	(1,316,570)	(29,518,664)
採用權益法認列之關聯企業損益之份額		121,373		_		_		_		121,373
減損損失	(139,397)		_	(102,389)	(16,343)	(258,129)
部門稅前淨利		15,474,976		6,354,140		2,874,944		302,836		25,006,896
部門之資本支出		19,691,068		4,754,481		2,917,939		917,333		28,280,821
104年12月31日										
採用權益法認列之關聯企業投資餘額	•	37,141,552		_		-		-		37,141,552
部門資產		193,342,612		42,652,569		79,997,341		49,013,678		365,006,200

註:來自母公司及合併子公司之收入業已於編製合併報告時銷除。

(二) 主要產品及勞務之收入

	105年度		104	1年度	
先進封裝及積體電路打線服務	\$	112,838,646		\$	103,735,586
測試服務		26,065,195			24,136,399
電子產品構裝技術暨製造服務		114,425,790			137,347,359
其他		21,554,476			18,083,192
	\$	274,884,107		\$	283,302,536

(三) 地區別資訊

本集團來自外部客戶之收入依客戶所在地區及非流動資產按資產所在地區之資訊列示如下:

1.來自外部客戶之收入

	105年度		104年度	
地區				
美國	\$	180,745,837	\$	205,730,670
台灣		38,868,679		32,631,149
亞洲		29,896,304		22,885,128
歐洲		23,275,732		20,577,069
其他		2,097,555		1,478,520
	\$	274,884,107	\$	283,302,536

2.非流動資產

105年12月31	日	104年12月31	日
\$	97,349,392	\$	98,849,362
	34,142,577		40,385,484
	26,935,370		25,458,503
\$	158,427,339	\$	164,693,349
	\$	34,142,577 26,935,370	\$ 97,349,392 \$ 34,142,577 26,935,370

非流動資產不包括金融工具、退職後福利資產及遞延所得稅資產。

(四) 主要客戶資訊

除105及104年度營業收入總額中分別有66,554,659千元及88,311,697千元係來自封裝及電子組裝部門之某一客戶外,105 及104年度無其他來自單一客戶之收入達本集團收入總額之10%以上。

資金貸與他人

民國105年1月1日至12月31日

附表一

編號	資金貸與他人者 公司名稱	貸與對象	往來項目	是否為關係人	本年度 最高額度餘額	年底額度餘額	年底實際 動支餘額
1	A.S.E. Holding Limited	本公司	其他應收款-關係人	是	\$ 2,932,040	\$ 2,902,500	\$ 2,902,500
		日月光貿易(上海)有限公司	長期應收款-關係人	是	834,000	_	_
2	J & R Holding Limited	本公司	其他應收款-關係人	是	9,561,000	7,417,500	4,966,500
		Global Advanced Packaging Technology Limited	長期應收款-關係人	是	2,502,000	548,250	548,250
		日月光半導體(威海)有限公司	其他應收款-關係人	是	3,000,580	1,515,750	1,515,750
		Omniquest Industrial Limited	其他應收款-關係人長期應收款-關係人	是	1,504,536	1,454,475	3,225
		日月光封裝測試 (上海)有限 公司	長期應收款-關係人	是	567,120	548,250	548,250
		Anstock Limited	其他應收款-關係人長期應收款-關係人	是	2,113,290	1,901,441	1,761,971
		日月光貿易(上海)有限公司	長期應收款-關係人	是	5,004,000	_	-
		Innosource Limited	長期應收款-關係人	是	733,920	3,225	3,225
		ASE Corporation	長期應收款-關係人	是	3,063,750	3,063,750	3,063,750
		ASE Labuan Inc.	長期應收款-關係人	是	645,500	645,000	645,000
		ASE Investment (Labuan) Inc.	長期應收款-關係人	是	1,290,000	1,290,000	1,290,000
		Real Tech Holdings Limited	其他應收款-關係人	是	2,168,400	_	=
3	ASE Test Limited	本公司	其他應收款-關係人	是	5,901,750	5,901,750	5,901,750
		A.S.E. Holding Limited	長期應收款-關係人	是	2,257,500	2,257,500	2,257,500
		Omniquest Industrial Limited	長期應收款-關係人	是	3,098,425	1,451,250	1,451,250
		ASE Investment (Labuan) Inc.	長期應收款-關係人	是	489,225	483,750	483,750
		J & R Holding Limited	長期應收款-關係人	是	645,000	645,000	645,000
4	台灣福雷電子公司	本公司	其他應收款-關係人	是	5,600,000	5,600,000	5,600,000
		日月光貿易(上海)有限公司	其他應收款-關係人	是	667,200	_	-
		ASE Corporation	其他應收款-關係人	是	1,910,076	_	_
		ASE Investment (Labuan) Inc.	其他應收款-關係人	是	2,668,800	1,269,163	-
		元隆電子股份有限公司	其他應收款-關係人	是	75,000	_	-
		Omniquest Industrial Limited	其他應收款-關係人	是	1,612,500	1,612,500	1,550,000
5	日月瑞公司	本公司	其他應收款-關係人	是	190,000	190,000	190,000
		日月光電子公司	其他應收款-關係人	是	190,000	190,000	190,000
6	ISE Labs, Inc.	J & R Holding Limited	長期應收款-關係人	是	1,534,560	1,483,500	1,483,500
7	ASE (Korea) Inc.	本公司	其他應收款-關係人	是	3,002,400	2,418,750	2,418,750
		日月光半導體 (威海)有限公司	其他應收款-關係人	是	3,665,050	1,290,000	1,290,000

	750 A 400 TH THE	*** 757/ * ^ ^ ~	有短期融通	提列備抵呆 擔保		品	對個別對象	資金貸與最高
利率區間(%)	資金貸與性質	業務往來金額	資金必要之原因	帳金額	名稱	價值	資金貸與限額(註1)	限額(註2)
0.83~1.27	短期融通	\$ -	營業週轉	\$ -	-	\$ -	\$ 3,093,672	\$ 6,187,345
_	短期融通	_	營業週轉/購置設備	-	-	_	15,735,521	23,603,281
0.83~1.27	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	10,305,266	20,610,532
0.83~1.02	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	15,735,521	23,603,281
0.05 1.02	74E703104XEE		E382270				.3,,33,52.	25,005,20
0.76~1.34	短期融通	_	營業週轉	-	-	_	15,735,521	23,603,281
0.83~1.02	短期融通	_	營業週轉	_	_	-	15,735,521	23,603,281
0.84~1.34	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	15,735,521	23,603,281
4.52~7.17	短期融通	-	營業週轉	_	-	_	15,735,521	23,603,281
_	短期融通	_	營業週轉/購置設備	_	_	_	15,735,521	23,603,281
0.83~1.02	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	15,735,521	23,603,281
0.85~1.02	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	15,735,521	23,603,281
0.85~1.02	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	15,735,521	23,603,28
0.91~1.02	短期融通		營業週轉	_	-	_	15,735,521	23,603,28
0.83~0.89	短期融通	_	營業週轉	_	-		10,305,266	20,610,532
0.83~1.27	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	6,260,537	12,521,074
0.83~1.02	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	15,735,521	23,603,28
0.83~1.02	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	15,735,521	23,603,28
0.83~1.02	短期融通	_	營業週轉	_	-	-	15,735,521	23,603,28
1.16	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	15,735,521	23,603,28
0.73~0.81	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	5,886,491	11,772,98
-	短期融通	_	營業週轉	-	-	_	5,886,491	11,772,98
0.76~0.81	短期融通	_	營業週轉	-	-	_	5,886,491	11,772,98
0.73~0.80	短期融通	_	營業週轉	-	-	_	5,886,491	11,772,98
3.33	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	5,886,491	11,772,98
0.73~0.74	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	5,886,491	11,772,98
0.73~0.81	短期融通	_	營業週轉	-	-	_	200,133	400,26
0.73~0.81	短期融通	_	營業週轉	-	-	_	200,133	400,26
0.92~1.40	短期融通	_	營業週轉	_	_	-	15,735,521	23,603,28
2.76~3.62	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	3,154,015	6,308,03
2.46~3.44	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	15,735,521	23,603,28

編號	資金貸與他人者 公司名稱	貸與對象	往來項目	是否為關係人	本年度 最高額度餘額	年底額度餘額	年底實際 動支餘額
8	ASE Japan Co., Ltd.	J & R Holding Limited	其他應收款-關係人	是	\$ 2,642,650	\$ 2,397,720	\$ 2,397,720
9	USI Enterprise	本公司	 其他應收款-關係人	是	7,584,625	7,578,750	7,578,750
	Limited	環電公司	其他應收款-關係人	是	2,268,480	2,193,000	1,935,000
		J&R Holding Limited	其他應收款-關係人	是	6,475,392	1,290,000	1,290,000
		Global Advanced Packaging Technology Limited	其他應收款-關係人	是	2,096,250	2,096,250	2,096,250
10	Huntington Holdings International Co.Ltd.	本公司	其他應收款-關係人	是	1,834,800	1,612,500	1,612,500
11	Anstock Limited	日月光封裝測試(上海)有限 公司	其他應收款-關係人長期應收款-關係人	是	3,274,092	1,841,004	1,841,004
12	日月光半導體(昆山)有限公司	日月光投資(昆山) 有限公司	其他應收款-關係人	是	2,039	1,999	1,999
13	Real Tech Holdings Limited	本公司	其他應收款-關係人	是	4,003,200	1,773,750	1,773,750
14	上海鼎匯房地產開發		其他應收款-關係人	是	687,407	348,675	348,675
	有限公司	上海鼎祺物業管理有限公司	其他應收款-關係人	是	14,984	13,947	13,947
15	環旭電子公司	環鴻電子(昆山)有限公司	其他應收款-關係人	是	1,527,570	_	_
		環維電子(上海)有限公司	其他應收款-關係人	是	6,493,110	2,556,950	464,900
		Universal Global Technology Co., Limited	其他應收款-關係人	是	6,110,280	2,789,400	_
		環豪電子(上海)有限公司	其他應收款-關係人	是	509,190	_	_
16	Omniquest Industrial Limited	本公司	其他應收款-關係人	是	3,169,200	3,063,750	3,001,250
17	Anstock II Limited	J & R Holding Limited	其他應收款-關係人	是	9,907,920	9,578,250	9,578,250
18	環勝電子(深圳)有限公司	環維電子(上海)有限公司	其他應收款-關係人	是	1,559,740	1,510,925	1,466,741
		Universal Global Technology Co., Limited	其他應收款-關係人	是	1,526,265	1,510,925	967,503
19	日月光封裝測試(上海)	 日月光貿易(上海)有限公司	長期應收款-關係人	是	1,000,800	_	_
	有限公司	上海鼎威房地產開發有限公司	其他應收款-關係人	是	464,900	464,900	464,900
20	日月光貿易(上海)有限	J & R Holding Limited	長期應收款-關係人	是	6,672,000	_	_
20	公司	A.S.E. Holding Limited	長期應收款-關係人	是	3,336,000	_	_
			ZONING NOVE INCOME.	~=	3,330,300		
21	日月光半導體(上海)有限公司	日月光半導體(威海)有限公司	其他應收款-關係人	是	166,800	_	-
22	Innosource Limited	本公司	其他應收款-關係人	是	733,920	_	-

利率區間(%)	資金貸與性質	業務往來金額	有短期融通	提列備抵呆	擔保品	品	對個別對象	資金貸與最高
19平皿同(70)	英亚英六江英	未切止不业积	資金必要之原因	帳金額	名稱	價值	資金貸與限額(註1)	限額(註2)
0.43~0.53	短期融通	\$ -	營業週轉	\$ -	=	\$ -	\$ 15,735,521	\$ 23,603,28
0.83~1.27	短期融通	_	營業週轉	_	_		8,081,317	16,162,634
0.83~1.42	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	8,081,317	16,162,634
0.83~3.37	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	8,081,317	16,162,634
1.16	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	8,081,317	16,162,634
0.83~1.27	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	8,784,812	17,569,62
4.45~8.93	短期融通	_	營業週轉	_	_	-	15,735,521	23,603,28 ⁻
4.35~4.85	短期融通	_	營業週轉	_	-	-	15,735,521	23,603,28
0.83~1.27	短期融通	_	營業週轉	_	-	-	8,371,228	16,742,450
4.35~6.00	短期融通	_	營業週轉	_		_	15,735,521	23,603,28
4.35	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	15,735,521	23,603,28
-	短期融通	_	營業週轉	_		_	7,026,188	14,052,37
0.80~1.75	短期融通	_	營業週轉	-	_	_	7,026,188	14,052,37
_	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	7,026,188	14,052,37
-	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	7,026,188	14,052,37
0.83~1.27	短期融通	_	營業週轉	_	-	-	3,187,078	6,374,15
2.45	短期融通	-	營業週轉	_	-	-	15,735,521	23,603,28
0.80~1.75	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	1,990,218	3,980,43
0.8	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	1,990,218	3,980,43
_	短期融通	_	營業週轉		_	_	15,735,521	23,603,28
4.35	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	15,735,521	23,603,28
_	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	15,735,521	23,603,28
_	短期融通	_	營業週轉	-	-	_	15,735,521	23,603,28
1.12~1.19	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	15,735,521	23,603,28
0.83~0.89	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	848,863	1,697,720

編號	資金貸與他人者 公司名稱	貸與對象	往來項目	是否為關係人	本年度最高額度餘額	年底額度餘額	年底實際 動支餘額
23	ASE Investment (Labuan) Inc.	本公司	其他應收款-關係人	是	\$ 3,105,880	\$ 2,996,025	\$ 1,770,525
24	Global Advanced Packaging Technology Limited	本公司	其他應收款-關係人	是	2,096,250	2,096,250	2,096,250
25	ASE Corporation	本公司	其他應收款-關係人	是	3,063,750	3,063,750	3,063,750
26	日月光電子公司	本公司	其他應收款-關係人	是	300,000	300,000	300,000
27	ASE Singapore Pte. Ltd.	A.S.E. Holding Limited	其他應收款-關係人	是	400,320	_	_
28	環鴻電子(昆山)有限公司	環維電子(上海)有限公司	其他應收款-關係人	是	399,576	371,920	232,450
29	ASE Labuan Inc.	本公司	其他應收款-關係人	是	645,500	645,000	645,000
30	ASE Electronics (M) SDN. BHD.	J & R Holding Limited	其他應收款-關係人	是	258,000	258,000	225,750

註1:對個別對象資金貸與限額為不超過該公司淨值之百分之二十。惟本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與者,以不超過本公司最近期財務報表淨值 之百分之十為限。

註2:因公司間或與行號間有短期融通資金之必要而將資金貸與他人之總額度,以不超過該公司淨值百分之四十為限。惟本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事 資金貸與者,以不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之十五為限。

註3:已於編製合併報告時沖銷。

 利率區間(%)	資金貸與性質	業務往來金額	有短期融通	提列備抵呆	擔保品		對個別對象	資金貸與最高
刊 华 回 目 (%)	貝並貝架性貝	未務住外並領	資金必要之原因	資金必要之原因帳金額		價值	資金貸與限額(註1)	限額(註2)
0.76~1.27	短期融通	\$ -	營業週轉	\$ -	_	\$ -	\$ 3,188,947	\$ 6,377,894
0.83~1.45	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	2,206,319	4,412,638
0.76~1.27	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	3,188,378	6,376,756
0.74~0.81	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	819,814	1,639,627
0.83~0.89	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	15,735,521	23,603,281
1.75	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	571,816	1,143,632
0.85~1.27	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	823,471	1,646,942
1.16	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	15,735,521	23,603,281

為他人背書保證

民國105年1月1日至12月31日

附表二

編號	背書保證者	被背	背書保證對象	對單一企業背書	本年度最高	年底	年底實際
が出った	公司名稱	公司名稱	關係	保證限額(註1)	額度餘額	額度餘額	動支餘額
0	本公司	Anstock Limited	間接持有表決權股份100%之子公司	\$ 47,206,562	\$ 2,653,363	\$ -	\$ -
					(註3)	(註3)	(註3)
		Anstock II Limited	間接持有表決權股份100%之子公司	47,206,562	10,327,005	9,880,594	9,766,375
					(註3)	(註3)	(註3)
1	上海鼎匯房	昆山鼎泓房地產開發有限	直接持有表決權股份100%之子公司	13,372,559	633,647	_	_
	地產開發	公司			(註3)	(註3)	(註3)
	有限公司						

註1:依本公司及上海鼎匯房地產開發有限公司「背書保證作業程序」,對單一企業之背書保證額度分別以不超過股東權益總額之百分之三十及百分之七十為限。

註2:依本公司及上海鼎匯房地產開發有限公司「背書保證作業程序」,背書保證責任總額分別以不超過股東權益總額之百分之四十及百分之百為限。

註3:係包含本金及利息。

單位:新台幣干元

以財產擔保之 背書保證金額	累計背書保證金額佔 最近期財務報表淨值之比率(%)	背書保證最高 限額(註2)	屬母公司對子公司 背書保證	屬子公司對母公司 背書保證	屬對大陸地區 背書保證
\$ -	-	\$ 62,942,082	是	否	否
-	6.3	62,942,082	是	否	否
_	_	19,103,656	是	否	是

年底持有有價證券情形明細表

民國105年12月31日 附表三

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目
本公司	股票		
	漢驊創業投資公司	_	備供出售金融資產-非流動
	漢大創業投資公司	_	備供出售金融資產-非流動
	神通資訊科技公司	-	備供出售金融資產-非流動
	亞太新興產業創業投資公司	_	備供出售金融資產-非流動
	晶錡科技公司	_	備供出售金融資產-非流動
	債券		
	元隆電子公司國内第二次私募無擔保轉換公司債	_	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動
	有限合夥		
	Ripley Cable Holdings I, L.P.	_	備供出售金融資產-非流動
台灣福雷電子公司	股票		
	日月光半導體製造公司	母公司	備供出售金融資產-非流動
	寶德能源科技股份有限公司	_	備供出售金融資產-非流動
	神通資訊科技公司	_	備供出售金融資產-非流動
	漢通創業投資股份有限公司	_	備供出售金融資產-非流動
	基金		
	中國信託華盈貨幣市場基金	_	備供出售金融資產-流動
	中國信託全球不動產收益基金	_	備供出售金融資產-流動
	公司債		
	南山人壽保險股份有限公司105年度第一期無到期日累積 次順位公司債	_	其他金融資產-非流動
日月瑞公司	基金		
,	台新大衆貨幣市場	_	 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動
	日盛貨幣市場	_	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動
	華南永昌麒麟貨幣市場基金	_	透過損益按公允價值衡量之金融資產 – 流動
	華南永昌鳳翔貨幣市場基金	_	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動
陸竹開發公司	股票		
	力晶科技公司	_	備供出售金融資產-非流動
A.S.E. Holding	股票		
Limited	Global Strategic Investment Inc.	_	 備供出售金融資產-非流動
	SiPhoton, Inc.	_	備供出售金融資產 – 非流動
	Global Strategic Investment, Inc. (Samoa)	_	備供出售金融資產-非流動
J & R Holding Limited	股票		
2 2	日月光半導體製造公司	母公司	備供出售金融資產-非流動

單位:新台幣干元(除另予註明者外)

接面金額 持股比率(%) 公允價値 備註	
1,613,793 27,164 13 27,164 4,203 12 — 12 6,000,000 38,262 7 38,262 333,334 — 6 — 1,000 100,583 — 100,583 — 219,921 4 219,921 10,978,776 362,849 — 362,849 97,000,000 226,994 4 226,994	
1,613,793 27,164 13 27,164 4,203 12 — 12 6,000,000 38,262 7 38,262 333,334 — 6 — 1,000 100,583 — 100,583 — 219,921 4 219,921 10,978,776 362,849 — 362,849 97,000,000 226,994 4 226,994	
4,203 12 — 12 6,000,000 38,262 7 38,262 333,334 — 6 — 1,000 100,583 — 100,583 — 219,921 4 219,921 10,978,776 362,849 — 362,849 97,000,000 226,994 4 226,994	
6,000,000 38,262 7 38,262 333,334 - 6 - 1,000 100,583 - 100,583 - 219,921 4 219,921 10,978,776 362,849 - 362,849 97,000,000 226,994 4 226,994	
333,334 - 6 - 1,000 100,583 - 100,583 - 219,921 4 219,921 10,978,776 362,849 - 362,849 97,000,000 226,994 4 226,994	
1,000 100,583 — 100,583 — 219,921 4 219,921 10,978,776 362,849 97,000,000 226,994 4 226,994	
- 219,921 4 219,921 10,978,776 362,849 97,000,000 226,994 4 226,994	
- 219,921 10,978,776 362,849 97,000,000 226,994 4 219,921 - 362,849 226,994 4 226,994	
- 219,921 10,978,776 362,849 97,000,000 226,994 4 219,921 - 362,849 226,994 4 226,994	
10,978,776 362,849 — 362,849 97,000,000 226,994 4 226,994	
10,978,776 362,849 — 362,849 97,000,000 226,994 4 226,994	
10,978,776 362,849 — 362,849 97,000,000 226,994 4 226,994	
97,000,000 226,994 4 226,994	
97,000,000 226,994 4 226,994	
97,000,000 226,994 4 226,994	
1,133,303	
7,725,000 63,502 7 63,502	
7,725,000	
18,323,744 200,011 – 200,011	
2,500,000 23,425 — 23,425	
1,000	
33,664,705 473,693 – 473,693	
1,575,019 23,105 – 23,105	
2,616,592 31,046 — 31,046 2,833,825 45,664 — 45,664	
2,833,825 45,664 - 45,664	
1,677,166 38,231 – 38,231	
30,231	
490,000 美金 546千元 3 美金 546千元	
544,800 \$ - 4 \$ -	
869,891 美金 450千元 2 美金 450千元	
46,703,763 美金 47,862干元 1 美金 47,862干元	

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目
	有限合夥		
	Crimson Velocity Fund, L.P.	_	備供出售金融資產-非流動
	H&QAP Greater China Growth Fund,L.P.	_	備供出售金融資產-非流動
ASE Test Limited	股票		
	日月光半導體製造公司	母公司	備供出售金融資產-非流動
上海鼎匯房地產開發	基金		
有限公司	180ETF	_	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動
	300ETF	_	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動
	股票		
	珠海格力電器股份有限公司	_	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動
	上海汽車集團股份有限公司	_	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動
	中原證券股份有限公司	_	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動
78.50 J	20.46		
環電公司	股票		
	博智電子公司	_	備供出售金融資產 - 流動
	全球創業投資公司	_	備供出售金融資產-非流動
	行動檢測服務公司	_	備供出售金融資產-非流動 (#供出售金融資產-非流動
	威力陽公司 精磁科技公司		備供出售金融資產-非流動 備供出售金融資產-非流動
Huntington Holdings	股票		
International Co.,	United Pacific Industrial Ltd.	_	 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動
Ltd.	Cadence Design SYS Inc.	_	透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動
	Solid Gain Invenstments Ltd.	_	備供出售金融資產-非流動
	特別股		
	Techgains I Corporation	_	備供出售金融資產-非流動
	Techgains II Corporation	_	備供出售金融資產-非流動
Jnitech Holdings	股票		
International Co.,	United Pacific Industrial Ltd.	_	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動
Ltd.	WacomCo., Ltd.	_	備供出售金融資產-非流動
	Sequans Communications SA	_	備供出售金融資產-非流動
	Asia Global Venture Co., Ltd.	_	備供出售金融資產-非流動
環鴻科技公司	基金		
	富蘭克林貨幣市場基金	_	備供出售金融資產-流動
	股票		
	士鼎創業投資股份有限公司	=	備供出售金融資產-非流動

註: ASE Test Limited持有本公司股票88,200,472股,則全數以非保留運用決定權信託專戶保管。

		年	 底			,·
		帳面金額	持股比率(%)		公允價值	備註
_	美金	804干元	-	美金	804干元	
-	美金	853干元	8	美金	853干元	
88,200,472 (註)	美金	90,388千元	1	美金	90,388千元	
447,825	人民幣	1,319千元	-	人民幣	1,319干元	
339,700	人民幣	1,141千元	-	人民幣	1,141干元	
28,000	人民幣	689千元	_	人民幣	689干元	
19,250	人民幣	451千元	_	人民幣	451干元	
1,000	人民幣	4干元	_	人民幣	4干元	
827,009	\$	23,239	2	\$	23,239	
6,200,000	Ψ	35,973	5	Ψ	35,973	
275,000		3,614	4		3,614	
108,000		1,293	1		1,293	
733,000		_	2		_	
·						
5,548,800	美金	351干元	_	美金	351干元	
9,633	美金	243千元	-	美金	243千元	
1,322,833	美金	710千元	20	美金	710千元	
526,732	美金	267千元	10	美金	267千元	
669,705	美金	185干元	4	美金	185干元	
5,613,600	美金	355千元	_	美金	355千元	
1,200,000	美金	3,138千元	1	美金	3,138千元	
370,554	美金	693千元	1	美金	693千元	
1,000,000	美金	576千元	10	美金	576干元	
1,956,583	\$	20,022	_	\$	20,022	
10 500 000		105.000	-		105 000	
10,500,000		105,000	5		105,000	

重大累積買進或賣出同一有價證券明細表

民國105年1月1日至12月31日

附表四

= ・売う八ヨ	左應該光廷叛兵 勾延	#E ZII XI C	六日料色	關係		年初
買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象		股數/單位數	金額(註1)
本公司	股票					
	環隆電氣公司	採權益法之長期股權投資	註2	子公司	39,603,222	\$ 1,187,548
	矽品公司	採權益法之長期股權投資	註3	關聯企業	779,000,000	35,141,701
	Deca Technologies Inc.	採權益法之長期股權投資	註4	關聯企業	_	_
台灣福雷電子公司	基金					
	統一強棒貨幣市場基金	備供出售金融資產-流動	_	_	_	_
	中國信託華盈貨幣市場基金	備供出售金融資產-流動	_	_	_	_
	公司債 南山人壽保險股份有限公司 105年度第一期無到期日 累積次順位公司債	其他金融資產-非流動	_	_	_	-
Innosource Limited	股權憑證 日月光電子元器件(上海)有 限公司	採權益法之長期股權投資	註5	子公司	_	美金 18,777千元
	日月光半導體(上海)有限公 司	採權益法之長期股權投資	註5	子公司	_	\$ -
日月光半導體(上海)有限公司	股權憑證 日月光電子元器件(上海)有 限公司	採權益法之長期股權投資	註5	聯屬公司	_	-
環鴻科技公司	股票					
環鴻香港公司	環隆電氣公司 股票	採權益法之長期股權投資	註2	子公司	_	_
環ル公司(上海)	環鴻科技公司	採權益法之長期股權投資	註4	子公司	98,000,000	美金 83,745千元
	環鴻香港公司	採權益法之長期股權投資	註4	子公司	390,000,000	人民幣 1,421,145干元

註1:採權益法之長期股權投資金額係包括權益法認列之投資損益及股東權益相關調整項目等。其他金融資產金額則包括以公平價值衡量之評價調整數。

註2:係子公司環鴻科技公司取得環隆電氣公司之組織架構調整。

註3:係公開市場取得。

註4:係辦理現金增資。

註5:係日月光半導體(上海)有限公司以增資方式交換Innosource Limited所持有日月光電子元器件(上海)有限公司之股權。

單位:新台幣干元(除另予註明者外)

	入			1	賣	出			:	年底	
股數/單位數		金額	股數/單位數		售價	¢	長面成本	處分(損)益	股數/單位數	:	金額(註1)
-	\$	_	39,603,222	\$	792,064	\$	1,242,836	\$ _	_	\$	-
258,300,000		13,735,498	-		-		_	-	1,037,300,000		45,884,727
98,489,803		1,934,062	_		-		_	-	98,489,803		1,820,329
18,170,696		300,000	18,170,696		300,454		300,000	454	_		_
36,700,692		400,000	18,376,948		200,311		200,000	311	18,323,744		200,011
1,000		1,000,000	-		-		-	-	1,000		1,000,000
-		_	-	美金	17,411干元	美金	17,411干元	-	_		-
-	美金	17,411干元	_	\$	-	\$	-	-	_	美金	28,545干元
-	美金	17,411千元	-		_		_	_	_	美金	1,123千元
39,603,222	\$	894,612	_		-		-	-	39,603,222	\$	1,000,490
100,000,000	美金	31,835千元	_		-		-	-	198,000,000	美金	137,978千元
387,716,500	人民幣	338,205千元	_		-		-	=	777,716,500	人民幣	8 2,200,741干元

取得不動產之金額達新台幣3億或實收資本額20%以上

民國105年1月1日至12月31日 附表五

取得不動產之公司	財產名稱	事實發生日	交易金額(未稅)	價款支付情形	交易對象	關係
本公司	高雄廠區供營業用之廠務設 備及工程等	105.01.01~105.12.31	\$ 473,529	尚餘129,323干元將於 驗收後付款	漢唐集成股份有限 公司	無
	女子員工宿舍	105.01.01~105.12.31	370,400	尚餘228,500千元將於 驗收後付款	福華工程股份有限 公司	被投資公司宏璟建設之子公司
ASE (Korea) Inc.	New Production Building Interior work	105.08.17~105.12.09	753,453	尚餘463,283干元將於 驗收後付款	Hyundai Engineering & Construction	無
	RO,DI,WWT Expansion Work	105.08.01~105.11.28	347,747	尚餘84,512干元將於 驗收後付款	EnTech	無

單位:新台幣干元

	交易對象為關係人者	香,其前次移轉資料		價格決定之參考依據	取得目的及使用情形	其他約定事項
所有人	與發行人之關係	移轉日期	金額	順俗次足之参与似據	以待日的汉使用铜形	共心心化争块
-	-	-	\$ -	依詢、比、議價	依營業用之廠務設備 及工程擴充	無
-	-	-	-	依詢、比、議價	因應未來營運成長之 住宿需求,並提升 女性員工之居住安 全及品質	無
-	_	_	_	依詢、比、議價	依營業用之廠務設備 及工程擴充	無
-	-	_	_	依詢、比、議價	依營業用之廠務設備 及工程擴充	無

重大與關係人進、銷貨明細表

民國105年1月1日至12月31日 附表六

進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關係			交	易情形		
连(朝)貝之公司	父勿到象石博	不 時間	進(銷)貨		金額	佔總進(銷)貨之比率%	授信期間	
本公司	日月光半導體(上海)有限公司	子公司	進貨	\$	2,114,192	6	月結60天	
	日月光電子公司	子公司	進貨		2,480,624	7	月結60天	
	台灣福雷電子公司	子公司	進貨		126,024	_	月結60天	
	環隆電氣公司	子公司	銷貨	(4,475,225)	(5)	月結60天	
	ISE Labs, Inc.	子公司	銷貨	(167,245)	_	發票日後45天	
	ASE Japan Co., Ltd.	子公司	銷貨	(107,254)	_	月結60天	
日月光封裝測試(上	日月光半導體(上海)有限公司	聯屬公司	進貨		182,476	6	月結60天	
海)有限公司	日月光電子公司	聯屬公司	進貨		163,924	6	月結60天	
	日月光半導體(香港)有限公司	聯屬公司	進貨		211,167	7	發票日後45天	
日月光半導體(香港)	日月光半導體(上海)有限公司	母公司	進貨		1,566,836	100	月結90天	
有限公司	日月光封裝測試(上海)有限公司	聯屬公司	銷貨	(211,167)	(14)	發票日後45天	
ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	日月光電子公司	聯屬公司	進貨		466,944	28	發票日後60天	
SE Labs, Inc.	本公司	最終母公司	進貨		167,245	57	發票日後45天	
農隆電氣公司	本公司	最終母公司	進貨		4,475,225	20	月結60天	
日月光半導體(上海)	本公司	最終母公司	銷貨	(2,114,192)	(45)	月結60天	
有限公司	日月光封裝測試(上海)有限公司	聯屬公司	銷貨	(182,476)	(4)	發票日後60天	
	日月光半導體(香港)有限公司	子公司	銷貨	(1,566,836)	(33)	月結90天	
日月光電子公司	本公司	最終母公司	銷貨	(2,480,624)	(55)	月結60天	
	ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	聯屬公司	銷貨	(466,944)	(10)	發票日後60天	
	日月光封裝測試(上海)有限公司	聯屬公司	銷貨	(163,924)	(4)	月結60天	
	環旭電子公司	聯屬公司	銷貨	(230,243)	(5)	月結60天	
台灣福雷電子公司	本公司	最終母公司	銷貨	(189,345)	(2)	月結60天	
SE Japan Co., Ltd.	本公司	最終母公司	進貨		107,254	43	月結60天	
球州日月新半導體有 限公司	台灣恩智浦半導體公司	對蘇州日月新半導體 有限公司有重大影 響力公司之子公 司 - 荷蘭NXP B.V 之子公司	銷貨	(1,977,338)	(32)	月結90天	
睘勝電子(深圳)有限	環旭科技有限公司	聯屬公司	進貨	人民幣	632,717干元	18	75天	
公司			銷貨	(人民幣	2,634,900千元)	(56)	75天	

1 11 = -	票據、帳款	應收(付)	不同之情形及原因	交易條件與一般交易	
備討	佔總應收(付)票據、帳款之比率(%)	餘額	授信期間	單價	
註	(6)	(\$ 510,991)			
註	(6)	(514,799)	_	_	
註	_	(85)	_	_	
註	9	1,702,509			
註	_	24,814			
註	_	17,413	-	-	
註	_	(13)	_	_	
註	(1)	(4,110)	_	_	
註	(17)	(94,072)	-	-	
註	(100)	(382,786)	-	_	
註	28	94,072	-	-	
註	(32)	(91,153)	-	-	
註	(30)	(24,814)	-	-	
註	(35)	(1,701,561)	-	-	
註	49	511,960	_	_	
註	-	13	-	_	
註	37	382,786	-	-	
註	55	544,192	_	-	
註	9	91,172	-	_	
註	-	4,110	-	_	
註	7	64,171	-	-	
註	69	1,935,712	_	_	
註	(17)	(17,341)	_	_	
PT	17)	(17,341)			
註	45	649,456	_	-	
=+	423	(人 足 轍女			
註註	(13) 58	(人民幣 146,677千元) 人民幣 631,306千元	-	_	

光/40/毛 力刀目	立日料会 存取	88 17	交易情形						
進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關係	進(銷)貨		金額	佔總進(銷)貨之比率%	授信期間		
環旭電子公司	Universal Global Technology	子公司	進貨	人民幣	840,612干元	12	75天		
	Co., Limited								
	環旭科技有限公司	子公司	銷貨	(人民幣	62,370千元)	(1)	75天		
	環鴻電子(昆山)有限公司	子公司	銷貨	(人民幣	27,137千元)	-	75天		
	環勝電子(深圳)有限公司	子公司	銷貨	(人民幣	35,874千元)	-	75天		
	日月光電子公司	聯屬公司	進貨	人民幣	52,038千元	1	月結60天		
Universal Global	環旭電子公司	母公司	銷貨	美金	124,439干元)	(55)	75天		
Technology Co.,	環鴻電子(昆山)有限公司	聯屬公司	銷貨	(美金	97,824千元)	(43)	75天		
Limited	環維電子(上海)有限公司	子公司	銷貨	美金	4,451千元)	(2)	75天		
環旭科技有限公司	環勝電子(深圳)有限公司	聯屬公司	進貨	美金	397,045干元	52	75天		
			銷貨	(美金	92,675千元)	(13)	75天		
	環旭電子公司	母公司	進貨	美金	9,379千元	1	75天		
	環鴻科技公司	聯屬公司	銷貨	(美金	488,935千元)	(71)	75天		
	環鴻電子(昆山)有限公司	聯屬公司	進貨	美金	192,312千元	25	75天		
			銷貨	(美金	7,976千元)	(1)	75天		
環鴻科技公司	環旭科技有限公司	聯屬公司	進貨	\$	15,804,399	90	75天		
	環旭電子公司	母公司	銷貨	(225,600)	(1)	75天		
	環勝電子(深圳)有限公司	聯屬公司	銷貨	(155,660)	(1)	75天		
	環隆電氣公司	子公司	銷貨	(878,092)	(4)	75天		
環鴻電子(昆山)有限 公司	Universal Global Technology Co., Limited	聯屬公司	進貨	人民幣	664,729千元	35	75天		
	環旭科技有限公司	聯屬公司	進貨	人民幣	52,758千元	3	75天		
			銷貨	(人民幣	1,283,735千元)	(56)	75天		
環維電子(上海)有限 公司	Universal Global Technology Co., Limited	聯屬公司	進貨	人民幣	31,666千元	2	75天		
	環旭電子公司	母公司	銷貨	(人民幣	30,518千元)	(1)	75天		

註:已於編製合併報告時沖銷。

交易條件與一般交易	不同之情形及原因	應收(付)票據、帳款				
單價	授信期間		餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率(%)	備註	
_	-	(人民幣	193,628干元)	(14)	註	
_	_	人民幣	15,558干元	1	註	
_	=	人民幣	696干元	-	註	
_	_	人民幣	179千元	-	註	
-	-	(人民幣	13,296干元)	(1)	註	
_	_	美金	27,920千元	48	註	
-	_	美金	27,952千元	48	註	
-	-	美金	2,764干元	5	註	
_	-	(美金	91,006干元)	(50)	註	
-	_	美金	21,040千元	12	註	
-	_	(美金	2,240千元)	(1)	註	
-	_	美金	117,165千元	67	註	
-	_	(美金	50,801千元)	(28)	註	
-	-	美金	1,859干元	1	註	
-	-	(\$	3,778,624)	(83)	註	
-	-		-	-	註	
-	_		42,497	1	註	
-	-		399,994	7	註	
_	-	(人民幣	193,857千元)	(28)	註	
_	-	(人民幣	12,895干元)	(2)	註	
-	-	人民幣	356,210千元	53	註	
-	-	(人民幣	19,176干元)	(3)	註	
_	_	人民幣	203千元	_	註	

重大應收關係人款項明細表

民國105年12月31日 附表七

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關係
本公司	環隆電氣公司	子公司
日月光電子公司	本公司	最終母公司
Omniquest Industrial Limited	本公司	母公司
ISE Labs, Inc.	J & R Holding Limited	母公司
Anstock Limited	日月光封裝測試(上海)有限公司	聯屬公司
Anstock II Limited.	J & R Holding Limited	母公司
A.S.E. Holding Limited	本公司	母公司
台灣福雷電子公司	 本公司	 母公司
	Omniquest Industrial Limited	聯屬公司
ASE Test Limited	本公司	最終母公司
	J & R Holding Limited	母公司
	A.S.E. Holding Limited	聯屬公司
	Omniquest Industrial Limited	聯屬公司
	ASE Investment(Labuan)Inc.	聯屬公司
ASE (Korea) Inc.	本公司	最終母公司
	日月光半導體(威海)有限公司	子公司
J & R Holding Limited	本公司	母公司
	Global Advanced Packaging Technology Limited	子公司
	Anstock Limited	子公司
	日月光半導體(威海)有限公司	聯屬公司
	日月光封裝測試(上海)有限公司	聯屬公司
	ASE Investment(Labuan)Inc.	子公司
	ASE Corporation	聯屬公司
	ASE Labuan Inc.	聯屬公司
日月瑞公司	本公司	最終母公司
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	聯屬公司
ASE Japan Co., Ltd.	J & R Holding Limited	母公司
ASE Investment(Labuan)Inc.	本公司	最終母公司
ASE Corporation	本公司	最終母公司

單位:新台幣干元(除另予註明者外)

提列備抵	應收關係人款項	、款項(註1)	逾期應收關係人		應收關係人	
呆帳金額	期後收回金額	處理方式	金額	(註2)	1)	款項餘額(註
	\$ 1,290,049 \$	持續催収	\$ 4,422	2	(註5)	1,702,509
					(=+-)	
	386,045	_	_	5	(註5)	844,692
	-	-	-	_	(註3及5)	3,001,250
	-	-	-	-	(註3及5)	1,484,010
	_	-	_	-	(註3及5)	1,844,653
	_	_	-	-	(註3及5)	9,638,220
	_	-	_	-	(註3及5)	2,902,500
	937,192	_	_	_	(註3、4及5)	7,587,311
	937,192	_	_	_	(註3及5)	1,550,000
						, ,
	-	-	-	-	(註3及5)	5,901,750
	-	-	-	-	(註3及5)	645,083
	-	_	-	_	(註3及5)	2,264,836
	-	-	-	=	(註3及5)	1,461,604
	-	_	-	-	(註3及5)	487,111
	646,084	-	_	_	(註3及5)	2,418,954
	-	_	-	_	(註3及5)	1,292,075
	548,250	-	_	-	(註3及5)	4,966,500
	-	_	_	_	(註3及5)	564,014
	-	_	-	_	(註3及5)	1,860,478
	-	_	-	_	(註3及5)	1,520,658
	-	_	_	_	(註3及5)	556,634
	-	-	-	=	(註3及5)	1,294,642
	-	-	-	-	(註3及5)	3,076,321
	483,750	_	-	-	(註3及5)	648,116
	_	_	_	_	(註3及5)	190,000
	-	_	-	-	(註3及5)	190,000
	-	-	_	-	(註3及5)	2,398,477
	-	-	_	-	(註3及5)	1,770,525
	_	_	-	_	(註3及5)	3,063,750

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關係
ASE Labuan Inc.	本公司	最終母公司
Global Advanced Packaging Technology Limited	本公司	最終母公司
ASE Electronics (M) SDN. BHD.	J & R Holding Limited	母公司
日月光半導體(上海)公司	本公司 日月光半導體(香港)有限公司	最終母公司子公司
日月光封裝測試(上海)有限公司	上海鼎威房地產開發有限公司	聯屬公司
上海鼎匯房地產開發有限公司	昆山鼎泓房地產開發有限公司	子公司
USI Enterprise Limited	本公司 J & R Holding Limited Global Advanced Packaging Technology Limited 環電公司	最終母公司聯屬公司母公司
Huntington Holdings International Co. Ltd.	本公司	最終母公司
Real Tech Holdings Limited	本公司	最終母公司
蘇州日月新半導體有限公司	台灣恩智浦半導體公司	對蘇州日月新半導體有限公司有重大影響力公司之子公司
環勝電子(深圳)有限公司	環旭科技有限公司 Universal Global Technology Co., Limited 環維電子(上海)有限公司	聯屬公司 母公司 聯屬公司
環旭電子公司	環維電子(上海)有限公司	子公司
Universal Global Technology Co., Limited	環旭電子公司 環鴻電子(昆山)有限公司	母公司 聯屬公司
環旭科技有限公司	環勝電子(深圳)有限公司 環鴻科技公司	聯屬公司聯屬公司
環鴻科技公司	環隆電氣公司	子公司
環鴻電子(昆山)有限公司	環旭科技有限公司 環維電子(上海)有限公司	聯屬公司

註1:係包含應收帳款及其他應收款。 註2:不含其他應收款。

註3:主係應收融資款:詳附表一說明。 註4:主係Turnkey代收代付。 註5:已於編製合併報表時沖銷。

	應收關係人		週轉率(次)	逾期應收關係		應收關係人款項	提列備抵	
	款項餘額(註		(註2)	金額	處理方式	期後收回金額	呆帳金額	
\$	645,000	(註3及5)	_	\$ -	_	\$ 480,525	\$ -	
	2,096,250	(註3及5)	-	_	_	_	_	
	225,786	(註3及5)	_	_	_	64,500	_	
	511,960	(註5)	4	269,293	持續催収	242,667	_	
	382,786	(註5)	5	140,328	持續催収	242,458	_	
	465,494	(註3及5)	_	_	_	_	_	
	355,640	(註3及5)	_			182,307		
	333,040	(CX/CIE)		_	_	162,307	_	
	7,578,750	(註3及5)	-	_	_	_	_	
	1,294,620	(註3及5)	_	_	_	1,294,620	_	
	2,096,587	(註3及5)	_	_	_	_	_	
	1,935,733	(註3及5)	-	_	_	_	_	
	1,612,500	(註3及5)	_	_	_	_	_	
	1,773,750	(註3及5)	_	_	_	_	_	
	654,435		3	_	_	172,788	-	
	534,027干元	(註5)	4	_	_	人民幣 529,720千元	_	
	208,230千元 315,640千元	(註3及5)	_	_	_	\$ -	_	
八氏帝:	515,040 76	(CX/CIq)						
人民幣	100,196干元	(註3及5)	3	_	_	_	_	
美金	27,920千元	(註5)	1	_	_	美金 4,523千元	_	
美金	27,954干元	(註5)	5	_	_	美金 7,849干元	_	
*^	24.450==	,=.b				*^		
美金	21,160千元	(註5)	4	_	_	美金 7,645千元	_	
美金 ′	118,006干元	(註5)	4	_	_	美金 47,925千元	_	
\$	400,136	(註5)	2	_	_	\$ 128,592	_	
•	,	,,,,,	-					
人民幣 3	356,210干元	(註5)	5	_	_	人民幣 134,028千元	-	
人民幣	50,027千元	(註3及5)	_	_	_	\$ -	_	

被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊

民國105年1月1日至12月31日 附表八

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目
本公司	A.S.E. Holding Limited	百慕達群島	從事專業性投資活動
	J & R Holding Limited	百慕達群島	從事專業性投資活動
	ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	日本	從事半導體封裝及測試之市場行銷及客戶服務等業務
	Omniquest Industrial Limited	英屬維京群島	從事專業性投資活動
	Innosource Limited	英屬維京群島	從事專業性投資活動
	宏錦光公司	台灣	自有剩餘攤位及辦公大樓出租
	宏璟建設公司	台灣	委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租業務、買賣各種建材及其進出口 業務、房屋租售之介紹業務、室内設計裝潢工程
	環隆電氣公司	台灣	各種電腦資訊之週邊設備,厚膜混合積體電路,電子零件配件及個人電腦及 其零件之製造、加工與買賣
	台灣福雷電子公司	台灣	半導體產品測試服務
	環電公司	台灣	從事專業性投資活動
	陸竹開發公司	台灣	從事土地及建築開發業務
	日月暘公司	台灣	從事積體電路內埋式基板之產銷業務
	矽品公司	台灣	各項積體電路構裝之製造、加工、買賣及測試等有關業務
	Deca Technologies Inc.	開曼群島	控股公司,集團從事半導體之製造、組合、加工、測試及銷售
	元隆電子公司	台灣	晶圓積體電路代工
台灣福雷電子公司	Alto Enterprises Limited	英屬維京群島	從事專業性投資活動
	Super Zone Holdings Limited	香港	從事專業性投資活動
	陸竹開發公司	台灣	從事土地及建築開發業務
	笛林傑公司	台灣	從事資訊軟體服務業務
	元隆電子公司	台灣	晶圓積體電路代工
A.S.E. Holding Limited	ASE Test Limited	新加坡	從事專業性投資活動
	ASE Investment (Labuan) Inc.	馬來西亞	從事專業性投資活動
J & R Holding Limited	ASE Test Limited	新加坡	從事專業性投資活動
	Omniquest Industrial Limited	英屬維京群島	從事專業性投資活動
	日月瑞公司	台灣	各型積體電路封裝測試用機器設備及引線架機器設備之租賃等
	ASE Japan Co., Ltd.	日本	積體電路之封裝及製造
	ASE (U.S.) Inc.	美國	從事市場行銷支援及客戶服務等業務
	Global Advanced Packaging Technology Limited	開曼群島	從事專業性投資活動
	Anstock Limited	開曼群島	從事專業性投資活動
	Anstock II Limited	開曼群島	從事專業性投資活動
ASE Investment (Labuan) Inc.	ASE (Korea) Inc.	南韓	電子零組件,通信機械器材製造
ASE Test Limited	ASE Holdings (Singapore) Pte Ltd.	新加坡	從事專業性投資活動
	ASE Test Holdings, Ltd.	開曼群島	從事專業性投資活動
	ASE Investment (Labuan) Inc.	馬來西亞	從事專業性投資活動
	ASE Singapore Pte. Ltd.	新加坡	半導體產品測試服務

單位:新台幣干元(除另予註明者外)

										單位:新台幣	干元(除另予註明者外) T
	原始投	資金額	<u> </u>		年底持有			-	投資公司	本年度認列之	備註
:	本年年底	:	去年年底	股數	比率		帳面金額	本	年度(損)益	投資(損)益(註1)	PROT
美金	283,966千元	美金	283,966千元	243,966	100	\$	15,171,321	\$	379,950	\$ 365,594	子公司
美金	479,693千元	美金	479,693千元	435,128	100		47,880,837		3,999,715	3,794,189	子公司
日幣	60,000千元	日幣	60,000千元	1,200	100		30,527		2,432	2,432	子公司
美金	250,504干元	美金	250,504干元	250,504,067	71	71 10,972,509			1,120,450	798,249	子公司
美金	86,000干元	美金	86,000干元	86,000,000	100		4,252,833		236,259	238,289	子公司
\$	390,470	\$	390,470	35,497,273	27		321,120	(41,463)	(11,324)	被投資公司
	2,845,913		2,845,913	68,629,782	26		1,162,234		63,921	33,758	被投資公司
	_		520,490	-	=		_	(34,564)	55,288	子公司
	20,698,867		20,698,867	1,131,452,502	100		28,968,727		2,946,367	2,928,832	子公司
	20,836,477		20,836,477	1,112,236,706	99		43,122,309		2,776,807	2,593,352	子公司
	1,366,238		1,366,238	131,961,457	67		1,332,892	(10,222)	(6,860)	子公司
	765,000		618,097	76,500,000	51		670,550	(177,414)	(90,478)	被投資公司
	48,790,498		35,055,000	1,037,300,000	33		45,884,727		9,933,160	1,755,091	被投資公司
美金	59,882千元		_	98,489,803	22		1,820,329	(497,868)	(109,880)	被投資公司
\$	178,861		178,861	33,308,452	10		36,939	(236,048)	(40,991)	被投資公司
美金	188,000千元	美金	188,000千元	188,000,000	100		4,262,348		134,821	註2	子公司
美金	100,000千元	美金	100,000千元	100,000,000	100		3,149,846		86,379	註2	子公司
\$	372,504	\$	372,504	37,250,448	19		376,173	(10,222)	註2	子公司
	89,998		-	2,119,080	60		88,900	(4,978)	註2	子公司
	225,000		_	90,000,000	28		229,146	(236,048)	註2	被投資公司
美金	84,889干元	美金	84,889干元	11,148,000	10	美金	107,472干元	美金	67,360千元	註2	子公司
美金	168,643干元	美金	168,643干元	168,642,842	70	美金	346,087干元	美金	7,243千元	註2	子公司
美金	964,524千元	美金	964,524干元	98,276,087	90	美金	1,069,120千元	美金	67,360千元	註2	子公司
美金	30,200千元	美金	30,200千元	30,200,000	8	美金	42,050千元	美金	34,546千元	註2	子公司
美金	51,344千元	美金	51,344千元	170,000,006	100	美金	31,028千元	美金	92千元	註2	子公司
美金	25,606千元	美金	25,606千元	7,200	100	美金	75,082千元	美金	2,735千元	註2	子公司
美金	4,600千元	美金	4,600千元	1,000	100	美金	12,850千元	美金	830千元	註2	子公司
美金	190,000千元	美金	190,000千元	190,000,000	100	美金	354,732千元	美金	49,510千元	註2	子公司
美金	10千元	美金	10千元	10,000	100	美金	368干元	(美金	209干元)	註2	子公司
美金	10千元		10千元	10,000	100		198千元		164千元	註2	子公司
<u>Д</u>	.0178		.0178	10,000			130 170		.0.178	, pi	323
美金	160,000千元	美金	160,000千元	20,741,363	100	美金	494,454干元	美金	7,042千元	註2	子公司
美金	65,520千元	美金	65,520千元	71,428,902	100	美金	142,671干元	羊余	20,369千元	註2	子公司
美金	222,399千元		222,399千元	71,428,302	100		100,904千元		1,289千元	註2	子公司
美金	72,304千元		72,304千元	72,304,040	30	美金	148,323干元		7,243千元	註2	子公司
美金	55,815千元		55,815千元	30,100,000	100		153,333千元		37,752千元	註2	子公司
大亚	ا/ ۱ د ۱ ن,دد		JJ,01J /L	30,100,000	100	マ皿	۱۱۱۱ دودادد ۱	<u>~π</u>	J1,1J4 7L	PÍZ	2 전략

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目
ASE Test Holdings, Ltd.	ISE Labs, Inc.	美國	半導體產品測試服務
ASE Holdings (Singapore) Pte Ltd	ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	馬來西亞	各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售
Omniquest Industrial Limited	ASE Corporation	開曼群島	從事專業性投資活動
ASE Corporation	ASE Mauritius Inc.	模里西斯	從事專業性投資活動
	ASE Labuan Inc.	馬來西亞	從事專業性投資活動
ASE Labuan Inc.	日月光電子公司	台灣	電子材料批發業、電子材料零售業及國際貿易業
Innosource Limited	Omniquest Industrial Limited	英屬維京群島	從事專業性投資活動
日月光半導體(上海)有限 公司	日月光半導體(香港)有限公司	香港	從事貿易相關業務活動
環電公司	Huntington Holdings International Co. Ltd.	英屬維京群島	控股公司
Huntington Holdings	Unitech Holdings International Co. Ltd.	英屬維京群島	控股公司
International Co. Ltd.	Real Tech Holdings Limited	英屬維京群島	控股公司
	Universal ABIT Holding Co., Ltd.	開曼群島	控股公司
	Rising Capital Investment Limited	英屬維京群島	控股公司
	Rise Accord Limited	英屬維京群島	控股公司
Real Tech Holdings Limited	USI Enterprise Limited	香港	投資諮詢服務及倉儲管理服務
環旭電子公司	Universal Global Technology Co., Limited	香港	控股公司
Universal Global	環旭科技有限公司	香港	貿易及投資控股公司
Technology Co., Limited	環鴻科技公司	台灣	有線通信機械器材、無線通信機械器材、電子零組件、電腦及其週邊設備、 汽車及其零件製造業、產品設計業及研究發展服務業
	USI Japan Co., Ltd	日本	 電腦資訊之週邊設備、積體電路、電子零件等之製造買賣
	Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V.	墨西哥	主機板及電腦系統組裝
	USI America Inc.	美國	新型主機板組裝與製作、無線通訊產品製作、維修服務
環旭科技有限公司	Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V.	墨西哥	主機板及電腦系統組裝
環鴻科技公司	環隆電氣公司	台灣	從事各種電腦及週邊設備之製造、加工維修及銷售

註1:本期認列之投資(損)益業已考量公司間交易之未實現損益之影響數。 註2:該被投資公司之損益業已包含於其投資公司,為避免混淆,於此不再另行表達。

		資金額	Į		 年底持有			被		本年度認列之	
	本年年底			股數	比率		 帳面金額	1	年度(損)益	投資(損)益(註1)	備註
美金	221,145千元		221,145千元	26,250,000	100	美金	100,903千元	美金	1,289千元	註2	子公司
美金	60,000千元	美金	60,000千元	159,715,000	100	美金	142,671干元	美金	20,369千元	註2	子公司
美金	352,784干元	美金	352,784干元	352,784,067	100	美金	494,322千元	美金	34,635干元	註2	子公司
美金	217,800千元	美金	217,800千元	217,800,000	100	美金	366,601干元	美金	26,005千元	註2	子公司
美金	126,184干元	美金	126,184干元	126,184,067	100	美金	127,670千元	美金	8,688千元	註2	子公司
美金	125,813千元	美金	125,813千元	398,981,900	100	美金	127,103干元	美金	8,697千元	註2	子公司
美金	74,000干元	美金	74,000干元	74,000,000	21	美金	103,074干元	美金	34,546干元	註2	子公司
美金	1,000千元	美金	1,000千元	-	100	美金	9,145千元	美金	8千元	註2	子公司
\$	8,370,606	\$	8,370,606	255,856,840	100	\$	44,037,750	\$	2,872,792	註2	子公司
美金	3,000干元	美金	3,000干元	3,000,000	100	美金	7,487干元	(美金	16千元)	註2	子公司
美金	149,151干元	美金	149,151干元	149,151,000	100	美金	1,297,865千元	美金	93,782千元	註2	子公司
美金	28,125干元	美金	28,125千元	90,000,000	100	美金	13千元	美金	-千元	註2	子公司
美金	6,000干元	美金	6,000干元	6,000,000	100	美金	1,140干元	美金	4干元	註2	子公司
美金	2,000千元	美金	2,000千元	20,000	100	美金	63干元	(美金	87千元)	註2	子公司
美金	210,900千元	美金	210,900千元	210,900,000	98	美金	1,225,980千元	美金	94,764干元	註2	子公司
人民幣	烙662,390干元	人民幣	岑 324,185干元	777,716,500	100	人民幣	将 2,200,741干元	人民幣	325,744千元	註2	子公司
美金	11,000干元	美金	11,000干元	85,800,000	100	美金	20,164千元	美金	1,531干元	註2	子公司
美金	62,235千元	美金	30,400千元	198,000,000	100	美金	137,978千元	美金	13,833千元	註2	子公司
美金	885千元	美金	885干元	6,400	100	美金	803干元	美金	27千元	註2	子公司
美金	23,963干元	美金	23,963干元	281,085,325		美金	44,532千元		2,801千元	註2	子公司
美金	9,500干元	美余	9,500干元	250,000	100	美金	6,274干元	美余	909干元	註2	子公司
				230,000	130				303170	μ	
美金	-千元	美金	-千元	1	_	美金	-千元	美金	2,801千元	註2	子公司
\$	792,064	\$		39,603,222	99	\$	1,000,490	\$	329,003	註2	子公司

大陸投資資訊

民國105年1月1日至12月31日 附表九

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	看	軍收資本額	投資方式		年年初自台灣	本年度匯出	3X4XI	1)父貝亚积
NIIINAAA SIIII				32,324	進出	出累積投資金額	匯出		收回
3月光半導體(上海)有限公司	從事半導體材料製造業務	\$	4,349,312	註1(1)	\$	4,398,576	\$ _	- \$	
		(美金	148,496干元)		(美金	137,800千元)			
			(註12)						
3月光半導體(昆山)有限公司	從事半導體材料製造及半		8,350,204	註1(2)		8,350,204	=	_	
	導體產品之封裝測試業	(美金	268,000千元)	DI 1(2)	(美金	268,000千元)			
	務	()<112	200,000 1 707		()<	(註10)			
	5,5					(1-2-1-7)			
3月光電子元器件(上海)有限	從事新型電子元器件產銷		_	註2		383,640	-	-	
公司	及提供技術諮詢服務	(美金	-千元)		(美金	12,000千元)			
			(註12)						
3月光封裝測試(上海)有限公司	半導體產品封裝及測試業務		6,501,336	註1(3)		5,792,530	_	-	
		(美金	203,580千元)		(美金	180,000千元)			
蘇州日月新半導體有限公司	從事半導體封裝測試及技		1,568,467	註1(4)		711,180	_		
林州口户和干等腹户限公司	術諮詢服務等業務	(美金	48,672千元)	EI (4)	(美金	21,600千元)			
	(사업 수도 (사업 기타 타기 타기	124	40,072 76/		(×w	21,000 76/			
3月光半導體(威海)有限公司	一般類之分離式元器件封		4,507,081	註1(5)		1,295,307	-	-	
	裝及測試業務	(美金	152,200千元)		(美金	40,000千元)			
				=					
上海鼎匯房地產開發有限公司	房地產項目開發、建設及	/ 1 🗆 🕾	16,345,070 3,600,000千元)	註2			_		
	商品房銷售物業管理	八氏常	\$ 3,600,000 T /L)			(註2)			
上海鼎威房地產開發有限公司	房地產項目開發、建設及		6,908,089	註2		-	-	-	
	商品房銷售物業管理	(人民幣	3 1,548,000干元)			(註2)			
上海鼎裕房地產開發有限公司	房地產項目開發、建設及		4,936,538	註2		-	_	-	
	商品房銷售物業管理	(人民幣	图 1,100,000千元)			(註2)			
昆山鼎泓房地產開發有限公司	房地產項目開發、建設及		3,139,662	註2		-	-	-	
	商品房銷售物業管理	(人民幣	670,000千元)			(註2)			
昆山鼎悦房地產開發有限公司	房地產項目開發、建設及		1,546,415	註2		-	_	-	
	商品房銷售物業管理	(人民幣	330,000千元)			(註2)			

單位:新台幣干元(除另予註明者外)

								單位:	: 新台幣干元(除另予註明者外)
	F年底自台灣 累積投資金額		投資公司 年度(損)益	本公司直接或間接 投資之持股比例(%)	本年度記	忍列投資(損)益	年底:	投資帳面價值	截至本年年底 已匯回投資收益
\$	4,398,576	\$	800,407	100	\$	800,407	\$	10,881,393	無
(美金	137,800千元)	(美金	24,619千元)		(美金	24,619千元)	(美金	337,408千元)	
			(註5)			(註5)			
	8,350,204		192,308	100		192,308		6,078,455	無
(美金	268,000千元)	(美金	6,028千元)		(美金	6,028千元)	(美金	188,479千元)	
			(註4)			(註4)			
	383,640	(7,761)	100	(7,761)		36,206	無
(美金	12,000千元)	(美金	-247千元)		(美金	-247千元)	(美金	1,123干元)	
			(註5)			(註5)			
	5,792,530		1,607,317	100		1,607,317		11,555,401	無
(美金	180,000千元)	(美金	49,737千元)		(美金	49,737千元)	(美金	358,307千元)	
			(註4)			(註4)			
	711,180		799,903	60		479,942		2,701,718	無
(美金	21,600千元)	(美金	24,982千元)		(美金	14,989千元)	(美金	83,774千元)	
			(註5)			(註5)			
	1,295,307	(37,897)	100	(37,897)		1,553,737	無
(美金	40,000千元)	(美金	-1,111千元)		(美金	-1,111千元)	(美金	48,178干元)	
			(註5)			(註5)			
	-		1,080,928	100		996,445		19,213,957	無
	(喜主2)	(人民幣	219,059千元)		(人民幣	202,315千元)	(人民幣	4,132,937千元)	
			(註5)			(註5)			
	-	(34,119)	100	(34,119)		7,094,585	無
	(註2)	(人民幣	-7,050千元)		(人民幣	-7,050千元)	(人民幣	1,526,051千元)	
			(註5)			(註5)			
	_	(14,746)	100	(14,746)		5,107,770	無
	(註2)	(人民幣	-2,952干元)		(人民幣	-2,952干元)	(人民幣	1,098,685干元)	
			(註5)			(註5)			
	_		92,806	100		92,806		3,203,426	無
	(葦主2)	(人民幣	20,237千元)		(人民幣	20,237千元)	(人民幣	689,059千元)	
			(註5)			(註5)			
	_	(107)	100	(107)		1,532,824	無
	(註2)	(人民幣	-21千元)		(人民幣	-21千元)	(人民幣	329,712千元)	
			(註5)			(註5)			

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實	收資本額	投資方式	本往	年年初自台灣	本年度匯	出或收	回投資金額
八座似汉真公司古悟	工女呂木坝口	貝	以 員中說	及員乃以	匯出	累積投資金額	匯出		收回
日月光集成電路製造(中國) 有限公司	從事半導體封裝測試、售 後服務、諮詢及廠房出 租	(美金	3,149,000 100,000干元)	註1(6)	(美金	3,149,000 100,000千元)	\$	- \$	
日月光投資(昆山)有限公司	從事投資控股業務	(美金	3,717,318 122,000千元)	註1(7)	(美金	3,717,318 122,000干元) (註10)		-	
無錫通芝微電子有限公司	半導體產品封裝及測試業務	(人民幣	356,682 73,461干元)	註2		— (註2)		-	
日月光貿易(上海)有限公司	從事貨物及技術進出口等 業務	(人民幣	2,566 500千元)	註2		— (註2)		-	
上海鼎祺物業管理有限公司	物業管理、房地產經紀等業務	(人民幣	5,078 1,000干元)	註2		— (註2)		-	
上海鼎凡百貨有限公司	百貨貿易等業務	(人民幣	7,199 1,500干元)	註2		— (註2)		-	
環勝電子(深圳)有限公司	生產經營電腦主機板、其 他相關電腦周邊設備及 通訊工業控制等產品之 設計、製造及銷售	美金	2,270,625 75,000千元)	註1(8)		1,180,746		_	
環旭電子公司	提供電子產品設計製造服 務,生產及加工新型電 子元器件、計算機高性 能主機板、無線網路通 信元器件等	(人民幣)	10,649,110 2,175,924干元)	註1(8)		1,668,233		_	
環銓電子(昆山)有限公司	生產計算機輔助系統及高 性能主板、無線網路通 訊卡等	(美金	383,201 12,000千元)	註1(8)		383,201		-	
雲電貿易(上海)有限公司	電子產品及通訊產品批發	美金	147,450 5,000干元)	註1(9)		147,450		-	
矽翔微機電系統(上海)有限 公司	氣體流量暨感測器之製造 及批發零售	(美金	227,063 7,500千元)	註3		3,035		-	
環鴻電子(昆山)有限公司	提供電子產品設計及製造服務	(人民幣	1,202,223 250,000千元)	註2		— (註2)		-	

	F年底自台灣 累積投資金額		投資公司 丰度(損)益	本公司直接或間接 投資之持股比例(%)	本年度認	忍列投資(損)益	年底接	设資帳面價値		至本年年底 重回投資收益
\$	3,149,000	\$	86,378	100	\$	86,378	\$	3,149,723		無
(美金	100,000干元)	(美金	2,717干元)		(美金	2,717千元)	(美金	97,666干元)		
			(註4)			(註4)				
	3,717,318		87,455	100		87,455		2,765,225		無
(美金	122,000千元)	(美金	2,741干元)		(美金	2,741千元)	(美金	85,743干元)		
			(註4)			(註4)				
	_		21,647	100		21,647		439,081		無
	(註2)	(人民幣	4,442千元)		(人民幣	4,442千元)	(人民幣	94,447千元)		
			(註4)			(言主4)				
	-	(57)	100	(57)		2,041		無
	(註2)	(人民幣	-12干元)		(人民幣	-12千元)	(人民幣	439千元)		
			(註4)			(言主4)				
	-	(9,111)	100	(9,111)	(7,324)		無
	(註2)	(人民幣	-1,897千元)		(人民幣	-1,897千元)	(人民幣	-1,575千元)		
			(註5)			(註5)				
	-	(22)	100	(22)		6,952		無
	(註2)	(人民幣	-5干元)		(人民幣	-5千元)	(人民幣	1,495干元)		
			(註5)			(註5)				
	1,180,746		2,348,392	76		1,809,287		7,550,536	\$	1,196,256
		(人民幣	483,666干元)		(美金	56,155干元)	(美金	234,125干元)	(美金	41,243干元)
			(註6)			(註6)				
	1,668,233	/羊仝	3,898,364	76	(羊会	2,959,139 91,843千元)		26,670,665 826,997千元)	(羊会	349,290
		(美金	120,996干元)		(美金	(註6)	(美壶	826,997十元)	(美壶	10,955干元)
			(BLU)			(610)				
	383,201		13,829	99		13,714		331,527		無
		(美金	429千元)		(美金	426千元)	(美金	10,280千元)		
			(註6)			(註6)				
	147,450		_	_		-		-		無
								(註11)		
	3,035		_	-		-		-		無
			740,833	76		574,756		2,170,542		無
		(人民幣	152,579千元)	70	(人民幣	118,452干元)		466,885千元)		7111
	(PTZ)	V (10 m)	(註6)		V (1/m	(註6)	IV VEVIN	-00,000 7b/		
			(57.0)			(010)				

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	東 山	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	投資方式	本年年初自台灣	本年度匯出或	似中世紀
人陸恢复其公司右伸	土安宮未坝日	貝収	人具中部	投 負刀式	匯出累積投資金額	匯出	收回
環維電子(上海)有限公司	電子產品的研發及製造,	\$	6,652,140	註2	\$ -	\$ -	\$ -
	新型電子元器件、計算	(人民幣 1,	330,000千元)		(註2)		
	機高性能主機板、無線						
	網絡通信元器件、移						
	動通信產品及模塊、零						
	配件的加工及維修,電						
	子產品、通訊產品及零						
	配件的銷售,第三方物						
	流服務,從事貨物及技						
	術的進出口業務						
環豪電子(上海)有限公司	電子元器件、計算機軟硬		240,850	註2	_	=	_
	件、通訊設備及配件的	(人民幣	50,000千元)		(註2)		
	銷售,第三方物流服務						
	,從事貨物及技術的進						
	出口業務,轉口貿易,						
	區内企業間貿易及貿易						
	代理						

投資公司名稱		F年底累計自台灣匯出 上大陸地區投資金額	經	濟部投審會核准投資金額	Į	本公司赴大陸地區投資限額
本公司	\$	15,203,097	\$	16,790,306	(註9)	\$ 一 (註7
	(美金	471,400千元)	(美金	576,400千元)		
台灣福雷電子公司		8,878,838		8,878,838		17,659,472 (註8
	(美金	288,000千元)	(美金	288,000千元)		
環電公司		3,382,665		32,402,340		- (註7
			(美金	1,027,236千元)		

- 註1:透過第三地區再投資大陸公司,第三地區之投資公司如下:
 - (1) ASE Mauritius Inc. $^{\circ}$ ASE Corporation $^{\circ}$ Omniquest Industrial Limited $^{\circ}$ Innosource Limited $^{\circ}$ J&R Holding Limited $^{\circ}$
 - (2) ASE Mauritius Inc. Alto Enterprises Limited Innosource Limited ASE Corporation Omniquest Industrial Limited J&R Holding Limited ()
 - (3) Global Advanced Packaging Technology Ltd. $\,^{\backprime}$ J&R Holding Limited $^{\circ}$
 - (4) J&R Holding Limited \circ
 - (5) ASE (Korea) Inc. $^{\circ}$ ASE Test Limited $^{\circ}$ ASE Investment (Labuan) Inc. $^{\circ}$ ASE Holding Ltd. $^{\circ}$ J&R Holding Limited $^{\circ}$
 - (6) Super Zone Holdings Limited •
 - (7) Alto Enterprises Limited •
 - (8) Real Tech Holdings Limited \circ Huntington Holdings International Co. Ltd. \circ
 - (9) Rise Capital Investment Limited and Huntington Holdings International Co. Ltd. •
- 註2:係由大陸地區現有公司再投資。
- 註3:係由本公司之子公司Unitech Holdings International Co. Ltd.公司投資備供出售金融資產Asia Global Venture Co., Ltd.以自有資產間接投資大陸公司Asia Golbal Venture Co., Ltd.公司2年10月處分矽翔微機電系統(上海)有限公司之股權,故截至105年12月31日止,Unitech Holdings International Co. Ltd.公司已無間接投資大陸公司。
- 註4: 依經台灣母公司簽證會計師查核或核閱之財務報表揭露。
- 註5:依經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核或核閱之財務報表揭露。
- 註6:依經台灣母公司簽證會計師所屬事務所之其他會計師查核或核閱之財務報表揭露。
- 註7:依經濟部投審會規定,本公司赴大陸地區投資投資限額係依經濟部97年8月29日經審字第09704604680號令修正發布並自同年8月1日生效之「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」第參點,取得經經濟部工業局核發符合營連總部營業範圍證明文件並具跨國企業條件之公司,是以對大陸地區投資金額無上限之規定。
- 註8: 茲將台灣福雷電子公司赴大陸地區投資投資限額計算如下: \$29,432,453 * 60% = 17,659,472
- 註9:經濟部投審會核准投資金額與累計自台灣匯出投資金額之差額總計美金105,000千元;其中美金80,000千元,係由子公司ASE (Korea) Inc.直接匯出。另美金25,000千元亦由ASE (Korea) Inc.值予日月光半導體(威海)有限公司之價權轉作為股本。
- 註10:係同一筆資金由台灣福雷電子公司透過第三地區間接增資日月光投資(昆山)有限公司再轉增資日月光半導體(昆山)有限公司之投資金額。
- 註11:雲電貿易(上海)有限公司於102年12月完成清算。
- 註12:日月光半導體(上海)有限公司吸收合併日月光電子元器件(上海)有限公司,日月光電子元器件(上海)有限公司清算期間,由日月光半導體(上海)有限公司持股至吸收合併完成。

	I							
 本年年底自台灣 匯出累積投資金額		投資公司 年度(損)益	本公司直接或間接 投資之持股比例(%)	本年度認	忍列投資(損)益	年底抽	投資帳面價値	截至本年年底 已匯回投資收益
\$ =	(\$	589,959)	76	(\$	453,668)	\$	2,152,382	無
(註2)	(人民幣	-121,506干元)		(人民幣	-93,497千元)	(人民幣	462,979千元)	
		(註6)			(註6)			
_		6,095	76		4,687		190,241	無
	/ L D ##5		76	/ L 🖵 👑		/ L 🖵 👑		////
(註2)	(人民幣	1,255千元)		(人民幣	966千元)	(人民幣	40,921千元)	
		(註6)			(註6)			

母子公司間業務關係及重要交易往來情形

民國105年1月1日至12月31日 附表十

編號	交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係
0	本公司	台灣福雷電子公司	母公司對子公司
			母公司對子公司
			母公司對子公司
			母公司對子公司
		環隆電氣公司	母公司對子公司
			母公司對子公司
		日月光半導體(上海)有限公司	母公司對子公司
			母公司對子公司
		ASE (U.S.) Inc.	母公司對子公司
		ASE Japan Co., Ltd.	母公司對子公司
		日月光電子公司	母公司對子公司
			母公司對子公司
			母公司對子公司
		ISE Labs,Inc.	母公司對子公司
		J & R Holding Limited	母公司對子公司
		Omniquest Industrial Limited	母公司對子公司
		ASE Labuan Inc.	母公司對子公司
		ASE Test Limited	母公司對子公司
		Global Advanced Packaging Technology Limited	母公司對子公司
		ASE Investment (Labuan) Inc.	母公司對子公司
		日月瑞公司	母公司對子公司
		ASE (Korea) Inc.	母公司對子公司
		Huntington Holdings International Co., Ltd.	母公司對子公司
		USI Enterprise Limited	母公司對子公司
		Real Tech Holdings Limited	母公司對子公司
		ASE Corporation	母公司對子公司
		A.S.E. Holding Limited	母公司對子公司
1	台灣福雷電子公司	本公司	子公司對母公司
		Omniquest Industrial Limited	子公司對子公司
2	ASE (U.S.) Inc.	ASE (Korea) Inc.	子公司對子公司
3	 日月光半導體(上海)有限公司	日月光封裝測試(上海)有限公司	子公司對子公司
		日月光半導體(香港)有限公司	子公司對子公司
			子公司對子公司
4	上海鼎匯房地產開發有限公司	昆山鼎泓房地產開發有限公司	子公司對子公司
5	ASE Investment (Labuan) Inc.	ASE Test Limited	子公司對子公司

單位:新台幣干元(除另予註明者外)

科目	金額(註)	交易條件	佔合併總營收或總資產之比率(%
	\$ 7,587,255	文勿除IT	2
出售固定資產	269,844		2
講置固定資產	1,252,950		_
營業成本	126,024	與一般廠商相當	_
悪 収帳款	1,702,509		_
營業収入	4,475,225	 與一般廠商相當	2
悪付帳款	510,991	Z ZZ Z	_
營業成本		 與一般廠商相當	1
營業費用	831,311	次	_
	,		
營業收入	107,254	與一般廠商相當	_
	514,799		_
其他應付款	315,727		_
營業成本	2,480,624	與一般廠商相當	1
營業收入	167,245		-
其他應付款	4,966,500		1
其他應付款	3,001,250		1
其他應付款	645,000		_
其他應付款	5,901,750		2
其他應付款	2,096,250		1
其他應付款	1,770,525		_
其他應付款	190,000		_
其他應付款	2,418,954		1
其他應付款	1,612,500		_
其他應付款	7,578,750		2
其他應付款	1,773,750		_
其他應付款	3,063,750		1
其他應付款	2,902,500		1
D A # F			
目金費用 + //b/第4/15 表現	173,865		_
其他應收款	1,550,000		_
營業收入	151,239		_
營業收入	182,476	與一般廠商相當	_
態收帳款	382,786		_
營業收入	1,566,836	與一般廠商相當	1
其他應收款	355,640		_
其他負債	487,111		_

6 A.S.E. Holding Limited ASE Test Limited 子公司對子公司 7 Omniquest Industrial Limited ASE Test Limited 子公司對子公司	
7. Opening set ladgetical Limited ACC Test Limited 7.公司戦了公司	
7 Offiniquest industrial Limited ASE lest Limited ラム可動子公司	
8 J & R Holding Limited Global Advanced Packaging 子公司對子公司 Technology Limited	
ASE Labuan Inc. 子公司對子公司	
Anstock Limited 子公司對子公司	
子公司對子公司	
ASE Test Limited 子公司對子公司	
ISE Labs, Inc. 子公司對子公司	
Anstock II Limited 子公司對子公司	
ASE Japan Co., Ltd. 子公司對子公司	
ASE Electronics (M) Sdn. Bhd. 子公司對子公司	
日月光封裝測試(上海)有限公司 子公司對子公司	
日月光半導體(威海)有限公司 子公司對子公司	
USI Enterprise Limited 子公司對子公司	
ASE Investment (Labuan) Inc. 子公司對子公司	
ASE Corporation 子公司對子公司	
9 Anstock II Limited J&R Holding Limited 子公司對子公司	
10 Global Advanced Packaging USI Enterprise Limited 子公司對子公司 Technology Limited	
11 日月光半導體(威海)有限公司 ASE (Korea) Inc. 子公司對子公司	
12 日月光電子公司 日月瑞公司 子公司對子公司	
環旭電子公司 子公司對子公司	
ASE Electronics (M) Sdn. Bhd. 子公司對子公司	
13 日月光封裝測試(上海)有限公 Anstock Limited 子公司對子公司	
司 子公司對子公司	
子公司對子公司	
上海鼎威房地產開發有限公司 子公司對子公司	
日月光半導體(香港)有限公司 子公司對子公司	
日月光電子公司 子公司對子公司	
14 環電公司 USI Enterprise Limited 子公司對子公司	
15 環旭電子公司 Universal Global Technology Co., 子公司對子公司	
Limited 子公司對子公司	
環維電子(上海)有限公司 子公司對子公司	
環旭科技有限公司 子公司對子公司	
環鴻電子(昆山)有限公司 子公司對子公司	
環勝電子(深圳)有限公司 子公司對子公司	
16 環旭科技有限公司 環勝電子(深圳)有限公司 子公司對子公司	
子公司對子公司	
子公司對子公司	

	A AT	交易往來情形(註)	
科目	金額(註)	交易條件	佔合併總營收或總資產之比率(%)
其他應付款	\$ 2,264,836		1
其他負債	1,461,604		_
其他資產	564,014		_
其他應收款	646,116		_
其他資產	1,274,994		_
其他應收款	585,484		_
其他負債	645,083		_
其他負債	1,484,010		_
其他應付款	9,638,220		3
其他應付款	2,398,477		1
其他應付款	225,786		
其他應收款	556,634		_
其他應收款	1,520,658		_
其他應付款	1,294,620		_
其他資產	1,294,642		_
其他資產	3,076,321		1
利息收入	238,330		_
	,		
其他應付款	2,096,587		1
其他應付款	1,292,075		_
其他應付款	190,000		_
營業收入	230,243	與一般廠商相當	_
營業收入	466,944	與一般廠商相當	_
其他應付款	673,109		_
其他負債	1,171,544		_
利息費用	120,408		_
其他應收款	465,494		_
營業成本	211,167		_
營業成本	163,924		_
其他應付款	1,935,000		1
營業成本	4,018,281		1
應付帳款	900,174		_
其他應收款	465,759		_
營業收入	300,703		_
營業收入	131,778		_
營業收入	174,334		_
營業收入	2,983,935		1
營業成本	12,765,779		5
應收帳款	678,554		_

編號	交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係
			子公司對子公司
		環鴻科技公司	子公司對子公司
			子公司對子公司
		環鴻電子(昆山)有限公司	子公司對子公司
			子公司對子公司
			子公司對子公司
17	Universal Global Technology	環鴻電子(昆山)有限公司	子公司對子公司
	Co., Limited		子公司對子公司
		環維電子(上海)有限公司	子公司對子公司
		環勝電子(深圳)有限公司	子公司對子公司
		USI America Inc.	子公司對子公司
18	環鴻科技公司	環勝電子(深圳)有限公司	子公司對子公司
		環旭電子公司	子公司對子公司
		環隆電氣公司	子公司對子公司
			子公司對子公司
19	環勝電子(深圳)有限公司	環維電子(上海)有限公司	子公司對子公司
20	環鴻電子(昆山)有限公司	環維電子(上海)有限公司	子公司對子公司
21	環維電子(上海)有限公司	環旭電子公司	子公司對子公司

註:已於編製合併報告時沖銷。

交易往來情形(註)										
科目	金額(註)	交易條件	佔合併總營收或總資產之比率(%)							
應付帳款	\$ 2,934,929		1							
營業收入	15,728,562		6							
應收帳款	3,778,579		1							
營業收入	256,737		_							
營業成本	6,189,786		2							
應付帳款	1,638,320		-							
營業收入	3,154,743		1							
應收帳款	901,453		_							
營業收入	140,832		_							
其他應付款	967,500		_							
營業費用	117,905		-							
營業收入	155,660		_							
營業收入	225,600		_							
營業收入	878,092		_							
應收帳款	399,994		-							
其他應收款	1,467,405		_							
其他應收款	232,573		_							
營業收入	145,707		_							

本公司依修正後之證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)認可之2013年版國際財務報導準則(IFRS)、國際會計準則(IAS)、解釋(IFRIC)及解釋公告(SIC)(以下簡稱Taiwan IFRS)編製合併財務報告並向台灣金管會證券期貨局申報。另本公司依國際會計準則理事會發布之IFRS、IAS、IFRIC及SIC(以下簡稱IFRS)編製自結合併財務報告並向美國證券管理委員會申報。

本公司適用Taiwan IFRS及IFRS編製之合併財務報告,其差異項目主係未分配盈餘加徵10%營利事業所得稅之認列時點不同所致。

詳細調節内容請參考本公司向美國證管會申報之2016英文年報(20-F)

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1122411/000095010317003702/0000950103-17-03702-index.htm

單位:新台幣仟元

差異調節項目	Taiwan IFRS	IFRS
(1)歸屬於本公司業主之合併淨利	21,680,339	21,361,606
(2)歸屬於非控制權益之合併淨利	1,269,560	1,272,691
(3)歸屬於本公司業主之綜合損益總額	14,312,892	13,994,159
(4)歸屬於非控制權益之綜合損益總額	677,748	680,879
(5)基本每股盈餘(元)	2.83	2.79
(6)稀釋每股盈餘(元)	2.37	2.33
(7)資產總額	357,943,079	357,951,176
(8)負債總額	188,595,703	191,089,411
(9)非控制權益	11,992,170	11,983,968
(10)歸屬於本公司業主之權益	157,355,206	154,877,797

五、最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告:

會計師查核報告

日月光半導體製造股份有限公司 公鑒:

香核意見

日月光半導體製造股份有限公司(以下稱「日月光公司」)民國105年及104年12月31日之個體資產負債表,暨民國105及104年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表,以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段),上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製,足以允當表達日月光公司民國105年及104年12月31日之個體財務狀況,暨民國105及104年1月1日至12月31日之個體財務績效及個體現金流量。

香核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範,與日月光公司保持超然獨立,並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據,以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對日月光公司民國105年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已 於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應,本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對日月光公司民國105年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下:

投資子公司成本超過可辨認淨資產公允價值其減損之評估

日月光公司於民國105年12月31日採用權益法之投資子公司計新台幣(以下同)151,731,955千元,占總資產約48%。日月光公司取得該等子公司成本超過於取得日所享有其可辨認淨資產公允價值計10,558,878千元(子公司商譽)。該子公司商譽係包含於該投資之帳面金額且不得攤銷,管理階層依照國際會計準則公報第36號「資產減損」規定每年底進行子公司商譽減損測試,即比較包含受攤子公司商譽之現金產生單位其帳面價值是否有重大超過其可回收金額之情形。

上述子公司商譽主要來自測試產業之子公司,管理階層於評估估計包含受攤子公司商譽之現金產生單位可回收金額係以使用價值為計算基礎。為計算使用價值,公司需估計未來5年現金流量及以持平之成長率1.5%外推其後之現金流量,並使用加權平均資金成本率予以折現計算而得。由於該等假設涉及管理階層之主觀判斷,且可能受未來半導體測試產業市場景氣影響,具有估計之高度不確定性。因是,將日月光公司對測試產業子公司投資中商譽之減損評估考量為本年度關鍵查核事項之一。

採用權益法之投資中商譽之減損評估相關揭露資訊,請參閱個體財務報告附註四(六)、五及十一。

本會計師針對管理階層評估子公司商譽是否減損時,所估計之未來營運現金流量及加權平均資金成本率使用之重大會計判斷、估計及假設,執行主要查核程序如下:

- 詢問並檢視相關文件,以了解管理階層估計測試產業子公司未來營運展望所預測之營收成長率、利潤率及預估現金流量 之過程及依據。
- 2. 計算以前年度營收估列與實際達成情形、比較管理階層估列之未來營收成長率與相關產業預測報告之差異,以評估管理 階層估計之未來營收成長率是否合理。
- 3. 採用本所財務顧問專家以協助評估管理階層於估計使用價值時所採用之加權平均資金成本率,包括無風險報酬利率、波動性及風險溢酬該等假設,是否與公司現行及所屬產業情況相符,並重新執行與驗算。
- 4. 針對重要假設,包括營收成長率及加權平均資金成本率,查詢管理階層執行敏感度分析之流程及文件資料並重新計算, 以評估該等重要假設之變動是否有相當可能使測試產業子公司之帳面價值重大超過其可回收金額。

取得重大之關聯企業其無形資產之辨認及評價

日月光公司陸續取得矽品精密工業公司(矽品)共33.29%股權,計48,790,498千元;民國105年12月31日對矽品採用權益法 之投資餘額為45,884,727千元,占資產總額15%,對整體個體財務報告係屬重大。管理階層依據國際財務報導準則規定, 於收購日起一年內完成投資成本與所享有矽品可辨認資產及負債之淨公允價值份額間差額之辨識。

管理階層於辨識投資成本與所享有矽品可辨認資產及負債之淨公允價值份額間差額,需評估有形資產之公允價值、可能產生之無形資產類型及該等無形資產未來可能產生之營運現金流量或節省之費用支出等。由於該等假設涉及管理階層之主觀判斷,可能受未來半導體產業景氣之影響,具有高度不確定性,且該等無形資產依照估計經濟效益年限攤銷會影響日月光公司採用權益法認列關聯企業損益之份額。因是,本會計師考量上述差額辨識過程中有關無形資產之辨認及評價為關鍵查核事項之一。

與投資矽品相關會計政策、會計估計及假設之不確定性估計與攸關揭露資訊,請參閱附註四(七)、五及十一。

本會計師除了解管理階層辨認及評價無形資產之過程外,尚執行之主要查核程序如下:

- 1. 針對管理階層於辨認及評價無形資產過程中所使用之外部評價專家,詢問並評估其專業能力、適任能力及客觀性。
- 2. 採用本所財務顧問專家執行攸關程序以評估管理階層所使用之外部評價專家出具之收購價格分攤報告内所辨認出矽品應有之無形資產項目、使用之評價方法與所採用假設(包括未來營業收入、折現率及估計耐用年限),及評價模型計算過程與結果之合理性。
- 3. 評估所辨識出無形資產之耐用年限衡量依據並核算本年度採用權益法認列關聯企業綜合損益之份額其調整數之允當性, 並查核個體財務報告是否依循國際財務報導準則規範已適當調整以前年度比較報表及揭露相關資訊。

其他事項

列入上開個體財務報告中,有關採用權益法之被投資公司矽品之合併財務報告係由其他會計師查核。因此,本會計師對上開個體財務報告出具之查核報告中,有關矽品合併財務報告所列金額及揭露資訊,係依據其他會計師之查核報告。民國105年及104年12月31日對矽品採用權益法之投資餘額分別為45,884,727千元及35,141,701千元,占資產總額分別為15%及11%:民國105及104年度對矽品採用權益法認列關聯企業損益之份額分別為1,755,091千元及129,580千元,占各年度淨利分別為8%及1%。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告,且維持與個體財務報告編製有關之必要内部控制,以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時,管理階層之責任亦包括評估日月光公司繼續經營之能力、相關事項之揭露、以及繼續經營會計基礎之採用,除非管理階層意圖清算日月光公司或停止營業,或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

日月光公司之治理單位(審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的,係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信,並 出具查核報告。合理確信係高度確信,惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重 大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所 作之經濟決策,則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時,運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作:

- 1. 辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所評估之風險設計及執行適當之因應對策;並取得 足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或逾越内部控制,故 未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2. 對於查核攸關之内部控制取得必要之了解,以設計當時情況下適當之查核程序,惟其目的非對日月光公司内部控制之有效性表示意見。
- 3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4. 依據所取得之查核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性,以及使日月光公司繼續經營之能力可能產生重大

疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性,作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性,則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露,或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致日月光公司不再具有繼續經營之能力。

- 5. 評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及内容,以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6. 對於日月光公司内組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對個體財務報告表示意見。本會計師負責日月光公司查核案件之指導、監督及執行,並負責形成日月光公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制 顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明, 並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對日月光公司民國105年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查 核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定 事項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公衆利益。

勤業衆信聯合會計師事務所

會計師 陳珍麗

陳珍麗



金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第1010028123號 證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第0920123784號

會計師 江佳玲





中華民國106年3月13日

民國105年及104年12月31日

		105年12月31	日	104年12月31日(
代碼	資產	 金額	%	金額	%	
	流動資產					
1100	現金(附註四及六)	\$ 3,159,351	1	\$ 8,533,346	3	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七)	600,946	_	1,503,196	1	
1170	應收帳款淨額(附註四及九)	17,825,948	6	14,030,441	5	
1180	應收帳款-關係人(附註二七)	1,760,150	1	2,281,805	1	
1200	其他應收款(附註四)	1,445,567	_	1,367,621	_	
1210	其他應收款-關係人(附註二七)	61,419	_	161,080	_	
1310	存貨(附註四及十)	4,666,009	2	3,769,108	1	
1479	其他流動資產	416,799	_	485,422	_	
11XX	流動資產合計	29,936,189	10	32,132,019	11	
	非流動資產					
1523	備供出售金融資產-非流動(附註四及八)	285,359	_	473,107	_	
1550	採用權益法之投資(附註四、五及十一)	201,327,705	64	189,712,813	62	
1600	不動產、廠房及設備(附註四、、十二、十九、二三、二七、及二九)	78,375,027	25	80,375,695	26	
1805	商譽(附註四及五)	958,620	_	958,620	1	
1821	其他無形資產(附註四、十三、十九、二三及二七)	1,020,259	1	655,689	_	
1840	遞延所得稅資產(附註四及二十)	812,546	_	906,821	_	
1980	其他金融資產-非流動(附註四及二八)	222,074	_	209,817	_	
1985	長期預付租金	13,155	_	80,887	_	
1990	其他非流動資產	83,983	_	156,113	_	
15XX	非流動資產合計	 283,098,728	90	273,529,562	89	

1XXX 資產總計 \$ 313,034,917 100 \$ 305,661,581 100

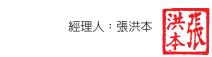
後附之附註係本個體財務報告之一部分。 (參閱勤業衆信聯合會計師事務所民國106年3月13日查核報告)

單位:新台幣干元

		105年12月3	104年12月31日(調整後)		
代碼	負債及股東權益	金額	%	金額	%
	流動負債				
2100	短期借款(附註十四)	\$ 4,192,500	1	\$ 11,231,973	4
2110	應付短期票券(附註十四)	_	_	4,348,054	1
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債 - 流動(附註四及七)	1,550,677	_	2,669,605	1
2170	應付帳款	7,994,777	3	6,801,383	2
2180	應付帳款-關係人(附註二七)	1,027,410	_	910,211	1
2200	其他應付款(附註十六及十七)	11,045,976	4	10,565,591	3
2220	其他應付款-關係人(附註二七)	46,303,141	15	40,191,954	13
2230	本期所得稅負債(附註四及二十)	1,582,327	1	1,685,349	1
2321	一年内到期之應付公司債(附註四及十五)	_	_	12,162,192	4
2322	一年内到期之長期借款(附註十四)	5,285,722	2	-	_
2399	其他流動負債	699,394	_	738,805	_
21XX	流動負債合計	79,681,924	26	91,305,117	30
	非流動負債				
2530	應付公司債(附註四及十五)	27,341,557	9	13,938,894	5
2540	長期借款(附註十四)	41,896,587	13	37,424,607	12
2570	遞延所得稅負債(附註四及二十)	3,740,806	1	3,774,152	1
2610	長期應付款-關係人(附註二七)	40,313	_	_	_
2640	浄確定福利負債(附註四、五及十七)	2,516,119	1	2,287,072	1
2670	其他非流動負債	462,405	_	297,092	_
25XX	非流動負債合計	75,997,787	24	57,721,817	19
2XXX	負債總計	155,679,711	50	149,026,934	49
	權益(附註四、十一及十八)				
	股本				
3110	普通股股本	79,364,735	25	79,029,290	26
3140	預収股本	203,305	_	156,370	_
3100	股本總計	79,568,040	25	79,185,660	26
3200	資本公積	22,265,049	7	23,757,099	8
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	14,597,032	5	12,649,145	4
3320	特別盈餘公積	3,353,938	1	3,353,938	_
3350	未分配盈餘	46,747,234	15	39,899,629	13
3300	保留盈餘總計	64,698,204	21	55,902,712	17
3400	其他權益	(1,883,574)	(1)	(5,081,689)	2
3500	庫藏股票	(7,292,513)	(2)	(7,292,513)	(2)
3XXX	權益總計	157,355,206	50	156,634,647	51
	負債及權益總計	\$ 313,034,917	100	\$ 305,661,581	100









民國105及104年1月1日至12月31日

單位:新台幣干元,惟每股盈餘為新台幣元

			105年度			104年度(調整後)			
代碼			金額	%		金額	%		
4000	營業收入(附註四)	\$	99,190,777	100	\$	94,206,807	100		
5000	營業成本(附註十及十九)		75,049,226	76	_	69,059,001	73		
5900	營業毛利		24,141,551	24		25,147,806	27		
	營業費用(附註十九)								
6100	推銷費用		1,154,570	1		1,100,826	1		
6200	管理費用		5,269,698	5		4,788,073	5		
6300	研究發展費用		5,645,973	6		5,366,121	6		
6000	營業費用合計		12,070,241	12		11,255,020	12		
6900	營業淨利		12,071,310	12		13,892,786	15		
	營業外收入及支出								
7010	其他收入(附註十九)		96,649	_		451,354	_		
7020	其他利益(附註十九)		943,785	1		722,437	1		
7050	財務成本(附註十九)	(1,676,157)	(2)	(1,166,632)	(1)		
7070	採用權益法認列子公司、關聯企業及合資損益份額(附註四)		12,305,543	12		8,252,050	9		
7000	營業外收入及支出合計		11,669,820	11		8,259,209	9		
7900	稅前淨利		23,741,130	23		22,151,995	24		
7950	所得稅費用(附註四及二十)		2,060,791	2		2,954,479	3		
8200	本年度淨利		21,680,339	21		19,197,516	21		
	其他綜合損益								
8310	不重分類至損益之項目								
8311	確定福利計畫精算之再衡量數(附註十七)	(364,628)	_		39,710	-		
8330	採用權益法認列子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額	(99,543)	-	(119,176)	-		
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		61,987	_	(6,751)	_		
8310		(402,184)		(86,217)	_		

			105年度			é)		
代碼		金額		%		金額		%
8360	· 後續可能重分類至損益之項目							
8362	備供出售金融資產未實現評價損失	(\$	63,777)		_	(\$	36,166)	_
8380	採用權益法認列子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額	(6,901,486)	(7)		49,316	
8360		(6,965,263)	(7)		13,150	_
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	(7,367,447)	(7)	(73,067)	
8500	本年度綜合損益總額	\$	14,312,892		14	\$	19,124,449	21
	每股盈餘(附註二一)							
9750	基本每股盈餘	\$	2.83			\$	2.51	
9850	稀釋每股盈餘	\$	2.37			\$	2.41	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。 (參閱勤業衆信聯合會計師事務所民國106年3月13日查核報告)

董事長:張虔生

經理人:張洪本

會計主管:郭宏銘



日月光半導體製造股份

個體權益變動表

民國105及104年1月1日至12月31日 普通股股本

	普通股股本						保留	盈餘	
代碼		股數(千股)	金額	•	資本公積		定盈餘公積	特別	 引盈餘公積
A1	104年1月1日餘額	7,861,725	\$ 78,715,179	\$	16,013,058	\$	10,289,878	\$	3,353,938
C5	發行可轉換公司債認列權益組成部分(附註 十八)		_		214,022		_		_
C7	採用權益法認列子公司、關聯企業及合資之變 動數	_	-		150		_		-
D1	104年度淨利(調整後)	_	_		_		_		_
D3	104年度稅後其他綜合損益								
D5	104年度綜合損益總額	_	-		_		_		_
	103年度盈餘指撥及分配								
В1	提列法定盈餘公積	_	_		_		2,359,267		_
B5	普通股現金股利	_	_		_		_		_
		_	_		_		2,359,267		_
L1	庫藏股買回	_	_		_		_		
M1	發放予子公司股利調整資本公積	_	_		292,351		_		_
M5	取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額(附註十一)		_		7,197,510		_		_
M7	對子公司所有權權益變動			(564,344)		_		
N1	股份基礎給付交易	48,703	470,481		604,352				
Z1	104年12月31日餘額(調整後)	7,910,428	79,185,660		23,757,099		12,649,145		3,353,938
C7	採用權益法認列子公司、關聯企業及合資之變 動數		_		51,959		_		_
D1	105年度淨利		_		-		-		_
D3	105年度稅後其他綜合損益	_	_		_		_		
D5	105年度綜合損益總額		_						
	104年度盈餘指撥及分配								
B1	提列法定盈餘公積	_	_		_		1,947,887		_
B5	普通股現金股利								
							1,947,887		
M1	發放予子公司股利調整資本公積				233,013				
M5	取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額(附註十一)	_	_	(20,552)				_
M7	對子公司所有權權益變動(附註十一)			(1,912,887)		_		_
N1	股份基礎給付交易	35,756	382,380		600,737		_		_
01	子公司員工認股權		_	(444,320)		_		_
Z1	105年12月31日餘額	7,946,184	\$ 79,568,040	\$	22,265,049	\$	14,597,032	\$	3,353,938

後附之附註係本個體財務報告之一部分。 (參閱勤業衆信聯合會計師事務所民國106年3月13日查核報告)

其他權益項目

				國	外營運機構								
	保留	盈餘		囙	務報表換算	備供	共出售金融資						
-	未分配盈餘		 合計	7	之兌換差額	產	末實現損益		合計		庫藏股票		權益總計
\$	38,737,422	\$	52,381,238	\$	4,541,761	\$	526,778	\$	5,068,539	(\$	1,959,107)	\$	150,218,907
													214,022
	_		_		_		_		_		_		150
	19,197,516		19,197,516		_		_		_				19,197,516
(86,217)	(86,217)	(48,191)		61,341		13,150		-	(73,067)
	19,111,299		19,111,299	(48,191)		61,341		13,150		_		19,124,449
(2,359,267)		-		_		-		-		-		-
(15,589,825)	(15,589,825)									(15,589,825)
(17,949,092)	(15,589,825)									(15,589,825)
										(5,333,406)	(5,333,406)
													292,351
													7 107 510
													7,197,510 564,344)
													1,074,833
	39,899,629	_	55,902,712		4,493,570		588,119		5,081,689	(7,292,513)		156,634,647
			33,302,712		4,433,370		300,113		3,001,003				150,054,047
	_		_		_		_				_		51,959
	21,680,339		21,680,339		_		_		_		_		21,680,339
(402,184)	(402,184)	(6,13	6,136,294)	((828,969)		6,965,263)			(7,367,447)
	21,278,155		21,278,155	(6,136,294)	(828,969)	(6,965,263)				14,312,892
(1,947,887)		_		_		-		_		_		_
(12,476,779)	(12,476,779)									(12,476,779)
(14,424,666)	(12,476,779)									(12,476,779)
													233,013
(5,884)	(5,884)		_		_		_		_	(26,436)
												(1,912,887)
													983,117
	_		_		_		_		_		_	(444,320)
\$	46,747,234	\$	64,698,204	(\$	1,642,724)	(\$	240,850)	(\$	1,883,574)	(\$	7,292,513)	\$	157,355,206









會計主管:郭宏銘



日月光半導體製造股份

個體現金流量表

民國105及104年1月1日至12月31日

單位:新台幣干元

代碼		105年度	104年度(調整後)
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 23,741,130	\$ 22,151,995
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	15,238,017	14,630,862
A20200	攤銷費用	193,110	139,065
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(415,956)	(2,089,130)
A20900	財務成本	1,676,157	1,166,632
A21900	股份基礎給付酬勞成本	209,106	89,768
A22400	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益份額	(12,305,543)	(8,252,050)
A23500	金融資產減損損失	90,000	=
A23700	非金融資產減損損失	1,131,267	374,201
A29900	其他項目	(415,069)	984,117
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31110	持有供交易之金融資產	2,025,990	3,407,552
A31150	應收帳款	(3,795,485)	2,443,202
A31160	應收帳款-關係人	521,655	2,800,618
A31180	其他應收款	(55,464)	14,924
A31190	其他應收款-關係人	2,748	(27,049)
A31200	存貨	(1,137,565)	279,328
A31240	其他流動資產	(35,877)	(47,362)
A32110	持有供交易之金融負債	(1,862,453)	(1,047,740)
A32150	應付帳款	1,193,394	(164,380)
A32160	應付帳款-關係人	117,199	(313,539)
A32180	其他應付款	615,344	(1,239,689)
A32190	其他應付款-關係人	275,018	9,176
A32230	其他流動負債	(13,125)	44,553
A32240	淨確定福利負債	(135,581)	(88,872)
A33000	營運產生之現金流入	26,858,017	35,266,182
A33200	收取之股利	6,644,388	456,044
A33300	支付之利息	(1,105,450)	(709,474)
A33500	支付之所得稅	(2,040,897)	(1,903,810)
AAAA	營業活動之淨現金流入	30,356,058	33,108,942
	投資活動之現金流量		
B00100	取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	(11,910,813)	(22,059,285)
B00200	處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	11,946,554	22,404,777
B00300	取得備供出售金融資產	=	(1,322)
B00400	處分備供出售金融資產價款	33,971	433,165
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(15,816,463)	(35,673,097)
B01900	處分採用權益法之長期股權投資	792,064	_
B02700	取得不動產、廠房及設備	(14,945,941)	(18,106,610)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	893,304	114,976
B04500	取得無形資產	(396,430)	(308,562)
B09900	其他投資活動	(649)	(18,842)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(29,404,403)	(53,214,800)

代碼		105年度	104年度(調整後)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款減少	(\$ 7,039,473)	(\$ 404,268)
C00500	應付短期票券增加(減少)	(4,348,054)	4,347,406
C01200	發行公司債	9,000,000	6,136,425
C01300	償還公司債	(8,000,000)	_
C01600	舉借長期借款	60,267,196	36,638,397
C01700	償還長期借款	(50,154,795)	(19,237,092)
C03700	其他應付款-關係人增加	5,583,400	9,431,152
C04500	發放現金股利	(12,476,779)	(15,589,825)
C04800	員工執行認股權	747,161	1,003,789
C04900	購買庫藏股票	_	(5,333,406)
C09900	其他籌資活動	95,694	392,109
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(6,325,650)	17,384,687
EEEE	本年度現金淨減少	(5,373,995)	(2,721,171)
E00100	年初現金餘額	8,533,346	11,254,517
E00200	年底現金餘額	\$ 3,159,351	\$ 8,533,346

後附之附註係本個體財務報告之一部分。 (參閱勤業衆信聯合會計師事務所民國106年3月13日查核報告)





會計主管:郭宏銘



日月光半導體製造股份有限公司

個體財務報告附註

民國105及104年1月1日至12月31日

(除另註明外, 金額以新台幣干元為單位)

一、公司沿革

日月光半導體製造股份有限公司(以下稱本公司或日月光)於73年3月設立於高雄楠梓加工出口區:93年8月吸收合併子公司日月欣半導體公司及日月宏科技公司並設立中壢分公司,95年8月將材料事業部分割讓與日月光電子公司(日月光電子):100年1月經核准設立南投分公司,已於106年1月廢止:101年5月吸收合併子公司日月鴻科技公司:102年8月吸收合併子公司洋鼎科技公司。本公司所營業務主要為各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售。

本公司股票於78年7月在台灣證券交易所掛牌上市買賣,股票代碼為2311:另於89年9月發行美國存託憑證(ADR)在紐約證券交易所掛牌上市,代號為ASX。

本個體財務報告係以本公司之功能性貨幣新台幣表達。

二、通過財務報告之日期及程序

本個體財務報告於106年3月13日經董事會通過後發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一) 尚未生效之證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會(以下稱「金管會」)認可將於106年適用之國際財務報導準則(IFRS)、國際會計準則(IAS)、解釋(IFRIC)及解釋公告(SIC)

依據金管會發布之金管證審字第1050050021號及金管證審字第1050026834號函,本公司將自106年度開始適用業經國際會計準則理事會(IASB)發布且經金管會認可106年適用之IFRS、IAS、IFRIC及SIC(以下稱「IFRSs」)及相關證券發行人財務報告編製準則修正規定。

新發布 /	修正 /	修訂準則及解釋
/ נוו אבווא		

	2014年7月1日或交易於2014年7月1日及以後
「2011~2013週期之年度改善」	2014年7月1日
「2012~2014週期之年度改善」	2016年1月1日(註2)
IFRS 10、IFRS 12及IAS 28之修正「投資個體:適用合併報表之例外規定」	2016年1月1日
IFRS 11之修正「聯合營運權益之取得」	2016年1月1日
IAS 1之修正「揭露倡議」	2016年1月1日
IAS 16及IAS 38之修正「可接受之折舊及攤銷方法之闡釋」	2016年1月1日
IAS 19之修正「確定福利計畫:員工提撥金」	2014年7月1日
IAS 36之修正「非金融資產可回收金額之揭露」	2014年1月1日
IAS 39之修正「衍生工具之約務更替與避險會計之持續適用」	2014年1月1日
IFRIC 21「公課」	2014年1月1日

註1:除另註明外,上述新發布/修正/修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度期間生效。

除下列說明外,適用上述修正後之證券發行人財務報告編製準則及106年適用之IFRSs規定將不致造成本公司會計政策之重大變動:

1. IAS 36之修正「非金融資產可回收金額之揭露」

IAS 36之修正係釐清本公司僅須於認列或迴轉資產或現金產生單位減損損失當期揭露其可回收金額。已認列或迴轉減損之不動產、廠房及設備之可回收金額若以公允價值減處分成本衡量,本公司將揭露公允價值層級,對屬第2或3等級公

註2:除IFRS 5之修正推延適用於2016年1月1日以後開始之年度期間外,其餘修正係追溯適用於2016年1月1日以後開始之年度期間。

允價值衡量,並將額外揭露衡量公允價值之評價技術及每一關鍵假設。若以現值法衡量公允價值減處分成本,須增加 揭露所採用之折現率。前述修正將於106年追溯適用。

2. 證券發行人財務報告編製準則之修正

該修正除配合106年適用之IFRSs新增若干會計項目及非金融資產減損揭露規定外,另配合國内實施IFRSs情形,強調若 干認列與衡量規定,並新增關係人交易及商譽等揭露。

該修正規定,其他公司或機構與本公司之董事長或總經理為同一人,或具有配偶或二親等以内關係者,除能證明不具控制或重大影響者外,係屬實質關係人。此外,該修正規定應揭露與本公司進行重大交易之關係人名稱及關係,若單一關係人交易金額或餘額達本公司各該項交易總額或餘額10%以上者,應按關係人名稱單獨列示。

此外,若被收購公司於合併後之實際營運情形與收購時之預期效益有重大差異者,該修正規定應附註揭露。

106年追溯適用前述修正時,將增加關係人交易及商譽減損之揭露。

(二) IASB已發布但尚未經金管會認可之IFRSs

本公司未適用下列業經IASB發布但未經金管會認可之IFRSs。截至本個體財務報告通過發布日止,除IFRS 9及IFRS 15應自 107年度開始適用外,金管會尚未發布其他準則生效日。

车袋本	/ 依正	/ 修訂準則及解釋
新砂竹	/ 11念IF	/1修引连则及畔矮

「2014~2016週期之年度改善」	註2
IFRS 2之修正「股份基礎給付交易之分類與衡量」	2018年1月1日
IFRS 9「金融工具」	2018年1月1日
IFRS 9及IFRS 7之修正「強制生效日及過渡揭露」	2018年1月1日
IFRS 10及IAS 28之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	未定
IFRS 15「客戶合約之收入」	2018年1月1日
IFRS 15之修正「IFRS 15之闡釋」	2018年1月1日
IFRS 16「租賃」	2019年1月1日
IAS 7之修正「揭露倡議」	2017年1月1日
IAS 12之修正「未實現損失之遞延所得稅資產之認列」	2017年1月1日
IAS 40之修正「投資性不動產之轉換」	2018年1月1日
IFRIC 22「外幣交易與預收付對價」	2018年1月1日

註1:除另註明外,上述新發布/修正/修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度期間生效。

1. IFRS 9「金融工具」

金融資產之認列及衡量

就金融資產方面,所有原屬於IAS 39「金融工具:認列與衡量」範圍内之金融資產後續衡量係以攤銷後成本衡量或以公允價值衡量。IFRS 9對金融資產之分類規定如下:

本公司投資之債務工具,若其合約現金流量完全為支付本金及流通在外本金金額之利息,分類及衡量如下:

- (1) 以收取合約現金流量為目的之經營模式而持有該金融資產,則該金融資產係以攤銷後成本衡量。此類金融資產後續係按有效利率認列利息收入於損益,並持續評估減損,減損損益認列於損益。
- (2) 藉由收取合約現金流量與出售金融資產而達成目的之經營模式而持有該金融資產,則該金融資產係以透過其他綜合 損益按公允價值衡量。此類金融資產後續係按有效利率認列利息收入於損益,並持續評估減損,減損損益與兌換損 益亦認列於損益,其他公允價值變動則認列於其他綜合損益。於該金融資產除列或重分類時,原先累積於其他綜合 損益之公允價值變動應重分類至損益。

本公司投資非屬前述條件之金融資產,係以公允價值衡量,公允價值變動認列於損益。惟本公司得選擇於原始認列 時,將非持有供交易之權益投資指定為透過其他綜合損益按公允價值衡量。此類金融資產除股利收益認列於損益外, 其他相關利益及損失係認列於其他綜合損益,後續無須評估減損,累積於其他綜合損益之公允價值變動亦不重分類至 損益。

註2:IFRS 12之修正係追溯適用於2017年1月1日以後開始之年度期間:IAS 28之修正係追溯適用於2018年1月1日以後開始之年度期間。

金融資產之減損

IFRS 9改採用「預期信用損失模式」認列金融資產之減損。以攤銷後成本衡量之金融資產、強制透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產、應收租賃款、IFRS 15「客戶合約之收入」產生之合約資產或放款承諾及財務保證合約,係認列備抵信用損失。若前述金融資產之信用風險自原始認列後並未顯著增加,則其備抵信用損失係按未來12個月之預期信用損失衡量。若前述金融資產之信用風險自原始認列後已顯著增加且非低信用風險,則其備抵信用損失係按剩餘存續期間之預期信用損失衡量。但未包括重大財務組成部分之應收帳款必須按存續期間之預期信用損失衡量備抵信用損失。

此外,原始認列時已有信用減損之金融資產,本公司考量原始認列時之預期信用損失以計算信用調整後之有效利率, 後續備抵信用損失則按後續預期信用損失累積變動數衡量。

一般避險會計

IFRS 9在一般避險會計之主要改變,係調整避險會計之適用條件,以使適用避險會計之財務報表更能反映企業實際進行的風險管理活動。與IAS 39相較,其主要修正内容包括:(1)增加可適用避險會計之交易型態,例如放寬非財務風險適用避險會計之條件;(2)修改避險衍生工具之損益認列方式,以減緩損益波動程度;及(3)避險有效性方面,以避險工具與被避險項目間的經濟關係取代實際有效性測試。

過渡規定

IFRS 9生效時,首次適用日前已除列之項目不得適用。金融資產之分類、衡量與減損應追溯適用,惟本公司無須重編比較期間,並將首次適用之累積影響數認列於首次適用日。一般避險會計應推延適用,惟避險選擇權之損益認列則須追溯適用。

2. IFRS 10及IAS 28之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」

該修正規定,若本公司出售或投入資產予關聯企業(或合資),或本公司喪失對子公司之控制,但保留對該子公司之重大 影響(或聯合控制),若前述資產或前子公司符合IFRS 3「業務」之定義時,本公司係全數認列該等交易產生之損益。

此外,若本公司出售或投入資產予關聯企業(或合資),或本公司在與關聯企業(或合資)之交易中喪失對子公司之控制,但保留對該子公司之重大影響(或聯合控制),若前述資產或前子公司不符合IFRS 3「業務」之定義時,本公司僅在與投資者對該等關聯企業(或合資)無關之權益範圍內認列該交易所產生之損益,亦即,屬本公司對該損益之份額者應予以銷除。

3. IFRS 15「客戶合約之收入」及相關修正

IFRS 15係規範來自客戶合約之收入認列原則,該準則將取代IAS 18「收入」、IAS 11「建造合約」及相關解釋。 本公司於適用IFRS 15時,係以下列步驟認列收入:

- (1) 辨認客戶合約;
- (2) 辨認合約中之履約義務;
- (3) 決定交易價格;
- (4) 將交易價格分攤至合約中之履約義務;及
- (5) 於滿足履約義務時認列收入。

於辨認履約義務時,IFRS 15及相關修正規定,若商品或勞務能被區分(例如,經常單獨銷售某一商品或勞務),且移轉商品或勞務之承諾依合約之內涵係可區分(亦即,合約承諾之性質係為個別移轉每一商品或勞務,而非移轉組合產出),則該商品或勞務係可區分。

IFRS 15及相關修正生效時,本公司得選擇追溯適用至比較期間或將首次適用之累積影響數認列於首次適用日。

4. IFRS 16「租賃」

IFRS 16係規範租賃之會計處理,該準則將取代IAS 17「租賃」及相關解釋。

於適用IFRS 16時,若本公司為承租人,除小額租賃及短期租賃得選擇採用類似IAS 17之營業租賃處理外,其他租賃皆應於個體資產負債表上認列使用權資產及租賃負債。個體綜合損益表應分別表達使用權資產之折舊費用及租賃負債按有效利息法所產生之利息費用。在個體現金流量表中,償付租賃負債之本金金額表達為籌資活動,支付利息部分則列

為營業活動。

對於本公司為出租人之會計處理預計無重大影響。

IFRS 16生效時,本公司得選擇追溯適用至比較期間或將首次適用之累積影響數認列於首次適用日。

除上述影響外,截至本個體財務報告通過發布日止,本公司仍持續評估其他準則、解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響,相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

(一) 遵循聲明

本個體財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則編製。

(二)編製基礎

除按公允價值衡量之金融工具外,本個體財務報告係依歷史成本基礎編製。

公允價值衡量依照相關輸入值之可觀察程度及重要性分為第1等級至第3等級:

- 1. 第1等級輸入值:係指於衡量日可取得之相同資產或負債於活絡市場之報價(未經調整)。
- 2. 第2等級輸入值:係指除第1等級之報價外,資產或負債直接(亦即價格)或間接(亦即由價格推導而得)之可觀察輸入值。
- 3. 第3等級輸入值:係指資產或負債之不可觀察之輸入值。

本公司於編製個體財務報告時,對投資子公司、關聯企業及合資係採權益法處理。為使本個體財務報告之本年度損益、其 他綜合損益及權益與本公司合併財務報告中歸屬於本公司業主之本年度損益、其他綜合損益及權益相同,個體基礎與合併 基礎下若干會計處理差異係調整「採用權益法之投資」、「採用權益法認列子公司、關聯企業及合資損益份額」、「採用 權益法認列子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額」暨相關權益項目。

(三) 資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括現金、主要為交易目的而持有之資產及預期於資產負債表日後12個月內實現之資產,但不包括於資產負債表日後逾12個月用以交換或清償負債而受有其他限制者。流動負債包括主要為交易目的而持有之負債、預期於資產負債表日後12個月內到期清償之負債,以及不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少12個月之負債。非屬上述流動資產或流動負債者,係分類為非流動資產或非流動負債。

(四) 外幣

本公司編製財務報告時,以本公司功能性貨幣以外之貨幣(外幣)交易者,依交易日匯率換算為功能性貨幣記錄。

外幣貨幣性項目於每一資產負債表日以收盤匯率換算。因交割貨幣性項目或換算貨幣性項目產生之兌換差額,於發生當年 度認列於損益。

以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目係以決定公允價值當日之匯率換算,所產生之兌換差額列為當年度損益,惟屬公允價值變動認列於其他綜合損益者,其產生之兌換差額列於其他綜合損益。

以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目係以交易日之匯率換算,不再重新換算。

於編製個體財務報告時,本公司國外營運機構(包含營運所在國家或使用之貨幣與本公司不同之子公司、關聯企業及合資) 之資產及負債以每一資產負債表日匯率換算為新台幣:收益及費損項目係以當年度各月份之平均匯率換算並累計,所產生 之兌換差額認列於其他綜合損益。

(五) 存貨

存貨包括原料(不包括受託加工之晶圓)、物料、在製品、製成品及在途原物料。存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量,比較成本與淨變現價值時除同類別存貨外係以個別項目為基礎。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投入及完成出售所需之估計成本後之餘額。原料及物料成本按移動平均法計價,在製品及製成品成本按標準成本計價。

(六) 投資子公司

本公司採用權益法處理對子公司之投資。子公司係指本公司具有控制之個體。

權益法下,投資原始依成本認列,取得日後帳面金額係隨本公司所享有之子公司損益及其他綜合損益份額與利潤分配而增減。此外,針對本公司可享有子公司其他權益之變動係按持股比例認列。

當本公司對子公司所有權權益之變動未導致喪失控制者,係作為權益交易處理。投資帳面金額與所支付或收取對價之公允價值間之差額,係直接認列為權益。

取得成本超過本公司於取得日所享有子公司可辨認資產及負債淨公允價值份額之數額列為商譽,該商譽係包含於該投資之帳面金額且不得攤銷;本公司於取得日所享有子公司可辨認資產及負債淨公允價值份額超過取得成本之數額列為當年度收益。

本公司與子公司之順流交易未實現損益於個體財務報告予以銷除。本公司與子公司之逆流及側流交易所產生之損益,僅在與本公司對子公司權益無關之範圍內,認列於個體財務報告。

(七) 投資關聯企業及合資

本公司對投資關聯企業及合資係採用權益法。

關聯企業係指本公司具有重大影響,但非屬子公司之企業。合資係指本公司與他公司具有聯合控制且對淨資產具有權利之 聯合協議。

權益法下,投資關聯企業及合資原始依成本認列,取得日後帳面金額係隨本公司所享有之關聯企業及合資損益及其他綜合損益份額與利潤分配而增減。此外,針對關聯企業權益及合資之變動係按持股比例認列。

取得成本超過本公司於取得日所享有關聯企業及合資可辨認資產及負債淨公允價值份額之數額列為商譽,該商譽係包含於該投資之帳面金額目不得攤銷。

本公司與關聯企業及合資間之逆流、順流及側流交易所產生之損益,僅在與本公司對關聯企業權益及對合資權益無關之範圍內,認列於個體財務報告。

(八) 不動產、廠房及設備

除土地以成本計價外,土地以外之不動產、廠房及設備係以成本認列,後續以成本減除累計折舊及累計減損後之金額衡量。

建造中之不動產、廠房及設備係以成本減除累計減損後之金額認列。成本包括專業服務費用及符合資本化條件之借款成本。該等資產於完工並達預期使用狀態時,分類至不動產、廠房及設備之適當類別並開始提列折舊。

自有土地不提列折舊。

本公司之不動產、廠房及設備(包含融資租賃所持有之資產)於耐用年限内按直線基礎,對於每一重大部分單獨提列折舊。若租賃期間較耐用年限短者,則於租賃期間内提列折舊。本公司至少於每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及折舊方法進行檢視,並推延適用會計估計變動之影響。

不動產、廠房及設備除列時,淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於損益。

(九) 商譽

企業合併所取得之商譽係依收購日所認列之商譽金額作為成本,後續以成本減除累計減損後之金額衡量。

為減損測試之目的,商譽分攤至本公司預期因該合併綜效而受益之各現金產生單位或現金產生單位群組(簡稱「現金產生單位」)。

受攤商譽之現金產生單位每年(及有跡象顯示該單位可能已減損時)藉由包含商譽之該單位帳面金額與其可回收金額之比較,進行該單位之減損測試。若分攤至現金產生單位之商譽係當年度企業合併所取得,則該單位應於當年度結束前進行減損測試。若受攤商譽之現金產生單位之可回收金額低於其帳面金額,減損損失係先減少該現金產生單位受攤商譽之帳面金額,次就該單位內其他各資產帳面金額之比例減少各該資產帳面金額。任何減損損失直接認列為當年度損失。商譽減損損失不得於後續期間迴轉。

(十) 其他無形資產

單獨取得之有限耐用年限無形資產原始以成本衡量,後續係以成本減累計攤銷及累計減損後之金額衡量。無形資產於耐用年限內按直線基礎進行攤銷,並且至少於每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及攤銷方法進行檢視。並推延適用會計估計變動之影響。

無形資產除列時,淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於當年度損益。

(十一) 有形及無形資產(商譽除外)之減損

本公司於每一資產負債表日評估是否有任何跡象顯示有形及無形資產(商譽除外)可能已減損。若有任一減損跡象存在,則估計該資產之可回收金額。倘無法估計個別資產之可回收金額,本公司估計該資產所屬現金產生單位之可回收金額。共用資產係依合理一致基礎分攤至個別現金產生單位。可回收金額為公允價值減出售成本與其使用價值之較高者,個別資產或現金產生單位之可回收金額若其低於帳面金額時,則將該資產或現金產生單位之帳面金額調減至其可回收金額,減損損失係認列於損益。

當減損損失於後續迴轉時,該資產或現金產生單位之帳面金額調增至修訂後之可回收金額,惟增加後之帳面金額以不超過該資產或現金產生單位若未於以前年度認列減損損失時所決定之帳面金額(減除折舊或攤銷)。減損損失之迴轉係認列於損益。

(十二) 金融工具

金融資產與金融負債於本公司成為該工具合約條款之一方時認列於個體資產負債表。原始認列時,若金融資產或金融負債非屬透過損益按公允價值衡量者,係按公允價值加計直接可歸屬於取得或發行金融資產或金融負債之交易成本衡量。直接可歸屬於取得或發行透過損益按公允價值衡量之金融資產或金融負債之交易成本,則立即認列為損益。

金融資產

金融資產之慣例交易係採交割日會計認列及除列。

1. 衡量種類

本公司所持有之金融資產分類係於原始認列時視其性質及目的而決定。

(1) 透過損益按公允價值衡量之金融資產

透過損益按公介價值衡量之金融資產包括持有供交易及指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產。

本公司於下列情況下,係將金融資產於原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量:

- A. 該指定可消除或重大減少衡量或認列不一致;或
- B. 一組金融資產、金融負債或兩者,依書面之風險管理或投資策略,以公允價值基礎管理並評估其績效,且本公司內部提供予管理階層之該投資組合資訊,亦以公允價值為基礎;或
- C. 將包含一個或多個嵌入式衍生工具之混合(結合)合約整體進行指定。

透過損益按公允價值衡量之金融資產係按公允價值衡量,其再衡量產生之利益或損失(包含該金融資產所產生之任何股利或利息)係認列於損益。

公允價值之決定方式請參閱附註二六。

(2) 備供出售金融資產

備供出售金融資產係非衍生金融資產被指定為備供出售,或未被分類為放款及應收款、持有至到期日投資或透過損益按公允價值衡量之金融資產。

備供出售金融資產係按公允價值衡量,備供出售貨幣性金融資產帳面金額之變動中屬外幣兌換損益與以有效利息法 計算之利息收入,以及備供出售權益投資之股利,係認列於損益。其餘備供出售金融資產帳面金額之變動係認列於 其他綜合損益,於投資處分或確定減損時重分類為損益。

備供出售權益投資之股利於本公司收款之權利確立時認列。

(3) 放款及應收款

放款及應收款主要包括現金、應收帳款(含關係人)、其他應收款(含關係人)及其他金融資產,係採用有效利息法按攤

銷後成本減除減損損失後之金額衡量,惟短期應收款項之利息認列不具重大性之情況除外。

2. 金融資產之減損

除透過損益按公允價值衡量之金融資產外,本公司係於每一資產負債表日評估其他金融資產是否有減損客觀證據,當有客觀證據顯示,因金融資產原始認列後發生之單一或多項事項,致使金融資產之估計未來現金流量受損失者,該金融資產即已發生減損。

按攤銷後成本列報之金融資產,如應收帳款及其他應收款,該資產經個別評估未有客觀減損證據後,再以組合就過去收款經驗以及與應收款項違約有關之可觀察因素評估減損。

按攤銷後成本列報之金融資產之減損損失金額係該資產帳面金額與估計未來現金流量按該金融資產原始有效利率折現之現值間之差額。於後續期間減損損失金額減少,且經客觀判斷該減少與認列減損後發生之事項相連結,則先前認列之減損損失直接或藉由調整備抵帳戶予以迴轉認列於損益,惟該迴轉不得使金融資產帳面金額超過若未認列減損情況下於迴轉日應有之攤銷後成本。

當備供出售權益投資之公允價值低於成本且發生大幅或持久性下跌時,係為客觀減損證據。當備供出售金融資產發生減損時,原先已認列於其他綜合損益之累計損失金額將重分類至損益。備供出售權益工具投資已認列於損益之減損損失不得透過損益迴轉。任何認列減損損失後之公允價值回升金額係認列於其他綜合損益。備供出售債務工具之公允價值若於後續期間增加,而該增加能客觀地連結至減損損失認列於損益後發生之事項,則減損損失予以迴轉並認列於損益。

所有金融資產之減損損失係直接自金融資產之帳面金額中扣除,惟應收帳款係藉由備抵帳戶調降其帳面金額。當判斷 應收帳款無法收回時,係沖銷備抵帳戶。原先已沖銷而後續收回之款項則貸記備抵帳戶。除因應收帳款無法收回而沖 銷備抵帳戶外,備抵帳戶帳面金額之變動認列於損益。

3. 金融資產之除列

本公司僅於對來自金融資產現金流量之合約權利失效,或已移轉金融資產且該資產所有權之幾乎所有風險及報酬已移轉予其他企業時,始將金融資產除列。除列時,其帳面金額與所收取對價加計已認列於其他綜合損益之任何累計利益或損失之總和間之差額係認列於損益。

權益工具

本公司發行之債務及權益工具係依據合約協議之實質與金融負債及權益工具之定義分類為金融負債或權益。

本公司發行之權益工具係以取得之價款扣除直接發行成本後之金額認列。

再取回本公司本身之權益工具係於權益項下認列與減除。購買、出售、發行或註銷本公司本身之權益工具不認列於損益。

金融負債

金融負債係以有效利息法計算之攤銷後成本或透過損益按公允價值衡量。透過損益按公允價值衡量之金融負債係持有供交易之金融負債。

透過損益按公允價值衡量之金融負債係按公允價值衡量,其再衡量產生之利益或損失係認列於損益,包含所支付之股利或利息。公允價值之決定方式請參閱附註二六。

本公司僅於義務解除、取消或到期時,始將金融負債除列。除列時,其帳面金額與所支付對價間之差額認列為損益。

衍生工具

衍生工具於簽訂合約時,原始以公允價值認列,後續於資產負債表日按公允價值再衡量,後續衡量產生之利益或損失直接 列入損益,然指定且為有效避險工具之衍生工具,其認列損益之時點則將視避險關係之性質而定。當衍生工具之公允價值 為正值時,列為金融資產;公允價值為負值時,列為金融負債。

嵌入式衍生工具之風險及特性與主契約之風險及特性並非緊密關聯,且主契約非屬透過損益按公允價值衡量之金融資產或 金融負債時,該衍生工具係視為單獨衍生工具。

可轉換公司債

1. 可轉換公司債包含之轉換權屬權益性質

本公司發行之複合金融工具(可轉換公司債)係依據合約協議之實質與金融負債及權益工具之定義,於原始認列時將其組

成部分分別分類為金融負債及權益。

原始認列時,負債組成部分之公允價值係以類似之不可轉換工具當時市場利率估算,並於執行轉換或到期日前,以有效利息法計算之攤銷後成本衡量。屬嵌入非權益衍生工具之負債組成部分則以公允價值衡量。

分類為權益之轉換權係等於該複合工具整體公允價值減除經單獨決定之負債組成部分公允價值之剩餘金額,經扣除所得稅影響數後認列為權益,後續不再衡量。於該轉換權被執行時,其相關之負債組成部分及於權益之金額將轉列股本及資本公積—股票發行溢價。可轉換公司債之轉換權若於到期日仍未被執行,該認列於權益之金額將轉列資本公積—股票發行溢價。

發行可轉換公司債之相關交易成本,係按分攤總價款之比例分攤至該工具之負債(列入負債帳面金額)及權益組成部分(列入權益)。

2. 可轉換公司債包含之轉換權屬負債性質

本公司發行之可轉換公司債所含轉換權組成部分,如非透過以固定金額現金或其他金融資產交換固定數量之本公司之權益工具交割之轉換權,則分類為衍生性金融負債。

原始認列時,可轉換公司債之衍生性金融負債部分係以公允價值衡量,非衍生性金融負債部分之原始帳面金額則為分離嵌入式衍生工具後之餘額。於後續期間,非衍生性金融負債係採有效利息法按攤銷後成本衡量,衍生性金融負債係按公允價值衡量,且公允價值變動認列於損益。

發行可轉換公司債之相關交易成本,係按相對公允價值之比例分攤至該工具之非衍生性金融負債部分(列入負債帳面金額)及衍生性金融負債部分(列入損益)。

(十三) 收入認列

收入係按已收或應收對價之公允價值衡量,並扣除估計之客戶退貨、折扣及其他類似之折讓。

1. 商品之銷售

銷售商品係於下列條件完全滿足時認列收入:

- (1) 本公司已將商品所有權之重大風險及報酬移轉予買方;
- (2) 本公司對於已經出售之商品既不持續參與管理,亦未維持有效控制;
- (3) 收入金額能可靠衡量;
- (4) 與交易有關之經濟效益很有可能流入本公司;及
- (5) 與交易有關之已發生或將發生之成本能可靠衡量。
- 2. 勞務之提供

勞務收入係於勞務提供時予以認列。

3. 股利收入及利息收入

投資所產生之股利收入及金融資產之利息收入係於經濟效益很有可能流入本公司,且收入金額能可靠衡量時認列。利息收入係依時間之經過按流通在外本金與所適用之有效利率採應計基礎認列。

(十四) 租賃

營業租賃之租賃收益或給付係按直線基礎於租賃期間内認列為收入或費用。

(十五) 借款成本

直接可歸屬於取得或建造符合要件之資產之借款成本,係作為該資產成本之一部分,直到該資產達到預定使用狀態之幾乎 所有必要活動已完成為止。

特定借款如於符合要件之資本支出發生前進行暫時投資而賺取之投資收入,係自符合資本化條件之借款成本中減除。除上述外,其他借款成本係於發生當年度認列為損益。

(十六) 退職後福利

確定提撥退休計畫之退休金係於員工提供服務期間將應提撥之退休金數額認列為費用。

確定福利退休計畫之確定福利成本(含服務成本、淨利息及再衡量數)係採預計單位福利法精算。服務成本(含當期服務成本 及前期服務成本)及淨確定福利負債(資產)淨利息於發生時認列為員工福利費用。再衡量數(含精算損益及扣除利息後之計畫 資產報酬)於發生時認列於其他綜合損益並列入保留盈餘,後續期間不重分類至損益。

淨確定福利負債(資產)係確定福利退休計畫之提撥短絀(剩餘)。淨確定福利資產不得超過從該計畫退還提撥金或可減少未來 提撥金之現值。

(十七) 股份基礎給付協議

對員工之員工認股權,係以給與日權益工具之公允價值與預期既得之最佳估計數量,於既得期間内以直線基礎認列費用,並同時調整資本公積一員工認股權。若其於給與日立即既得,係於給與日全數認列費用。

本公司於每一資產負債表日修正預期既得之員工認股權估計數量。若有修正原估計數量,其影響數係認列為損益,使累計費用反映修正之估計數,並相對調整資本公積—員工認股權。

本公司給與子公司員工以本公司權益工具交割之員工認股權,係視為對子公司之資本投入,並以給與日權益工具之公允價值衡量,於既得期間內認列為對子公司投資帳面金額之增加,並相對調整資本公積一員工認股權。

(十八) 所得稅

所得稅費用係當期所得稅及遞延所得稅之總和。

1. 當期所得稅

依所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵10%所得稅列為股東會決議年度之所得稅費用。 以前年度應付所得稅之調整,列入當期所得稅。

2. 滤延所得稅

遞延所得稅係依帳載資產及負債帳面金額與計算課稅所得之課稅基礎二者所產生之暫時性差異計算。遞延所得稅負債 一般係就所有應課稅暫時性差異予以認列,而遞延所得稅資產則於很有可能有課稅所得以供可減除暫時性差異使用時 認列。

與投資子公司相關之應課稅暫時性差異皆認列為遞延所得稅負債,惟本公司若可控制暫時性差異迴轉之時點,且該暫時性差異很有可能於可預見之未來不會迴轉者除外。

遞延所得稅資產之帳面金額於每一資產負債表日予以重新檢視,並針對已不再很有可能有足夠之課稅所得以供其回收 所有或部分資產者,調減帳面金額。原未認列為遞延所得稅資產者,亦於每一資產負債表日予以重新檢視,並在未來 很有可能產生課稅所得以供其回收所有或部分資產者,調增帳面金額。

遞延所得稅資產及負債係以預期負債清償或資產實現當年度之稅率衡量,該稅率係以資產負債表日已立法或已實質性 立法之稅率及稅法為基礎。遞延所得稅負債及資產之衡量係反映本公司於資產負債表日預期回收或清償其資產及負債 帳面金額之方式所產生之租稅後果。

3. 本年度當期及遞延所得稅

當期及遞延所得稅係認列於損益,惟與認列於其他綜合損益之項目相關之當期及遞延所得稅係認列於其他綜合損益。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本公司於採用附註四所述之會計政策時,對於不易自其他來源取得相關資訊者,管理階層必須基於歷史經驗及其他攸關之因素作出相關之判斷、估計及假設。實際結果可能與估計有所不同。

管理階層將持續檢視估計與基本假設。若會計估計之修正僅影響當年度,則於修正當年度認列。若會計估計之修正同時影響當年度及未來年度,則於修正當年度及未來年度認列。

(一) 投資子公司成本超過可辨認淨資產公允價值其減損之評估

本公司取得子公司時,取得成本超過本公司於取得日所享有子公司可辨認資產及負債淨公允價值份額之數額列為商譽,係 包含於該投資之帳面金額且不得攤銷,並於每年度進行該商譽減損測試。本公司於決定該商譽是否減損時,須估計分攤到 該商譽之現金產生單位之使用價值。為計算使用價值,管理階層應估計預期自現金產生單位所產生之未來現金流量,並決 定計算現值所使用之適當折現率。若實際現金流量少於預期,可能會產生重大減損損失。

(二) 取得重大之關聯企業

本公司對取得採用權益法之關聯企業,將取得成本超過各取得日所享有關聯企業可辨認資產及負債淨公允價值份額之數額認列為商譽,並列入該投資之帳面金額中,其中,可辨認資產及負債之公允價值之評價涉及重大會計判斷及估計。本公司管理階層聘請外部獨立評價專家針對關聯企業所有可辨認之有形及無形資產與負債進行辨識及評價,主要評價範圍及假設包含有形資產之現時重置成本、無形資產之種類及其依預期未來經濟效益、成長率及折現率而採用現金流量折現等,所辨認之有形及無形資產公允價值與各取得日之帳面價值差額則依照原剩餘耐用年限或預期未來經濟效益年限提列折舊或攤銷。本公司管理階層認為相關評價及假設已適當反映取得關聯企業可辨認資產及負債淨公允價值。

六、現金

	105年12月31	日	104年12月3	31日
庫存現金	\$	1,200	\$	1,657
銀行支票及活期存款		3,158,151	<u> </u>	8,531,689
	\$	3,159,351	\$	8,533,346

七、透過損益按公允價值衡量之金融工具

	105年12月	31日	104年1	2月31日	
指定透過損益按公允價值衡量之金融資產					
上櫃公司私募可轉換公司債	\$	100,583	-	\$	100,500
持有供交易之金融資產					
換匯合約		435,418			1,389,931
遠期外匯合約		64,945			7,745
外幣選擇權合約		-			5,020
		500,363			1,402,696
透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動	\$	600,946	:	\$	1,503,196
持有供交易之金融負債					
可轉換公司債轉換、贖回與賣回權(附註十五)	\$	1,213,890		\$	2,632,565
換匯合約		301,734			14,876
遠期外匯合約		35,053			22,045
利率交換合約					119
透過損益按公允價值衡量之金融負債一流動	\$	1,550,677	-	\$	2,669,605

(一)本公司投資之私募可轉換公司債包括非與主契約緊密關聯之嵌入式衍生工具,於原始認列時將前述合約整體指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產。

(二) 於資產負債表日未適用避險會計且尚未到期之換匯合約如下:

幣別	到期期間	合約金額(千元)
105年12月31日		
新台幣兌美金	106.01~106.12	NTD57,836,641 / USD1,809,000
美金兌人民幣	106.03	USD49,904 / CNY349,800

幣別		到期期間	合約金額(千元)	
Ī	104年12月31日			
	新台幣兌美金	105.01~105.12	NTD55,220,316 / USD1,731,334	
	美金兌新台幣	105.01	USD26,000 / NTD849,486	
	美金兌人民幣	105.03	USD53,734 / CNY 349,800	

(三) 於資產負債表日未適用避險會計且尚未到期之遠期外匯合約如下:

幣別	到期期間	合約金額(千元)	
105年12月31日			
新台幣兌美金	106.01~106.02	NTD2,842,330 / USD90,000	
美金兌歐元	106.01	USD281 / EUR270	
美金兌日幣	106.01	USD40,000 / JPY4,624,315	
美金兌新台幣	106.02~106.03	USD150,000 / NTD4,818,730	
104年12月31日			
美金兌日幣	105.01	USD14,000 / JPY1,713,388	
美金兌新台幣	105.01~105.03	USD121,000 / NTD3,971,877	

(四)於104年12月31日未適用避險會計且尚未到期之外幣選擇權合約如下:

合約内容	到期期間	合約金額(千元)
Buy USD Put / CNY Call	105.03	USD20,000 / CNY131,600

(五)於104年12月31日未適用避險會計且尚未到期之利率交換合約如下:

到期期間	到期期間 名目本金(千元)		收取利率區間
105.10	NTD1,000,000	4.6%	0.0%~5.0%

八、備供出售金融資產 - 非流動

	105年12月31	日	104年12月31日			
有限合夥	\$	219,921	\$	390,987		
非上市(櫃)公司普通股		65,438		82,120		
	\$	285,359	\$	473,107		

九、應收帳款淨額

	105年12月31日	3	104年12月31日		
應收帳款	\$	17,849,718	\$	14,054,233	
减:備抵呆帳		23,770		23,792	
	\$	17,825,948	\$	14,030,441	

(一) 應收帳款

本公司之主要授信期間為30~90天。於評估應收帳款備抵呆帳時,本公司考量應收帳款之帳齡分析、歷史經驗及客戶財務 狀況等。

截至105年及104年12月31日止,前五大客戶之應收帳款餘額占本公司應收帳款餘額之百分比分別為40%及35%,其餘應收帳款之信用集中風險相對並不重大。

應收帳款以逾期天數為基準之帳齡分析如下:

	105年12月31日	104年1	104年12月31日			
未逾期	\$	14,747,406		\$	12,074,151	
1至30天		2,553,411			1,639,016	
31至90天		502,329			231,365	
91天以上		46,572			109,701	
合計	\$	17,849,718		\$	14,054,233	

已逾期但未減損應收帳款之逾期帳齡分析如下:

	105年12月31	104年12月31日			
1至30天	\$	2,553,411		\$	1,636,231
31至90天		478,199			192,339
合計	\$	3,031,610		\$	1,828,570

於資產負債表日已逾期但本公司尚未認列備抵呆帳之應收帳款,因其信用品質並未重大改變,本公司管理階層認為仍可回收其金額。本公司對該等應收帳款並未持有任何擔保品或其他信用增強保障。

應收帳款之備抵呆帳變動資訊如下:

		個別評估 減損損失		群組評估 減損損失		合計
105年1月1日餘額	\$	13,948	\$	9,844	\$	23,792
本年度提列(迴轉)減損損失	(9,373)		9,351	(22)
105年12月31日餘額	\$	4,575	\$	19,195	\$	23,770
104年1月1日餘額	\$	5,100	\$	18,831	\$	23,931
本年度提列(迴轉)減損損失		8,848	(8,826)		22
本年度實際沖銷		_	(161)	(161)
104年12月31日餘額	\$	13,948	\$	9,844	\$	23,792

(二) 金融資產之移轉

本公司讓售應收帳款之相關資訊如下:

交易對象	本年度讓售	金額(千元)	本年度已	收現金額(千元)	截至年度	民已預支金額(千元)	已預支金額年利率(%)	額度	(千元)
105年度				<u>.</u>		_			
花旗銀行	USD	-	USD	41,849	USD	_	_	USD	66,000
104年度									
花旗銀行	USD	78,804	USD	36,955	USD	41,849	1.30	USD	92,000

上述額度可循環使用,另依讓售合約之規定,因商業糾紛(如銷貨退回或折讓等)而產生之損失由本公司承擔,因信用風險而產生之損失則由該銀行承擔。本公司於105年及104年12月31日分別提供美金2,000千元及5,000千元之商業本票予銀行用以補償商業糾紛損失。截至105年12月31日止,本公司並未發生重大商業糾紛,於可預見之未來亦預期不會發生重大商業糾紛。

十、存貨

	105年12月31日		104年12月31日	3
製成品	\$	402,842	\$	243,240
在製品		299,929		241,352
原料		3,553,662		2,898,215
物料		329,963		335,229
在途原物料		79,613		51,072
	\$	4,666,009	\$	3,769,108

105及104年度與存貨相關之營業成本分別為75,049,226千元及69,059,001千元,其中分別包括存貨損失240,664千元及275,232千元。

十一、採用權益法之投資

	105年12月31	104年12月31日(調整後)			
投資子公司	\$	151,731,955		\$	152,571,261
投資關聯企業		48,925,200			36,527,711
投資合資		670,550			613,841
	\$	201,327,705	-	\$	189,712,813

(一) 投資子公司

	105年12月31日			3	
帳面金額 股權%		帳面金額		股權%	
49,569,777	100.0	\$	47,271,666	100.0	
43,122,309	99.2		44,733,359	99.2	
29,165,404	100.0		29,586,903	100.0	
15,244,811	100.0		15,251,124	100.0	
10,972,509	70.6		11,140,252	70.6	
4,252,833	100.0		3,998,959	100.0	
1,332,892	67.1		1,332,571	67.1	
_	_		1,187,548	99.0	
30,527	100.0		27,986	100.0	
153,691,062			154,530,368		
1,959,107			1,959,107		
151,731,955		\$	152,571,261		
	49,569,777 43,122,309 29,165,404 15,244,811 10,972,509 4,252,833 1,332,892 - 30,527 153,691,062 1,959,107	49,569,777 100.0 43,122,309 99.2 29,165,404 100.0 15,244,811 100.0 10,972,509 70.6 4,252,833 100.0 1,332,892 67.1 — — 30,527 100.0 153,691,062 1,959,107	49,569,777 100.0 \$ 43,122,309 99.2 29,165,404 100.0 15,244,811 100.0 10,972,509 70.6 4,252,833 100.0 1,332,892 67.1 — — 30,527 100.0 153,691,062 1,959,107	49,569,777 100.0 \$ 47,271,666 43,122,309 99.2 44,733,359 29,165,404 100.0 29,586,903 15,244,811 100.0 15,251,124 10,972,509 70.6 11,140,252 4,252,833 100.0 3,998,959 1,332,892 67.1 1,332,571 — — 1,187,548 30,527 100.0 27,986 153,691,062 154,530,368 1,959,107 1,959,107	

104年4月本公司之子公司USI Enterprise Limited(環誠)以人民幣1,992,060千元出售其持有之環旭電子公司股權54,000千股。此交易並未改變本公司對子公司環旭電子公司之控制,本公司及子公司係採權益交易處理之,並認列資本公積增加7,197,510千元。

105年2月本公司之子公司環誠買回已發行流通在外之普通股計4,501干股。此交易並未改變本公司對子公司環誠之控制,本公司及子公司係採權益交易處理之,並認列資本公積減少1,912,887千元。

105年2月本公司以每股20元處分子公司環隆電氣股權39,603干股予子公司環鴻科技公司,交易總金額為792,064千元,致本公司對環隆電氣之持股比例由99.0%降至0%。此交易並未改變本公司對子公司環隆電氣之控制,本公司係採權益交易處理之,並認列資本公積減少20,552千元。

另105及104年度子公司環誠之員工認股權持有人執行轉換,致使本公司對其持股比例降低。此交易並未改變本公司對子公司環誠之控制,本公司採權益交易處理之,並分別認列資本公積減少444,320千元及564,344千元。

105及104年度採用權益法之子公司之損益及其他綜合損益份額,係依據各子公司同期間經會計師查核之財務報告認列。

(二) 投資關聯企業

1. 本公司採用權益法之關聯企業投資列示如下:

被投資公司名稱	主要業務	營運地點	1	105年12月31日		12月31日(調整後)
具重大性之關聯企業						
矽品精密工業公司(矽品)	各項積體電路構裝之製造、加工、買賣及 測試等業務	台灣	\$	45,884,727	\$	35,141,701
個別不重大之關聯企業						
Deca Technologies Inc. (Deca)	控股公司,集團從事半導體之製造、組 合、加工、測試及銷售	英屬開曼群島		1,820,329		_
宏璟建設公司(宏璟)	委託營造廠商興建大樓及出租業務等	台灣		1,162,234		1,313,499
宏錦光公司(宏錦光)	經營辦公大樓及攤位出租業務	台灣		321,120		332,444
元隆電子公司(元隆)	晶圓積體電路代工	台灣		36,939		40,216
				49,225,349		36,827,860
	減:以土地作價投資宏錦光之未實現利益			300,149		300,149
			\$	48,925,200	\$	36,527,711

2. 資產負債表日對關聯企業持有之股權百分比如下:

被投資公司名稱	105年12月31日	104年12月31日
矽品	33.29%	24.99%
Deca	22.07%	_
宏璟	26.22%	26.22%
宏錦光	27.31%	27.31%
元隆	10.47%	18.24%

3. 本公司於104年9月收購矽品股權24.99%,對矽品具重大影響。本公司復於105年3月至4月間陸續以現金13,735,498 干元於公開市場上取得矽品普通股及海外存託憑證(每單位表彰普通股5股)258,300干股,致持股比例由24.99%上升至 33.29%。

截至105年12月31日止,本公司已完成投資成本與所享有矽品可辨認資產及負債之淨公允價值份額間差額之辨識,並追 溯調整財務報表。104年12月31日資產負債表調整項目如下:

	追溯調		追溯	調整後		
採用權益法之投資-矽品	_	\$	35,423,058		\$	35,141,701
保留盈餘	-	\$	56,184,069		\$	55,902,712

- 另,本公司於105年6月經董事會通過並與矽品簽署共同轉換股份協議,請參閱附註三一。
- 4. 本公司於105年7月以每股美金0.608元投資Deca發行之特別股98,490千股共計1,934,062千元(美金59,882千元),投資後持股比例為22.07%,取得對Deca重大影響力。截至105年12月31日止,本公司尚未完成投資成本與所享有Deca可辨認資產及負債之淨公允價值份額間差額之辨識。
- 5. 元隆於105年度發行私募普通股,且其轉換公司債持有人亦於105年間行使轉換權,本公司未依持股比例認購亦未參與轉換,致本公司持股比例由18.24%降至10.47%。
- 6. 關聯企業具公開市場報價之第1級公允價值資訊如下:

	105年12月	31日	104年12月31日	∃
矽品	\$	49,634,805	\$	40,741,700
宏璟	\$	1,310,829	\$	1,149,549
元隆	\$	82,938	\$	104,255

7. 本公司重大關聯企業之彙整性財務資訊

以下彙總性財務資訊係以矽品依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可之IFRSs編製之合併財務報告為基礎編 製,並已反映採權益法時所做之調整。另,本公司於105及104年度自矽品收取之股利分別為3,941,740千元及0元。

	105年12月31日	104年12月31日(調整後)
流動資產	\$ 50,451,295	\$ 48,785,212
非流動資產	107,606,186	112,547,467
流動負債	(41,088,439)	(30,677,239)
非流動負債	(16,484,482)	(21,967,349)
權益	\$ 100,484,560	\$ 108,688,091
本公司持股比例	33.29%	24.99%
本公司享有之權益	\$ 33,451,310	\$ 27,161,154
商譽	12,433,417	7,980,547
投資帳面金額	\$ 45,884,727	\$ 35,141,701
	105年度	104年度
營業收入	\$ 85,111,913	\$ 82,839,922
營業毛利	\$ 15,027,247	\$ 20,483,422
税前淨利	\$ 7,362,092	\$ 9,264,979
本年度淨利	\$ 5,610,685	\$ 7,636,379
本年度其他綜合損益	(2,504,310)	(906,053)
本年度綜合損益總額	\$ 3,106,375	\$ 6,730,326
8. 本公司個別不重大之關聯企業之彙總性財務資	訊訊	

	105年原	ŧ	104年度	
本公司享有之份額				
本年度淨利	(\$	145,435)	\$	115,857
其他綜合損益	(115,165)	(2,916)
綜合損益總額	(\$	260,600)	\$	112,941

9. 採用權益法之關聯企業及本公司對其所享有之損益及其他綜合損益份額,係依據各關聯企業同期間經會計師查核之財 務報告計算。

(三) 投資合資

- 1. 本公司採用權益法之個別不重大之合資投資為日月陽電子公司(日月暘),係於104年5月與日商TDK Corporation簽署 合資協議共同出資成立。本公司於104年8月以現金投資618,097千元,復於105年9月按持股比例參與日月暘現金增資 案,投資金額為146,903千元,105年及104年12月31日之持股比率均為51.00%。日月暘位於台灣,主要從事電子零組 件製造。依據聯合協議,由出資雙方共同主導日月陽相關營運活動,因此本公司對日月陽不具控制力,對日月暘之投 資採用權益法。
- 2. 本公司個別不重大之合資彙總資訊如下:

	105年度		104年度	
本公司享有之本年度淨損及綜合損益份額	(\$	90,478)	(\$	4,274)

3. 採用權益法之合資及本公司對其所享有之損益及其他綜合損益份額,係依據該合資公司同期間經會計師查核之財務報 告認列。

十二、不動產、廠房及設備

不動產、廠房及設備每一類別之帳面金額如下:

105年12月31日	3	104年1	2月31日	l
\$	1,562,945		\$	1,562,945
	32,314,750			30,722,699
	41,595,676			44,069,302
	431,607			460,699
	2,470,049			3,560,050
\$	78,375,027		\$	80,375,695
	\$	32,314,750 41,595,676 431,607 2,470,049	\$ 1,562,945 32,314,750 41,595,676 431,607 2,470,049	\$ 1,562,945 \$ 32,314,750 41,595,676 431,607 2,470,049

105年度

	土地		建築物及 附屬設備		機器設備		其他設備		未完工程及 待驗設備		合計
成本											
105年1月1日餘額	\$ 1,562,945	\$	45,721,780	\$	117,135,623	\$	1,633,776	\$	3,571,414	\$	169,625,538
增添	_	(19,367)		377,018		29,741		14,569,900		14,957,292
處分	_	(305,306)	(3,812,196)	(31,958)	(78,549)	(4,228,009)
重分類			4,038,681		11,414,256		122,491	(15,575,428)		_
105年12月31日餘額	\$ 1,562,945	\$	49,435,788	\$	125,114,701	\$	1,754,050	\$	2,487,337	\$	180,354,821
累計折舊及減損											
105年1月1日餘額	\$ _	\$	14,999,081	\$	73,066,321	\$	1,173,077	\$	11,364	\$	89,249,843
折舊費用	_		2,359,165		12,697,775		181,077		_		15,238,017
減損損失	_		8,556		876,123		_		5,924		890,603
處分	 _	(245,764)	(3,121,194)	(31,711)			(3,398,669)
105年12月31日餘額	\$ _	\$	17,121,038	\$	83,519,025	\$	1,322,443	\$	17,288	\$	101,979,794

104年度

	土地		建築物及 附屬設備		機器設備		其他設備	:	未完工程及 待驗設備		合計
成本											
104年1月1日餘額	\$ 1,562,945	\$	38,879,974	\$	110,668,151	\$	1,429,067	\$	2,709,430	\$	155,249,567
增添	_	(16,412)		103,847		32,649		17,531,501		17,651,585
處分	_	(115,669)	(3,111,192)	(36,721)	(12,032)	(3,275,614)
重分類	 		6,973,887		9,474,817		208,781	(16,657,485)		_
104年12月31日餘額	\$ 1,562,945	\$	45,721,780	\$	117,135,623	\$	1,633,776	\$	3,571,414	\$	169,625,538
累計折舊及減損											
104年1月1日餘額	\$ _	\$	12,927,240	\$	63,647,813	\$	1,026,355	\$	7,164	\$	77,608,572
折舊費用	_		2,095,142		12,360,166		175,554		_		14,630,862
減損損失	_		76,792		15,977		_		4,200		96,969
處分		(100,093)	(2,957,635)	(28,832)			(3,086,560)
104年12月31日餘額	\$ 	\$	14,999,081	\$	73,066,321	\$	1,173,077	\$	11,364	\$	89,249,843

由於本公司考量未來營運計畫並評估現有產能規劃,部分廠房及設備不符本公司生產需求,本公司於105及104年度分別認 列減損損失890,603千元及96,969千元,並列入個體綜合損益表之其他利益(損失)項下。本公司評估已減損之廠房及設備之 可回收金額,係依據市場中相似狀況之資產報價減處分成本衡量,因該市場之交易並非活絡,故該資產報價屬於第三級之 公允價值;餘以該資產之使用價值衡量且本公司預期該等資產已無未來現金流入。

本公司之不動產、廠房及設備係以直線基礎按下列耐用年數計提折舊:

建築物及附屬設備

廠房主建物	10至40年
無塵室工程	10至20年
其他	3至20年
機器設備	2至10年
辦公設備	2至9年

利息資本化資訊請參閱附註十九。

十三、其他無形資產

其他無形資產每一類別之帳面金額如下:

	105年12月3	1日	104年12月	31日
專利權及專門技術	\$	288,413	\$	179
電腦軟體及其它		731,846		655,510
	\$	1,020,259	\$	655,689

105年度

	專利權及專門技術			電腦軟體及其他		合計
成本						
105年1月1日餘額	\$	142,285	\$	1,666,739	\$	1,809,024
增添		301,351		256,329		557,680
除列	(1,310)	(10,655)	(11,965)
105年12月31日餘額	\$	442,326	\$	1,912,413	\$	2,354,739
累計攤銷及減損						
105年1月1日餘額						
攤銷費用	\$	142,106	\$	1,011,229	\$	1,153,335
除列		13,117		179,993		193,110
105年12月31日餘額	(1,310)	(10,655)	(11,965)
	\$	153,913	\$	1,180,567	\$	1,334,480

104年度

	專利權及專門技術		電腦軟體及其他		合計
成本					
104年1月1日餘額	\$	141,406	\$ 1,359,086	\$	1,500,492
增添		909	307,653		308,562
除列	(30)	_	(30)
104年12月31日餘額	\$	142,285	\$ 1,666,739	\$	1,809,024
累計攤銷及減損					
104年1月1日餘額					
攤銷費用	\$	141,406	\$ 872,894	\$	1,014,300
除列		730	138,335		139,065
104年12月31日餘額	(30)	_	(30)
	\$	142,106	\$ 1,011,229	\$	1,153,335

上述無形資產係以直線基礎按下列耐用年數計提攤銷費用:

 專利權及專門技術
 5至10年

 電腦軟體及其他
 2至5年

十四、借款

(一) 短期借款

係無擔保之銀行週轉性借款,105年及104年12月31日年利率分別為1.15%~1.39%及0.68%~0.85%。

(二) 應付短期票券 - 僅104年12月31日

係應付商業本票面額4,350,000千元減除未攤銷折價1,946千元後之餘額,年利率0.78%。保證機構為中華及兆豐票券金融公司。

(三) 長期借款

銀行借款

本公司之長期借款均為週轉性借款且主係浮動利率,包括:

	105年12月31日	104年12月31日
銀行團聯貸-將陸續於106年1月至107年7月償還,年利率105 年及104年12月31日分別為2.55%及1.56%	\$ 9,223	3,500 \$ 11,160,500
其他-將陸續於106年2月至108年11月償還,年利率105年及		
104年12月31日分別為0.74%~1.23%及0.90%~1.26%	35,966	5,666 24,283,112
	45,190	0,166 35,443,612
減:未攤銷遞延主辦費	7	7,198 17,994
	45,182	2,968 35,425,618
減:一年內到期之長期借款	5,285	5,722
銀行借款	\$ 39,897	7,246 \$ 35,425,618

上述銀行團聯合融資合約,除其他有關規定外,尚規定本公司以經會計師查核或核閱之年度或半年度合併財務報告為計算基礎,於貸款存續期間內,應維持約定流動比率、負債比率、有形淨值金額及利息償付能力。本公司於105年及104年12月31日均符合上述規定。

本公司預計可將部分一年內到期之長期借款再融資至104年12月31日後至少12個月,是以截至104年12月31日止尚有2,105,883千元未列入一年內到期部分。

應付票券

	105年12月31日	1	104年12月31日		
面額	\$	2,000,000	\$	2,000,000	
減:未攤銷折價		659		1,011	
	\$	1,999,341	\$	1,998,989	
年利率(%)		1.00		1.03	

係本公司與大慶票券金融公司於104年12月簽訂發行3年期循環冤保證票券2,000,000千元。

十五、應付公司債

	105年12月31日		104年12月31日	
國内無擔保公司債				
期間5年,將於110年1月到期一次償還,每年付息,年利率				
1.30%	\$	7,000,000	\$	_
期間7年,將於112年1月到期一次償還,每年付息,年利率				
1.50%		2,000,000		_
海外無擔保轉換公司債				
美金400,000千元		12,900,000	1	13,130,000
美金200,000千元(新台幣計價)		6,185,600		6,185,600

105年12月31日		104年12月31日			
	_	,	_		
\$		\$	8,000,000		
	28,085,600		27,315,600		
	744,043		1,214,514		
	27,341,557		26,101,086		
	_		12,162,192		
\$	27,341,557	\$	13,938,894		
	\$	\$ 28,085,600 744,043 27,341,557 	\$ — \$ 28,085,600 744,043 27,341,557 —		

本公司於104年12月31日預計可將部分一年內到期之應付公司債再融資至資產負債表日後至少12個月,是以截至104年12月31日止尚有8,000,000千元仍列為非流動。

(一)本公司於102年9月發行海外第三次無擔保轉換公司債,發行總額計美金400,000千元,每張面額為美金200千元或其整數倍數,票面利率為0%,發行期限5年。每單位公司債持有人有權於發行日後第41日起至到期日前10日止,除依法令規定停止過戶期間外,請求按固定匯率美金1元對新台幣29.956元及轉換當時每股轉換價格轉換為本公司之普通股。發行時轉換價格為33.085元,後續轉換價格遇有本公司因反稀釋條款之情況,將依轉換辦法規定予以調整,105年及104年12月31日轉換價格分別為28.99元及30.28元。

發行滿3年後,如本公司普通股於台灣證券交易所連續20個交易日之收盤價格依當時市場匯率換算為美金後,均達轉換價格之130%;或90%之公司債業已贖回、買回並經註銷或經債券持有人行使轉換權利;或因法令變更致使本公司因此公司債負擔稅賦增加時,本公司得提前贖回部分或全部債券。

公司債持有人亦得於此公司債發行屆滿3年當日:或本公司控制權發生變動:或本公司普通股下市時,要求本公司贖回 部分或全部債券。

於發行日此可轉換公司債包括主債務契約(列入應付公司債項下)及轉換權、贖回權及賣回權(列入透過損益按公允價值 衡量之金融負債項下),主債務契約原始認列之有效利率為3.16%,轉換權、贖回權與賣回權原始認列之公允價值為 1,667,950千元。

(二)本公司於104年7月發行海外第四次無擔保轉換公司債,發行總額計美金200,000千元,每張面額為美金200千元或其整數倍數,票面利率為0%,發行期限2.75年。償還、賣回及贖回金額將按固定匯率美金1元對新台幣30.928元換算為新台幣,並以該新台幣金額按償還、賣回及贖回當時之匯率換算為美金計算。每單位公司債持有人有權於發行日後第41日起至到期日前10日止,除依法令規定停止過戶期間外,請求按固定匯率美金1元對新台幣30.928元及轉換當時每股轉換價格轉換為本公司之普通股,本公司庫藏股可供轉換股權之用。發行時轉換價格為54.55元,後續轉換價格遇有本公司因反稀釋條款之情況,將依轉換辦法規定予以調整,105年及104年12月31日轉換價格分別為49.52元及51.73元。發行滿2.72年後,如本公司普通股於台灣證券交易所連續30個營業日中有20個交易日之收盤價格依當時市場匯率換算為美金後,均達轉換價格之130%;或90%之公司債業已贖回、買回並經註銷或經債券持有人行使轉換權利;或因法令變更致使本公司因此公司債負擔稅賦增加時,本公司得提前贖回部分或全部債券。

公司債持有人亦得於本公司控制權發生變動;或本公司普通股下市時,要求本公司贖回部分或全部債券。

於發行日此可轉換公司債包括主債務契約(列入應付公司債項下)及轉換權(列入資本公積項下)。主債務契約原始認列之 有效利率為1.58%,轉換權原始認列之金額為214,022千元。

本公司於106年1月發行無擔保普通公司債,發行總額計8,000,000千元,分為甲類3,700,000千元及乙類4,300,000千元,將分別於111年1月及113年1月到期一次償還,每年付息,年利率分別為1.25%及1.45%。

十六、 其他應付款

_	105年12月31	日	104年12月3	104年12月31日		
應付設備款	\$	2,677,230	\$	2,888,533		
應付薪資及獎金		2,708,329		2,379,823		
應付員工酬勞及董事酬勞		2,342,534		2,218,000		
其他		3,317,883		3,079,235		
	\$	11,045,976	\$	10,565,591		

十七、退職後福利計畫

(一) 確定提撥計畫

本公司所適用「勞工退休金條例」之退休金制度,係屬政府管理之確定提撥退休計畫,依員工每月薪資6%提撥退休金至 勞工保險局之個人專戶。

(二)確定福利計畫

- 1. 本公司依我國「勞動基準法」辦理之退休金制度係屬政府管理之確定福利退休計畫。員工退休金之支付,係根據服務年資及核准退休日前6個月平均工資計算。本公司按員工每月薪資總額之一定比率按月提撥員工退休基金,交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入台灣銀行之專戶,年度終了前,若估算專戶餘額不足給付次一年度內預估達到退休條件之勞工,次年度3月底前將一次提撥其差額。該專戶係委託勞動部勞動基金運用局管理,本公司並無影響投資管理策略之權利。
- 2. 本公司另提列委任經理人退休金準備,105及104年度分別認列退休金成本4,435千元及1,180千元(列入淨確定福利負債項下),並分別支付經理人退休金為0千元及2,549千元。截至105年及104年12月31日止,屬委任經理人之淨確定福利負債分別為138,696千元及134,261千元。
- 3. 除經理人退休金外,本公司列入個體資產負債表之確定福利計畫金額列示如下:

	105年12月31日	<u> </u>	104年12月31日		
確定福利義務現值	\$	4,015,053	\$	3,634,267	
計畫資產公允價值	(1,622,868)	(1,467,174)	
提撥短絀		2,392,185		2,167,093	
列入其他應付款	(14,762)	(14,282)	
淨確定福利負債	\$	2,377,423	\$	2,152,811	

淨確定福利負債變動如下:

	確定補	確定福利義務現值 計畫資產		計畫資產公允價值		福利負債(資產)
105年1月1日餘額	\$	3,634,267	(\$	1,467,174)	\$	2,167,093
服務成本						
當期服務成本		31,624		_		31,624
利息費用(收入)		68,097	(28,882)		39,215
認列於損益		99,721	(28,882)		70,839
再衡量數						
計畫資產報酬(除包含於淨利息之金額外)		-		17,993		17,993
精算損失-財務假設變動		138,799		-		138,799
精算損失-經驗調整		207,836				207,836
認列於其他綜合損益		346,635		17,993		364,628
轉入負債		11,787				11,787
雇主提撥			(222,162)	(222,162)
福利支付	(77,357)		77,357	-	
105年12月31日	\$	4,015,053	(\$	1,622,868)	\$	2,392,185
104年1月1日餘額	\$	3,660,738	(\$	1,348,084)	\$	2,312,654
服務成本						
當期服務成本		36,899		-		36,899
利息費用(收入)		81,249	(31,356)		49,893
認列於損益		118,148	(31,356)		86,792

	確定福利義務現值		利義務現值 計畫資產公允價值		淨確定福利負債(資產	
再衡量數		_				
計畫資產報酬(除包含於淨利息之金額外)	\$	_	(\$	4,226)	(\$	4,226)
精算損失-財務假設變動		152,319		_		152,319
精算利益-經驗調整	(168,955)		_	(168,955)
精算利益-人口統計假設變動	(18,848)		_	(18,848)
認列於其他綜合損益	(35,484)	(4,226)	(39,710)
雇主提撥			(192,643)	(192,643)
福利支付	(109,135)		109,135		
104年12月31日	\$	3,634,267	(\$	1,467,174)	\$	2,167,093

4. 計畫資產之主要類別於資產負債表日之公允價值如下:

	105年12月31日	3	104年12月31日		
現金	\$	338,044	\$	261,891	
債務工具		461,057		390,269	
權益工具		765,344		784,791	
其他		58,423		30,223	
	\$	1,622,868	\$	1,467,174	

5. 本公司因「勞動基準法」之退休金制度暴露於下列風險:

(1) 投資風險

勞動部勞動基金運用局透過自行運用及委託經營方式,將勞工退休基金分別投資於國内(外)權益證券與債務證券及 銀行存款等標的,惟本公司之計畫資產得分配金額係以不低於當地銀行2年定期存款利率計算而得之收益。

(2) 利率風險

政府公債之利率下降將使確定福利義務現值增加,惟計畫資產之債務投資報酬亦會隨之增加,兩者對淨確定福利負債之影響具有部分抵銷之效果。

(3) 薪資風險

確定福利義務現值之計算係參考計畫成員之未來薪資。因此計畫成員薪資之增加將使確定福利義務現值增加。

6. 本公司之確定福利義務現值(不含經理人)係由合格精算師進行精算,衡量日之重大假設如下:

	105年12月31日	104年12月31日
折現率(%)	1.60	1.90
薪資預期增加率(%)	2.75~3.00	2.75~3.00

若重大精算假設分別發生合理可能之變動,在所有其他假設維持不變之情況下,將使確定福利義務現值增加(減少)之金額如下:

	105年12月31	目	104年12月31日		
折現率					
增加0.5%	(\$	227,516)	(\$	213,385)	
减少0.5%	\$	247,685	\$	236,088	
					
薪資預期增加率					
增加0.5%	\$	243,541	\$	232,856	
减少0.5%	(\$	226,103)	(\$	212,647)	

由於精算假設可能彼此相關,僅單一假設變動之可能性不大,故上述敏感度分析可能無法反映確定福利義務現值實際變動 情形。

7. 未折現之退休金福利支付到期分析如下:

	105年12月31日		104年12月	月31日
1年内	\$	120,199	\$	100,459
超過1年但未超過5年		650,238		533,315
超過5年		4,430,355		4,434,125
	\$	5,200,792	\$	5,067,899

本公司於105年及104年12月31日預期1年內對確定福利計畫提撥之金額分別為214,294千元及206,280千元。 截至105年及104年12月31日,本公司確定福利義務平均到期期間均約為12年。

十八、權益

(一) 股本

普通股股本

105年12月31日	104年12月31日
10,000,000	10,000,000
800,000	800,000
\$ 100,000,000	\$ 100,000,000
\$ 8,000,000	\$ 8,000,000
7,936,473	7,902,929
9,711	7,499
7,946,184	7,910,428
	\$ 100,000,000 \$ 100,000,000 \$ 8,000,000 7,936,473 9,711

本公司已發行之普通股每股面額為10元,每股享有一表決權(子公司持有之本公司股票除外)及收取股利之權利。105年及104年12月31日額定股數中均尚有500,000千股暫無須辦理變更登記。

本公司董事會於105年12月決議辦理現金增資發行普通股300,000千股,業經金管會於106年1月4日核准申報生效,並以106年2月15日為增資基準日,每股34.3元溢價發行。

發行海外存託憑證

本公司發行ADR,每單位表彰本公司普通股5股,截至105年及104年12月31日止,流通在外之ADR分別為125,518千單位及115,240千單位,折合普通股分別約627,590千股及576,198千股。

(二) 資本公積

	105年12月31日	1	104年12月31日	
—— 得用以彌補虧損、發放現金或撥充股本(註1)				
股票發行溢價	\$	5,844,397	\$	5,479,616
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額		7,176,958		7,197,510
僅得用以彌補虧損				
認列對子公司所有權權益變動數(註2)		6,132,777		8,489,984
庫藏股票交易		950,368		717,355
員工認股權執行		630,411		544,112
員工認股權失效		3,626		3,626
採權益法認列關聯企業資本公積之變動數		82 243		30 284

	105年12月31日		104年12月3	1日
不得作為任何用途				
員工認股權	\$	1,230,247	\$	1,080,590
發行可轉換公司債認列權益組成部分		214,022		214,022
	\$	22,265,049	\$	23,757,099

註1:此類資本公積得用以彌補虧損,亦得於公司無虧損時,用以發放現金或撥充股本,惟撥充股本時每年以實收股本之一定比率為限。

註2:此類資本公積係本公司未實際取得或處分子公司股權時,因子公司權益變動認列之權益交易影響數,或本公司採權益法認列子公司資本公積之調整數。

(三) 保留盈餘及股利政策

依104年5月公司法之修正,股息及紅利之分派限於股東,員工非屬盈餘分派之對象。配合上述法規,本公司業已於105年度之股東常會決議修改公司章程。員工酬勞及董事酬勞估列基礎及實際配發情形,請參閱稅前淨利之員工福利費用(附註十九(五))。

依本公司105年6月修正後之章程規定,每年度有純益時,依下列順序分派之:

- 1. 彌補虧損。
- 2. 提存百分之十為法定盈餘公積。
- 3. 依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。
- 4. 加計或減除保留盈餘中屬已實現之透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益。

本公司正處於企業穩定成長階段,為因應目前及未來業務擴展之資金需求,並滿足股東對現金流入之需求,本公司之股利政策係採取剩餘股利政策分派股利,其中現金股利發放之比例不低於股利總額30%,餘額則配發股票股利,並由董事會擬具盈餘分配案,經股東會決議後辦理。

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止。法定盈餘公積得用以彌補虧損。公司無虧損時,法定盈餘公積 超過實收股本總額25%之部分除得撥充股本外,尚得以現金分配。

本公司依金管證發字第1010012865號函、金管證發字第1010047490號函及「採用國際財務報導準則(IFRSs)後,提列特別 盈餘公積之適用疑義問答」規定提列及迴轉特別盈餘公積。

分配未分配盈餘時,除屬非中華民國境内居住者之股東外,其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣 抵稅額。

本公司於105年及104年6月舉行股東常會,決議通過104及103年度盈餘分配案如下:

	盈餘分配案			每股股利(元)				
		104年度		103年度		104年度		103年度
法定盈餘公積	\$	1,947,887	\$	2,359,267		_		
現金股利		12,476,779		15,589,825	\$	1.60	\$	2.00
	\$	14,424,666	\$	17,949,092				

(四) 其他權益項目

1. 國外營運機構財務報表換算之兌換差額

	105年度		104	04年度		
年初餘額	9	;	4,493,570		\$	4,541,761
採用權益法之子公司、關聯企業及合資之換算差額之份額	(6,136,294)		(48,191)
年底餘額	(\$	1,642,724)		\$	4,493,570

2. 備供出售金融資產未實現損益

	105年度		104年度	
年初餘額	\$	588,119	\$	526,778
備供出售金融資產未實現損失	(72,625)	(37,204)
處分備供出售金融資產累計損益重分類至損益		8,848		1,038
採用權益法之子公司、關聯企業及合資之備供出售金融資產未				
實現損益之份額	(765,192)		97,507
年底餘額	(\$	240,850)	\$	588,119

(五) 庫藏股票

	年初股數(千股)	本年度增加(千股)	本年度減少(千股)	年底股數(千股)
105年度				
子公司持有本公司股票	145,883	_	_	145,883
買回供轉換公司債股權轉換之用	120,000	_	_	120,000
合計	265,883	_	_	265,883
104年度				
子公司持有本公司股票	145,883	_	_	145,883
買回供轉換公司債股權轉換之用	_	120,000	_	120,000
合計	145,883	120,000		265,883

本公司董事會於104年2月通過買回庫藏股120,000千股,俾供本公司海外無擔保轉換公司債轉換股權之用,並已於104年3月間執行完畢,實際買回股份占本公司已發行股份總數1.53%,實際買回平均價格為每股44.45元。

子公司於資產負債表日持有本公司股票之相關資訊如下:

	持有股數(千股) 帳面金額		帳面金額		公允價值
105年12月31日					
ASE Test	88,200	\$	1,380,721	\$	2,915,026
J&R Holding	46,704		381,709		1,543,559
台灣福雷	10,979		196,677		362,849
	145,883	\$	1,959,107	\$	4,821,434
104年12月31日					
ASE Test	88,200	\$	1,380,721	\$	3,351,618
J&R Holding	46,704		381,709		1,774,743
台灣福雷	10,979		196,677		417,193
	145,883	\$	1,959,107	\$	5,543,554

上述公允價值係屬具公開市場報價之第1級公允價值。

子公司持有本公司股票係本公司因吸收合併及收購子公司,而將子公司持有本公司股票之帳面價值依本公司對子公司持股 比例計算之金額轉列庫藏股票。

本公司持有之庫藏股票,依證券交易法規定不得質押,亦不得享有股利之分派及表決權等權利。子公司持有本公司股票視同庫藏股票處理,除不得參與本公司之現金增資及無表決權外,其餘與一般股東權利相同。

十九、稅前淨利

(一) 其他收入

	105年度		104年度	
租金收入	\$	89,304	\$	90,996
利息收入-主係銀行存款		5,160		7,259
股利收入		2,185		353,099
	\$	96,649	\$	451,354
(二) 其他利益(損失)				
	105年度		104年度	
持有供交易之金融工具利益	\$	380,132	\$	1,743,638
指定透過損益按公允價值衡量之金融工具利益		35,824		345,492
處分資產損失	(10,457)	(8,208)
外幣兌換利益(損失)		1,475,545	(750,179)
賠償損失	(13,924)	(604,587)
減損損失	(980,603)	(96,969)
其他		57,268		93,250
	\$	943,785	\$	722,437

(三) 財務成本

	105年度		104年度	丰度	
以攤銷後成本衡量之金融負債之利息費用總額	\$	1,673,913	\$	1,171,258	
減:列入不動產、廠房及設備頂下	(29,642)	(34,510)	
		1,644,271		1,136,748	
其他財務成本		31,886		29,884	
	\$	1,676,157	\$	1,166,632	

105及104年度列入不動產、廠房及設備之利息資本化年利率分別為1.15%~1.28%及0.95%~1.26%。

(四) 折舊及攤銷

	105年度		104年度		
不動產、廠房及設備	\$	15,238,017	\$	14,630,862	
無形資產		193,110		139,065	
合計	\$	15,431,127	\$	14,769,927	
折舊費用依功能別彙總					
營業成本	\$	14,308,325	\$	13,751,129	
營業費用		929,692		879,733	
	\$	15,238,017	\$	14,630,862	
攤銷費用依功能別彙總					
營業成本	\$	78,759	\$	41,471	
營業費用		114,351		97,594	
	\$	193,110	\$	139,065	
(五) 員工福利費用					

	105年度		104年度			
退職後福利(附註十七)						
確定提撥計畫	\$	802,228	\$	788,519		
確定福利計畫		75,228		87,904		
		877,456		876,423		
權益交割之股份基礎給付		209,106		89,768		
薪資、獎金及紅利		21,243,312		19,852,325		
其他員工福利		2,403,353		2,414,150		
員工福利費用合計	\$	24,733,227	\$	23,232,666		
依功能別彙總						
營業成本	\$	17,632,450	\$	16,634,736		
營業費用		7,100,777		6,597,930		
	\$	24,733,227	\$	23,232,666		

依104年5月修正後公司法及105年6月經股東會決議之修正後章程,本公司係按當年度扣除分派員工及董事酬勞前之稅前利 益分別以5.25%~8.25%及0.75%以下提撥員工及董事酬勞。105及104年度係分別按前述稅前利益之8.25%及0.75%估列 員工酬勞及董事酬勞如下:

	105年度		104年度	104年度		
員工酬勞	\$	2,147,323	\$	2,033,500		
董事酬勞		195.211		184,500		

年度個體財務報告通過發布日後若金額仍有變動,則依會計估計變動處理,於次一年度調整入帳。

本公司於105年4月舉行董事會及104年6月舉行股東常會,分別決議通過104年度員工酬勞(以現金配發)及董事酬勞與103年 度員工紅利(以現金配發)及董監事酬勞如下。104年度員工酬勞及董事酬勞已於105年6月召開之股東常會決議修正章程後, 報告股東會。

	104年度		103年度	103年度		
員工酬勞 / 紅利	\$	2,033,800	\$	2,335,600		
董事酬勞/董監事酬勞		140,000		211,200		

上述104年度員工酬勞及董事酬勞及103年度員工紅利及董監事酬勞與前一年度財務報告估列金額之差異分別為44,200千元 及1,330千元,主要係因估計改變,分別調整為105及104年度之損益。

有關本公司董事會及股東會決議之員工酬勞(紅利)及董(監)事酬勞資訊,請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢。 截至105年及104年12月31日止,本公司員工人數分別為29,390人及28,921人。

二十、所得稅

(一) 認列於損益之所得稅主要組成項目

	105年度	104年度
當期所得稅		
當年度產生者	\$ 1,401,891	\$ 1,434,757
未分配盈餘加徵	467,059	561,104
以前年度之調整	68,925	(24,609)
	1,937,875	1,971,252
遞延所得稅		
當年度產生者	122,916	983,227
認列於損益之所得稅費用	\$ 2,060,791	\$ 2,954,479
會計所得與所得稅費用之調節如下:		
	105年度	104年度

	105年度			104年度			
稅前淨利	\$;	23,741,130		\$	22,151,995	
	_						
稅前淨利按法定稅率17%計算之所得稅費用	\$;	4,035,992		\$	3,765,839	
稅上不可減除之費損(加計之所得)	(130,548)			159,332	
暫時性差異之產生及迴轉	(2,145,261)		(1,952,154)	
趸稅所得	(358,292)		(255,528)	
未分配盈餘加徵			467,059			561,104	
所得稅抵減			_		(282,732)	
遞延所得稅淨變動			122,916			983,227	
以前年度所得稅調整			68,925		(24,609)	
認列於損益之所得稅費用	\$	5	2,060,791		\$	2,954,479	

由於106年度股東會盈餘分配情形尚具不確定性,故105年度未分配盈餘加徵10%所得稅之潛在所得稅後果尚無法可靠決 定。

(二) 認列於其他綜合損益之所得稅

	105年度		104年度		
遞延所得稅					
與確定福利計畫再衡量數有關	\$	61,987	(\$	6,751)	

(三) 遞延所得稅資產與負債

遞延所得稅資產及負債之變動如下:

105年度

	年初餘額認列於損益		年初餘額認列於損益		認列於損益		認列於損益		認列於損益		認列於損益		認列於其他綜合損益		認列於損益認列於其他綜合損益		認列於其他綜合損益			年底餘額
遞延所得稅資產(負債)																				
暫時性差異	•																			
不動產、廠房及設備	(\$	3,520,720)	(\$	167,083)	\$	_	(\$	3,687,803)												
確定福利退休計畫		391,230	(23,779)		61,987		429,438												
其他		262,159		67,946				330,105												
	(\$	2,867,331)	(\$	122,916)	\$	61,987	(\$	2,928,260)												

104年度

	年初餘額認列於損益		認列於其他綜合損益		年底餘額		
(\$	2,724,143)	(\$	796,577)	\$	_	(\$	3,520,720)
	382,007		15,974	(6,751)		391,230
	223,032		39,127				262,159
(2,119,104)	(741,476)	(6,751)	(2,867,331)
	241,751	(241,751)		_		_
(\$	1,877,353)	(\$	983,227)	(\$	6,751)	(\$	2,867,331)
	(\$	(\$ 2,724,143) 382,007 223,032 (2,119,104) 241,751	(\$ 2,724,143) (\$ 382,007 223,032 (2,119,104) (241,751 ((\$ 2,724,143) (\$ 796,577) 382,007 15,974 223,032 39,127 (2,119,104) (741,476) 241,751 (241,751)	(\$ 2,724,143) (\$ 796,577) \$ 382,007 15,974 (223,032 39,127 (2,119,104) (741,476) (241,751 (241,751)	(\$ 2,724,143) (\$ 796,577) \$ — 382,007 15,974 (6,751) 223,032 39,127 — (2,119,104) (741,476) (6,751) 241,751 (241,751) —	(\$ 2,724,143) (\$ 796,577) \$ — (\$ 382,007 15,974 (6,751) 223,032 39,127 — (2,119,104) (741,476) (6,751) (241,751) —

(四) 冤稅相關資訊

截至105年12月31日止,下列增資擴展產生之所得可享受5年冤稅:

增資擴展案	
93年增資擴展案	101.01~105.12
94年增資擴展案	101.01~105.12
96年增資擴展案	105.01~109.12
97年增資擴展案	103.01~107.12

(五) 與投資相關之未認列遞延所得稅負債

截至105年及104年12月31日止,與投資子公司相關且未認列為遞延所得稅負債之應課稅暫時性差異分別為8,513,008千元 及7,729,422千元。

(六) 兩稅合一資訊

105年及104年12月31日本公司之未分配盈餘均屬87年度(含)以後產生,股東可扣抵稅額帳戶餘額105年及104年12月31日分別為3,328,374千元及1,913,243千元。

105及104年度盈餘分配適用之稅額扣抵比率分別為9.31%(預計)及9.65%(實際)。

(七) 所得稅核定情形

本公司截至101年度之營利事業所得稅結算申報案件,業經稅捐稽徵機關核定。惟本公司對93至97年度核定内容不服,已 依法提起行政救濟並於104年第2季達成和解。上述相關所得稅影響數已分別估列於核定年度所得稅費用項下。

二一、每股盈餘

用以計算每股盈餘之盈餘及普通股加權平均股數如下:

本年度淨利

	105年度		104年度(調整	整後)
本年度淨利	\$	21,680,339	\$	19,197,516
具稀釋作用潛在普通股之影響				
子公司發行員工認股權憑證	(374,359)	(210,126)
關聯企業潛在普通股之影響	(494,388)		_
轉換公司債	(1,165,506)		901,187
用以計算稀釋每股盈餘之淨利	\$	19,646,086	\$	19,888,577

股數

		單位:干股
	105年度	104年度
用以計算基本每股盈餘之普通股加權平均股數	7,662,870	7,652,773
具稀釋作用潛在普通股之影響		
轉換公司債	515,295	455,671
員工認股權	59,218	86,994
員工酬勞	46,746	54,626
用以計算稀釋每股盈餘之普通股加權平均股數	8,284,129	8,250,064
	<u>-</u>	

本公司得選擇以股票或現金發放員工酬勞,於計算稀釋每股盈餘時,須假設員工酬勞將採發放股票方式,並於該潛在普通 股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數,以計算稀釋每股盈餘。於次年度董事會決議員工酬勞發放股數前計算稀釋 每股盈餘時,亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

二二、 股份基礎給付協議

(一) 員工認股權計畫

本公司為吸引並留任公司所需之專業人才,激勵員工並提昇員工向心力,業經主管機關核准發行5次員工認股權憑證(其中104年4月核准發行100,000千單位),每單位得認購本公司普通股1股,並以等於或不低於給與日當日之普通股股票收盤價為行使價格。該認股權憑證給與對象包含本公司及子公司之全職正式員工,且存續期間為10年,不得轉讓,持有認股權憑證之員工自被給與後屆滿2年才可行使被給與之一定比例之認股權。認股權發行後,遇有本公司普通股股份發生變動時,認股權行使價格依規定公式予以調整。

本公司發行之員工認股權憑證相關資訊如下:

	10)5年度	10	04年度
認股權憑證	單位(千)	加權平均行使價格(元)	單位(千)	加權平均行使價格(元)
年初流通在外	252,607	\$ 26.6	209,745	\$ 20.7
本年度給與	_	-	94,270	36.5
本年度沒收	(6,056)	34.6	(1,975)	30.3
本年度逾期失效	-	-	(730)	11.1
本年度行使	(35,756)	20.9	(48,703)	20.6
年底流通在外	210,795	27.3	252,607	26.6
年底可行使	123,007	20.8	158,103	20.8
本年度給與之認股權加權平均公允價值(元)			7.18~7.39	

105及104年度執行之本公司員工認股權,其於執行日之加權平均股價分別為36.2元及38.8元。

截至資產負債表日止,本公司發行之流通在外之員工認股權憑證相關資訊如下:

	執行價格之範圍(元)	加權平均剩餘合約期限(年)
105年12月31日	20.4~22.6	2.5
	36.5	8.7
104年12月31日	20.4~22.6	3.5
	36.5	9.7

子公司ASE Mauritius Inc.96年12月發行員工認股權憑證,發行條件與本公司相同,並給與本公司員工19,265千單位,105及104年度均無行使。截至105年及104年12月31日止,可行使之員工認股權憑證均為19,265千單位,加權平均行使價格均為美金1.7元。

子公司環誠發行員工認股權憑證之發行條件與本公司相同。環誠於104年12月修改96年度發行之員工認股權憑證辦法,將存續期間自12年再延長為13年。環誠給與本公司員工20,718千單位,相關資訊如下:

	10)5年度	10)4年度
認股權憑證	單位(千)	加權平均行使價格(元)	單位(千)	加權平均行使價格(元)
年初流通在外	18,658	\$ 2.1	20,135	\$ 2.1
本年度沒收	_	_	(19)	2.8
本年度行使	(1,547)	2.0	(1,803)	1.9
子公司移轉	375	1.8	345	2.8
年底流通在外	17,486	2.1	18,658	2.1
年底可行使	17,486	2.1	18,239	2.1

(二) 認股權公允價值資訊

本公司104年度發行之員工認股權憑證係採用Hull & White(2004)結合Ritchken(1995)三項樹模型以估計給與日認股權憑證之公允價值,評價模型所採用之參數分別如下:

	本公司
	36.5元
行使價格	36.5元
預期股價波動率	27.02%
合約期間	10年
預期股利率	4.00%
無風險利率	1.34%

預期股價波動率係基於本公司過去10年歷史股票價格波動情形,且在Hull & White(2004)結合Ritchken(1995)三項樹模型下,為將提早執行之效果納入考量,係假設於既得期間屆滿後之股票價格為行使價格1.88倍時,員工將執行認股權。105及104年度本公司及子公司合計認列之員工認股權之酬勞成本分別為470,788千元及133,496千元。

二三、 非現金交易

本公司於105及104年度進行下列非現金交易之投資活動:

	105年度		104年度	Ę
同時影響現金及非現金項目之投資活動				_
不動產、廠房及設備增加數	\$	14,957,292	\$	17,651,585
支付之資本化利息	(29,642)	(34,510)
預付設備款(列入其他非流動資產項下)增加(減少)	(61,181)		30,488
其他應付款減少		211,303		557,049
其他應付款項-關係人增加	(131,831)	(98,002)
支付現金數	\$	14,945,941	\$	18,106,610

	105年度		104年	度	
出售不動產、廠房及設備價款	\$	818,873	5	5	180,846
其他應收款(含關係人)減少(增加)		74,431			65,870)
收取現金數	\$	893,304	9	5	114,976
			_		
其他無形資產增加數	\$	557,680	Ş	6	308,562
其他應付款-關係人增加	(120,938)			_
長期應付款-關係人增加	(40,312)	_		
支付現金數	\$	396,430	5	5	308,562

二四、營業租賃協議

本公司高雄廠之廠房用地係向政府租用,其租期將陸續於124年6月底前屆滿。租期屆滿時得予續約,但政府得於該土地公告地價增高時調整租金,並得於若干條件下終止租約。此外本公司亦簽有建築物及機器設備之營業租賃合約。

105及104年度認列之租金費用分別為446,879千元及604,360千元。

二五、 資本風險管理

本公司資本結構係由淨債務及權益組成,而資本管理的目標是保障本公司能夠持續經營,並進而藉由將債務及權益餘額最適化,以使股東報酬極大化,是以定期檢視內容包括考量各類資本之成本及相關風險,並藉由支付股利、發行新股、買回股份及發行新債或償付舊債等方式平衡其整體資本結構。

除附註十四所述外,本公司尚無須遵循之其他外部資本規定。

二六、金融工具

(一) 公允價值之資訊 – 非按公允價值衡量之金融工具

1. 帳面金額與公允價值有重大差異之金融負債

除以攤銷後成本衡量之應付公司債外,本公司管理階層認為非按公允價值衡量之金融資產及金融負債之帳面金額趨近 其公允價值。105年及104年12月31日應付公司債外之帳面金額及公允價值如下:

資產負債表日	帳面金額	公允價值
105年12月31日	\$ 27,341,557	\$ 27,655,942
104年12月31日	26.101.086	26.507.124

2. 公允價值衡量層級

上述應付公司債之公允價值屬第3等級公允價值衡量,係按現金流量折現分析或最近一次交易價格決定之。

(二) 公允價值資訊 - 按公允價值衡量之金融工具

1. 公允價值層級

105年12月31日

	第1等級		第2等級		第3等級		合計	
透過損益按公允價值衡量之金融資產								
指定透過損益按公允價值衡量之金融資產								
私募可轉換公司債	\$	-	\$	100,583	\$	_	\$	100,583
衍生金融資產								
換匯合約		-		435,418		_		435,418
遠期外匯合約				64,945				64,945
合計	\$		\$	600,946	\$		\$	600,946

	第1等級		第2等級	第3等級	合計
備供出售金融資產				 	
有限合夥	\$	_	\$ _	\$ 219,921	\$ 219,921
非上市(櫃)公司股票		-	_	65,438	65,438
合計	\$	_	\$ 	\$ 285,359	\$ 285,359
透過損益按公允價值衡量之金融負債					
衍生金融負債					
可轉換公司債轉換、贖回與賣回權	\$	_	\$ 1,213,890	\$ _	\$ 1,213,890
換匯合約		_	301,734	_	301,734
遠期外匯合約		_	35,053	_	35,053
合計	\$	_	\$ 1,550,677	\$ _	\$ 1,550,677
104年12月31日					
	第1等級		第2等級	第3等級	合計
透過損益按公允價值衡量之金融資產					
指定透過損益按公允價值衡量之金融資產					
私募可轉換公司債	\$	-	\$ 100,500	\$ _	\$ 100,500
衍生金融資產					
換匯合約		-	1,389,931	_	1,389,931
遠期外匯合約		-	7,745	-	7,745
外幣選擇權合約		_	5,020		5,020
合計	\$	_	\$ 1,503,196	\$ 	\$ 1,503,196
備供出售金融資產					
有限合夥	\$	_	\$ _	\$ 390,987	\$ 390,987
非上市(櫃)公司股票		_	_	82,120	82,120
合計	\$	_	\$ _	\$ 473,107	\$ 473,107
透過損益按公允價值衡量之金融負債					
衍生金融負債					
可轉換公司債轉換、贖回與賣回權	\$	_	\$ 2,632,565	\$ _	\$ 2,632,565
遠期外匯合約		_	22,045	-	22,045

105及104年度尚無第1等級與第2等級公允價值衡量間移轉之情形。

2. 金融資產以第3等級公允價值衡量之調節

換匯合約

合計

利率交換合約

本公司以第3等級公允價值衡量之金融資產,係列入備供出售金融資產-非流動項下之無公開報價之權益工具投資, 105及104年度之調節如下:

14,876

2,669,605

14,876

119 2,669,605

105年度		104年度	
\$	473,107	\$	542,147
	_		1,322
(33,971)	(34,203)
(90,000)		_
(63,777)	(36,166)
\$	285,359	\$	473,100
	\$ (((\$ 473,107 — (33,971) (90,000) (63,777)	\$ 473,107

3. 衡量公允價值所採用之評價技術及假設

(1) 第2等級公允價值衡量之評價技術及輸入值

全融工目粨则

衍生工具-換匯合約、遠期外匯合約、外幣選擇權合約	現金流量折現法:按資產負債表日之可觀察遠期匯率或利率及合約所訂匯率或利率估計未來現金
及利率交換合約	流量,並以可反映各交易對方信用風險之折現率分別折現。
衍生工具-可轉換公司債轉換、贖回與賣回權	選擇權定價模式:納入現值技術並反映選擇權之時間價值及內含價值。
私募可轉換公司債	現金流量折現法:按資產負債表日之可觀察股價,及合約所訂之轉換價格估計未來現金流量,並
	以可反映各交易對方信用風險之折現率分別折現。

虾槽坊街及榆入值

(2) 第3等級公允價值衡量之評價技術及輸入值

無活絡市場之非上市(櫃)公司股票係以市場法估計公允價值,其判定係參考公司近期籌資活動、技術發展情形、同種類公司評價、市場狀況及其他經濟指標等。

有限合夥投資係依預計處分價款減除處分成本後之未來現金流量估計公允價值。105年度並認列90,000千元之減損損失,列入個體綜合損益表之其他利益(損失)項下。

(三) 金融工具之種類

	105年12月31日	104年12月31日
金融資產		
透過損益按公允價值衡量		
指定透過損益按公允價值衡量	\$ 100,583	\$ 100,500
持有供交易	500,363	1,402,696
備供出售金融資產	285,359	473,107
放款及應收款(註1)	24,474,509	26,584,110
金融負債		
透過損益按公允價值衡量		
持有供交易	1,550,677	2,669,605
以攤銷後成本衡量(註2)	145,127,983	137,574,859

註1:餘額係包含現金、應收帳款(含關係人)、其他應收款(含關係人)、其他金融資產等以攤銷後成本衡量之放款及應收款。

(四) 財務風險管理目的與政策

本公司從事衍生商品交易之經營避險策略,主要係以確保公司穩健、安全經營為原則。從事衍生性金融商品交易時,應依其交易目的區分為「避險性」及「非避險性」兩種交易,除依規定分別適用不同部位限制外,以避險為目的之交易其商品的選擇應以規避本公司業務經營所產生之收入、支出、資產或負債等風險為主,持有之幣別必須與公司實際進出口交易之外幣需求相符。

風險管理部門係為專責監督風險以減輕暴險之單位,每月就持有部位、交易餘額及損益狀況對財務長提出報告。

1. 市場風險

本公司之營運活動使本公司承擔之主要財務風險為外幣匯率變動風險以及利率變動風險。從事各式衍生金融工具以管理所承擔之外幣匯率及利率風險,因此匯率變動產生之損益大致會與被避險項目之損益相抵銷,而利率風險亦因預期之資金成本已固定,故市場價格風險並不重大。

本公司有關金融工具市場風險之暴險及其對該等暴險之管理與衡量方式並無改變。

(1) 匯率風險

本公司從事外幣計價之進銷貨交易及融資活動,因而產生匯率變動暴險。為避免因匯率變動造成外幣資產或負債價值波動,本公司使用衍生金融工具來規避匯率風險。此類衍生金融工具之使用,可協助本公司減少但仍無法完全排除外幣匯率變動所造成之影響。

本公司於資產負債表日具重大影響之非功能性貨幣計價之資產及負債,以及具匯率風險暴險之衍生工具外幣合約金額,參閱附註三十。

註2:餘額係包含短期借款、應付短期票券、應付帳款(含關係人)、其他應付款(含關係人)、應付公司債、長期借款及長期應付款-關係人等以攤銷後成本衡量之金融負債。

本公司主要受到美金及日幣兌新台幣匯率波動之影響。本公司内部向主要管理階層報告匯率風險時所使用之敏感度 比率為1%,敏感度分析之範圍包括主要之金融資產及金融負債。當資產負債表日美金及日幣兌新台幣變動1%時, 105及104年度稅前淨利影響數將分別約為9,000千元及35,000千元。上述稅前淨利影響數業已考量避險合約及被避 險項目之影響,惟資產負債表日之外幣暴險無法反映年中暴險情形。

(2) 利率風險

本公司除發行固定利率之公司債及舉借固定利率之借款外,主係以浮動利率借入資金,因而產生利率暴險,市場利率變動將使借款之有效利率隨之變動,而產生未來現金流量之波動。

本公司於資產負債表日受利率暴險之金融資產及金融負債帳面金額如下:

	105年12月31日	3	104年12月31日	
具公允價值利率風險				
金融負債	\$	30,046,527	\$	7,981,190
具現金流量利率風險				
金融資產		3,338,179		8,710,362
金融負債		93,703,942		75,431,163

對於浮動利率之資產及負債,本公司內部向主要管理階層報告利率風險時所使用之變動率為100個基點,若資產負債表日利率變動100個基點(1%),在所有其他變數維持不變之情況下,本公司105及104年度之稅前淨利將分別增減約904,000千元及677,000千元。

(3) 其他價格風險

本公司持有備供出售金融資產受權益價格暴險之影響。若資產負債表日權益價格變動1%,105及104年度稅前其他 綜合損益將分別增減約2,900千元及4,700千元。

此外,本公司發行於海外無擔保轉換公司債亦受本公司股票價格暴險之影響。本公司向主要管理階層報告價格風險時所使用之敏感度比率為7%。若資產負債表日本公司股票價格增加或減少7%,105及104年度稅前淨利將分別減少約510,000千元及605,000千元或分別增加約445,000千元及638,000千元。

2. 信用風險

信用風險係指交易對方拖欠合約義務而造成本公司財務損失之風險。本公司之信用風險,主要係來自於現金、應收款項及其他金融資產等。最大之信用風險暴險與個體資產負債表上之金融資產帳面價值相同。

本公司主係與信譽卓著之對象進行交易,並訂有授信政策及應收帳款管理程序以確保應收款項之回收及評價。另交易 對象涵蓋衆多客戶及銀行,除附註九所述外,並無重大集中的信用暴險。

3. 流動性風險

本公司透過管理適當之營運資金及融資額度以支應公司營運及資本支出之現金流量需求,另本公司流動負債之部分債權人為本公司之子公司,是以無被要求立即清償之風險,且本公司亦監督銀行融資額度使用狀況並確保借款合約條款之遵循,故未有因無法籌措資金以履行合約義務之流動性風險。

本公司可被要求立即清償之金融負債,係列於下表中最早之期間內,不考慮交易對手立即執行該權利之機率;其他非衍生金融負債到期分析係依照約定之還款日編製。

以浮動利率支付之利息現金流量,其未折現之利息金額係依據資產負債表日之利率做為估計未來利息現金流量之基礎。

105年12月31日

	要求即	D付或短於1個月	1至3個月	3個月至1年	1至5年	超過5年
非衍生金融負債						
無附息負債	\$	8,780,041	\$ 8,318,457	\$ 1,039,075	\$ 40,313	\$ _
浮動利率工具		6,195,585	3,814,760	44,311,908	40,723,862	-
固定利率工具		126,695	 8,312	41,697	28,548,527	 2,062,500
	\$	15,102,321	\$ 12,141,529	\$ 45,392,680	\$ 69,312,702	\$ 2,062,500

104年12月31日

	要求即位	付或短於1個月	1至3個月		3個月至1年		1至5年		超過5年
非衍生金融負債									
無附息負債	\$	7,500,676	\$	7,819,035	\$	144,065	\$	_	\$ _
浮動利率工具		1,745,677		39,953,192		2,415,098		32,227,631	_
固定利率工具		12,344,873		3,028		27,535,656		3,830,690	
	\$	21,591,226	\$	47,775,255	\$	30,094,819	\$	36,058,321	\$

上述非衍生金融資產及負債之浮動利率工具金額,將因浮動利率與資產負債表日所估計之利率不同而改變。

下表詳細說明本公司針對衍生金融工具所作之流動性分析,就採淨額交割之衍生性金融工具,係以未折現之合約淨現金流入及流出為基礎編製:就採總額交割之衍生性金融工具,係以未折現之總現金流入及流出為基礎編製。當應付或應收金額不固定時,揭露之金額係依資產負債表日殖利率曲線所推估之預計利率決定。

105年12月31日

	要求	即付或短於1個月	1至3個月		於1個月 1至3個月 3個月			3個月至1年
淨額交割	'							
遠期外匯合約	\$	22,680	\$	18,720	\$			
總額交割								
遠期外匯合約								
流入	\$	1,283,615	\$	_	\$	_		
流出	(1,299,075)						
	(15,460)						
換匯合約								
流入		3,386,250		14,977,720		41,602,500		
流出	(3,471,940)	(14,989,214)	(40,984,881)		
	(85,690)	(11,494)		617,619		
	(\$	101,150)	(\$	11,494)	\$	617,619		

104年12月31日

	要求即	要求即付或短於1個月		1至3個月	3個月至1年		
淨額交割							
遠期外匯合約	(\$	23)	\$	75	\$	_	
外幣選擇權		_		8,735		_	
	(\$	23)	\$	8,810	\$	_	
總額交割							
遠期外匯合約							
流入	\$	467,241	\$	_	\$	_	
流出	(459,550)				_	
		7,691				_	
換匯合約							
流入		7,250,361		17,601,055		34,597,550	
流出	(7,037,259)	(17,173,087)	(33,627,250)	
		213,102		427,968		970,300	

	_	要求即付或短於1個月	1至3個月	3個月至1年
利率交換				
流入	\$	12,603	\$ 12,466	\$ 25,069
流出	(11,595)	(11,469)	(23,063)
	<u> </u>	1,008	997	2,006
	\$	221,801	\$ 428,965	\$ 972,306

二七、 關係人交易

本公司與關係人間之重大交易如下:

(一) 營業收入

關係人類別	105年度	104年度
子公司	\$ 4,909,617	\$ 9,394,518
合資	131	
	\$ 4,909,748	\$ 9,394,518

(二) 進貨

關係人類別	105年度		104年度	
子公司	\$	4,657,395	\$ 3,	374,644
合資		1,274		57
	\$	4,658,669	\$ 3,	374,701

公司與關係人之交易條件與一般廠商及客戶相當,收付款條件主係月結60天。關係人交易產生之未實現銷貨毛利業已銷除。

(三) 應收關係人款項

帳列項目	關係人類別	105年12月31日		104年12月31日	
應收帳款-關係人	子公司	\$	1,760,017	\$	2,281,805
	合資		133		-
		\$	1,760,150	\$	2,281,805
其他應收款-關係人	子公司	\$	45,515	\$	154,363
	合資		15,904		6,717
		\$	61,419	\$	161,080

應收關係人款項末收取保證。105年及104年12月31日之應收關係人款項並未提列呆帳費用。

(四) 應付關係人款項(不含向關係人借款)

帳列項目	關係人類別	105年12月31日		104年12月31日	
應付帳款-關係人		\$	1,027,410	\$	910,150
	合資				61
		\$	1,027,410	\$	910,211
其他應付款-關係人	子公司	\$	2,117,736	\$	1,912,834
	關聯企業		352,705		41,245
		\$	2,470,441	\$	1,954,079
長期應付款-關係人	關聯企業	\$	40,313	\$	

流通在外之應付關係人款項餘額係未提供擔保且將以現金清償之貨款、設備款及代收款等。

(五) 取得之不動產、廠房及設備

	取得價款					
關係人類別	105年度	104年度	₹.			
子公司	\$ 1,7	.332,519 \$	180,658			
關聯企業		370,400	2,970,600			
	\$ 1,	,702,919 \$	3,151,258			

(六) 處分不動產、廠房及設備

		105年度				104年度		
	關係人類別	 處分價款				處分價款		處分利益
子公司		\$ 567,831	\$	2,873	\$	142,442	\$	922
合資		 4,633						
		\$ 572,464	\$	2,873	\$	142,442	\$	922

(七)取得其他資產-僅105年度

關係人類別	帳列項目	取得價款			
關聯企業	其他無形資產	\$ 300,797			

(八) 向關係人借款

關係人類別	105年12月31日	104年12月31日		
子公司	\$ 43,821,275	\$ 38,237,875		

本公司向關係人借款之借款利率與市場利率相當。

(九) 背書保證

關係人類別	105年12月31日	104年12月31日		
子公司	\$ 9,880,594	\$ 12,900,154		

(十) 其他關係人交易

帳列項目	關係人類別	105年度		104年度	
服務費支出	子公司	\$	999,187	\$	921,269
捐贈	實質關係人		100,000		100,000
		\$	1,099,187	\$	1,021,269
(十一) 對主要管理階層	層之薪酬	10-F		40.4TE	
		105年度		104年度	
短期員工福利		\$	508,496	\$	531,847
退職後福利			1,080		1,017
股份基礎給付			508		10,368
		\$	510,084	\$	543,232

董事及其他主要管理階層之薪酬係依照個人績效及市場趨勢決定。

二八、質抵押之資產

除附註九所述外,本公司105年及104年12月31日分別提供定期存單181,757千元及181,796千元作為進口原物料之關稅擔保及雇用外籍勞工之保證金。

二九、 重大或有負債及未認列之合約承諾

除已於其他附註所述者外,本公司於資產負債表日之重大承諾事項及或有事項如下:

(一) 重大承諾

- 1. 截至105年及104年12月31日止,本公司已承諾購置之不動產、廠房及設備金額約4,872,981千元及5,781,000千元,其中已支付金額為363,850千元及1,369,971千元。
- 2. 本公司為善盡環境保護之社會責任,於102年12月經董事會決議通過預計未來將捐獻每年至少1億元、至少30年、總金額至少30億元以推動台灣環保相關工作。

本公司於106年1月經董事會決議提撥100,000千元交由財團法人日月光文教基金會繼續執行環保相關捐贈作業,以持續協助國内環保相關工作之推動及公益活動。

(二) 不可取消之營業租賃承諾未來給付總額

	105年12月31日	
1年内	\$ 12	24,863
超過1年但未超過5年	18	31,099
超過5年	18	34,763
	\$ 49	90,725

三十、具重大影響之外幣資產及負債資訊

本公司具重大影響之外幣金融資產及負債資訊如下:

	外幣	匯率		帳面金額
105年12月31日				
貨幣性金融資產				
美金	\$ 2,554,333	USD1=NTD32.25	\$	82,377,239
日幣	4,907,209	JPY1=NTD0.2756		1,352,427

	外幣		外幣 匯率	
貨幣性金融負債				
美金	\$	2,574,249	USD1=NTD32.25	\$ 83,019,530
日幣		5,724,908	JPY1=NTD0.2756	1,577,785
104年12月31日				
貨幣性金融資產				
美金		2,407,360	USD1=NTD32.825	79,021,592
日幣		3,285,728	JPY1=NTD0.2727	896,018
貨幣性金融負債				
美金		2,512,262	USD1=NTD32.825	82,465,000
日幣		3,606,237	JPY1=NTD0.2727	983,421

具重大影響之外幣未實現兌換損益如下:

	105	105年度			104年度			
外幣	匯率		淨兌換利益	匯率		淨兌換損失		
美金	USD1=NTD32.25	\$	387,428	USD1=NTD32.825	(\$	2,279,778)		
日幣	JPY1=NTD0.2756		83,850	JPY1=NTD0.2727	(6,981)		
		\$	471,278		(\$	2,286,759)		

三一、其他

- (一)本公司於104年11月收到臺灣高雄地方法院所送達之起訴書狀,係矽品訴請法院確認本公司請求於矽品股東名簿記載 為股東之請求權不存在。因矽品未於期限内補正裁判費,臺灣高雄地方法院已依法於105年6月27日裁定駁回本件訴 訟,故對本公司財務狀況及財務績效並無重大影響。
- (二) 高雄市政府環境保護局(以下稱「環保局」)於102年12月20日以本公司違反水污染防治法科處本公司102,014千元之罰鍰(以下稱「罰鍰處分」)。嗣本公司對該罰鍰處分提起訴願並於訴願遭高雄市政府駁回後依法向高雄高等行政法院提起行政訴訟,請求撤銷訴願決定與該罰鍰處分並請求環保局返還本公司已繳交之罰鍰。高雄高等行政法院審理後於105年3月22日判決訴願決定及該罰鍰處分均撤銷,原告其餘之訴(即請求返還罰鍰之部分)駁回。本公司已於105年4月14日針對該判決不利於本公司之部分提出上訴,案件現由最高行政法院審理中。另因前述事件,高雄地方法院檢察署於103年1月間依違反廢棄物清理法等法對本公司提起公訴並經高雄地方法院以本公司違反廢棄物清理法第47條規定判處3,000千元罰金。嗣經本公司依法提出上訴後,高雄高等法院業於104年9月29日判決本公司無罪確定。
- (三)本公司為半導體產業之未來發展及永續經營,於105年6月經董事會通過與矽品簽署共同轉換股份協議,將由本公司申請設立日月光投資控股公司,並與矽品共同以股份轉換方式由日月光投資控股公司取得本公司與矽品100%股權。股份轉換對價係以本公司每1股普通股換發日月光投資控股公司普通股0.5股,及矽品每1股普通股換發現金新台幣55元(矽品分派105年度盈餘後調整為新台幣51.2元)。

截至本個體財務報告通過發布日止,股份轉換案尚未完成。依共同轉換股份協議約定,股份轉換案須待全部先決條件 (包括本公司及矽品股東會之核准、取得相關主管機關就本交易所為之核准或同意等)均成就(或被冤除)始得完成。除經本公司及矽品另行協議,若上述條件於106年12月31日前無法成就或被冤除,此協議將自動終止。

另因上述共同轉換股份協議,本公司持有之庫藏股及已發行具股權性質之轉換公司債處理原則如下:

1. 本公司發行之海外第三次無擔保轉換公司債尚流通在外者,除於股份轉換基準日前經贖回、購回並經註銷或債券持有人行使轉換權利情況外,持有人於本公司取具相關主管機關核准後,得依相關法令、該海外無擔保轉換公司債受 託契約約定以及換股比例,於股份轉換基準日後轉換為日月光投資控股公司新發行之普通股。

- 2. 本公司為配合發行海外第四次無擔保轉換公司債,於股份轉換基準日前已買回供轉換之庫藏股,將依換股比例轉換 為日月光投資控股公司股份並由本公司繼續持有,並將依股份轉換協議所訂之換股比例調整該海外無擔保轉換公司 之轉換價格。
- 3. 本公司於共同轉換股份協議簽署前,業經主管機關核准所發行之認股權憑證,於股份轉換基準日起,將由日月光投資控股公司承受本公司之履行義務,除執行價格及數量應依共同轉換股份協議之換股比例調整且履約之執行標的改為日月光投資控股公司之普通股新股外,其餘發行條件與原發行條件相同,惟具體執行方式則由日月光投資控股公司依相關法令規定及主管機關之核示辦理。

三二、 附註揭露事項

(一) 重大交易事項及(二)轉投資事業相關資訊:

- 1. 資金貸與他人:詳附表一。
- 2. 為他人背書保證:詳附表二。
- 3. 年底持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資部分):詳附表三。
- 4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達3億元或實收資本額20%以上:詳附表四。
- 5. 取得不動產之金額達3億元或實收資本額20%以上:詳附表五。
- 6. 處分不動產之金額達3億元或實收資本額20%以上:無。
- 7. 與關係人進、銷貨之金額達1億元或實收資本額20%以上:詳附表六。
- 8. 應收關係人款項達1億元或實收資本額20%以上:詳附表七。
- 9. 從事衍生工具交易:詳附註七。
- 10. 被投資公司資訊(對非屬大陸地區之被投資公司直接或間接具重大影響、控制或合資權益者): 詳附表八。

(三) 大陸投資資訊

- 1. 大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入情形、持股比例、本年度損益及認列之投資損益、年底投資帳面金額、已匯回投資損益及赴大陸地區投資限額:無。
- 2. 與大陸被投資公司直接或間接經由第三地區所發生下列之重大交易事項,及其價格、付款條件、未實現損益:
 - (1) 進貨金額及百分比與相關應付款項之年底餘額及百分比:無
 - (2) 銷貨金額及百分比與相關應收款項之年底餘額及百分比:無。
 - (3) 財產交易金額及其所產生之損益數額:無重大交易。
 - (4) 票據背書保證或提供擔保品之年底餘額及其目的:無。
 - (5) 資金融通之最高餘額、年底餘額、利率區間及當年度利息總額:無。
 - (6) 其他對當年度損益或財務狀況有重大影響之交易事項,如勞務之提供或收受等:無。

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,發生財務週轉困難之情事:無。

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況:最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響,若影響重大者應 說明未來因應計畫。

最近二年度資產、負債及股東權益未發生重大變動,故免分析變動原因。

二、財務績效:最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與 其依據,對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫。

營業外收入及支出:營業外收入增加,主要係本年度依持股比例認列轉投資公司之投資收益較去年度增加所致。

三、現金流量:最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性 分析。

(一) 最近年度現金流量分析

最近二年度現金流量比率增減變動均未達20%以上,故未予以分析。

(二) 未來一年現金流動性分析

單位:新台幣仟元

年初現金餘額①	預計全年來自營業活動	預計全年現金流出量③	預計現金剩餘(不足)數額	預計現金不足	額之補救措施
中初 坑亚际镇(1)	淨現金流量②		1+2-3	投資計劃	理財計劃
\$38,392,524	\$49,662,256	\$58,278,420	\$29,776,360	-	-

^{1.} 現金流量變動情形分析

- (1) 營業活動:預計106年度主係營業淨利增加、營業資產及負債淨變動所產生之淨現金流入增加所致。
- (2) 投資活動:預計106年度主係購置機器設備及擴建廠房。
- (3) 融資活動:預計106年度主係發行國内公司債、現金增資及支付盈餘分配。
- 2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析:不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響:

(一) 重大資本支出之運用情形及資金來源

單位:新台幣仟元

計劃項目	實際或預期之資金來源	實際或預期完工日期	所需資金總額	實際或預定資金運用情形	
口 則 次 口	貝际以识别と貝亚木脈	貝际以供别元工口别	门而真亚秘识	一〇六年度	
擴建廠房	營運資金及銀行借款	106.12	5,318,467	5,318,467	
購置機器設備	營運資金及銀行借款	106.12	24,157,948	24,157,948	

本公司截至目前為止對於未來二至五年之資本支出及預計可能產生效益情況尚無法合理估計。

(二)預計可能產生效益

A. 預計將增加之產銷量、値及毛利

單位:數量仟個/新台幣仟元

年度	項目	生產量	銷售量	銷售額	毛利
一〇六	半導體製造封裝	1,966,231	1,953,293	5,727,483	1,514,052
一○六	半導體製造測試	(註二)	(註二)	794,734	149,806

註一:僅針對一〇六年度重大之資本支出於一〇六年度預計產生之效益估算。有關EMS部分,因資本支出比重較小及產業特性難以預估,故未列入。

B. 其他效益說明:無。

註二:係以測試時間為計價基礎,故無法揭露數量。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫:

本公司最近年度之轉投資政策主要係以核心競爭力為主要考量,對每一投資案皆經審慎評估後為之。

本公司轉投資事業獲利,主因為轉投資事業之生產營運達經濟規模及管理制度落實,虧損主因為轉投資事業產能不足於未達經濟規模下造成虧損及處於發展擴充階段之故,本公司將持續輔導以加速達到獲利目標。

六、風險事項分析評估:

(一) 最近年度及截至年報刊印日止之利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施:

1. 利率變動:本公司及子公司因應營運活動所需之現金部位,均已做適當的彈性調度調整,公司損益受利率變動衝擊之影響甚小。

未來仍將密切注意利率走勢,運用低利率之融資工具,採用有利之利率條件,以維持低融資成本及適足活絡之融資額度為主,規避營運上可能產生之利率風險。

2. 匯率變動:本公司及子公司之避險策略係採取自然避險為原則,配置低風險、安全且避險性高之投資標的,公司損益並無受匯率變動影響之疑慮。

未來將關注國際經濟事件及匯率變化,並以降低匯率變動風險為主要管理方向,同時亦審慎檢視公司資金配置,因 應匯率變動造成之影響,期達有效管理之目標。

3. 通貨膨脹情形: 本公司及子公司未有因通貨膨脹而對損益產生重大影響之情事。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施:

本公司及子公司均採取穩健保守操作策略,並未從事高風險、高槓桿之投資。本公司已依據證期局相關法令及規定, 訂定以健全財務及營運為基礎的內部管理辦法及作業程序,包括「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」 及「取得或處分資產處理程序」。

未來公司仍將嚴恪遵守程序規範,所有交易均依相關規定辦理。

(三) 未來研發計畫及預計投入之進度與研發費用:

1. 未來研發計劃(包括正在進行中)

封裝技術

	新技術(Advanced Technology)
	1. 晶片-晶片、晶片-晶圓堆疊技術(Die-to-Die,Die-to-Wafer Stacking)
	2. 微間距銅柱覆晶封裝技術(Fine Pitch Cu Pillar FC Solution)
	3. 矽光子系統封裝技術(Si Photonic SiP Technology)
	4. 矽材光基板系統封裝技術(Si Optical Bench SiPTechnology)
	5. 熱壓融接技術(Thermo-Compression Bonding Technology)
	6. 晶圓級微機電封裝(Wafer Level MEMS Packaging)
	7. 内引腳式Map PoP堆疊技術PoP(Fan-in Map PoPTechnology)
3D系統封裝	8. 外引腳式Map PoP堆疊技術PoP(Fan-out Map PoP Technology)
(3D SiP)	9. 薄基板核層覆晶PoP堆疊技術(Thin Core FC PoP Technology)
	10. 整合被動元件封裝技術(Integrated Passive Device)
	11. 基板内埋被動元件技術(Embedded Passives Laminate Substrate)
	12. 異質晶片整合系統封裝(Heterogeneous Chip Integration SiP)
	13. 微間距面對面堆疊系統封裝(Fine Pitch CoC SiP Solution)
	14. 2.nD微間距基板晶片堆疊封裝(2.nD Fine Line/Space Substrate Stacking)
	15. 大板面外引腳式晶圓級封裝(Panel Level Fan-out/PoPTechnology)
	16. 2.5D封膠技術方案(2.5D Molding Solution)

	1. 高功率、高亮度LED封裝方案(High Power/High Brightness LED Packaging Solution)
	2. 晶圓級白光LED封裝方案(Wafer Level White Light LED Packaging Solution)
	3. 光感測元件封裝技術(Optical Sensor Packaging Solution)
	4. 光電整合傳導技術(Optical-Electronic Interconnection)
	5. 300mm二維外引腳式晶圓級封裝(300mm Wafer 2D Fan-out WLP)
	6. 200mm三維外引腳式晶圓級封裝(200 mm Wafer 3D Fan-out WLP)
	7. 細線RDL電鍍銅技術(Fine Line Cu-Plated RDLTechnology)
光電封裝	8. 4層Polymer晶圓RDL電鍍銅技術(4-layer Polymer,Cu-Plated RDL Technology)
(OEP)	9. 低溫烘烤型Polymer 晶圓RDL電銀銅技術(Low Temperature Cure Polymer,Cu-Plated RDL Technology)
	10. 晶圓級封裝切割再測試專案(Sawn Wafer Probing)
	11. 多腳數/微型化之晶圓級晶片尺寸封裝產品技術開發計畫(High IO/Die Shrinkage WLCSP)
	12. 晶背貼合材料技術開發(IR Through BSL)
	13. 線路重部製程與保護層疊層技術開發
	14. 線路重佈製程線寬線距5um/5um技術開發
	15. 薄片晶背貼合能力技術開發
	16. 降低切割製成風險技術開發
	1. 面板級外引腳式Chip First封裝(Panel Fan out Chip First Packaging 300x300, 450x450, 600x600mm)
(Large Panel Fan out Package)	2. 面板級外引腳式Chip Last封裝(Panel Fan out Chip Last Packaging 300x300mm)
	1. 無核心層機板之覆晶封裝(Coreless Flip Chip Package)
	2. 20奈米超低介電係數晶圓之無鉛覆晶封裝(20 nm ELK Wafer Lead-Free FC)
	3. 300mm晶圓穿導孔晶圓50微米厚度CMP研磨技術(300mmTSV Wafer 50 um CMPTechnology)
	4. 超低介電常數薄晶圓之隱匿式雷射切割技術(SD Laser Technology on Thin ELK Wafer)
	核心扱入式封膠製程封裝(Molded Core Embedded Package)
覆晶封裝	7. 裸露晶體封裝(Exposed Mold UnderFill)
(Flip Chip)	
	8. 四方平面無引腳覆晶封裝(Flip Chip Quad Flat No Leads)
	9. 覆晶封装產品之極微距銅柱距離(Very Fine Pitch Cu Pillar Flip Chip Product)
	10. 高頻寬封裝堆疊技術開發(HBPOP Package Development)
	11. 銅凸塊於內埋式線路基板之開發應用(16奈米以下之覆晶封裝技術)
	12. 高階覆晶封裝型四方平面無引腳構裝開發計畫(FC QFN Development)
	13. 單層板内嵌式線路基版封裝研發(1L ETS(1 Layer Embeded Trace Substrate) Assembly)
	1. MCU+BLE+ AoP模組完整方案(MCU Wireless Connection Module Total Solution)
射頻模組	2. 非圓柱覆晶式多模多頻射頻前端模組完整方案(Irregular FC Cu-Pillar Multi-Band Multi-Mode SiP Module Solution)
(RF Module)	3. 基板内埋被動元件通訊模組(Embedded Passive Substrate Wireless Module)
	4. 低頻分段式屏蔽技術(Compartment Shielding Technology)
	5. 毫米波無線通訊模組(mmWave Module)
	1. 14奈米銅製程/超低介電係數晶圓之銲線封裝(14 nm Cu/ELK Wafer Wire Bond Solution)
	2. 15微米銅線製程開發(15 um Cu Wire Bond Technology Development)
	3. 新銅線材料製程開發(New Cu Wire Bonding Material Technology Development)
	4. 新打線材料製程開發(New Wire Bonding Material Technology Development)
銲線封裝 (/A/ira Band Bankaga)	5. 低成本、高效能aS3/aQFN封裝方案(Low Cost & High Performance aS3/aQFN)
(Wire Bond Package)	6. 先進單層板的封裝技術開發(Single Layer Carrier Package Development)
	7. 四方平面無引腳產品於車用領域之應用(FC QFN For ATV Development)
	8. 高散熱材料評估(High Thermal_HS Evaluation)
	9. 被動元件應用研發(Cap on Die)
	Company Comment of the Company Comment of Company Comment of Com

	1. 整合BB+RF(Multi-Bands)+DRAM+PMIC以及周邊被動元件複合式封裝SiP模組,偕同最新複合無線通訊技術通訊規格			
	(Multiple Mode Communication SiP Module Solution)			
無線通訊模組	2. 超微小型高整合封裝功能模組(Highly Miniaturized and Integrated SiP Communication Function Module Solution)			
(Wireless Communication SiP	. 低功耗4G通訊SiP封裝模組(LTE Cat.M Modem SiP Module)			
Module)	可彎曲基板及封裝技術(Flexible Substrate & Assembly Technology)			
	5. 低功耗藍芽天線設計與封裝技術(BLE Component Antenna & Assembly Technology)			
	6. 雙面薄化無線通訊模組技術(Ultra Thin Double Side Wireless Module Technology)			
	凸塊(Bumping)			
	1. 低銀之錫銀無鉛電鍍晶圓為小型凸塊技術(Low Ag of Sn/Ag Lead-Free Micro Bump Plating Technology)			
	2. 單層PI與單層銅 RDL 結構之晶圓級封裝技術(Single PI and Single RDL For WLCSP)			
電鍍製程	3. 微小型銅柱凸塊技術(Micro Cu Pillar Bumping)			
(Plating)	4. 線路重佈製程和無鉛錫銀電鍍製程疊層技術開發(RDL+LF Bump)			
	5. 線路重佈製程和銅柱製程疊層技術開發(RDL+Cu Pillar)			
	6. 扇出型晶片無鉛凸塊之覆晶封裝(FOCoS _Cu Pillar)			

測試技術

	新測試技術(New Test Technology)
	1. 晶圓級封裝測試技術(Wafer Level Package Testing Technology)
	2. 高密度多工並列測試技術(High Parallel Site Test Solution)
	3. 晶圓級光通訊二極體老化測試(Wafer Level Photonic Laser Diode Burn-In Test)
	4. 探針抗沾黏奈米層級鍍膜技術(Pin Coating Technology For Probe Card)
晶圓測試 Wafer Probe)	5. 薄化晶圓晶粒復原測試技術(Film Frame Probing Solution)
(vvaler i lobe)	6. 垂直銅柱晶圓針測技術(Copper Pillars Probing Solution)
	7. 高密度多工並列測試技術(High Parallel Site Test Solution)
	8. 超薄片晶圓測試技術(Thin-Wafer Test Solutions)
	9. 雷射Kink偵測Algorithm
	1. 802.11ac射頻系統級封裝測試技術(802.11ac RF SiPTest Solution)
	2. 毫微米波射頻測試技術(mmWave RF Testing Technology)
	3. 射頻前端模組系統級封裝試技術(RFFEM SiP Testing Technology)
	4. 感測器測試技術(Sensor Testing Technology)
	5. 通用型無線通訊系統模組測試開發(Universal Wireless SiPTest System Development)
	6. 物聯網/穿戴式元件之低成本(Non-ATE)測試技術開發(Low Cost Non-ATE Test Methodology For Low I/O Count Device Test
	IoT/Wearable Devices)
	7. 高產出電源管理元件測試機開發(High UPH Power Management IC Tester Development)
	8. 多通道多功能多執行序之系統級封裝模組測試機開發(Multi-Channel Multi-Function, and Multi-Process SIPTester Development)
	9. 高通道密度系統級晶片測試機開發(High Channel Density SOC Tester Development)
	10. 硬體模組控制整合平台暨共用測試機介面開發(Hardware Module Controlled Platform and Common Tester User Interface
	Development)
	11. 高效能數位測試模組開發(High Performance Digital Testing Module Development)
/	12. SiP Open/Short不開機測試機(SiP Unpowered Open/Short Tester)
後段封裝測試 (Final Test)	13. Auto-Learn Open/Short測試技術開發(Auto-Learn Open/Short Testing Technology)
i iliai lest/	14. 高整合度SiP for穿戴式裝置之測試方案
	15. Golden Unit Test Solution For Zigbee SiP
	16. Simulation-aided Matching Tuning For RF Devices
	17. 低成本測試方法For Envelop Tracking Module
	18. Heart Rate Sensor Testing Algorithm
	19. Univeral Wireless/RF Modular Test System
	20. 光感元件測試技術(Optical Sensor Testing Solution)
	21. 超高速介面元件測試技術(USB3.0 Type-C Testing Technology)
	22. 系統級封裝測試技術(SiP Testing Technology)
	23. 微小封裝型態多重溫度測試(Tri-Temp Testing Technology For Small Packages)
	24. 高感度封裝型態溫度測試(Accurate Temperature Control For IC Testing)
	25. 無人駕駛光學感知技術(LiDAR Sensing Test Technology)
	26. 車用先進駕駛輔助系統(ADAS Test Technology)
	27. 生物感測元件測試(Biometric Sensor)

		巨量資料分析與探勘雛型系統建置(Big Data Analysis/Mining Prototype System Build)
		Substrate即時疊圖預警系統(Substrate Real-Time Map Stack Highlight System)
測試資料分析(Test Data Analysis)	3.	製程資訊自動化管理暨深度學習系統(Process Information Automation Management & Deep Learning System)
	4.	IV-Curve產生器暨分析工具(IV-Curve Generator & Analysis Tool)
	5.	BGA 腳位異常顯示輔助工具(BGA Ball Fail Highlight Tool)

IGBT模組製程技術

新製程技術(New Process Technology)			
焊錫端子在DBC基板上組裝	1. 焊錫端子在DBC基板上組裝技術		
(Soldering Pin Attach on DBC)	2. 銲錫介面孔洞小於1%		
銅導熱基板在DBC基板上組裝 (Baseplate Soldering on DBC)	1. 銅導熱基板(105x45mm)焊錫組裝在DBC基板上技術		
	2. 銲錫介面孔洞小於1%		
高導熱導電銀膠使用在陶瓷基板上著 晶組裝	高導熱導電銀膠應用在著晶製程之組裝技術		
(Die Attach with Sintering Material on Ceramic Substrate.)			

COB模組製程技術

新製程技術(New Process Technology)				
降低封膠高度在卡片產品應用				
(Minimize Epoxy Height of	膠高度小於300微米			
Encapsulation For Smart Card)				
液晶聚合材質及陶瓷材質蓋板密封組裝	1. 蓋板密封組裝在基板上偏移精度小於50微米			
(Alumina & LCP Lid Sealing)	2. 蓋板密封測漏良率提升			

2. 預計再投入之進度與研發費用

封裝試產預計投入之研發費用為新台幣470,000仟元,另其他封裝研發費用預計投入新台幣4,245,000仟元。 測試試產預計投入之研發費用為新台幣127,706仟元,另其他測試研發費用預計投入新台幣63,700仟元。 模組製程技術測試試產預計投入之研發費用為新台幣35,000仟元。

- 3. 未來研發得以成功之主要影響因素
 - 先進封裝技術能力的建立並與現有封裝技術整合
 - 現有封裝及測試技術低成本最佳解決方案
 - 流程、製程標準化暨產業鏈整合
 - 關鍵新設備量產化驗證暨即時導入
 - 封裝、測試、基板、模組、系統整合能力的建立與深耕
 - 基板、元件、模組設計能力的建立與深耕
 - 完善的產品研發流程及專案管理系統
 - 結合產品開發和現有生產設備相容性以降低研發成本
 - 客戶導向的組織設計與内部運作機制
 - 充分掌握市場行銷之供需狀況,並依據市場動態與趨勢,先行開發先進封裝、基板、模組組裝技術與測試技術以確保 技術領先地位,適時提供客戶新產品上市時程之最佳解決方案
 - 研發人才培育機制之強化
 - 知識管理系統之落實與強化

- 強化智慧財產權策略與管理
- 符合環保法規與綠色設計(Eco-design)之產品設計、研發與製造
- 研發效益、研發風險、時程及人員能夠有效管控
- 與標竿客戶策略聯盟、降低研發成本與風險
- 晶片-封裝-系統一元化設計(IC-package-system Co-design)
- 測試程式開發能力的建立與深耕
- 研發核心技術能力的建立與深耕

(四) 國内外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施:

- 1. 依據金融監督管理委員會(以下稱「金管會」)發布之金管證審字第1050050021號及金管證審字第1050026834號函,本集團將自106年度開始適用業經國際會計準則理事會(IASB)發布且經金管會認可106年適用之IFRS、IAS、IFRIC及SIC(以下稱「IFRSs」)及相關證券發行人財務報告編製準則修正規定。另,業經IASB發布但未經金管會認可之IFRSs對合併財務報告之影響,本公司將依照金管會時程持續評估並於預計時程完成。
- 2. 因應公司法及證券交易法之修訂,隨時檢視及修訂本公司管理辦法,以符合法令。
- 3.105年修正通過之勞動基準法及勞動基準法施行細則,本公司已依法採取適當措施並調整相關作法。
- 4. 因應職業安全衛生管理辦法及個人資料保護法施行細則等與公司營運有關法規之修訂,隨時檢視及修訂本公司相關管理 辦法,以符合法令。

(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施:

- 1. 全球總體經濟的不確定性與不連續性為半導體產業的一大挑戰。因應措施是日月光透過與客戶及廠商的共同開發來符合 客戶需求與降低成本及風險、持續觀察市場的脈動以及與客戶之間更緊密的互動來掌握客戶的需求與變化,並強化市場 資訊的蒐集與分析來降低產品需求改變對科技所造成的影響。
- 2. 客戶市場競爭力與上市時程是新技術研發是否順利上市之關鍵。因應措施為充分掌握市場行銷趨勢與供需動態之狀況,並依據市場趨勢方向與標竿客戶產品藍圖,先行開發關鍵技術暨專利以確保技術領先地位,結合產品開發和現有生產設備相容性以降低研發成本,提供客戶新產品上市時程之最佳解決方案。
- 3. 新技術研發創新的經驗中,開發經費與關鍵新設備扮演極為重要一環。因應措施為確保新技術和日月光未來藍圖發展一致,並積極和客戶策略聯盟,落實資源共享,以降低研發風險。日月光定期拜訪產業領先地位之客戶,透過技術研討會與標竿客戶共同規劃產品藍圖與產品規範,確保研發技術能符合客戶上市需求。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施:

本公司一向秉持誠信、守法及善盡社會責任之永續經營理念,針對102年高雄廠廢水外洩的單一意外事件,公司勇於面對,積極處理並持續改善,為重塑企業形象盡最大的努力。有關本公司社會責任運作情形,請參閱本年報第24-26頁。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施:無。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施:

由於半導體市場成長前景樂觀,預計本集團2017年之成長幅度會超越2016年的成長率。至於投資部分,鑒於落實現有產能之充分及有效利用,本集團前幾年在產能上之擴充已能滿足部分成長之訂單,為提昇實質報酬率並降低投資風險,對於市場之成長乃以現有產能與設備為主,新設備之投資案,除因應新廠房之使用外,將以市場實際需求之必要性再做新投資的考量。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施:

本公司進貨或銷貨並無過度集中之情事。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施: 無。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施:無。

(十二) 訴訟或非訟事件:

高雄市政府環境保護局(以下稱「環保局」)於102年12月20日以本公司違反水污染防治法科處本公司102,014千元之罰鍰(以下稱「罰鍰處分」)。嗣本公司對該罰鍰處分提起訴願並於訴願遭高雄市政府駁回後依法向高雄高等行政法院提起行政訴訟,請求撤銷訴願決定與該罰鍰處分並請求環保局返還本公司已繳交之罰鍰。高雄高等行政法院審理後於105年3月22日判決訴願決定及該罰鍰處分均撤銷,原告其餘之訴(即請求返還罰鍰之部分)駁回。本公司已於105年4月14日針對該判決不利於本公司之部分提出上訴,案件現由最高行政法院審理中。

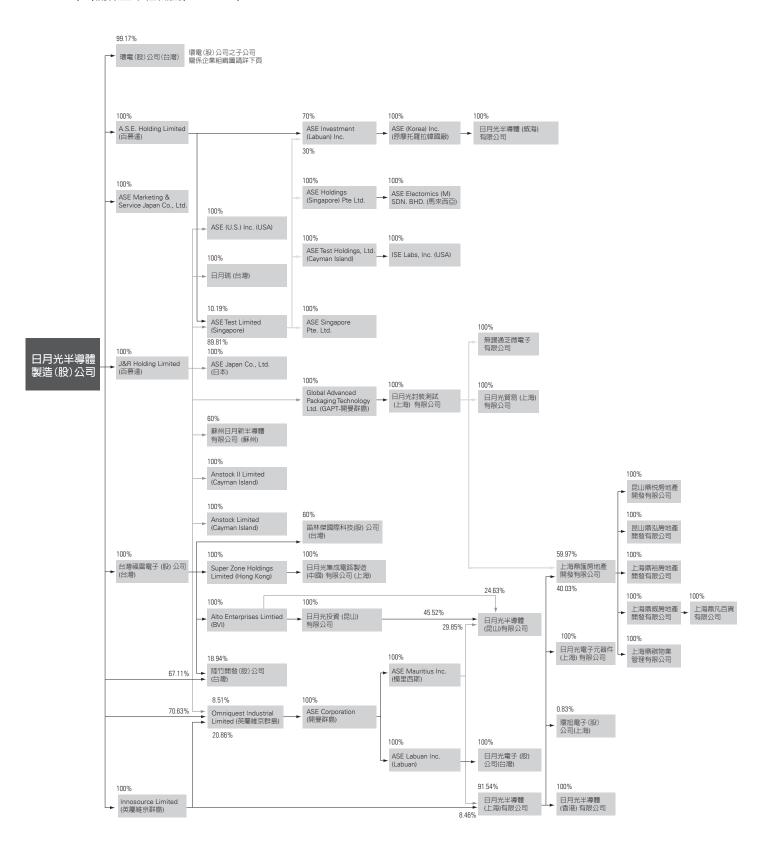
(十三) 其他重要風險及因應措施:無。

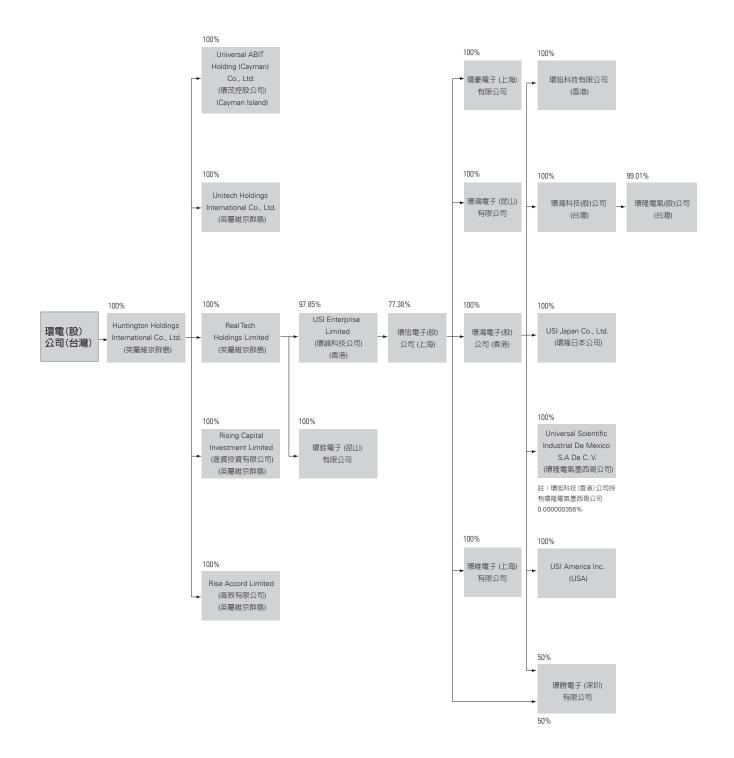
七、其他重要事項:無。

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業組織圖(105.12.31)





(二)各關係企業基本資料

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
日月光半導體製造(股)公司	73年3月	高雄市楠梓加工出口區經三路二十六號	NT\$79,364,735干元	各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售
ASE Corporation	95年3月	Walkers SPV Limited, Walker House, Mary Street, P.O.Box 908 GT, Grant Cayman, Cayman Islands	NT\$11,425,922千元 (US\$352,784千元)	從事專業性投資
日月光半導體(上海)有限公司(註)	90年12月	上海市張江高科技園區金科路2300號	NT\$4,349,312千元 (US\$148,496千元)	發光二極體及二極體顯器製造、印 刷電路板產銷
日月光電子股份有限公司	95年3月	高雄市楠梓加工出口區開發路73號	NT\$3,989,819干元	電子材料批發業,電子材料零售業,國際貿易業
笛林傑國際科技(股)公司	89年12月	台北市信義區光復南路475號5樓	NT\$35,318千元	資訊軟體服務業務
ASE Labuan Inc.	95年3月	Labuan F.T. Malaysia	NT\$4,099,954干元 (US\$126,184干元)	從事專業性投資
ASE Mauritius Inc.	95年4月	608, St. James Court, St. Denis Street, Port Louis, Republic of Mauritius.	NT\$7,046,629干元 (US\$217,800千元)	從事專業性投資
日月光半導體(香港)有限公司	97年4月	RMS 2702-3 ,27/F Bank of EAST ASIA Harbour view Centre, 56 Gloucester RD, Wan Chai ,HK	NT\$32,130千元 (US\$1,000千元)	從事貿易活動
ASE Test Limited. (Singapore)	84年12月	1 Marina Boulevard #28-00 One Marina Boulevard, Singapore (018989)	NT\$659,075千元 (US\$27,356千元)	從事專業性投資
ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	80年2月	Plot 20, Phase IV, Bayan Lepas Free Industrial Zone, 11900 Bayan Lepas, Penang	NT\$2,019,907千元 (US\$62,260千元)	半導體產品封裝測試服務
ISE Labs, Inc.	72年11月	46800 Bayside Parkway Fremont, CA94538, U.S.A	NT\$852干元 (US\$26干元)	半導體產品測試服務
ASE Singapore Pte. Ltd.	87年2月	2 Woodlands Loop Singapore 738074	NT\$984,851干元 (US\$30,056干元)	半導體產品封裝測試服務
ASETest Holdings, Ltd.	88年4月	Ugland House, P.O. Box 309, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies.	NT\$162元 (US\$ 5元)	從事專業性投資
ASE Holdings (Singapore) Pte Ltd	83年12月	10, Hoe Chiang Road, #17-02 Keppel Towers, Singapore	NT\$1,633,708干元 (SG\$71,429干元)	從事專業性投資
台灣福雷電子(股)公司	76年12月	高雄市楠梓加工出口區西五街十號	NT\$11,314,525干元	半導體產品測試服務
ASE (Korea) Inc.	56年3月	76, Saneopdanji-gil, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea	NT\$3,031,771干元 (US\$97,976干元)	半導體產品封裝測試服務
ASE Japan Co., Ltd.	93年5月	1863,Iryuda,Takahata-machi, Higashiokitama- gun,Yamagata, 992-0324,Japan	NT\$105,802干元 (¥360,000干元)	半導體產品封裝測試服務
日月光電子元器件(上海)有限公司 (註)	94年1月	上海市張江高科技園區金科路2300號六號樓2層	NT\$0干元 (US\$0干元)	光電子器件等新型電子元器件、印 刷電路板產銷、提供技術諮詢服務
日月光封裝測試(上海)有限公司	89年12月	上海市張江高科技園區郭守敬路669號	NT\$6,501,336干元 (US\$203,580干元)	半導體產品封裝測試服務
蘇州日月新半導體有限公司	90年5月	江蘇省蘇州工業園區蘇虹西路188號	NT\$1,568,467干元 (US\$48,672干元)	半導體產品封裝測試服務
日月光半導體(威海)有限公司	90年12月	山東省威海市經濟技術發展區出口加工區海南路16-1 號	NT\$4,507,081干元 (US\$152,200干元)	半導體產品封裝測試服務
日月光集成電路製造(中國)有限公司	99年7月	上海市浦東新區華東路5001號T3-10-202室	NT\$3,149,000干元 (US\$100,000干元)	從事半導體封裝及測試之市場行銷 及客戶服務等業務
日月光半導體(昆山)有限公司	93年8月	江蘇省昆山市干燈鎮凇南路373號	NT\$8,350,204干元 (US\$268,000干元)	半導體產品封裝測試服務
無錫通芝微電子有限公司	99年3月	江蘇省無錫市新區閩江路21號52地塊29-B廠房	NT\$356,682干元 (人民幣73,461干元)	半導體產品封裝及測試業務
Global Advanced Packaging Technology Ltd.	89年10月	Walkers House 87 Mary Street, Grand Cayman, KY1 - 9002, Cayman Islands	NT\$6,119,380千元 (US\$190,000千元)	從事專業性投資
A.S.E Holding Limited.	79年2月	Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda	NT\$7,915,000干元 (US\$243,966干元)	從事專業性投資
J&R Holding Limited.	84年12月	Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda	NT\$13,907,259干元 (US\$435,128干元)	從事專業性投資
ASE Investment (Labuan) Inc.	88年6月	Lot 2 & 3, Level 3, Wisma Lazenda, Jalan Kemajuan, 87000 Labuan, F.T. Labuan, Malaysia	NT\$7,277,867干元 (US\$240,947千元)	從事專業性投資
Omniquest Industrial Limited	89年9月	P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	NT\$11,457,298干元 (US\$354,704干元)	從事專業性投資
Innosource Limited	90年6月	P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	NT\$2,770,696干元 (US\$86,000干元)	從事專業性投資
日月瑞(股)公司	88年4月	高雄市楠梓加工出口區内環北路107號	NT\$1,700,000干元	

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	92年11月	Sumitomo Fudosan Shinyokohama Bldg., 10F, 2-5-5, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan 222-0033	NT\$18,298千元 (¥60,000千元)	從事市場行銷及顧客服務等業務
ASE (U.S.) Inc.	72年12月	1255 E. Arques Ave. Sunnyvale, CA 94085, USA	NT\$649干元 (US\$20干元)	從事市場行銷及顧客服務等業務
Super Zone Holdings Limited	97年6月	1408 World-Wide House,19 Des Voeux Road Central,Hong Kong	NT\$3,082,400干元 (US\$100,000干元)	從事專業性投資活動
Alto Enterprises Limited	99年3月	P.O. Box 957,Offshore Incorporations Centre,Road Town, Tortola, British Virgin Islands	NT\$5,709,330干元 (US\$188,000干元)	從事專業性投資活動
Anstock Limited	100年3月	Scotia Centre, 4th Floor, P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Isaland	NT\$303干元 (US\$ 10干元)	從事專業性理財活動
Anstock II Limited	103年7月	Scotia Centre, 4th Floor, P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Isaland	NT\$300干元 (US\$ 10干元)	從事專業性理財活動
日月光貿易(上海)有限公司	104年1月	上海市自由貿易試驗區華申路218號1幢樓5層504室	NT\$ 2,566干元 (人民幣500干元)	從事貨物及技術進出口等業務
日月光投資(昆山)有限公司	101年5月	江蘇省昆山市干燈鎮凇南路373號	NT\$3,717,318干元 (US\$122,000干元)	從事專業性投資活動
上海鼎匯房地產開發有限公司	94年8月	上海市浦東新區郭守敬路351號2號樓602A-04室	NT\$16,345,070干元 (人民幣3,600,000千元)	房地產項目開發、物業管理
上海鼎威房地產開發有限公司	98年10月	上海市漕溪路270號1號樓338室	(NT\$6,908,089干元 人民幣1,548,000千元)	房地產開發經營、物業管理
上海鼎裕房地產開發有限公司	99年3月	上海市寶山區錦秋路48號E192	NT\$4,936,538干元 (人民幣1,100,000千元)	房地產開發經營、物業管理
昆山鼎泓房地產開發有限公司	101年2月	江蘇省昆山市干燈鎖聖祥東路25號2號房	NT\$3,139,662干元 (人民幣670,000干元)	房地產開發經營、物業管理
昆山鼎悦房地產開發有限公司	101年2月	江蘇省昆山市干燈鎖聖祥東路25號2號房	NT\$1,546,415干元 (人民幣330,000干元)	房地產開發經營、物業管理
上海鼎祺物業管理有限公司	104年1月	上海市徐滙區欽州路772號160室	NT\$ 5,078干元 (人民幣1,000干元)	房地產經紀、物業管理
陸竹開發(股)公司	93年12月	臺北市信義區基隆路1段333號19樓	NT\$1,966,344干元	房地產開發業務
上海鼎凡百貨有限公司	105年7月	上海市徐滙區田林東路588號D468室	NT\$ 7,199干元 (人民幣1,500干元)	百貨貿易業務
環隆電氣股份有限公司	63年2月	南投縣草屯鎖太平路一段351巷141號	NT\$400,000干元	各種電腦資訊之週邊設備、厚膜混合積體電路、無線區域網路設備、電子零件配件及個人電腦暨其零件之製造、加工與買賣
環電(股)公司	104年4月	南投縣草屯鎮太平路一段351巷141號	NT\$11,214,953干元	從事專業性投資活動
Huntington Holdings International Co., Ltd.	85年10月	Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands	NT\$8,370,606干元 (US\$255,857干元)	控股公司
Universal ABIT Holding Co., Ltd.	95年2月	P.O. Box 30691 SMB, GrandCayman.	NT\$906,249千元 (EUR 3,800千元)	控股公司
Unitech Holdings International Co., Ltd.	85年10月	P.O. Box 3321 Road TownTortola BVI	NT\$93,495千元 (US\$3,000千元)	控股公司
Rising Capital Investment Limited	99年11月	Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands	NT\$ 176,940干元 (US\$ 6,000干元)	控股公司
Rise Accord Limited	100年5月	Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands	NT\$ 57,730干元 (US\$ 2,000干元)	控股公司
Real Tech Holdings Litimted	89年3月	Trust Net Chambers, P.O. Box3444, Road Town, Tortola, B.V. I.	NT\$4,832,906干元 (US\$149,151干元)	控股公司
環銓電子(昆山)有限公司	94年8月	江蘇省昆山市干燈鎖黃浦江路東側中央大道北側	NT\$383,201千元 (US\$12,000千元)	生產計算機輔助系統、無線網路通 訊卡、計算機高性能主機板及銷售 自產產品
USI Enterprise Limited (環誠公司)	96年11月	Rooms 2702-3, 27th Floor, Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong	NT\$6,780,756千元 (US\$215,535千元)	投資諮詢服務及倉儲管理服務

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
環旭電子公司 (環旭上海公司)	92年1月	上海市浦東新區張江高科技園區張東路1558號	NT\$10,649,110干元 (人民幣2,175,924干元)	提供電子產品設計製造服務、生產 加工新型電子元器件、計算機高性 能主機板、無線網路通信元器件暨 移動通訊產品及零配件,銷售自產 產品及提供相關技術諮詢服務:電 子、通訊產品及相關零配件的批 發、零售
環鴻電子(昆山)有限公司	100年8月	江蘇省昆山市干燈鎖黃浦路497號4棟	NT\$ 1,202,223千元 (人民幣250,000千元)	提供電子產品設計製造服務、生產 加工新型電子元器件、計算機高性 能主機板、無線網路通信元器件暨 移動通訊產品及零配件,銷售自產 產品及提供相關技術諮詢服務:電 子、通訊產品及相關零配件的批 發、零售
Universal Global Technology Co., Limited (環鴻公司)	97年3月	RMS 2702-3 27/F, BANK OFEAST ASIA HARBOUR VIEWCENTRE, 56 GLOUCESTERRD, WAN CHAI, HK	NT\$3,054,056干元 (US\$100,000干元)	控股公司
Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V. (環隆墨西哥公司)	86年9月	Anillo Periferico ManuelGomez Morin No 656R. Santa Isabel C.P. 44290 Guadalajara, Jalisco, Mexico	NT\$776,221干元 (US\$23,963干元)	主機板及電腦系統組裝
USI Japan Co., Ltd.	89年3月	8F West Tower, YokohamaBusiness Park, 134 Godo- cho, Hodogaya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 240- 0005	NT\$27,231千元 (JPY 95,000千元)	電腦資訊之週邊設備、積體電路、電子零件等之製造買賣
環勝電子(深圳)公司	89年7月	廣東省深圳市南山區高新技術產業園北區環旭電子園	NT\$2,270,625千元 (US\$75,000千元)	生產經營電腦主機板、其他相關電 腦週邊設備及通訊工業控制等產品 之設計、製造及銷售
環旭科技有限公司	98年10月	RMS 2702-3 27/F, BANK OFEAST ASIA HARBOUR VIEWCENTRE, 56 GLOUCESTERRD, WAN CHAI, HK	NT\$330,960千元 (US\$11,000千元)	貿易及投資控股公司
環維電子(上海)有限公司	102年9月	上海市浦東新區金橋出口加工區龍桂路501號		電子產品的研發、製造,新型電子元器件、計算機高性能主機板、無線網絡通信元器件、移動通信產品及模塊、零配件的加工及維修,電子產品、通訊產品及零配件的銷售,第三方物流服務(除運輸),從事貨物及技術的進出口業務,以上相關業務的技術諮詢、技術服務
環豪電子(上海)有限公司	103年5月	上海市自由貿易試驗區加楓路8號二層229室	NT\$240,850干元 (人民幣50,000干元)	電子元器件、計算機軟硬體(除計算機資訊系統安全專用產品)、通訊設備及配件(除地面衛星接收裝置)的銷售,第三方物流服務(除運輸),實業投資,從事貨物及技術的進出口業務,轉口貿易,區內企業間貿易及貿易代理
USI America, Inc.	89年10月	3600 Peterson Way, Santa Clara,CA95054,USA	NT\$314,015干元 (US\$9,500干元)	
環鴻科技股份有限公司	98年12月	南投縣草屯鎮太平路一段351巷141號	NT\$1,980,000千元	有線及無線通信機械器材、電子零 組件、電腦及其週邊設備、汽車及 其零件製造業、產品設計業及研究 發展服務業

註:日月光半導體(上海)有限公司吸收合併日月光電子元器件(上海)有限公司,日月光電子元器件(上海)有限公司清算期間,由日月光半導體(上海)有限公司持股至吸收合併完成。

(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料:無此情形。

(四)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業:

- 1. 本公司整體關係企業經營業務所涵蓋之行業包括電子製造業、電子服務業、投資業、租賃業及建設業。
- 2. 本集團長久以來專注於提供半導體客戶完整之半導體封裝及測試服務,包括晶片前段測試及晶圓針測至後段之封裝材料 及性能測試之服務。此外,客戶也可透過子公司環電(股)公司獲得完善的電子製造服務整體解決方案。
- 3. 大體而言本公司各關係企業間所經營業務互有關聯,其往來分工情形向以透過技術、產能、行銷以及服務之相互支援, 以發揮集團最大競爭實力,創造最大綜效,鞏固本公司在業界的領導地位。

(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料

企業名稱	職稱		持有股份		
近耒名柟	取 件	姓名或代表人 	股數	持股比例	
	副董事長兼總經理	張洪本	104,414,941股	1.31%	
	董事	張能傑	1,779,708股	0.02%	
	董事	香港商微電子國際公司	1,327,202,773股	16.71%	
	董事(代表人)兼董事長	張虔生	-	_	
	董事(代表人)	吴田玉	-	_	
日月光半導體製造股份有限公司	董事(代表人)	董宏思	_	_	
口户几十等股表足权仍有权公司	董事(代表人)	羅瑞榮	-	_	
	董事(代表人)	陳昌益	-		
	董事(代表人)	陳天賜	-	_	
	獨立董事	游勝福	-		
	獨立董事	徐大麟	-		
	獨立董事	何美玥	-		
	董事及監察人	日月光半導體製造(股)公司	1,131,452,502 股	100.00%	
	董事(代表人)兼董事長	張虔生	-	_	
	董事(代表人)	張洪本	-		
	董事(代表人)兼總經理	羅瑞榮	-	_	
	董事(代表人)	潘士華	-		
	董事(代表人)	張能傑	-	_	
	董事(代表人)	陳天賜	-		
台灣福雷電子股份有限公司	董事(代表人)	董宏思	-	_	
	董事(代表人)	陳昌益	-		
	董事(代表人)	曾元一	-		
	董事(代表人)	張能超	-		
	董事(代表人)	李俊哲	-	_	
	監察人(代表人)	鄭天正	-		
	監察人(代表人)	周家佩	-		
	監察人(代表人)	郭宏銘	-		
	董事及監察人	ASE Labuan Inc.	398,981,900股	100%	
	董事(代表人)兼董事長	張虔生	-	_	
日月光電子股份有限公司	董事(代表人)	董宏思	-	_	
	董事(代表人)	陳昌益	-		
	監察人(代表人)	潘士華	-	_	
	董事	台灣福雷電子(股)公司	2,119,080股	60%	
	董事(代表人)兼董事長	潘士華	-	_	
	董事	林世玲	617,720股	17.49%	
笛林傑國際科技股份有限公司	董事	董宏思	366,000股	10.36%	
	董事(代表人)	李柏練	-		
	董事(代表人)	劉珠玲	-		
	監察人	劉詩亮	-	_	
	董事	Jason C. S. Chang	-		
J&R Holding Limited	董事	Richard H. P. Chang	-		
	董事	Joseph Tung	-	_	
	董事	Jason C. S. Chang	-	_	
A.S.E Holding Limited	董事	Richard H. P. Chang	-	_	
	董事	Joseph Tung	-	_	
	董事	Richard H. P. Chang	-	_	
Omniquest Industrial Limited	董事	Joseph Tung	-	_	
	董事	Jeffrey Chen	-	_	
	董事	Jason C. S. Chang	_	-	
Innosource Limited	董事	Richard H. P. Chang	-	_	
	董事	Joseph Tung	-		
ASE Corporation	董事	Jason Chang	-		
ASE Corporation	董事	Joseph Hung Szu Tung	_	_	

企業 夕極	H#F±4Z	かって (小主)	持有股	持有股份			
企業名稱	職稱	姓名或代表人	股數	持股比例			
	董事	Jason Chang	-	=			
ACE Manustrius III -	董事	M. Aslam Koomar	-	-			
ASE Mauritius Inc	董事	M. Shariff Golam Hossen	-	-			
	董事	Joseph Tung	-	=			
	董事	Jason Chang	-	-			
ASE Labuan Inc.	董事	Joseph Hung-Szu Tung	_	-			
	董事	Chau Siew Ha	_	-			
	董事	Joseph Tung	_	-			
SE Investment (Labuan) Inc.	董事	Mathew-Willie	_	-			
	董事	Jeffrey Chen	_	-			
Global Advanced Packaging Technology	董事	張洪本	_				
_imited	董事	Tien-Yue Wu	_				
	董事	Jason Chang	_	-			
Anstock Limited	董事	Richard Chang	_				
Wilder Eliminou	董事	Joseph Tung	_	-			
	董事	Jason C. S. Chang	_				
Anstock II Limited	董事	Alan Li					
MISCOGN II EITHICGU	董事	Murphy Kuo					
	董事		170,000,006股	1009			
		J&R Holding Limited					
日月瑞股份有限公司	董事(代表人)兼董事長	張虔生	_	-			
	董事(代表人)	張洪本	-	-			
	董事(代表人)	董宏思	-	-			
	監察人(代表人)	馮美珍	=	-			
日月光半導體(上海)有限公司	董事長	張虔生	-	-			
	董事	張洪本	-				
	董事	張能傑	-	-			
	監事	張能超	_	-			
	董事長	張洪本	_	-			
日月光電子元器件(上海)有限公司	董事	張虔生	-	-			
	董事	陳昌益	_	-			
	董事長	張洪本	-	-			
日月光半導體(香港)有限公司	董事	陳昌益	-	-			
	董事	鄭世欣	-	-			
	董事長	陳昌益	-	-			
	董事	Rutherford Chang	-				
上海鼎匯房地產開發有限公司	董事	俞旭濬	-	-			
	監事	彭國強	_	-			
	董事長	陳昌益	_	-			
	董事	Rutherford Chang	_	-			
上海鼎威房地產開發有限公司	董事	· 前旭濬	_				
	監事	彭國強	_	-			
	董事長	陳昌益	_				
	董事	Rutherford Chang	_	-			
上海鼎裕房地產開發有限公司	董事	新旭濬	_				
	監事						
			_	-			
	董事長	陳昌益 Duth of and Change					
尼山鼎悦房地產開發有限公司	董事	Rutherford Chang					
	董事	前旭濬	_	•			
	監事	彭國強	-	-			
	董事長	陳昌益	-				
昆山鼎泓房地產開發有限公司	董事	Rutherford Chang	-	-			
	董事		-				
	監事	彭國強	-	-			
	董事長	陳昌益	-	-			
上海鼎祺物業管理有限公司	董事	馬同舟	-				
ᆫᄱᇭᆒᄣᄱᅔᄃᅜᅜᅜᆚᄓ	董事		-				
	監事	彭國強	_	-			

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份		
			股數	持股比例	
	董事長	陳昌益	-		
每鼎凡百貨有限公司	董事		-		
^{安新八} 山 東 日欧 ム 山	董事	陳駿霆	_		
	監事	彭國強	-		
	董事長	張洪本	-		
	董事	張虔生	_		
月光半導體(昆山)有限公司	董事	陳昌益	_		
	監事	Rutherford Chang	_		
	董事	Jason Chang	_		
to Enterprises Limited	董事	Richard Chang	_		
to Enterprises Enrinted	董事	-			
		Joseph Tung	_		
	董事長	張虔生	_		
月光投資(昆山)有限公司	董事	Richard Chang	-		
	董事	許志安	_		
	監事	鄭世欣	-		
	董事	張虔生	-		
per Zone Holdings Limited	董事	張洪本	_		
	董事	陳昌益	-		
	董事	張洪本	-		
	董事	Tien-Yue Wu	_		
月光封裝測試(上海)有限公司	董事	Rutherford Chang	_		
	監事	陳昌益	_		
	董事	張虔生	_		
3月光集成電路製造(中國)有限公司	董事	張洪本	_		
	董事		_		
		Rutherford Chang			
	監事	鄭世欣	_		
	董事	陳昌益	-		
月光貿易(上海)有限公司	董事	董宏思	-		
	董事	李柏練	=		
	董事	Ung Bae	_		
	董事	Richard H. P. Chang	-		
SE (Korea) Inc.	董事	Joseph Tung	-		
	董事	Jason C. S. Chang	-		
	監察人	Alan Cheng	_		
	董事	Jason C.S. Chang	_		
	董事	Richard H.P. Chang	_		
SE Test Limited. (Singapore)		-	_		
	董事	Lee Kwai Mun			
	董事	Jeffrey Chen	_		
	董事	Jason C. S. Chang	_		
ETest Holdings, Ltd.	董事	David Pan	_		
J -, - -	董事	Joseph Tung	-		
	董事	Jeffrey Chen	_		
	董事	Hsiang De Way	-		
SE Holdings (Singapore) Pte Ltd	董事	Choong Lai Heng	-		
	董事	Jeswant Singh s/o Darshan Singh	-		
	董事	Richard H. P. Chang	_		
	董事	Mei-Jean Chang	_		
	董事	Hsiang, De-Way	_		
E Electronics (M) Sdn, Bhd.	董事	Joseph Tung	_		
	董事	Choong Lai Heng	_		
	董事	Lee Kwai Mun	_		
	董事	Jason C. S. Chang	_		
	董事	Tien Wu	-		
E Labs,Inc.	董事	David Pan	_		
	董事	Kenneth Hsiang Shih-Jye	-		
	董事	Jeffrey Chen	_		

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份			
止未有円	期以1円 	姓白以1\衣人	股數	持股比例		
	董事	Jason C. S. Chang	_			
SE Singapore Pte. Ltd.	董事	Kenneth Hsiang Shih-Jye	-			
	董事	Kuo Hung-Ming	-			
	董事	Tien Wu	-			
	董事	David Pan	-			
SE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	董事	Chih-Hsiao Chung	-			
	監察人	Joseph Tung	_			
	董事	Tien Wu	_			
	董事	David Pan	_			
	董事	Chih-Hsiao Chung	_			
SE Japan Co., Ltd.	董事	Jason C.S. Chang	_			
	董事	Richard Chang	_			
	監察人	Joseph Tung	_			
SE (U.S.) Inc.	董事	Kenneth Shih-Jye Hsiang				
SE (U.S.) IIIC.	董事	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		67		
		日月光半導體製造股份有限公司	131,961,457股	67.		
	董事(代表人)兼董事長	潘士華	-			
	董事(代表人)	陳天賜	-			
竹開發股份有限公司	董事(代表人)	郭宏銘	-			
	董事(代表人)	李柏練	-			
	董事(代表人)	董宏思	-			
	監察人		_			
	監察人	張聲華	-			
	董事長	張虔生	_			
床州日月新半導體有限公司	董事	吳田玉	-			
	董事	陳昌益	-			
	董事	David Damian French	_			
	董事	David Reed	_			
	監事	周宏康	_			
	監事	陳天賜	_			
	董事	吳田玉	_			
	董事	表 熊	_			
月光半導體(威海)有限公司	董事	張能傑				
	監事	金首虎	_			
	董事	張能傑	-			
锡通芝微電子有限公司	董事	鍾智孝	_			
	董事	吳田玉	-			
	監事	董宏思	-			
	董事	環鴻科技股份有限公司	39,603,222股	99.		
	董事(代表人)兼董事長	魏鎭炎	_			
隆電氣股份有限公司	董事(代表人)	張洪本	_			
	董事(代表人)	石孟國	_			
	監察人	劉丹陽	-			
	董事	日月光半導體製造(股)公司	1,112,236,706 股	99.		
	董事(代表人)兼董事長	魏鎭炎				
	董事	張虔生	_			
	董事	張洪本	_			
	董事(代表人)	魏振隆	_			
	董事(代表人)	潘士華	_			
	董事(代表人)	石孟國				
表の小女明 ヘマ	董事(代表人)	朱曙華	_			
電股份有限公司	董事(代表人)	李俊哲	_			
	董事(代表人)	張能超	_			
	董事(代表人)	張能傑	-			
	董事(代表人)	三田吴	-			
	監察人	董宏思	-			
	監察人	俞旭濬	-			
	監察人	陳昌益	_			
	監察人	曾元一	_			
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				

^# 7 15	田舎 おべ	₩ ₹ ₹₩ ± 1	持有服	·····································
企業名稱	職稱	姓名或代表人	股數	持股比例
	董事	陳昌益	_	-
	董事	魏鎭炎	-	-
luntington Holdings International Co., Ltd.	董事	石孟國	-	-
	董事	魏振隆	_	-
	董事	魏鎭炎	_	-
Jnitech Holdings International Co., Ltd	董事	石孟國	_	-
	董事	張洪本	_	-
Real Tech Holdings Limited	董事	石孟國	_	-
3	董事	魏鎭炎	_	-
Rising Capital Investment Limited	董事	石孟國		
Rise Accord Limited	董事	石孟國	_	
100 / 1000 rd Enritted	董事	魏振隆	_	
	董事	何弘	_	
niversal ABIT Holding (Cayman) Co., Ltd.	董事	林大毅	_	
	董事	石孟國		
	董事	吳國相	-	
	董事長	張洪本	_	
景銓電子(昆山)有限公司	董事	魏鎭炎	-	-
	董事	魏振隆	-	
	監事	石孟國	-	
	董事	張洪本	-	-
JSI Enterprise Limited	董事	石孟國	_	
	董事	魏鎭炎	-	
	董事長	張洪本	-	
	董事	張虔生	_	
	獨立董事	Charles Chang	_	
	董事	Rutherford Chang	-	
	董事兼總經理	魏鎮炎	-	
	董事	陳昌益	-	
	董事	董偉	_	
	獨立董事	陳啓杰	_	
	獨立董事	潘飛	_	
	監事	Andrew Robert Tang		
	監事	石孟國		
	監事		_	
	董事長	張洪本	_	
	董事兼總經理	林大毅	_	
儇鴻電子(昆山)有限公司	董事	魏鎭炎	_	
	監事	石孟國		
	董事	張洪本	_	
Iniversal Global Technology Co., Limited	董事	魏鎭炎		
	董事	劉丹陽	-	
	董事	張洪本	=	
農旭科技有限公司	董事	魏鎭炎	-	
	董事	石孟國		
	董事及監察人	環鴻電子股份有限公司	198,000,000股	1009
	董事(代表人)兼董事長	魏鎭炎	-	
	董事(代表人)	張洪本	=	
	董事(代表人)	石孟國	_	
	監察人(代表人)	劉丹陽	_	
	董事	魏鎭炎	_	
ISI America Inc.	董事	陳麗華	-	
	董事	石孟國	_	
	董事	魏鎖炎	_	
	董事	魏振隆	_	
ICL Japan Co. 1 td	董事	侯爵	_	
JSI Japan Co., Liu.	, 	1 22 2 3	1	
JSI Japan Co., Ltd.	董事	鍾智孝	_	

^**~TI	Ditt 273	サクボルキー	持有	股份
企業名稱	職稱	姓名或代表人	股數	持股比例
	董事	魏鎭炎	-	=
	董事	侯爵	-	=
Universal Scientific Industrial De Mexico S.A De C.V.	董事	林大毅	-	=
De C.V.	董事	石孟國	-	-
	董事兼總經理	Omar Anaya Galván	-	-
	董事長	張洪本	_	-
	董事	侯爵	-	-
環勝電子(深圳)有限公司	董事	魏振隆	_	-
吸附电子(木川) 月限公司	董事	魏鎭炎	_	-
	董事	林大毅	_	-
	監事	石孟國	_	_
	董事長	張洪本	_	-
環維電子(上海)有限公司	董事	魏鎭炎	_	_
	董事	魏振隆	_	-
	監事	石孟國	_	-
	董事長	張洪本	-	-
要亮素了/上海\右阻公司	董事	魏鎭炎	_	-
環豪電子(上海)有限公司	董事	石孟國	-	-
	監事	劉丹陽	-	_

(六)各關係企業營運概況

單位:新台幣仟元/每股盈餘為新台幣元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業淨利	本期損益(稅後)	每股盈餘(稅後)
日月光半導體製造(股)公司	79,364,735	313,034,917	155,475,846	157,559,071	99,190,777	12,071,310	21,680,339	2.37
ASE Corporation	11,425,922	19,018,210	3,076,321	15,941,889	0	(337)	1,123,355	3.18
日月光半導體(上海)有限公司	4,349,312	14,457,503	3,576,110	10,881,393	4,735,228	248,348	800,407	不適用
日月光電子(股)公司	3,989,819	5,174,194	1,075,126	4,099,068	4,543,361	320,099	280,882	0.70
笛林傑國際科技(股)公司	35,318	19,169	3,446	15,723	4,341	(2,319)	(1,829)	(0.52)
ASE Labuan Inc.	4,099,954	4,765,472	648,116	4,117,356	0	(93)	280,620	2.22
ASE Mauritius Inc.	7,046,629	11,823,009	126	11,822,883	0	(544)	844,632	3.88
日月光半導體(香港)有限公司	32,130	738,065	418,707	319,358	1,551,006	420	230	0.23
ASE Test Ltd. (Singapore)	659,075	31,304,381	1,696	31,302,685	0	(4,704)	2,152,302	19.67
ASE Electronics (M) Sdn,Bhd.	2,019,907	5,367,225	766,073	4,601,152	4,959,356	649,197	651,455	4.08
ISE Labs,Inc.	852	2,804,188	215,882	2,588,306	1,089,948	22,126	41,494	1.58
ASE Singapore Pte. Ltd.	984,851	6,308,437	1,363,435	4,945,002	4,392,074	1,176,609	1,205,389	40.05
ASE Test Holdings, Ltd.	0	3,254,153	0	3,254,153	0	0	41,494	8,298,896
ASE Holdings (Singapore) Pte Ltd	1,633,708	5,367,225	766,073	4,601,152	4,959,356	649,197	651,455	9.12
台灣福雷電子(股)公司	11,314,525	32,156,979	2,724,526	29,432,453	11,685,051	3,061,613	2,946,367	2.60
ASE (Korea) Inc.	3,031,771	18,918,080	3,148,006	15,770,074	13,180,298	192,939	217,542	10.49
ASE Japan Co., Ltd.	105,802	3,710,923	1,312,764	2,398,159	1,947,276	142,585	87,443	12,144.85
日月光電子元器件(上海)有限公司	0	36,206	0	36,206	0	(729)	(7,761)	不適用
日月光封裝測試(上海)有限公司	6,501,336	19,861,245	8,305,844	11,555,401	8,028,915	1,409,851	1,607,317	不適用
蘇州日月新半導體有限公司	1,568,467	6,356,062	1,853,198	4,502,864	6,114,412	866,657	799,903	不適用
日月光半導體(威海)有限公司	4,507,081	4,951,300	3,397,563	1,553,737	3,452,271	205,940	(37,897)	不適用
日月光集成電路製造(中國)有限公司	3,149,000	3,240,663	90,940	3,149,723	0	(78,348)	86,378	不適用
日月光半導體(昆山)有限公司	8,350,204	8,013,244	1,934,789	6,078,455	3,028,230	222,035	192,308	不適用
無錫通芝微電子有限公司	356,682	515,557	76,476	439,081	435,011	26,521	21,647	不適用
Global Advanced Packaging Technology Ltd.	6,119,380	13,692,196	2,660,601	11,031,595	0	(254)	1,599,981	8.42
A.S.E Holding Limited	7,915,000	17,733,824	2,265,463	15,468,362	0	(5,830)	379,950	1,557.39
J&R Holding Limited	13,907,259	70,199,223	18,672,891	51,526,331	0	(7,553)	3,999,715	9,192.04

Memorament Luburah Inc.	企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業淨利	本期損益(稅後)	每股盈餘(稅後)
Innosouroe Limited	ASE Investment (Labuan) Inc.	7,277,867	17,726,486	1,781,753	15,944,734	0	(93)	224,018	0.93
日野麻原性之回	Omniquest Industrial Limited	11,457,298	18,955,052	3,019,661	15,935,392	0	0	1,120,450	3.16
ASE Murkening & Service Japan Co., Ltd. 18,298 35,303 4,776 30,527 80,559 5,370 2,432 2,026.67 ASE (US) Inc. 649 479,673 80,868 308,905 1,521,520 75,676 26,886 26,885.87 Super Zone Holdings Limited 3,082,400 3,149,846 0 0 0 0 86,370 0.88 ASE	Innosource Limited	2,770,696	4,247,548	3,234	4,244,314	0	0	236,259	2.75
ASE (U.S Inc. 644 479,673 80,868 398,805 1,521,520 75,876 26,888 26,885,87 Super Zone Holdings Limited 3,082,400 3,149,846 0 3,149,946 0 6 0 6,877 0,066 Alto Enterprises Limited 5,709,330 4,262,348 0 4,262,348 0 6 10 134,827 0,72 Anatook Limited 303 1,872,359 1,860,478 11,881 0 6 1 100 6,6713 (673,341 Anatook Illimited 300 9,756,166 9,749,795 6,371 0 6 19,749 1 5,500 5,507 1 5,	日月瑞(股)公司	1,700,000	1,000,926	259	1,000,667	0	(1,618)	2,971	0.02
Super Zone Holdings Limited 3,082,400 3,149,846 0 3,149,846 0 4,262,248 0 0 134,827 0,72 Anstock Limited 5,709,330 4,262,248 0 4,262,248 0 0 134,827 0,72 Anstock Limited 300 3,756,166 0,974,795 0,6777 0 1 100 1 1,573 0,573 Elp. 光陽原性	ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	18,298	35,303	4,776	30,527	80,559	5,370	2,432	2,026.67
Alto Enterprises Limited 5,709,330 4,262,348 0 4,262,348 0 10 114,821 0.72 Anstook Limited 303 1,872,359 1,860,478 11,881 0 1 109 (6,713) (67134) Anstook Limited 300 9,756,166 9,749,795 6,371 0 (1992) 5,308 530.79 日月光質剤に加剤限公司 2,566 2,066 2,062 2,041 0 (1511 0) 77 不適用 日月光質剤に加剤限公司 3,717,318 2,767,226 2,002 2,765,225 0 (5 5) 87,455 不適用 上海解菌院性番開發和限公司 16,345,070 20,745,654 1,641,998 19,103,656 3,079,887 1,669,800 1,060,928 不適用 上海解菌院性番開發和限公司 16,345,070 20,745,654 1,641,998 19,103,656 3,079,887 1,669,800 1,060,928 不適用 上海解菌院性番開發和限公司 6,908,089 12,607,262 5,512,677 7,094,585 0 (33,950) (34,119) 不適用 上海解菌院性番開發和限公司 4,936,538 177,794 77,071 5,107,70 0 (19,105) (14,146) 不適用 見山肺代防性番間發和限公司 1,546,415 1,534,006 1,182 1,532,824 0 (12,225 9,260	ASE (U.S) Inc.	649	479,673	80,868	398,805	1,521,520	75,876	26,886	26,885.87
Anstook limited 303 1.872,359 1,860,478 11,881 0 (109 (6,713) (6,7134) Anstook li Limited 300 9,756,166 9,749,795 6,371 0 (1922 5,308 530,79 日月光陽風上脚月限公司 2,666 2.066 2.5 2,041 0 (51) (57) 不適用 日月光解胃原出卵限公司 3,717,318 2,767,226 2,002 2,765,225 0 (55) (57) (57) 不適用 上炭陽陽原性素解發育限公司 15,345,707 20,745,654 1,641,998 19,103,656 3,079,887 1,669,890 1,080,928 不透用 上海陽陽時地差解發有限公司 6,908,089 12,607,262 5,512,677 7,094,585 0 (33,950 (34,119) 不適用 上海陽風地上脚角地上海陽風地上離發射限公司 4,938,533 5,177,942 70,171 5,107,770 0 (19,105) (14,746) 不透用 日油解光性差解發有限公司 3,139,662 3,790,054 566,628 3,203,426 772,172 1,112,26 9,066 不通用 日油解光性差解整有限公司 1,546,415 1,534,006 1,182 1,532,824 0 (28,894 (19,111) 不通用 日油解光性差解整有限公司 1,546,415 1,534,006 1,182 1,532,824 0 (28,894 (19,111) 不通用 日油解光性差解检育限公司 1,966,414 1,986,333 203 1,986,130 57,522 (9,506) (10,222 (0.055) 上海扇黑阳素溶解溶阻 1,966,344 1,986,333 203 1,986,130 57,522 (9,506) (10,222 (0.055) 上海扇黑阳疾日 1,966,344 1,986,333 203 1,986,130 57,522 (9,506) (10,222 (0.055) 上海扇黑阳疾日 1,966,344 1,986,333 44,047,265 2,008,015 42,039,249 0 (8,2620 2,276,807 2,488	Super Zone Holdings Limited	3,082,400	3,149,846	0	3,149,846	0	0	86,379	0.86
Anstock II Limited 300 9,756,166 9,749,795 6,371 0 (192) 5,308 530.79 日月光貿易に関有限公司 2,566 2,066 25 2,041 0 (51) 5,308 797 不適用 日月光貿易に関有限公司 3,717,318 2,767,226 2,002 2,765,225 0 (55) 87,455 不適用 上海麻匪無極難解放公司 16,345,070 20,745,654 1,641,998 19,103,656 3,079,887 1,666,980 (193,419) 不適用 上海麻匪無難解除可限公司 6,990,699 12,607,867 5,512,677 7,094,585 0 (33,950) (34,119) 不適用 上海麻匪無難解除可限公司 4,936,538 5,177,942 70,171 5,107,770 0 (19,105) 14,746 不適用 日川根島地產開發有限公司 1,546,415 1,534,006 1,182 1,532,224 0 (289) (107) 不適用 日川根島地產開發有限公司 1,546,415 1,534,006 1,182 1,532,224 0 (289) (107) 不適用 日川株島県地産開發有限公司 1,546,415 1,534,006 1,182 1,532,224 0 (289) (107) 不適用 日川株島県地産開發有限公司 1,546,415 1,534,006 1,182 1,532,224 0 (8,604) 9,111 不適用 陸門開發競投有限公司 1,546,415 1,534,006 1,182 1,532,224 0 (8,604) 9,111 不適用 限計算 整理解股公司 1,546,415 1,534,006 1,182 1,532,224 0 (8,604) 9,9111 不適用 限計算 整理解股公司 1,546,344 1,886,333 203 1,986,130 57,522 (9,506) (10,222) (0.055 1) 上海麻用油需整理操的有限公司 1,546,445 1,545,572 (28,604) 1,986,333 203 1,986,130 57,522 (9,506) (10,222) (0.055 1) 上海麻用酒酸全用混合司 400,000 8,062,603 6,052,109 2,010,494 19,857,231 380,266 363,567 9.99 月間整確認公司 11,214,953 44,047,265 2,008,015 42,099,249 0 (82,620) 2,776,807 2,48 Hurtington Holdings International Co., Ltd 93,495 241,874 416 241,458 0 (53,641) 2,872,811 11,22 Universal ABIT Holding (Cayman) Co., Ltd 93,495 241,874 416 241,458 0 (53,241) (43,641) 139 0.02 No. 10 No	Alto Enterprises Limited	5,709,330	4,262,348	0	4,262,348	0	0	134,821	0.72
日月光質易比勝利限公司 2.566 2.066 2.5 2.041 0 (51) 57) 不適用 日月光度資信山利限公司 3,717,318 2.767,226 2.002 2.765,225 0 (5.5) 87,455 不適用 上海県原地産制設有限公司 16,345,070 20,745,654 1.641,998 19,103,6566 3,079,887 1,669,880 1.080,928 不適用 上海県原地産制設有限公司 6,908,089 12,607,262 5.512,677 7,094,585 0 (3.379,087 1,169,880 1.080,928 不適用 上海県保護地産制設有限公司 4,936,538 5,177,942 7,0717 5,107,770 0 (19,105) (14,746) 不適用 配加層化助産制設有限公司 3,136,662 3,790,054 586,628 3,203,426 772,172 121,226 92,806 不適用 配加層化助産制設有限公司 1,546,415 1,534,006 1,182 1,532,824 0 (2.89) (107) 不適用 配加層化助産制設有限公司 1,546,415 1,534,006 1,182 1,532,824 0 (2.89) (107) 不適用 配加層性関連を制度保険公司 1,566,344 1,986,333 203 1,986,130 57,522 (9.566) (10,222) (0.05) 上海県凡医管制股公司 1,066,344 1,986,333 203 1,986,130 57,522 (9.566) (10,222) (0.05) 上海県凡医管制股公司 400,000 8,662,603 6,052,109 2,010,494 19,857,231 380,268 363,556 9,99 項障を実践が再収金司 400,000 8,662,603 6,052,109 2,010,494 19,857,231 380,268 363,556 9,99 項障を実践が再収金司 400,000 8,862,603 6,052,109 2,010,494 19,857,231 380,268 363,556 9,99 項障を実践が再収金司 11,214,953 44,047,265 2,008,015 42,039,249 0 (8.26,020 2,776,807 2,48 Huntington Holdings International Co., Ltd 93,495 241,874 416 241,458 0 (5.512) (4.75) (0.016) No. 10 Unitech Holdings International Co., Ltd 93,495 241,874 416 241,458 0 (5.512) (4.75) (0.016) No. 10 Unitech Holdings International Co., Ltd 93,495 241,874 416 241,458 0 (5.212) (2.776,807 2,783) (1.391,512) No. 10 (4.88) 139 0.002 No. 10 (4.88) 139 0.00	Anstock Limited	303	1,872,359	1,860,478	11,881	0	(109)	(6,713)	(671.34)
日月光段頃に山青限公司 3,717,318 2,767,226 2,002 2,765,225 0 0 5 87,455 不適用 上海開匯関地産開發有限公司 16,345,070 20,745,654 1,641,998 19,103,656 3,079,887 1,669,880 1,080,928 不適用 上海開放関地産開發有限公司 6,988,089 12,607,262 5,512,677 7,094,585 0 0 33,950 34,1119 不適用 上海開格開始展開發有限公司 4,936,533 5,177,942 770,171 5,107,770 0 0 19,105 14,746 不適用 日上海開格開始展開發有限公司 3,139,662 3,790,654 586,628 3,203,426 772,172 121,226 92,806 不適用 日上海開放財産開發有限公司 1,546,415 1,534,006 1,182 1,532,824 0 0 2,899 0 1071 不適用 上海開放財産開發有限公司 1,546,415 1,534,006 1,182 1,532,824 0 0 8,604 9,1111 不適用 上海開放財産開發有限公司 1,966,344 1,986,333 203 1,986,130 57,522 9,506 10,222 0 0.055 上海開成財産開發有限公司 1,966,344 1,986,333 203 1,986,130 57,522 9,506 10,222 0 0.055 1,222 1,226 1	Anstock II Limited	300	9,756,166	9,749,795	6,371	0	(192)	5,308	530.79
上海原匯伊地産開發有限公司 16,345,070 20,745,654 1,641,998 19,103,656 3,079,887 1,669,880 1,080,928 不適用 上海系統開地産開發有限公司 6,908,089 12,607,262 5,512,677 7,094,585 0 (33,950) (34,119) 不適用 日海系統開始企配開發有限公司 4,936,538 5,177,942 70,171 5,107,770 0 (19,105) (14,746) 不適用 見山所公開地産開發有限公司 3,139,662 3,790,054 586,628 3,203,426 772,172 121,226 92,806 不適用 見山所公開地産開發有限公司 1,546,415 1,534,006 1,182 1,532,824 0 (28) (107) 不適用 配用機能管理有限公司 1,546,415 1,534,006 1,182 1,532,824 0 (28) (107) 不適用 医性阴镜胶性角膜公司 1,546,415 1,534,006 1,182 1,532,824 0 (8,604) (9,111) 不適用 医性阴镜胶性有限公司 1,966,344 1,986,333 203 1,986,130 57,522 (9,506) (10,222) (0.05) 上海原凡直管有限公司 7,199 6,952 0 6,952 0 (20) (20) (22) 不適用 整電電影的行限公司 400,000 8,062,603 6,052,109 2,010,494 19,857,231 380,268 363,567 9,09 電電股公司 400,000 8,062,603 6,052,109 2,010,494 19,857,231 380,268 363,567 9,09 電電股公司 11,214,953 44,047,265 2,008,015 42,039,249 0 (8,2620) 2,776,807 2,48 Huntington Holdings International Co., Ltd 8,370,666 43,971,538 47,476 43,924,062 0 (13,643) 2,872,811 1123 Universal ABIT Holding (Cwyman) Co., Ltd 93,495 241,874 416 241,488 0 (5,210) (4,481 139 0.02 Rises Accord Limited 176,940 36,778 0 36,778 0 (4,881 139 0.02 Rises Accord Limited 4,832,906 41,856,972 833 41,856,139 0 (2,294,881 2,398,172 20.10 理整電子促出处司 383,201 335,132 831 334,301 0 (3,322) 13,670 不適用 理磁公司 6,780,756 40,452,098 45,513 40,406,585 17,412 1,945 3,029,705 14,06 理磁公司 1,0649,110 43,742,414 8,615,906 55,127,388 4,099,128 889,261 3,867,862 2.178 理磁公司 3,054,056 13,915,204 3,882,304 12,859,801 12,854,801 13,915 3,032,007 75,002 不適用 理磁公司 3,054,056 13,915,204 3,082,904 12,823,800 10,983,800 76,9207 75,062 不適用 理磁公司 3,054,056 13,915,204 3,082,904 10,232,240 7,313,855 (135,409) 1,564,868 2.01 理磁器可任规内积公司 2,202,625 17,833,468 75,882,376 99,9192 2,205,051 12,351,509 13,564,868 2.01 理磁器可任规则和同公司 3,054,056 13,915,204 3,082,906 10,232,240 7,313,855 (135,409) 1,564,868 2.01 理磁器可任规内积公司 3,054,056 13,915,204 3,082,906 10,232,806 14,365,155 3,133,862 2,123,899 90,415 0.32 2,104,104 10,104 10,104 10,104 10,104 10,104 10,104 10,104 10,104 10,104 10,10	日月光貿易(上海)有限公司	2,566	2,066	25	2,041	0	(51)	(57)	不適用
上海開放房池離開發有限公司 6,908,089 12,607,262 5,512,677 7,094,585 0 1 33,950 (34,119) 不適用 上海開格房地離開發有限公司 4,936,538 5,177,942 70,171 5,107,770 0 (19,105) (14,746) 不適用 昆山開弘房地離開發有限公司 3,199,662 3,790,054 586,628 3,203,426 772,172 121,226 92,805 不適用 昆山開弘房地離開發有限公司 1,546,415 1,534,006 1,182 1,532,824 0 (289) (107) 不適用 昆山開弘房地離開發有限公司 1,546,415 1,534,006 1,182 1,532,824 0 (289) (107) 不適用 昆山開弘房地離開發有限公司 1,966,344 1,986,333 203 1,986,130 57,522 (9,506) (10,222) (0.05) 上海屏凡呂西南原公司 400,000 8,062,603 6,052,109 2,010,494 19,857,231 380,268 363,567 9.09 理権地別公司 11,214,953 44,047,265 2,008,015 42,039,249 0 (82,620) 2,776,807 2,48 Huntington Holdings International Co, Ltd 8,370,606 43,971,538 47,476 43,924,062 0 (136,943) 2,872,811 11,23 Universal ABIT Holding (Cayman) Co, Ltd 93,495 241,874 416 224,1458 0 (5,5210) (475) (0.16) Rising Capital Investment Limited 176,940 36,778 0 36,778 0 (48) 139 0.02 Rise Accord Limited 4,832,906 41,835,972 833 41,856,139 0 (29,948) 2,998,172 20,10 理酸金元目 10,649,110 43,742,414 8,615,056 35,173,385 (13,34,001) (3,322) 13,670 不適用 理解公司 1,202,223 6,443,441 3,584,361 2,889,061 13,386,62 3,387,862 17,888,361 2,889,061 3,318,662 3,387,862 17,888,361 2,889,061 10,332,862 3,867,862 17,888,361 2,889,061 10,332,862 3,867,862 21,788 40,905,128 899,261 3,867,862	日月光投資(昆山)有限公司	3,717,318	2,767,226	2,002	2,765,225	0	(5)	87,455	不適用
上海原格傳地羅爾發有限公司 4,936,538 5,177,942 70,171 5,107,770 0 19,105 (14,746) 不適用 昆山爾弘房地羅開發有限公司 3,139,662 3,790,054 586,628 3,203,426 772,172 121,226 92,806 不適用 昆山爾松房地羅開發有限公司 1,546,415 1,534,006 1,182 1,532,824 0 (289) (107) 不適用 上海原祥物著管理有限公司 5,078 14,557 21,881 (7,224) 0 (8,604) (9,1111 不適用 陸門開發股何限公司 1,966,344 1,986,333 203 1,986,130 57,522 (9,506) (10,222) (0,05) 上海陽紅面與紅力爾吸公司 7,199 6,952 0 6,952 0 (200 (22) 不適用 理腦鑑取分育限公司 400,000 8,062,603 6,052,109 2,010,494 19,857,231 380,268 363,567 9.09 理壓個別公司 11,214,953 44,047,265 2,008,015 42,039,249 0 (82,620) 2,776,807 2,248 Huntington Holdings International Co, Ltd. 8,370,606 43,971,538 47,476 43,924,062 0 (136,943) 2,872,811 11,23 Universal ABIT Holding (Cayman) Co. Ltd 99,495 241,874 416 241,458 0 (5,210) (475) (0,16) Rising Capital Investment Limited 176,940 36,778 0 36,778 0 (48) 139 0.02 Rise Accord Limited 4,832,906 41,856,972 833 41,856,139 0 (29,948) 2,998,172 20,10 理就公司 6,780,756 40,452,098 45,513 40,406,585 17,412 1,945 3,029,705 14,06 理風上海公司 1,0649,110 43,742,414 8,615,056 35,127,358 40,909,128 889,261 3,867,862 17,88 理測公司 7,76,221 1,960,021 523,866 1,436,155 3,133,862 21,2389 90,415 0,32 理測路至可 1,202,223 6,443,441 3,584,361 2,859,080 10,985,360 769,207 735,082 不適用 理測是否再公司 7,76,221 1,960,021 523,866 1,436,155 3,133,862 21,2389 90,415 0,32 理測路至可 2,776,221 1,960,021 523,866 1,436,155 3,133,862 21,2389 90,415 0,32 理測路至可 3,054,056 13,915,204 3,682,964 10,232,240 7,313,855 (135,409) 1,564,868 2,01 理測路至可 3,054,056 13,915,204 3,682,964 10,232,240 7,313,855 (135,409) 1,564,868 2,01 理測路至可 1,0649,110 43,742,414 8,615,056 3,123,240 7,313,856 (135,409) 1,564,868 2,01 理測路至可 1,0649,110 43,742,414 8,615,056 3,123,240 7,313,856 (13	上海鼎匯房地產開發有限公司	16,345,070	20,745,654	1,641,998	19,103,656	3,079,887	1,669,880	1,080,928	不適用
B山川湖房地産開發有限公司 3,139,662 3,790,054 586,628 3,203,426 772,172 121,226 92,806 不適用 昆山開悦房地産開發有限公司 1,546,415 1,534,000 1,182 1,532,824 0 (289) (107) 不適用 上海開開物業管理有限公司 5,078 14,557 21,881 (7,324) 0 (8,604) (9,111) 不適用 陸竹開發股行程院公司 1,966,344 1,986,333 203 1,986,130 57,522 (9,506) (10,222) (0,05) 上海飓凡百貨保公司 7,199 6,952 0 6,952 0 (20) (221) 不適用 環境限分可 400,000 8,062,603 6,052,109 2,010,494 19,857,231 380,268 363,567 9.09 環境限分面 11,214,953 44,047,265 2,008,015 42,039,249 0 (82,620) 2,776,807 2.48 Huntington Holding International Co., Ltd 93,3495 241,874 416 241,455 0 (5,210) 0 0 0 Universal Abli Holding International Co., Ltd<	上海鼎威房地產開發有限公司	6,908,089	12,607,262	5,512,677	7,094,585	0	(33,950)	(34,119)	不適用
日本	上海鼎裕房地產開發有限公司	4,936,538	5,177,942	70,171	5,107,770	0	(19,105)	(14,746)	不適用
上海無誠物業管理有限公司 5,078 14,557 21,881 (7,324) 0 8,604 (9,111) 不適用 控制酸股分有限公司 1,966,344 1,986,333 203 1,986,130 57,522 9,506 (10,222) (0.05) 上海無凡百貴有限公司 7,199 6,952 0 6,952 0 (20 (22) 不適用 項格電無股分有限公司 400,000 8,062,603 6,052,109 2,010,494 19,857,231 380,268 363,567 9,00 項本股公司 11,214,953 44,047,265 2,008,015 42,039,249 0 (82,620) 2,776,807 2,48 Huntington Holdings International Co., Ltd. 8,370,606 43,971,538 47,476 43,924,062 0 (136,943) 2,872,811 11,23 11,23 11,000 11,	昆山鼎泓房地產開發有限公司	3,139,662	3,790,054	586,628	3,203,426	772,172	121,226	92,806	不適用
Peti	昆山鼎悦房地產開發有限公司	1,546,415	1,534,006	1,182	1,532,824	0	(289)	(107)	不適用
上海順凡百貨有限公司 7,199 6,952 0 6,652 0 (20) (22) 不適用 環障電源股份有限公司 400,000 8,062,603 6,052,109 2,010,494 19,857,231 380,268 363,567 9,09 環電(酸)公司 11,214,953 44,047,265 2,008,015 42,039,249 0 (82,620) 2,776,807 2,48 Huntington Holdings International Co., Ltd. 8,370,606 43,971,538 47,476 43,924,062 0 (136,943) 2,872,811 11,23 Universal ABIT Holding (Cayman) Co., Ltd 906,249 536 110,683 (110,147) 0 0 0 0 0 0 0 Unitech Holdings International Co., Ltd 93,495 241,874 416 241,458 0 (5,210) (475) (0.16 Rissing Capital Investment Limited 176,940 36,778 0 36,778 0 (48) 139 0.02 Rise Accord Limited 57,730 4,852 2,812 2,040 0 (27) (2,783) (139,15) Real Tech Holdings Limited 4,832,906 41,856,972 833 41,856,139 0 (29,948) 2,998,172 20.10 環企電子(昆山)公司 383,201 335,132 831 334,301 0 (3,322) 13,670 不適用 現職公司 6,780,756 40,452,098 45,513 40,406,585 17,412 1,945 3,029,705 14.06 規阻上海公司 10,649,110 43,742,414 8,615,056 35,127,358 40,909,128 889,261 3,867,862 1.78 用理温公司 3,054,056 13,915,204 3,682,964 10,232,240 7,313,855 (135,409) 1,564,868 2.01 関衛整西哥公司 776,221 1,960,021 523,866 1,436,155 3,133,862 212,389 90,415 0.32 USI Japan Co., Ltd. 27,231 28,511 2,613 25,898 18,718 1,014 856 133,75 現際電子(深圳有限公司 330,960 6,605,326 5,955,041 650,285 22,285,566 46,368 49,704 0.58 現機電子(上)有限公司 30,960 6,605,326 5,955,041 650,285 22,285,566 46,368 49,704 0.58 現機電子(上)有限公司 340,850 251,481 893 250,588 0 (297,786) (592,611) 不適用 現態科技有限公司 240,850 251,481 893 250,588 0 (297,786) (592,611) 不適用	上海鼎祺物業管理有限公司	5,078	14,557	21,881	(7,324)	0	(8,604)	(9,111)	不適用
環障電氣股份有限公司 400,000 8,062,603 6,052,109 2,010,494 19,857,231 380,268 363,567 9.09 環電(股)公司 11,214,953 44,047,265 2,008,015 42,039,249 0 (82,620) 2,776,807 2,48 Huntington Holdings International Co., Ltd. 8,370,606 43,971,538 47,476 43,924,062 0 (136,943) 2,872,811 11,23 Universal ABIT Holding (Cayman) Co., Ltd 996,249 536 110,683 (110,147) 0 0 0 0 0 0 0 Unitech Holdings International Co., Ltd 93,495 241,874 416 241,458 0 (5,210) (475) (0.16) Rising Capital Investment Limited 176,940 36,778 0 36,778 0 (48) 139 0.02 Rise Accord Limited 57,730 4,852 2,812 2,040 0 (27) (2,783) (139,15) Real Tech Holdings Limited 4,832,906 41,856,972 833 41,856,139 0 (29,948) 2,998,172 20.10 環旋電子(昆山)公司 383,201 335,132 831 334,301 0 (3,322) 13,670 不適用 環旅公司 6,780,756 40,452,098 45,513 40,406,585 17,412 1,945 3,029,705 14.06 環ル上海公司 10,649,110 43,742,414 8,615,056 35,127,358 40,909,128 889,261 3,867,862 1.78 環境公司 1,202,223 6,443,441 3,584,361 2,859,080 10,985,360 769,207 735,082 不適用 環境公司 776,221 1,960,021 523,866 1,436,155 3,133,862 212,389 90,415 0.32 USI Japan Co., Ltd. 27,231 28,511 2,613 25,898 18,718 1,014 856 133,75 環境電子(深川)有限公司 30,960 6,605,326 5,955,041 650,285 22,285,566 46,368 49,704 0.58 環境電子(沢川)有限公司 30,960 6,605,326 5,955,041 650,285 22,285,566 46,368 49,704 0.58 環境電子(上間)有限公司 6,652,140 11,721,829 8,886,695 2,835,134 12,344,589 (297,786) (592,611) 不適用 環境電子(上間)有限公司 240,850 251,481 893 250,588 0 (239) 6,093 不適用 環境電子(上間)有限公司 240,850 251,481 893 250,588 0 (239) 6,093 不適用 環境電子(上間)有限公司 240,850 251,481 893 250,588 0 (239) 6,093 不適用 環境電子(上間)有限公司 240,850 251,481 893 250,588 0 (239) 6,093 不適用 環境電子(上間)有限公司 240,850 251,481 893 250,588 0 (239) 6,093 不適用 環境電子(上間)有限公司 240,850 251,481 893 250,588 0 (239) 6,093 不適用 環境電子(上間)有限公司 240,850 251,481 893 250,588 0 (239) 6,093 不適用	陸竹開發股份有限公司	1,966,344	1,986,333	203	1,986,130	57,522	(9,506)	(10,222)	(0.05)
環電倒公司 11,214,953 44,047,265 2,008,015 42,039,249 0 (82,620) 2,776,807 2.48 Huntington Holdings International Co., Ltd. 8,370,606 43,971,538 47,476 43,924,062 0 (136,943) 2,872,811 11.23 Universal ABIT Holding (Cayman) Co., Ltd 906,249 536 110,683 (110,147) 0 0 0 0 0 0 0 0 Unitech Holdings International Co., Ltd 93,495 241,874 416 241,458 0 (5,210) (475) (0.16) Rising Capital Investment Limited 176,940 36,778 0 (48) 139 0.02 Rise Accord Limited 57,730 4,852 2,812 2,040 0 (27) (2,783) (139,15) Real Tech Holdings Limited 4,832,906 41,856,972 833 41,856,139 0 (29,948) 2,998,172 20,10 環発電子促出分司 383,201 335,132 831 334,301 0 (3,322) 13,670 不適用 環路公司 6,780,756 40,452,098 45,513 40,406,585 17,412 1,945 3,029,705 14,06 環路公司 10,649,110 43,742,414 8,615,056 35,127,358 40,909,128 889,261 3,867,862 1.78 環路公司 10,649,110 43,742,414 8,615,056 35,127,358 40,909,128 889,261 3,867,862 1.78 環路公司 3,054,056 13,915,204 3,682,964 10,232,240 7,313,855 (135,409) 1,564,868 2.01 環路公司 776,221 1,960,021 523,866 1,436,155 3,133,862 212,389 90,415 0.32 USI Japan Co., Ltd. 27,231 28,511 2,613 25,898 18,718 1,014 856 133.75 環路母子保肥)有限公司 330,960 6,605,326 5,955,041 650,285 22,285,566 46,368 49,704 0.58 環路母子保肥)有限公司 330,960 6,605,326 5,955,041 650,285 22,285,566 46,368 49,704 0.58 環路母子化肥)有限公司 330,960 6,605,326 5,955,041 650,285 22,285,566 46,368 49,704 0.58 環路母子化肥)有限公司 330,960 6,605,326 5,955,041 650,285 22,285,566 46,368 49,704 0.58 環路母子化肥)有限公司 330,960 6,605,326 5,955,041 650,285 22,285,566 46,368 49,704 0.58 環路母子化肥)有限公司 340,015 212,395 10,067 202,328 117,947 6,601 29,048 116,19 USI America, Inc. 314,015 212,395 10,067 202,328 117,947 6,601 29,048 116,19	上海鼎凡百貨有限公司	7,199	6,952	0	6,952	0	(20)	(22)	不適用
Huntington Holdings International Co., Ltd. 8,370,606 43,971,538 47,476 43,924,062 0 (136,943) 2,872,811 11.23 Universal ABIT Holding (Cayman) Co., Ltd 906,249 536 110,683 (110,147) 0 0 0 0 0 0 0 0 Unitech Holdings International Co., Ltd 93,495 241,874 416 241,458 0 (5,210) (475) (0.16) Rising Capital Investment Limited 176,940 36,778 0 36,778 0 (488 139 0.02 Rise Accord Limited 57,730 4,852 2,812 2,040 0 (27) (2,783) (139,15) Real Tech Holdings Limited 4,832,906 41,856,972 833 41,856,139 0 (29,948) 2,998,172 20.10 限益金子(昆山)公司 383,201 335,132 831 334,301 0 (3,322) 13,670 不適用 限益金子(昆山)公司 383,201 335,132 831 334,301 0 (3,322) 13,670 不適用 限益金子(昆山)公司 10,649,110 43,742,414 8,615,056 35,127,358 40,909,128 889,261 3,867,862 1.78 限遇金子(昆山)有限公司 1,202,223 6,443,441 3,584,361 2,859,080 10,985,360 769,207 735,082 不適用 限遇金司 3,054,056 13,915,204 3,682,964 10,232,240 7,313,855 (135,409) 1,564,868 2.01 限选金西哥公司 776,221 1,960,021 523,866 1,436,155 3,133,862 212,389 90,415 0.32 USI Japan Co., Ltd. 27,231 28,511 2,613 25,898 18,718 1,014 856 133.75 限遗经金子(沢川)有限公司 2,270,625 17,833,468 7,882,376 9,951,092 22,600,511 2,351,597 2,339,304 不適用 取過科技有限公司 330,960 6,605,326 5,955,041 650,285 22,285,566 46,368 49,704 0.58 限继至子(上)有限公司 6,652,140 11,721,829 8,886,695 2,835,134 12,344,589 (297,786) (592,611) 不適用 限量管子(上)有限公司 240,850 251,481 893 250,588 0 (239) 6,093 不適用 图案管子(上)有限公司 240,850 251,481 893 250,588 0 (239) 6,093 不適用 图案管子(上)有限公司 240,850 251,481 893 250,588 0 (239) 6,093 不適用 USI America, Inc.	環隆電氣股份有限公司	400,000	8,062,603	6,052,109	2,010,494	19,857,231	380,268	363,567	9.09
Universal ABIT Holding (Cayman) Co., Ltd 906,249 536 110,683 (110,147) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	環電(股)公司	11,214,953	44,047,265	2,008,015	42,039,249	0	(82,620)	2,776,807	2.48
Unitech Holdings International Co., Ltd 93,495 241,874 416 241,458 0 (5,210) (475) (0.16) Rising Capital Investment Limited 176,940 36,778 0 36,778 0 (48) 139 0.02 Rise Accord Limited 57,730 4,852 2,812 2,040 0 (27) (2,783) (139.15) Real Tech Holdings Limited 4,832,906 41,856,972 833 41,856,139 0 (29,948) 2,998,172 20.10 现金管子促山)公司 383,201 335,132 831 334,301 0 (3,322) 13,670 不適用 限减公司 6,780,756 40,452,098 45,513 40,406,585 17,412 1,945 3,029,705 14.06 限旭上海公司 10,649,110 43,742,414 8,615,056 35,127,358 40,909,128 889,261 3,867,862 1.78 现场宣子 1,202,223 6,443,441 3,584,361 2,859,080 10,985,360 769,207 735,082 不適用 限递公司 3,054,056 13,915,204 3,682,964 10,232,240 7,313,855 (135,409) 1,564,868 2.01 现隆墨西哥公司 776,221 1,960,021 523,866 1,436,155 3,133,862 212,389 90,415 0.32 USI Japan Co., Ltd. 27,231 28,511 2,613 25,898 18,718 1,014 856 133.75 限费等子(深圳有限公司 2,270,625 17,833,468 7,882,376 9,951,092 22,600,511 2,351,597 2,339,304 不適用 费旭科技有限公司 330,960 6,605,326 5,955,041 650,285 22,285,566 46,368 49,704 0.58 限继電子(上海有限公司 240,850 251,481 893 250,588 0 (239) 6,093 不適用 费聚電子(上海有限公司 240,850 251,481 893 250,588 0 (239) 6,093 不適用 USI America, Inc. 314,015 212,395 10,067 202,328 117,947 6,601 29,048 116.19	Huntington Holdings International Co., Ltd.	8,370,606	43,971,538	47,476	43,924,062	0	(136,943)	2,872,811	11.23
Rising Capital Investment Limited 176,940 36,778 0 36,778 0 (48) 139 0.02 Rise Accord Limited 57,730 4,852 2,812 2,040 0 (27) (2,783) (139.15) Real Tech Holdings Limited 4,832,906 41,856,972 833 41,856,139 0 (29,948) 2,998,172 20.10	Universal ABIT Holding (Cayman) Co., Ltd	906,249	536	110,683	(110,147)	0	0	0	0
Rise Accord Limited 57,730 4,852 2,812 2,040 0 (27) (2,783) (139.15) Real Tech Holdings Limited 4,832,906 41,856,972 833 41,856,139 0 (29,948) 2,998,172 20.10 環発電子(昆山)公司 383,201 335,132 831 334,301 0 (3,322) 13,670 不適用 環滅公司 6,780,756 40,452,098 45,513 40,406,585 17,412 1,945 3,029,705 14.06 環旭上海公司 10,649,110 43,742,414 8,615,056 35,127,358 40,909,128 889,261 3,867,862 1.78 環鴻電子(昆山)有限公司 1,202,223 6,443,441 3,584,361 2,859,080 10,985,360 769,207 735,082 不適用 環鴻公司 3,054,056 13,915,204 3,682,964 10,232,240 7,313,855 (135,409) 1,564,868 2.01 環隆墨西哥公司 776,221 1,960,021 523,866 1,436,155 3,133,862 212,389 90,415 0.32 USI Japan Co., Ltd. 27,231 28,511 2,613 25,898 18,718 1,014 856 133.75 環勝電子(深圳)有限公司 2,270,625 17,833,468 7,882,376 9,951,092 22,600,511 2,351,597 2,339,304 不適用 環心程序限公司 330,960 6,605,326 5,955,041 650,285 22,285,566 46,368 49,704 0.58 環維電子(上海)有限公司 240,850 251,481 893 250,588 0 (239) 6,093 不適用 環影電子(上海)有限公司 240,850 251,481 893 250,588 0 (239) 6,093 不適用 USI America, Inc. 314,015 212,395 10,067 202,328 117,947 6,601 29,048 116.19	Unitech Holdings International Co., Ltd	93,495	241,874	416	241,458	0	(5,210)	(475)	(0.16)
Real Tech Holdings Limited 4,832,906 41,856,972 833 41,856,139 0 (29,948) 2,998,172 20.10 環幹電子(昆山)公司 383,201 335,132 831 334,301 0 (3,322) 13,670 不適用 環献公司 6,780,756 40,452,098 45,513 40,406,585 17,412 1,945 3,029,705 14.06 環旭上海公司 10,649,110 43,742,414 8,615,056 35,127,358 40,909,128 889,261 3,867,862 1.78 環鴻電子(昆山)有限公司 1,202,223 6,443,441 3,584,361 2,859,080 10,985,360 769,207 735,082 不適用 環鴻公司 3,054,056 13,915,204 3,682,964 10,232,240 7,313,855 (135,409) 1,564,868 2.01 環隆墨西哥公司 776,221 1,960,021 523,866 1,436,155 3,133,862 212,389 90,415 0.32 USI Japan Co., Ltd. 27,231 28,511 2,613 25,898 18,718 1,014 856 133.75 環勝電子(深圳)有限公司 2,270,625 17,833,468 7,882,376 9,951,092 22,600,511 2,351,597 2,339,304 不適用 環維電子(上海)有限公司 6,652,140 11,721,829 8,886,695 2,835,134 12,344,589 (297,786) (592,611) 不適用 環聚電子(上海)有限公司 240,850 251,481 893 250,588 0 (239) 6,093 不適用 USI America, Inc. 314,015 212,395 10,067 202,328 117,947 6,601 29,048 116.19	Rising Capital Investment Limited	176,940	36,778	0	36,778	0	(48)	139	0.02
環幹電子(昆山)公司 383,201 335,132 831 334,301 0 (3,322) 13,670 不適用 環誠公司 6,780,756 40,452,098 45,513 40,406,585 17,412 1,945 3,029,705 14.06 環旭上海公司 10,649,110 43,742,414 8,615,056 35,127,358 40,909,128 889,261 3,867,862 1.78 環鴻電子(昆山)有限公司 1,202,223 6,443,441 3,584,361 2,859,080 10,985,360 769,207 735,082 不適用 環鴻公司 3,054,056 13,915,204 3,682,964 10,232,240 7,313,855 (135,409) 1,564,868 2.01 環隆墨西哥公司 776,221 1,960,021 523,866 1,436,155 3,133,862 212,389 90,415 0.32 USI Japan Co., Ltd. 27,231 28,511 2,613 25,898 18,718 1,014 856 133.75 環勝電子(深圳)有限公司 2,270,625 17,833,468 7,882,376 9,951,092 22,600,511 2,351,597 2,339,304 不適用 環組科技有限公司 330,960 6,605,326 5,955,041 650,285 22,285,566 46,368 49,704 0.58 環維電子(上海)有限公司 6,652,140 11,721,829 8,886,695 2,835,134 12,344,589 (297,786) (592,611) 不適用 環豪電子(上海)有限公司 240,850 251,481 893 250,588 0 (239) 6,093 不適用	Rise Accord Limited	57,730	4,852	2,812	2,040	0	(27)	(2,783)	(139.15)
環献公司 6,780,756 40,452,098 45,513 40,406,585 17,412 1,945 3,029,705 14.06 環旭上海公司 10,649,110 43,742,414 8,615,056 35,127,358 40,909,128 889,261 3,867,862 1.78 環鴻電子(昆山)有限公司 1,202,223 6,443,441 3,584,361 2,859,080 10,985,360 769,207 735,082 不適用 環鴻公司 3,054,056 13,915,204 3,682,964 10,232,240 7,313,855 (135,409) 1,564,868 2.01 環隆墨西哥公司 776,221 1,960,021 523,866 1,436,155 3,133,862 212,389 90,415 0.32 USI Japan Co., Ltd. 27,231 28,511 2,613 25,898 18,718 1,014 856 133.75 環勝電子(深圳)有限公司 2,270,625 17,833,468 7,882,376 9,951,092 22,600,511 2,351,597 2,339,304 不適用 環旭科技有限公司 330,960 6,605,326 5,955,041 650,285 22,285,566 46,368 49,704 0.58 環維電子(上海)有限公司 6,652,140 11,721,829 8,886,695 2,835,134 12,344,589 (297,786) (592,611) 不適用 環影電子(上海)有限公司 240,850 251,481 893 250,588 0 (239,786) (592,611) 不適用 USI America, Inc. 314,015 212,395 10,067 202,328 117,947 6,601 29,048 116.19	Real Tech Holdings Limited	4,832,906	41,856,972	833	41,856,139	0	(29,948)	2,998,172	20.10
環旭上海公司 10,649,110 43,742,414 8,615,056 35,127,358 40,909,128 889,261 3,867,862 1.78 環鴻電子(昆山)有限公司 1,202,223 6,443,441 3,584,361 2,859,080 10,985,360 769,207 735,082 不適用 環鴻公司 3,054,056 13,915,204 3,682,964 10,232,240 7,313,855 (135,409) 1,564,868 2.01 環隆墨西哥公司 776,221 1,960,021 523,866 1,436,155 3,133,862 212,389 90,415 0.32 USI Japan Co., Ltd. 27,231 28,511 2,613 25,898 18,718 1,014 856 133.75 環勝電子(深圳)有限公司 2,270,625 17,833,468 7,882,376 9,951,092 22,600,511 2,351,597 2,339,304 不適用 環旭科技有限公司 330,960 6,605,326 5,955,041 650,285 22,285,566 46,368 49,704 0.58 環維電子(上海)有限公司 6,652,140 11,721,829 8,886,695 2,835,134 12,344,589 (297,786) (592,611) 不適用 環豪電子(上海)有限公司 240,850 251,481 893 250,588 0 (239) 6,093 不適用 USI America, Inc. 314,015 212,395 10,067 202,328 117,947 6,601 29,048 116.19	環銓電子(昆山)公司	383,201	335,132	831	334,301	0	(3,322)	13,670	不適用
環鴻電子(昆山)有限公司 1,202,223 6,443,441 3,584,361 2,859,080 10,985,360 769,207 735,082 不適用 環鴻公司 3,054,056 13,915,204 3,682,964 10,232,240 7,313,855 (135,409) 1,564,868 2.01 環隆墨西哥公司 776,221 1,960,021 523,866 1,436,155 3,133,862 212,389 90,415 0.32 USI Japan Co., Ltd. 27,231 28,511 2,613 25,898 18,718 1,014 856 133.75 環勝電子(深圳)有限公司 2,270,625 17,833,468 7,882,376 9,951,092 22,600,511 2,351,597 2,339,304 不適用 環旭科技有限公司 330,960 6,605,326 5,955,041 650,285 22,285,566 46,368 49,704 0.58 環維電子(上海)有限公司 6,652,140 11,721,829 8,886,695 2,835,134 12,344,589 (297,786) (592,611) 不適用 環豪電子(上海)有限公司 240,850 251,481 893 250,588 0 (239) 6,093 不適用	環誠公司	6,780,756	40,452,098	45,513	40,406,585	17,412	1,945	3,029,705	14.06
環鴻公司 3,054,056 13,915,204 3,682,964 10,232,240 7,313,855 (135,409) 1,564,868 2.01 環隆墨西哥公司 776,221 1,960,021 523,866 1,436,155 3,133,862 212,389 90,415 0.32 USI Japan Co., Ltd. 27,231 28,511 2,613 25,898 18,718 1,014 856 133.75 環勝電子(深圳)有限公司 2,270,625 17,833,468 7,882,376 9,951,092 22,600,511 2,351,597 2,339,304 不適用 環旭科技有限公司 330,960 6,605,326 5,955,041 650,285 22,285,566 46,368 49,704 0.58 環維電子(上海)有限公司 6,652,140 11,721,829 8,886,695 2,835,134 12,344,589 (297,786) (592,611) 不適用 環豪電子(上海)有限公司 240,850 251,481 893 250,588 0 (239) 6,093 不適用 USI America, Inc. 314,015 212,395 10,067 202,328 117,947 6,601 29,048 116.19	環旭上海公司	10,649,110	43,742,414	8,615,056	35,127,358	40,909,128	889,261	3,867,862	1.78
環隆墨西哥公司 776,221 1,960,021 523,866 1,436,155 3,133,862 212,389 90,415 0.32 USI Japan Co., Ltd. 27,231 28,511 2,613 25,898 18,718 1,014 856 133.75 環勝電子(深圳)有限公司 2,270,625 17,833,468 7,882,376 9,951,092 22,600,511 2,351,597 2,339,304 不適用 環旭科技有限公司 330,960 6,605,326 5,955,041 650,285 22,285,566 46,368 49,704 0.58 環維電子(上海)有限公司 6,652,140 11,721,829 8,886,695 2,835,134 12,344,589 (297,786) (592,611) 不適用 環豪電子(上海)有限公司 240,850 251,481 893 250,588 0 (239) 6,093 不適用 USI America, Inc. 314,015 212,395 10,067 202,328 117,947 6,601 29,048 116.19	環鴻電子(昆山)有限公司	1,202,223	6,443,441	3,584,361	2,859,080	10,985,360	769,207	735,082	不適用
USI Japan Co., Ltd. 27,231 28,511 2,613 25,898 18,718 1,014 856 133.75 環勝電子(深圳)有限公司 2,270,625 17,833,468 7,882,376 9,951,092 22,600,511 2,351,597 2,339,304 不適用 環旭科技有限公司 330,960 6,605,326 5,955,041 650,285 22,285,566 46,368 49,704 0.58 環維電子(上海)有限公司 6,652,140 11,721,829 8,886,695 2,835,134 12,344,589 (297,786) (592,611) 不適用 環豪電子(上海)有限公司 240,850 251,481 893 250,588 0 (239) 6,093 不適用 USI America, Inc. 314,015 212,395 10,067 202,328 117,947 6,601 29,048 116.19	環鴻公司	3,054,056	13,915,204	3,682,964	10,232,240	7,313,855	(135,409)	1,564,868	2.01
環勝電子(深圳)有限公司 2,270,625 17,833,468 7,882,376 9,951,092 22,600,511 2,351,597 2,339,304 不適用 環旭科技有限公司 330,960 6,605,326 5,955,041 650,285 22,285,566 46,368 49,704 0.58 環維電子(上海)有限公司 6,652,140 11,721,829 8,886,695 2,835,134 12,344,589 (297,786) (592,611) 不適用 環豪電子(上海)有限公司 240,850 251,481 893 250,588 0 (239) 6,093 不適用 USI America, Inc. 314,015 212,395 10,067 202,328 117,947 6,601 29,048 116.19	環隆墨西哥公司	776,221	1,960,021	523,866	1,436,155	3,133,862	212,389	90,415	0.32
環旭科技有限公司 330,960 6,605,326 5,955,041 650,285 22,285,566 46,368 49,704 0.58 環維電子(上海)有限公司 6,652,140 11,721,829 8,886,695 2,835,134 12,344,589 (297,786) (592,611) 不適用 環豪電子(上海)有限公司 240,850 251,481 893 250,588 0 (239) 6,093 不適用 USI America, Inc. 314,015 212,395 10,067 202,328 117,947 6,601 29,048 116.19	USI Japan Co., Ltd.	27,231	28,511	2,613	25,898	18,718	1,014	856	133.75
環維電子(上海)有限公司 6,652,140 11,721,829 8,886,695 2,835,134 12,344,589 (297,786) (592,611) 不適用 環豪電子(上海)有限公司 240,850 251,481 893 250,588 0 (239) 6,093 不適用 USI America, Inc. 314,015 212,395 10,067 202,328 117,947 6,601 29,048 116.19	環勝電子(深圳)有限公司	2,270,625	17,833,468	7,882,376	9,951,092	22,600,511	2,351,597	2,339,304	不適用
環豪電子(上海)有限公司 240,850 251,481 893 250,588 0 (239) 6,093 不適用 USI America, Inc. 314,015 212,395 10,067 202,328 117,947 6,601 29,048 116.19	環旭科技有限公司	330,960	6,605,326	5,955,041	650,285	22,285,566	46,368	49,704	0.58
USI America, Inc. 314,015 212,395 10,067 202,328 117,947 6,601 29,048 116.19	環維電子(上海)有限公司	6,652,140	11,721,829	8,886,695	2,835,134	12,344,589	(297,786)	(592,611)	不適用
	環豪電子(上海)有限公司	240,850	251,481	893	250,588	0	(239)	6,093	不適用
環鴻科技股份有限公司 1,980,000 11,804,495 7,354,710 4,449,785 20,891,434 106,435 435,897 2.20	USI America, Inc.	314,015	212,395	10,067	202,328	117,947	6,601	29,048	116.19
	環鴻科技股份有限公司	1,980,000	11,804,495	7,354,710	4,449,785	20,891,434	106,435	435,897	2.20

註:設立資本額為美金5元。

(七) 關係企業合併財務報表: 詳本年報第76頁之說明。

(八) 本公司業已於本年報財務報告第126-131頁及第136-143頁揭露所有關係企業從事衍生性商品交易資訊、背書保證及資金貸與他人,其他未列示之關係企業即無從事上述之交易。

二、私募有價證券辦理情形:無。

三、子公司持有或處分本公司股票情形:

106年02月28日單位:新台幣仟元(除另有註明者外):股:%

子公司名稱	實收資本額	資金來源	本公司 持股比例	取得或處分日期	取得股數 及金額	處分股數 及金額	投資 (損)益	截至年報刊印日止 持有股數及金額	設定質權情形	本公司為 子公司背書 保證金額	本公司貸與子公司金額
台灣福雷電子		日月光合併日月宏及日		105年	-	-	-	10,978,776股 帳面金額\$362,849干元 轉列庫藏股金額 \$196,677	-	-	-
(股)公司 11,314,	11,314,525	314,525 月欣三合一 換股及盈餘 分配取得	100%	本年度截 至年報刊 印日止	-	-	_	10,978,776股 帳面金額\$418,840千元 轉列庫臧股金額 \$196,677	_	-	_
		日月光合併日月宏及日		105年	-	-	-	88,200,472股(註) 帳面金額\$2,915,026千元 轉列庫藏股金額 \$1,380,721	_	-	-
ASE Test Ltd. 659,07	659,075	9,075 月欣三合一 100% 換股及盈餘 分配取得	è股及盈餘	本年度截 至年報刊 印日止	-	-	-	88,200,472股(註) 帳面金額\$3,364,848千元 轉列庫藏股金額 \$1,380,721	-	-	-
J&R		日月光合併日月宏及日		105年	-	-	-	46,703,763股 帳面金額\$1,543,559干元 轉列庫藏股金額 \$381,709	_	-	-
Holding Ltd.		07,259 月欣三合一 換股及盈餘 分配取得	P股及盈餘	本年度截 至年報刊 印日止	-	-	-	46,703,763股 帳面金額\$1,781,749千元 轉列庫藏股金額 \$381,709	-	-	-

註: 為配合ASE Test Ltd.當地法令規定ASE Test Ltd.取得本公司之股票88,200,472股全數信託予中國信託商業銀行。

四、其他必要補充說明事項:無。

玖、其他事項

最近年度及截至年報刊印日止,如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項:無。

日月光半導體製造股份有限公司

負責人 | 張虔生





日月光半導體製造股份有限公司 www.aseglobal.com

